목 차

분 기 보 고 서 1
【 대표이사 등의 확인 】 2
I. 회사의 개요 3
1. 회사의 개요 3
2. 회사의 연혁 3
3. 자본금 변동사항 3
4. 주식의 총수 등 3
5. 정관에 관한 사항 3
II. 사업의 내용 4
1. 사업의 개요 4
2. 주요 제품 및 서비스 6
3. 원재료 및 생산설비 7
4. 매출 및 수주상황 14
5. 위험관리 및 파생거래 19
6. 주요계약 및 연구개발활동 23
7. 기타 참고사항 29
III. 재무에 관한 사항 49
1. 요약재무정보 49
2. 연결재무제표 51
2-1. 연결 재무상태표 51
2-2. 연결 손익계산서 52
2-3. 연결 포괄손익계산서 53
2-4. 연결 자본변동표 53
2-5. 연결 현금흐름표 54
3. 연결재무제표 주석 55
1. 일반적 사항 (연결) 55
2. 중요한 회계처리방침 (연결) 65
3. 범주별 금융상품 (연결) 68
4. 공정가치금융자산 (연결) 70
5. 재고자산 (연결) 72
6. 관계기업 및 공동기업 투자 (연결) 72
7. 유형자산 (연결) 76
8. 무형자산 (연결) 78
9. 차입금 (연결) 79
10. 사채 (연결) 81
11. 순확정급여부채(자산) (연결) 82
12. 충당부채 (연결) 83
13. 우발부채와 약정사항 (연결) 84
14. 계약부채 (연결) 85
15. 자본금 (연결) 85
16. 연결이익잉여금 (연결) 87
17. 기타자본항목 (연결) 88
18. 비용의 성격별 분류 (연결) 91
19. 판매비와관리비 (연결) 92
20. 기타수익 및 기타비용 (연결) 93

21. 금융수익 및 금융비용 (연결) 94
22. 법인세비용 (연결) 95
23. 주당이익 (연결) 95
24. 현금흐름표 (연결) 97
25. 재무위험관리 (연결) 99
26. 공정가치측정 (연결) 103
27. 부문별 보고 (연결) 111
28. 특수관계자와의 거래 (연결) 113
29. 보고기간 후 사건 (연결) 119
4. 재무제표 119
4-1. 재무상태표 119
4-2. 손익계산서 121
4-3. 포괄손익계산서 121
4-4. 자본변동표 122
4-5. 현금흐름표 122
5. 재무제표 주석 123
1. 일반적 사항 123
2. 중요한 회계처리방침 124
3. 범주별 금융상품 127
4. 공정가치금융자산 128
5. 재고자산 129
6. 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자 130
7. 유형자산 131
8. 무형자산 132
9. 차입금 133
10. 사채 135
11. 순확정급여부채(자산) 136
12. 충당부채 137
13. 우발부채와 약정사항 138
14. 계약부채 140
15. 자본금 140
16. 이익잉여금 142
17. 기타자본항목 143
18. 비용의 성격별 분류 146
19. 판매비와관리비 147
20. 기타수익 및 기타비용 148
21. 금융수익 및 금융비용 149
22. 법인세비용 150
23. 주당이익 150
24. 현금흐름표 152
25. 재무위험관리 154
26. 공정가치측정 157
27. 부문별 보고 163
28. 특수관계자와의 거래 164
29. 보고기간 후 사건 186
6. 배당에 관한 사항 186
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 191

7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 191
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 193
8. 기타 재무에 관한 사항 194
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 216
1. 예측정보에 대한 주의사항 216
2. 개요 216
3. 재무상태 및 영업실적 216
4. 유동성 및 자금조달과 지출 216
5. 부외거래 216
6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 216
V. 회계감사인의 감사의견 등 217
1. 외부감사에 관한 사항 217
2. 내부통제에 관한 사항 221
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 222
1. 이사회에 관한 사항 222
2. 감사제도에 관한 사항 222
3. 주주총회 등에 관한 사항 222
VII. 주주에 관한 사항 223
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 230
1. 임원 및 직원 등의 현황 230
2. 임원의 보수 등 273
IX. 계열회사 등에 관한 사항 274
X. 대주주 등과의 거래내용 275
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 280
1. 공시내용 진행 및 변경사항 280
2. 우발부채 등에 관한 사항 281
3. 제재 등과 관련된 사항 283
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 283
XII. 상세표 284
1. 연결대상 종속회사 현황(상세) 284
2. 계열회사 현황(상세) 284
3. 타법인출자 현황(상세) 284
4. 연구개발실적(상세) 285
【 전문가의 확인 】 319
1. 전문가의 확인 319
2. 전문가와의 이해관계 319

분 기 보 고 서

(제 58 기)

사업연도 2026년 01월 01일 부터
2026년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중

2026년 11월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 삼성전자주식회사
대 표 이 사 : 전 영 현
본 점 소 재 지 : 경기도 수원시 영통구 삼성로 129(매탄동)
(전 화) 031-200-1114
(홈페이지) http://www.samsung.com/sec
작 성 책 임 자 : (직 책) 재경팀장 (성 명) 김 동 욱
(전 화) 031-277-7218

【 대표이사 등의 확인 】

확 인 서

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당임원으로서
2026년 3분기 보고서의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여
직접 확인·검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의
누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 반기보고서에 표시된
기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이
기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제8조의 규정에
따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.

2026. 11. 16

삼성전자 주식회사

대표이사: 전 영 현 

신고업무 담당임원: 박 순 철 

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

회사의 개요는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
(반기・사업보고서에 기재 예정)

2. 회사의 연혁

회사의 연혁은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
(반기・사업보고서에 기재 예정)

3. 자본금 변동사항

자본금 변동사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
(반기・사업보고서에 기재 예정)

4. 주식의 총수 등

주식의 총수 등은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
(반기・사업보고서에 기재 예정)

5. 정관에 관한 사항

정관에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기・사업보고서에 기재 예정)

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사는 본사를 거점으로 한국과 DX 부문 산하 해외 9개 지역총괄 및 DS 부문 산하 해외 5개 지역총괄의 생산·판매법인, SDC 및 Harman 산하 종속기업 등 305개의 종속기업으로 구성된 글로벌 전자 기업입니다.

사업별로 보면, Set 사업은 DX(Device eXperience) 부문이 TV를 비롯하여 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 스마트폰, 네트워크시스템, PC 등을 생산·판매하며, 부품 사업은 DS(Device Solutions) 부문에서 DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등의 제품을 생산·판매하고, SDC가 스마트폰용 OLED 패널 등을 생산·판매하고 있습니다.
또한, Harman에서는 디지털 콕핏(Digital Cockpit), 카오디오 등 전장제품과 포터블/사운드바 스피커 등 컨슈머오디오 제품 등을 개발, 생산, 판매하고 있습니다.

☞ 부문별 사업에 관한 자세한 사항은 '7. 기타 참고사항'의 '다. 사업부문별 현황'과 '라. 사업부문별 요약 재무 현황' 항목을 참고하시기 바랍니다.

지역별로 보면, 국내에서는 DX 부문 및 DS 부문 등을 총괄하는 본사와 37개의 종속기업이 사업을 운영하고 있습니다. 본사는 수원, 구미, 광주, 기흥, 화성, 평택사업장 등으로 구성되어 있으며, 국내 종속기업은 디스플레이 패널을 생산하는 삼성디스플레이㈜와 국내 대리점 판매를 전담하는 삼성전자판매㈜, 제품 수리 서비스를 담당하는 삼성전자서비스㈜, 제품 운송을 담당하는 삼성전자로지텍㈜ 등으로 구성되어 있습니다.

해외(미주, 유럽·CIS, 중동·아프리카, 아시아 등지)에서는 생산, 판매, 연구활동 등을 담당하는 268개의 비상장 종속기업이 운영되고 있습니다.

미주에는 TV, 스마트폰 등 Set제품의 미국판매를 담당하는 SEA(New Jersey, USA), TV 생산을 담당하는 SII(California, USA), 반도체・디스플레이 패널 판매를 담당하는 SSI(California, USA), 반도체 생산을 담당하는 SAS(Texas, USA), Set제품 복합 생산법인 SEDA(Brazil), 전장부품사업 등을 담당하는 Harman(Connecticut, USA) 등을 포함하여 총 62개의 판매・생산 등을 담당하는 법인이 있습니다.

유럽・CIS에는 SEUK(UK), SEG(Germany), SEF(France), SEI(Italy) 등 Set제품 판매법인과 SEH(Hungary) 등 TV 생산법인, 가전제품 생산법인 SEPM(Poland) 등을 포함하여 총 111개의 법인이 운영되고 있습니다.

중동・아프리카에는 SGE(UAE), SSA(South Africa) 등 Set제품 판매법인과 SEEG (Egypt), SSAP(South Africa) 등 TV 생산법인을 포함한 총 21개 법인이 운영되고 있습니다 .

아시아(중국 제외)에는 SESP(Singapore), SEAU(Australia), SEPCO(Philippines), SME(Malaysia) 등 판매법인과 스마트폰 등 생산법인 SEV・SEVT(Vietnam), TV 등 생산법인 SEHC(Vietnam), 디스플레이 패널 생산법인 SDV(Vietnam), 복합 생산법인 SIEL(India) 등을 포함한 총 38개의 법인이 운영되고 있습니다.

중국에는 SCIC(Beijing), SEHK(Hong Kong) 등 Set제품 판매법인과 SSS(Shanghai), SSCX(Xian) 등 반도체・디스플레이 패널 판매법인, SSEC(Suzhou) 등 Set제품 생산법인, SCS(Xian) 등 반도체 생산법인을 포함하여 총 36개의 법인이 운영되고 있습니다.

2026년 3분기 당사의 매출은 500조 6,261억원으로 전년 동기 대비 108.8% 증가하였으며, 주요 매출처로는 Alphabet, Amazon, Apple, Hong Kong Techtronics, Supreme Electronics 등(알파벳순)이 있습니다.

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 매출

당사는 TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 스마트폰 등 완제품과 DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등 반도체 부품 및 스마트폰용 OLED 패널 등을 생산・판매하고 있습니다. 또한, Harman에서는 디지털 콕핏(Digital Cockpit), 카오디오 등 전장제품과 포터블/사운드바 스피커 등 컨슈머 오디오 제품 등을 개발, 생산, 판매하고 있습니다.

2026년 3분기 매출은 DX 부문이 152조 7,316억원(30.5%), DS 부문이 356조 3,358억원(71.2%)이며, SDC가 22조 1,759억원(4.4%), Harman은 12조 7,224억원(2.5%)입니다.

(단위 : 억원, %)

부 문	주요 제품	매출액	비중
DX 부문	TV, 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 스마트폰, 네트워크시스템, PC 등	1,527,316	30.5%
DS 부문	DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등	3,563,358	71.2%
SDC	스마트폰용 OLED패널 등	221,759	4.4%
Harman	디지털 콕핏, 카오디오, 포터블 스피커 등	127,224	2.5%
기타	부문간 내부거래 제거 등	△433,396	△8.7%
총 계		5,006,261	100.0%

※ 각 부문별 매출액은 부문 등 간 내부거래를 포함하고 있습니다. [△는 부(-)의 값임]

※ 세부 제품별 매출은 '4. 매출 및 수주상황' 항목을 참고하시기 바랍니다.

나. 주요 제품 등의 가격 변동 현황

2026년 3분기 TV의 평균 판매가격은 전년 연간 평균 대비 약 3% 하락하였으며, 스마트폰은 전년 연간 평균 대비 약 13% 상승하였습니다. 그리고 메모리 평균 판매가격은 전년 연간 평균 대비 약 270% 상승하였으며, 스마트폰용 OLED 패널은 약 3% 상승하였습니다. 한편 디지털 콕핏의 평균 판매가격은 전년 연간 평균 대비 약 4% 하락하였습니다.

3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 현황

당사의 주요 원재료로 DX 부문은 모바일AP 솔루션, 모바일용 메모리, Camera Module 등을 Qualcomm, Micron, 삼성전기㈜ 등에서 공급받고 있으며, TV・모니터용 디스플레이 패널 등을 CSOT 등으로부터 공급받고 있습니다. DS 부문은 Chemical, Wafer 등을 솔브레인㈜, SILTRONIC 등으로부터, SDC는 FPCA, Cover Glass 등을 ㈜비에이치, Apple 등으로부터 공급받고 있습니다. Harman은 MCU(Micro Controller Unit)를 포함한 SOC(System-On-Chip), 통신 모듈 등을 NVIDIA, WNC 등에서 공급받고 있습니다.

(단위 : 억원, %)

부 문	품 목	구체적 용도	매입액	비중	주요 매입처
DX 부문	모바일AP 솔루션	CPU	107,929	17.3%	Qualcomm, MediaTek
	모바일용 메모리	모바일용 메모리	76,993	12.3%	Micron, Kioxia 등
	디스플레이 패널	TV・모니터용 화면표시장치	60,697	9.7%	CSOT, SDP 등
	Camera Module	스마트폰 카메라	47,601	7.6%	삼성전기㈜, ㈜파트론 등
	기타	-	331,087	53.0%	
	소 계		624,307	100.0%	
DS 부문	Chemical	원판 가공	26,802	16.8%	솔브레인㈜, 동우화인켐㈜ 등
	Wafer	반도체 원판	17,793	11.1%	SILTRONIC, SK실트론㈜ 등
	기타	-	115,341	72.1%	
	소 계		159,936	100.0%	
SDC	FPCA	구동회로	19,061	18.3%	㈜비에이치, SI FLEX 등
	Cover Glass	강화유리	14,867	14.3%	Apple, LENS 등
	기타	-	70,219	67.4%	
	소 계		104,147	100.0%	
Harman	SOC(System-On-Chip)	CPU	3,509	5.2%	NVIDIA, Intel 등
	통신 모듈	차량 통신	6,753	10.0%	WNC, COMPAL 등
	기타	-	57,096	84.8%	
	소 계		67,358	100.0%	
기타	-	-	230	-	
총 계			955,978	-	

※ 매입액은 부문 등 간의 내부거래를 포함하고 있지 않습니다.

※ 비중은 각 부문의 원재료 총매입액 대비 각 품목의 매입액 비중입니다.

※ 주요 매입처 중 삼성전기㈜는 계열회사입니다.

나. 주요 원재료 가격 변동 추이

DX 부문의 주요 원재료인 모바일AP 솔루션 가격은 전년 연간평균 대비 약 8% 상승하였고, Camera Module 가격은 전년 연간평균과 유사한 수준이며, TV・모니터용 디스플레이 패널 가격은 약 4% 하락하였습니다. 모바일용 메모리 가격은 약 263% 상승, DS 부문의 주요 원재료 중 반도체 Wafer 가격은 전년 연간평균 대비 약 9% 하락하였으며, SDC의 FPCA 가격은 약 6% 상승, 강화유리용 Cover Glass 가격은 약 24% 상승하였습니다. Harman의 원재료 중 SOC(System-On-Chip) 가격은 전년 연간평균 대비 약 6% 상승하였으며, 통신 모듈은 약 44% 상승하였습니다.

※ 원재료 가격은 부문 등 간의 내부거래 등을 포함하고 있습니다.

다. 생산능력, 생산실적, 가동률

(생산능력)

(단위 : 천대, 천개)

부 문	품 목	제58기 3분기	제57기	제56기
DX 부문	TV, 모니터 등	41,793	56,283	51,795
	스마트폰 등	200,960	270,050	265,700
DS 부문	메모리	2,000,437,183	2,245,908,090	2,238,240,405
SDC	디스플레이 패널	1,687	2,294	2,264
Harman	디지털 콕핏	6,130	7,815	8,520

※ 생산능력은 주요 제품의 연결 기준입니다.

DX 부문의 주요 품목별 생산능력은 '평균 라인 수'×'시간당 평균 생산실적'×'일 평균 가동시간'×'표준 가동일수'로 산출하였으며, DS 부문의 메모리 생산능력은 1Gb환산 기준으로 환산 생산실적(패키지OUT 기준)을 가동률로 나눠서 생산능력을 산출하고 있습니다. SDC의 경우 라인별 생산 가능한 제품의 총 면적을 8세대 Glass(2,200×2,500mm)로 환산하고 있으며, Harman의 디지털 콕핏 생산능력은 '각 거래처・제품별 생산셀(조립, 테스트) 수'×'각 생산셀별 시간당 생산능력'×'1일 표준 생산시간'×'표준생산일수'로 산출하였습니다.

(생산실적)

2026년(제58기) 3분기 DX 부문의 TV, 모니터 등 생산실적은 33,884천대이며 멕시코, 베트남, 브라질, 헝가리 등 세계 각 지역에서 생산되고 있습니다. 스마트폰 등 생산실적은 167,790천대이며 한국(구미), 베트남, 인도, 브라질 등 지역에서 생산되고 있습니다. DS 부문의 메모리 생산실적은 2,000,437백만개(1Gb 환산 기준)이며 한국(화성, 평택 등), 중국에서 생산하고 있습니다. SDC의 디스플레이 패널 생산실적은 1,374천개(8세대 Glass 환산 기준)이며 한국(천안, 아산) 등에서 생산 중입니다. Harman의 디지털 콕핏 생산실적은 4,025천개이며, 주로 멕시코, 헝가리, 중국 등에서 생산되고 있습니다.

(단위 : 천대, 천개)

부 문	품 목	제58기 3분기	제57기	제56기
DX 부문	TV, 모니터 등	33,884	44,361	41,354
	스마트폰 등	167,790	214,259	193,500
DS 부문	메모리	2,000,437,183	2,245,908,090	2,238,240,405
SDC	디스플레이 패널	1,374	1,851	1,759
Harman	디지털 콕핏	4,025	5,897	5,814

※ 생산실적은 주요 제품의 연결 기준입니다.

(가동률)

당사 DX 부문의 2026년(제58기) 3분기 가동률은 생산능력 대비 생산실적으로 산출하였으며, TV, 모니터 등은 81.1%, 스마트폰 등은 83.5%입니다.

(단위 : 천대)

부 문	품 목	제58기 3분기		
		생산능력 대수	실제 생산 대수	가동률
DX 부문	TV, 모니터 등	41,793	33,884	81.1%
	스마트폰 등	200,960	167,790	83.5%

DS 부문의 메모리 사업과 SDC의 디스플레이 패널 사업은 24시간 3교대 작업을 실시하고 있으며, 2026년(제58기) 3분기 가동일은 휴일을 포함하여 총 273일입니다. 가동률은 생산라인별 가동 가능시간 (가동일 ×생산라인 수 ×24시간) 대비 실제 가동 시간으로 산출하였습니다.

(단위 : 시간)

부 문	품 목	제58기 3분기		
		가동 가능 시간	실제 가동 시간	가동률
DS 부문	메모리	65,520	65,520	100.0%
SDC	디스플레이 패널	34,968	34,968	100.0%

Harman의 2026년(제58기) 3분기 가동률은 생산능력 대비 생산실적으로 산출하였으며 65.7%입니다.

(단위 : 천개)

부문	품 목	제58기 3분기		
		생산능력 개수	실제 생산 개수	가동률
Harman	디지털 콕핏	6,130	4,025	65.7%

라. 생산설비 및 투자 현황 등

(생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 등)

당사는 수원사업장을 비롯하여 구미, 광주, 화성, 평택, 아산 등 국내사업장 및 북미, 구주(유럽), 중국 등 해외 DX 부문 산하 9개 지역총괄과 DS 부문 산하 5개 지역총괄,SDC 및 Harman 산하 종속기업 등에서 주요 제품의 생산, 개발, 마케팅, 영업 등의 사업 활동을 수행하고 있습니다.

[주요 사업장 현황]

지역	사업장	소재지
국내 (DX 부문, DS 부문, SDC 산하 12개 사업장)	수원사업장	경기도 수원시 영통구 삼성로 129(매탄동)
	서초사업장	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동)
	우면사업장	서울특별시 서초구 성촌길 33(우면동)
	기흥사업장	경기도 용인시 기흥구 삼성로 1(농서동)
	화성사업장	경기도 화성시 삼성전자로 1(반월동)
	평택사업장	경기도 평택시 삼성로 114(고덕동)
	천안사업장	충청남도 천안시 서북구 번영로 465(성성동)
	온양사업장	충청남도 아산시 배방읍 배방로 158(북수리)
	아산사업장	충청남도 아산시 탕정면 삼성로 181(명암리)
	구미1사업장	경상북도 구미시 1공단로 244(공단동)
	구미2사업장	경상북도 구미시 3공단3로 302(임수동)
	광주사업장	광주광역시 광산구 하남산단6번로 107(오선동)
해외 (DX 부문 산하 9개 지역총괄)	북미 총괄	700 Sylvan Ave, Englewood Cliffs, New Jersey, USA, 07632
	유럽 총괄	2000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey, UK
	중국 총괄	Fortune Financial Center, No5. Dongsanhuan Zhong Rd., Chaoyang, Beijing, China
	동남아 총괄	30 Pasir Panjang Rd., Mapletree Business City, Singapore
	서남아 총괄	Two Horizon Centre, Golf Course RD, Gurgaon, Haryana, India
	CIS 총괄	31 Novinsky Boulevard, Moscow, Russia
	중동 총괄	7421 King Fahd Road Al Olaya Dist, Riyadh 12212, KSA
	아프리카 총괄	2929 William Nicol Drive, Bryanston, Johannesburg, South Africa
	중남미 총괄	Av. Dr. Chucri Zaidan, 1240 Diamond Tower, Sao Paulo, Brazil
해외 (DS 부문 산하 5개 지역총괄)	미주 총괄	3655 N. 1st St. San Jose, California, USA
	유럽 총괄	Koelner Str. 12, Eschborn, Germany
	중국 총괄	3F, No.458, Fute North Rd., Shanghai, China
	동남아 총괄	30 Pasir Panjang Rd., Mapletree Business City, Singapore
	일본 총괄	Shinagawa Grand Central Tower, Konan, Minato, Tokyo, Japan
Harman	미국 HQ	400 Atlantic St., Stamford, Connecticut, USA
	Harman Becker Automotive Systems, Inc.	30001 Cabot Drive, Novi, Michigan, USA
	Harman Becker Automotive	16 Becker Goering St., Karlsbad, Germany

	Systems GmbH	
	Harman Consumer Nederland B.V.	16 Danzigerkade, 1013 AP, Amsterdam, Netherlands

당사의 시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치, 건설중인자산 등이 있으며, 2026년 3분기말 현재 장부금액은 234조 92억원으로 전년말 대비 18조 7,045억원 증가하였습니다.

(단위 : 억원)

구 분		토지	건물및구축물	기계장치	건설중인자산	기타유형자산	계
기초	기초장부금액	104,739	510,089	924,232	567,653	46,334	2,153,047
	- 취득원가	106,800	902,892	4,042,330	567,653	166,997	5,786,672
	- 감가상각누계액 (손상 포함)	△2,061	△392,803	△3,118,098	-	△120,663	△3,633,625
증감	일반취득 및 자본적지출	1,843	40,538	356,321	161,535	18,929	579,166
	사업결합을 통한 취득	-	-	-	-	-	-
	감가상각	△336	△37,896	△303,511	-	△13,077	△354,820
	처분・폐기・손상	△669	△1,541	△880	△13	△275	△3,378
	기타	△586	△8,748	7,643	△30,522	△1,710	△33,923
기말	기말장부금액	104,991	502,442	983,805	698,653	50,201	2,340,092
	- 취득원가	107,223	921,227	4,321,264	698,653	173,760	6,222,127
	- 감가상각누계액 (손상 포함)	△2,232	△418,785	△3,337,459	-	△123,559	△3,882,035

※ 토지의 감가상각은 기업회계기준서 제1116호 '리스'에 따른 사용권자산의 감가상각비입니다. [△는 부(-)의 값임]

※ 기타는 환율변동에 의한 증감액 및 관련 정부보조금 차감 효과 등을 포함하고 있습니다.

※ 주요 유형자산에 대한 시가는 객관적인 시가 판단이 어려워 기재를 생략했습니다.

(시설투자 현황)

2026년 3분기 DS 부문 및 SDC 등의 첨단공정 증설・전환과 인프라 투자를 중심으로 56.9조원의 시설투자가 이루어졌습니다. 당사는 메모리 차세대 기술 경쟁력 강화 및 중장기 수요 대비를 위한 투자를 지속 추진하였고, 시스템 반도체는 Advanced 노드 CAPA 확보를 위한 투자도 진행 중입니다. 내실을 다지는 활동을 통해 투자 효율성 제고에도 집중할 계획입니다.

(단위 : 억원)

구 분	내 용	투자기간	대상자산	투자액
DS 부문	신・증설, 보완 등	2026.01~2026.09	건물・설비 등	527,509
SDC	신・증설, 보완 등	2026.01~2026.09	건물・설비 등	24,471
기 타	신・증설, 보완 등	2026.01~2026.09	건물・설비 등	17,460
합 계				569,440

4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

2026년(제58기) 3분기 매출은 500조 6,261억원으로 전년 동기 대비 108.8% 증가하였습니다. 부문별로는 전년 동기 대비 DX 부문이 6.3% 증가, DS 부문이 313.8% 증가, SDC는 9% 증가하였으며, Harman은 13.6% 증가하였습니다.

(단위 : 억원)

부 문	매출유형	품 목	제58기 3분기	제57기	제56기
DX 부문	제・상품, 용역 및 기타매출	TV, 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 스마트폰, 네트워크시스템, PC 등	1,527,316	1,879,673	1,748,877
DS 부문	제・상품, 용역 및 기타매출	DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등	3,563,358	1,301,282	1,110,660
SDC	제・상품, 용역 및 기타매출	스마트폰용 OLED 패널 등	221,759	298,417	291,578
Harman	제・상품, 용역 및 기타매출	디지털 콕핏, 카오디오, 포터블 스피커 등	127,224	157,833	142,749
기 타	부문간 내부거래 제거 등		△433,396	△301,146	△285,155
합 계			5,006,261	3,336,059	3,008,709

※ 각 부문별 매출실적은 부문 등 간 내부거래를 포함하고 있습니다. [△는 부(-)의 값임]

(1) 주요 제품별 매출실적

(단위 : 억원)

구 분	제58기 3분기	제57기	제56기
TV, 모니터 등	226,758	308,609	309,316
스마트폰 등	1,070,844	1,264,744	1,144,249
메모리	3,363,141	1,040,812	844,630
디스플레이 패널	221,759	298,417	291,578

※ 각 제품별 매출실적은 부문 등 간 내부거래를 포함하고 있습니다.

(2) 매출유형별 매출실적

(단위 : 억원)

구 분	제58기 3분기	제57기	제56기
제・상품	4,827,259	3,147,171	2,933,617
용역 및 기타매출	179,002	188,888	75,092
계	5,006,261	3,336,059	3,008,709

※ 기타매출은 로열티수익 등으로 구성되어 있습니다.

(3) 주요 지역별 매출 현황

(단위 : 억원)

구 분		제58기 3분기	제57기	제56기
내수	국내	214,022	216,560	202,978
수출	미주	1,214,170	678,942	613,533
	유럽	396,343	312,307	290,967
	아시아・아프리카	931,058	456,870	333,769
	중국	1,582,787	715,751	649,275
계		4,338,380	2,380,430	2,090,522

※ 별도 기준의 내수・수출 매출 현황입니다.

나. 판매경로 등

(1) 국내

판매자	판 매 경 로	소비자
생산 및 매입	전속 대리점	소비자
	유통업체(양판점, 할인점, 백화점, 홈쇼핑, 온라인 등)	
	통신사업자(SK텔레콤㈜, ㈜케이티, ㈜LG유플러스)	
	직접판매(B2B 및 온라인 등)	

(2) 해외

<table>
<tr><th>판매자</th><th colspan="4">판 매 경 로</th><th>소비자</th></tr>
<tr><td rowspan="6">생산법인</td><td rowspan="5">판매법인</td><td colspan="3">Retailer</td><td rowspan="6">소비자</td></tr>
<tr><td colspan="2">Dealer</td><td>Retailer</td></tr>
<tr><td>Distributor</td><td>Dealer</td><td>Retailer</td></tr>
<tr><td colspan="3">통신사업자, Automotive OEM</td></tr>
<tr><td colspan="3">직접판매(B2B 및 온라인)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">물류법인</td><td rowspan="3">판매법인</td><td colspan="3">Retailer</td></tr>
<tr><td colspan="2">Dealer</td><td>Retailer</td></tr>
<tr><td>Distributor</td><td>Dealer</td><td>Retailer</td></tr>
</table>

(3) 판매경로별 매출액 비중

경 로	도매	소매	특직판	기타
비 중	8%	10%	77%	5%

다. 판매방법 및 조건

(1) 국내

구 분	판매경로	대금회수조건	부대비용 비용분담
전속	대리점	약정여신조건	사안별 상호 협의하에 일부 분담
유통업체	양판점, 할인점, 백화점, 홈쇼핑, 온라인 등	개별계약조건	사안별 상호 협의하에 일부 분담
통신사업자	SK텔레콤㈜, ㈜케이티, ㈜LG유플러스	개별계약조건	사안별 상호 협의하에 일부 분담 (공동마케팅)
B2B 및 온라인	일반기업체, 삼성닷컴 등	개별계약조건	없 음

(2) 해외

구 분	판매경로	대금회수조건	부대비용 비용분담
Retailer	소매점	개별계약조건	사안별 상호 협의하에 일부 분담
Dealer	양판점, 할인점, 백화점	개별계약조건	사안별 상호 협의하에 일부 분담
Distributor	현지 거래처 직판 영업	개별계약조건	사안별 상호 협의하에 일부 분담
B2B 및 온라인	일반기업체, 삼성닷컴 등	개별계약조건	없 음

라. 판매전략

- 프리미엄 제품을 중심으로 한 시장 우위 강화
- 브랜드, 제품, 서비스를 통해 고객에게 차별화된 가치 제공
- 고객·시장 중심의 수요 촉발 마케팅 강화

마. 주요 매출처

2026년 3분기 당사의 주요 매출처는 Alphabet, Amazon, Apple, Hong Kong Techtronics, Supreme Electronics 등(알파벳순) 입니다. 당사의 주요 5대 매출처에 대한 매출 비중은 전체 매출액 대비 약 24% 수준입니다.

바. 수주상황

(1) 반도체 위탁생산

(단위 : 백만 달러)

사업부	발주처	품목	계약 체결일	계약 종료일	수주총액
DS부문 Foundry 사업부	Tesla, Inc.	반도체 위탁생산	2025.07.26	2033.12.31	16,544
합 계					16,544

※ 당사의 제품가격, 생산능력, 납품상황 등 영업비밀에 해당하는 정보의 누설 우려가 있는 항목(수량, 금액, 기납품액, 수주잔고)의 기재는 생략하였습니다.

※ 상기 수주총액, 계약 종료일 등은 고객사 수요 및 사업 경과에 따라 변동될 수 있습니다.

(2) 메모리반도체 공급

당사의 해외종속회사는 복수의 글로벌 고객사들과 메모리반도체 공급에 대한 다년계약을 체결하고 있습니다. 해당 계약과 관련한 구체적인 계약의 내용은 영업비밀에 해당하여 기재를 생략하였으며, 그에 따른 수주총액, 납품기간 등 거래조건은 고객사 수요 및 사업 경과에 따라 변동될 수 있습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

가. 재무위험관리정책

당사는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험, 유동성위험 등을 최소화하는데 중점을 두고 재무위험을 관리하고 있으며, 이를 위해 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링 및 대응하고 있습니다.

재무위험은 글로벌 재무관리기준을 수립하고 고객과 거래선에 대한 주기적인 재무위험 측정, 환헷지 및 자금수지 점검 등을 통해 관리하고 있습니다.

한편, 해외 주요 권역별 지역금융센터(미국, 영국, 싱가포르, 중국, 브라질, UAE)에서 환율변동 모니터링 및 환거래 대행을 통해 환율변동위험을 관리하고 있으며, 권역내 자금을 통합운용하여 유동성위험에 대응하고 있습니다.

당사 재무위험관리의 주요 대상인 자산은 현금및현금성자산, 단기금융상품, 매출채권, 기타포괄손익-공정가치금융자산 등으로 구성되어 있으며, 부채는 매입채무, 차입금 등으로 구성되어 있습니다.

나. 주요 재무위험관리

(1) 시장위험

(환율변동위험)

당사는 글로벌 영업활동을 수행함에 따라 기능통화와 다른 통화로도 거래를 하고 있어 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 환율변동위험에 노출되는 주요 통화로는 USD, EUR 등이 있습니다.

당사는 통화별 자산과 부채규모를 일치하는 수준으로 유지하여 환율변동 영향을 최소화하는데 주력하고 있습니다. 이를 위해 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 금융거래 발생시 기능통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시킴으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있고, 일부 발생된 환포지션은 채권매각, 선물환 등을 활용하여 환변동영향을 축소하고 있습니다. 이를 통해 당사에 노출된 환율변동위험은 감소되지만 완전히 제거되지는 않을 수 있습니다. 또한, 당사는 효율적인 환율변동위험 관리를 위해 환위험을 주기적으로 모니터링 및 평가하고 있으며 투기적 외환거래는 엄격히 금지하고 있습니다.

(이자율변동위험)

이자율변동위험은 시장금리 변동으로 인해 투자 및 재무활동에서 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로, 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯됩니다. 당사는 내부자금의 통합관리를 통해 외부차입금을 최소화하여 이자율 변동으로 인한 금융비용과 불확실성을 최소화하고 있습니다.

(주가변동위험)

당사는 전략적 목적 등으로 기타포괄손익-공정가치금융자산 및 당기손익-공정가치금융자산으로 분류된 지분상품에 투자하고 있습니다. 이를 위하여 직·간접적 투자수단을 이용하고 있습니다.

2026년 3분기말 현재 지분상품(상장주식)의 주가가 1% 변동할 경우 기타포괄손익(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 190,096백만원(전분기: 120,100백만원)이며, 당기손익(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 1,100백만원(전분기: 1,141백만원)입니다.

(2) 신용위험

신용위험은 통상적인 거래 및 투자 활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소를 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정·관리하고 있습니다. 그리고 위험국가에 소재한 거래처의 매출채권은 보험한도 내에서 적절하게 위험 관리되고 있습니다.

신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당 거래는 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해,

당사는 국제 신용등급이 높은 은행(S&P A등급 이상)에 대해서만 거래를 하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 기존에 거래가 없는 금융기관과의 신규 거래는 해당 기관에 대한 건전성 평가 등을 거쳐 시행하고 있습니다. 당사가 체결하는 금융계약은 부채비율 제한 조항, 담보제공, 차입금 회수 등의 제약조건이 없는 계약을 위주로 체결하고 있으며, 기타의 경우 별도의 승인을 받아 거래하고 있습니다.

당사의 금융자산 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 당사의 신용위험 최대노출액은 금융자산 장부금액과 동일합니다.

(3) 유동성위험

유동성위험이란 당사가 금융부채와 관련된 모든 의무를 이행하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 주요 유동성 공급원은 영업에서 창출한 현금 및 자본시장 및 금융기관에서 조달한 자금이며, 주요 유동성 수요는 생산, 연구개발을 위한 투자를 비롯해, 운전자본, 배당 등에 있습니다. 대규모 투자가 많은 당사의 사업 특성상 적정 유동성의 유지가 매우 중요합니다. 당사는 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 산정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지·관리하고 있습니다.

당사는 권역별로 Cash Pooling을 구축하여 권역 내 개별 법인의 자금이 부족한 경우에도 유동성위험에 효율적으로 대응하고 있습니다. Cash Pooling은 자금 부족 회사와 자금 잉여 회사간 자금을 통합관리하는 시스템으로 개별회사의 유동성위험을 최소화하고 자금운용 부담을 경감시키며, 금융비용을 절감하는 등의 효과가 있습니다.

또한 대규모 유동성이 필요한 경우를 대비하여 본사의 지급보증을 통해 해외 종속기업이 활용할 수 있는 차입한도를 확보하고 있으며, 보고기간종료일 현재 국제신용평가기관인 Moody's로부터 Aa2, S&P로부터 AA- 등 투자적격등급을 부여받고 있어, 필요시 자본시장을 통해 적기에 자금조달이 가능합니다.

(4) 자본위험

당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해관계자에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 건전한 자본구조를 유지하는 것입니다. 당사는 신용등급, 부채비율 등의 지표를 이용하여 자본위험을 관리하고 있습니다.

보고기간종료일 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제58기 3분기말	제57기말
부 채	177,730,304	130,621,773
자 본	614,111,577	436,320,337
부채비율	28.9%	29.9%

다. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황

당사는 환율변동 위험관리 목적상 장부 통화가 아닌 외화 포지션에 대하여 통화선도(Currency Forward) 상품을 매매하여 헷지하고 있습니다. 통화선도 상품은 매매목적 및 위험회피목적으로 은행을 통하여 매수 또는 매도하고 있습니다.

2026년 3분기말 현재 당사는 USD,EUR,JPY 등 총 31개 통화에 대하여 3,491건의 통화선도 거래를 체결하고 있으며, 자산·부채 장부금액 및 관련손익은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	자산	부채	이익	손실
통화선도	123,784	98,478	638,029	619,890

그리고 당사는 ㈜ 레인보우로보틱스 및 그 최대주주 등과 체결한 주주간 계약에 따라, 일정 기간 동안 최대주주 등에게 최대주주 등이 보유하는 주식의 전부 또는 일부를 당사 또는 당사가 지정한 제3자에게 매도할 것을 청구할 권리를 보유하고 있습니다. 당사가 보유한 옵션 중 2024년 12월 31일 이사회에서 ㈜레인보우로보틱스의 최대주주 등 6인이 보유한 지분 394만주를 인수하는 콜옵션의 행사를 보고하였고, 인수대가는 267,463백만원이며, 2025년 3월 12일에 지분인수 절차를 완료하였습니다. 2026년 3분기말 현재 보유한 콜옵션의 행사가액은 시가로 콜옵션의 공정가치를 별도로 평가하지 않았습니다.

또한, 종속회사인 삼성디스플레이㈜는 Corning Incorporated와 2021년 4월 8일 실행된 주식매매계약에 따라, 보유 중인 Corning 지분증권 일부를 Corning에게 매각할수 있는 풋옵션을 보유하고 있으며, TCL Technology Group Corporation (TCL) 및 TCL China Star Optoelectronics Technology Co. Ltd. (CSOT)와 2021년 4월 1일 실행된 주주간 계약에 따라 CSOT가 상장기한 내 비상장 시, 삼성디스플레이㈜가 보유 중인 CSOT 지분증권 전부 또는 일부를 TCL에게 매각할 수 있는 풋옵션을 보유하고 있습니다. 2026년 3분기말 현재 상기 풋옵션들의 공정가치는 한영회계법인이 평가하였습니다.

그리고 종속회사인 삼성디스플레이(주)는 당기중 복수의 금융기관과 당사 보통주를 기초자산으로 하는 차액결제형 주식선도계약을 체결하였습니다.

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요 계약 등

계약 상대방	항 목	내 용
Google	계약 유형	상호 특허 사용 계약
	체결시기	2014.01.25
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스 계약 체결을 통한 사업 자유도 확보
	기타 주요내용	영구 라이선스 계약 (향후 10년간 출원될 특허까지 포함)
Google	계약 유형	EMADA
	체결시기 및 기간	2019.02.27~2027.03.31
	목적 및 내용	유럽 32개국(EEA) 대상으로 Play Store, YouTube 등 구글 앱 사용에 대한

		라이선스 계약
Ericsson	계약 유형	상호 특허 사용 계약
	체결시기	2021.05.07
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스 계약 체결을 통한 사업 자유도 확보
Qualcomm	계약 유형	상호 특허 사용 계약
	체결시기	2022.07.06
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스·부제소를 통한 사업 자유도 확보
Huawei	계약 유형	상호 특허 사용 계약
	체결시기	2022.07.13
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스 계약 체결을 통한 사업 자유도 확보
Nokia	계약 유형	상호 특허 사용 계약
	체결시기	2023.01.19
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스 계약 체결을 통한 사업 자유도 확보
Netlist	계약유형	상호 특허 사용 계약
	체결시기	2026.08.04
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스 체결을 통한 소송 등의 특허 분쟁 리스크 해소
	기타 주요내용	계약기간 5년

※ 기타 영업기밀에 해당하는 사항은 기재하지 않았습니다.

나. 연구개발활동의 개요 및 연구개발비용

당사는 고객의 요구를 먼저 파악하고 발상의 전환을 통해 창조적이고 혁신적인 제품,미래를 선도하는 기술을 지속적으로 창출하여 세계 시장을 선도해 나가고 있습니다. 또한, 세계 IT업계에서의 위상을 더욱 굳건히 하기 위해 차세대 기술과 원천기술을 확보하여 세계 산업 기술을 이끄는 진정한 선도 기업(Leading Company)이 되도록 최선을 다하고 있습니다.

2026년(제58기) 3분기 당사의 연구개발비용은 41조 7,984억원이며, 이 중 정부보조금으로 차감된 연구개발비를 제외하고 41조 7,867억원을 당기비용으로 회계처리하였습니다.

[연구개발비용] (단위 : 백만원, %)

과 목		제58기 3분기	제57기	제56기
연구개발비용 총계		41,798,443	37,754,815	35,021,531
(정부보조금)		△11,702	△14,423	△23,389
연구개발비용 계		41,786,741	37,740,392	34,998,142
회계 처리	연구개발비(비용)	41,786,741	37,740,392	34,998,142
연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용 총계÷당기매출액×100]		8.3%	11.3%	11.6%

※ 연결 누계기준입니다.

※ 비율은 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정하였습니다. [△는 부(-)의 값임]

다. 연구개발 조직 및 운영

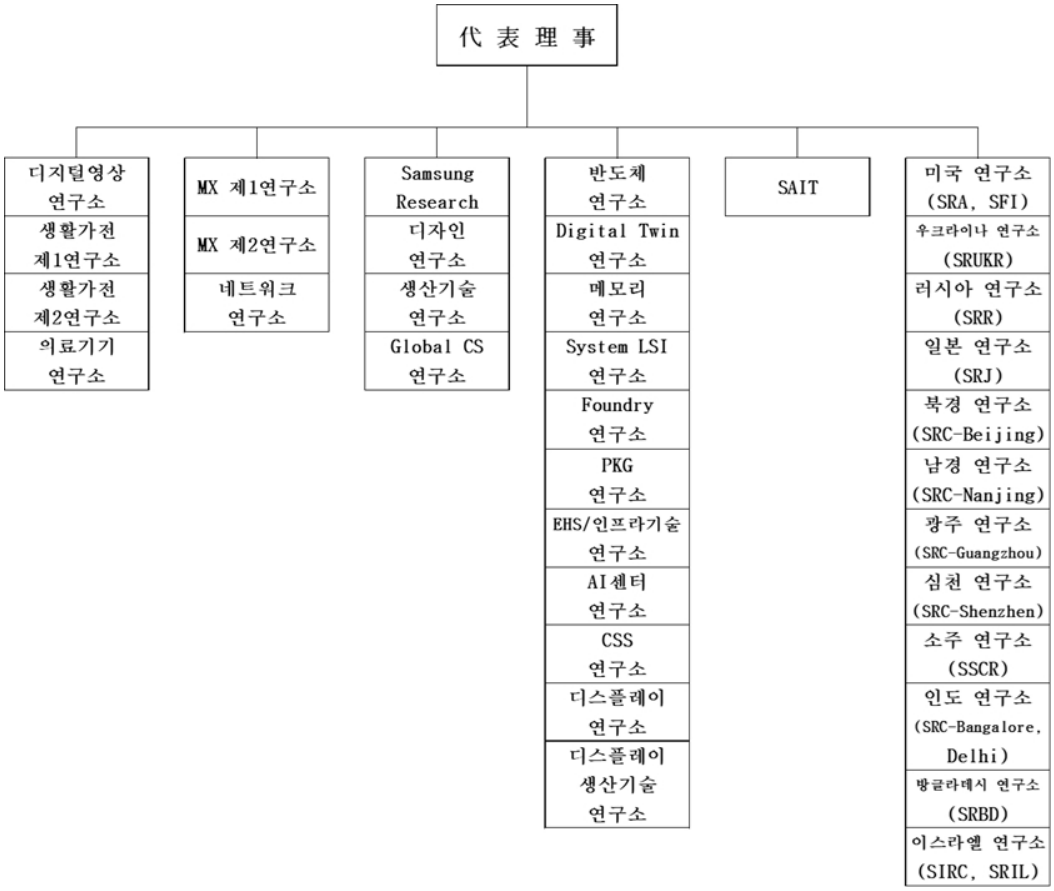
(국내)

당사는 연구개발 조직을 기술 상용화 시기에 따라 3단계로 체계화하여 운영하고 있습니다.

향후 1~2년 내 시장에 선보일 상품화 기술은 각 부문 산하 사업부 개발팀에서 개발하고 있으며, 3~5년 내 중장기 미래 유망 기술은 Samsung Research, 반도체연구소 등의 각 부문 연구소에서 개발하고 있습니다. 또한, 미래 성장엔진에 필요한 핵심 요소 기술은 당사의 종합연구소인 SAIT에서 선행 개발하고 있습니다. SAIT는 전사 차원에서 유망 성장 분야에 대한 연구개발 방향 제시와 주력 사업의 기술 경쟁력 강화, 창의적 R&D 체제를 구축하기 위한 연구개발 활동을 수행하고 있습니다.

(해외)

미국(SRA, SFI), 우크라이나(SRUKR), 러시아(SRR), 일본(SRJ), 중국(SRC-Beijing, SRC-Nanjing, SRC-Guangzhou, SRC-Shenzhen, SSCR), 인도(SRI-Bangalore, SRI-Delhi), 방글라데시(SRBD), 이스라엘(SIRC, SRIL) 등의 지역에 연구개발 조직을 운영하고 있으며 제품 개발 및 기초 기술 연구 등을 진행하고 있습니다.


代 表 理 事
디지털영상 연구소
생활가전 제1연구소
생활가전 제2연구소
의료기기 연구소
MX 제1연구소
MX 제2연구소
네트워크 연구소
Samsung Research
디자인 연구소
생산기술 연구소
Global CS 연구소
반도체 연구소
Digital Twin 연구소
메모리 연구소
System LSI 연구소
Foundry 연구소
PKG 연구소
EHS/인프라기술 연구소
AI센터 연구소
CSS 연구소
디스플레이 연구소
디스플레이 생산기술 연구소
SAIT
미국 연구소 (SRA, SFI)
우크라이나 연구소 (SRUKR)
러시아 연구소 (SRR)
일본 연구소 (SRJ)
북경 연구소 (SRC-Beijing)
남경 연구소 (SRC-Nanjing)
광주 연구소 (SRC-Guangzhou)
심천 연구소 (SRC-Shenzhen)
소주 연구소 (SSCR)
인도 연구소 (SRC-Bangalore, Delhi)
방글라데시 연구소 (SRBD)
이스라엘 연구소 (SIRC, SRIL)

라. 연구개발실적

2026년 3분기 중 당사의 각 부문별 주요 연구개발 실적은 다음과 같습니다.

부문	연구과제 등	연구결과 및 기대효과 등
DX 부문	Galaxy 폴더블	・Galaxy Z Fold8・Z Fold8 Ultra・Flip8 출시
	Galaxy S26	・Galaxy S26・S26+・S26 Ultra 출시
	Galaxy A	・Galaxy A07 5G, A57 5G, A37 5G, A27 5G, A08 출시
	Galaxy Book	・Galaxy Book6, Galaxy Book6 Ultra・Pro・Edge 출시
	Micro RGB	・Micro RGB LED 기반 4K TV R95(65・75・85D인치), R85(65・75・85・100인치) 출시
	Neo Mini LED TV	・Neo Mini LED 기반 2개 시리즈, 7개 사이즈 (43・50・55・65・75・85・100 인치) 출시
	OLED TV	・벽에 완전히 밀착되는 프리미엄 디자인(Dual Plate Design)과 WOC Ready 솔루션 적용
	냉장고	・자동 문 열림 기능 및 초격차 에너지 1등급 효율의 하이브리드 쿨링 기술을 탑재한 36인치 T-Type FDR 냉장고 출시
	세탁기	・AI 맞춤세탁 기능 등을 강화한 Bespoke 3세대 MASS, 3세대 Bespoke AI 콤보 출시
	기지국	・북미 PCS/AWS 주파수 대역에서 당사 최초 고출력(720W) Dual Band RU 개발 ・유럽 사업자 대응을 위해 1.8GHz/2.1GHz 대역 지원하는 Wideband AMP 적용한 당사 첫 제품 개발
DS 부문	HBM	・최선단 공정 1c D램(10나노급 6세대) 및 4나노 베이스 다이 적용한 세계 최초 업계 최고 성능의 HBM4 양산 출하 ・단일 스택 기준 초당 3.6TB(테라바이트)에 달하는 업계 최초 HBM4E 12단 샘플 출하
	eStorage	・업계 최초, 최고 성능의 온디바이스 AI 최적화 UFS 5.0 개발
	서버 SSD	・AI 인프라에 최적화된 기업용 SSD PM1763 양산
	LSI	・세가지 위성 통신 기술을 단일 칩에 통합한 '엑시노스 모뎀 5410' 출시 ・모바일 온디바이스 AI 경험을 위한 차세대 플랫폼 '엑시노스 1680' 출시 ・Wi-Fi7 과 Bluetooth6 결합한 Baseband IC '엑시노스 커넥트 6375' 출시
SDC	OLED	・Privacy 기능을 적용한 Galaxy S26 Ultra OLED 개발 ・폴더블 최초 티타늄 합금 소재 및 초정밀 가공 기술을 적용한 Galaxy Z Fold8 OLED 개발

※상세 현황은 '상세표-4. 연구개발실적(상세)' 참조

7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 관련

당사는 R&D 활동의 지적재산화에도 집중하여 1984년 최초로 미국에 특허를 등록한이래 현재 세계적으로 총 302,751건의 특허를 보유하고 있으며, 특히 미국에서의 분쟁에 효과적으로 대응하고자 미국에서 가장 많은 특허를 보유하고 있습니다.

[국가별 등록 건수(2026년 3분기말 현재, 연결 기준)] (단위 : 건)

구분	한국	미국	유럽	중국	일본	기타국가	계
등록건수	71,685	111,900	56,851	33,382	7,951	20,982	302,751

2026년 3분기 중 총 41.8조원의 R&D투자를 통해 국내 특허 8,411건, 미국 특허 8,470건 등을 등록하였습니다.

[주요 국가 연도별 특허등록 건수] (단위 : 건)

구 분	2026년 3분기	2025년	2024년
한 국	8,411	10,639	7,805
미 국	8,470	10,347	9,226

이 지적재산권은 대부분 스마트폰, 스마트 TV, 메모리, System LSI 등에 관한 특허로서 당사 전략사업 제품에 쓰이거나 향후 활용될 예정이며, 사업 보호의 역할뿐만 아니라 유사 기술・특허가 난립하는 상황에서 경쟁사 견제의 역할도 하고 있습니다. 또한, 미래 신기술 관련 선행 특허 확보를 통하여 향후 신규 사업 진출 시 사업 보호의 역할이 기대되고 있습니다. 당사는 Google(2014.1월 체결), Nokia(2023.1월), Qualcomm(2022.7월), Huawei(2022.7월) 등과의 특허 라이선스 체결을 통하여, 모바일, 반도체 등 당사 주력사업 및 신사업 분야에서 광범위한 특허 보호망을 확보하고 있습니다.

당사는 상기 특허뿐만 아니라 스마트폰, 스마트 TV 등에 적용된 당사 고유 디자인을보호하고자 디자인특허 확보도 강화하여, 2026년 3분기 중 미국에서 422건의 디자인특허(Design Patent)를 취득하였습니다.

나. 환경 관련 규제사항

당사는 법률에서 정하고 있는 각종 제품 환경규제와 사업장관리 환경규제를 철저하게 준수하고 있습니다. 특히 정부의 저탄소 녹색성장 정책에 부응하여 관련 법규에서요구하는 사업장에서 발생하는 온실가스 배출량과 에너지 사용량을 정부에 신고하고지속가능보고서 등을 통하여 이해관계자에게 관련 정보를 투명하게 제공하고 있습니다.

(제품 환경규제 준수)

전자제품은 일반적으로 소비자가 직접 휴대하거나, 가정에 설치하여 사용하고 있어 사용자 건강과 안전에 직・간접적인 영향을 미칠 수 있기 때문에 관련 환경규제가 강화되고 있습니다. 이에 대해 당사는 부품 및 제품의 개발단계부터 제조, 유통, 사용, 폐기 등 제품의 전 과정(Life Cycle)에 걸쳐 환경영향을 최소화하기 위한 활동을 하고있습니다. 유해물질을 제거한 부품 공급을 위해 협력회사 에코파트너 인증 제도를 운영하고 개발단계에서 제품의 친환경 요소(자원 사용 절감, 에너지 절약, 유해 물질 저감, 친환경소재 적용 등)를 제품에 반영하기 위해 에코디자인 평가 제도를 운영하며, 제품 사용 후 발생하는 폐전자제품을 회수하여 재활용하는 폐제품 회수・재활용시스템을 유럽, 북미, 한국, 인도 등 각국에서 운영하고 있습니다. 이러한 활동은 전기・전자 제품 관련 국내외 환경 법규를 준수할 뿐만 아니라 회사와 제품의 차별화 요소로 기여하고 있습니다.

각국의 관련 법률은 다음과 같습니다.
1. 폐제품 회수・재활용법 (예: EU WEEE Directive)
2. 유해물질 사용 제한 (예: EU RoHS Directive, REACH Regulation)
3. 제품 에너지 소비효율 규정 (예: EU ErP Directive)

(사업장관리 환경규제 준수)

제품생산과정에서 발생되는 오염물질의 배출을 최소화하기 위하여 대기오염방지시설, 수질오염방지시설, 폐기물처리시설과 같은 환경오염방지시설을 설치하여 운영함으로써 주변 환경에 대한 영향을 최소화 하고 있습니다. 이러한 사업장의 환경관리는관련 부처, 지방자치단체의 관리감독을 받고 있으며, 국내 및 글로벌 전 생산 사업장은 국제 환경안전보건경영시스템 인증(ISO 14001, ISO 45001)을 취득하여 법규준수 및 자율관리 체제를 강화하고 있습니다.

주요한 관련 법률은 다음과 같습니다.

1. 환경오염물질 배출 규제:「물환경보전법」「대기환경보전법」「폐기물관리법」
「소음・진동관리법」「환경영향평가법」등
2. 온실가스 배출 관리:「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」
「기후위기대응을 위한 탄소중립・녹색성장기본법」등
3. 기타 사업장환경관리법:「화학물질관리법」
「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」
「악취방지법」「토양환경보전법」등

(온실가스 배출량 및 에너지 사용량 관리)

당사는 국내에서「기후위기 대응을 위한 탄소중립・녹색성장기본법」제27조(관리업체의 온실가스 목표관리)에 따른 온실가스 에너지 목표관리업체에 해당됩니다. 따라서 동법 제27조 3항 및 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률 제24조(배출량의 보고 및 검증)에 따라 제3자 검증을 마친 당사의 온실가스 배출량과 에너지 사용량을 2011년 5월부터 정부 당국에 신고하고 이해관계자에게 공개하고 있습니다.

정부에 신고된 당사의 국내 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다.

(단위 : tCO_2-eq, TJ)

구 분	2025년	2024년	2023년
온실가스(tCO_2-eq)	18,029,119	17,680,900	17,338,033
에너지(TJ)	331,855	320,697	301,633

※ 정부에 신고된 본사 및 자회사 포함 기준입니다.

※ 대상은 국내 제조사업장, 사옥, 당사 소유 건물, 임차 건물 등입니다.

※ 온실가스 사용실적은 오존파괴물질(ODS) 제외된 기준입니다.

※ 배출량 및 에너지사용량은 정부의 적합성 평가 등에 따라 변동될 수 있습니다.

당사는 2015년부터「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」제8조(할당대상업체의 지정 및 지정취소)에 따라 온실가스 배출권 할당 대상업체에 해당합니다.

다. 사업부문별 현황

[DX 부문]

(산업의 특성 등)

1) TV산업

TV 산업은 1926년 흑백 TV, 1954년 컬러 TV 등장 이후 지금까지, 평면 TV (LCD), 스마트 TV, 초대형 TV, OLED, QLED, Micro LED, RGB 등 고화질 디스플레이로 진화를 거듭해 왔습니다. 칩 설계, 회로개발, 화질 및 신호 처리 등 고도화된 기술을 바탕으로, 소비자에게 궁극의 화질을 제공하기 위한 기술 혁신을 지속하며 시장의 외형을 확장해 나가고 있습니다.

TV 시장의 2026년 예상 출하량은 2.1억대로 최근 3년간 유사한 수준인 가운데 75인치이상 초대형 제품은 2030년까지 연평균 7% 이상 성장할 전망입니다 (출처: Omdia 2026.09).

스마트 TV 시장은 2016년에 전세계 TV 출하량의 50% 에서 2025년 95% 수준으로 확대되며 판매되는 대부분의 제품은 스마트TV로 전환되었습니다(출처: Omdia 2026.09).

스마트TV 대중화로 기존의 스트리밍 애플리케이션 외에도 FAST(Free Ad-supported Streaming TV), AVOD(Advertising Video On Demand) 등의 신규 플랫폼이 활성화되었으며 소비자의 콘텐츠 선택권과 소비 편의성이 향상되었습니다.

이러한 시청행태 변화에 따라 TV 산업은 단순한 하드웨어 판매를 넘어 독자적인 운영체제(OS) 확장과 광고 플랫폼 탑재 등을 통해 소프트웨어 및 서비스 분야에서 지속적인 부가가치를 창출하는 비즈니스 모델이 가속화되고 있습니다.

더불어 TV 업계는 AI 기술을 적극 도입하고 있습니다. 영화/스포츠/게임과 같은 일상적인 콘텐츠 소비 과정에서 화질/음질 최적화, 실시간 정보 탐색 및 번역, 화면 이미지 생성 등 소비자 맞춤형 AI TV 경험을 제공하기 위한 경쟁력 확보에 집중하고 있습니다. 또한 소비자의 다양한 니즈와 특성을 고려하여 디자인, 이동성 등을 강화한 라이프스타일 제품군이 새로운 수요를 창출하고 있습니다.

2) 모바일 산업

모바일 산업은 1980년대 초 음성통화만 가능했던 1세대 아날로그 방식으로 시작하여 음성 및 문자 메시지 전송이 가능한 CDMA와 GSM의 2세대 디지털 방식을 거쳐, 음성 데이터뿐만 아니라, 사진, 동영상과 같은 멀티미디어 데이터까지 전송 가능한 WCDMA 등의 3세대 이동통신으로 발전하였습니다. 이후 대용량 데이터의 초고속 전송이 가능한 4세대 LTE 서비스가 전 세계로 확산되었으며, 2019년 초 5세대 이동통신 5G 서비스가 한국과 미국을 시작으로 글로벌 상용화 되었습니다. 5G 스마트폰은 2020년 2.7억대에서 2025년에는 9.7억대로 판매가 확대되었습니다. 다만 2026년은 9.2억대로 소폭 감소할 전망이나, 전체 스마트폰 시장 내 5G 비중은 지속적으로 확대되는 추세입니다. 5G의 확산은 AI・ XR・자율주행 등 5G 융합 서비스 및 기반 산업의 생태계 조성을 가속화하고 있습니다 (출처: TechInsights 2026.09).

스마트폰 시장은 2007년 이후 큰 폭으로 성장하여 2026년 전체 휴대폰 판매량 중 스마트폰의 비중은 87% 수준, 피처폰의 비중은 일부 신흥 시장에서의 수요로 인해 13% 수준입니다 (출처: TechInsights 2026.09). 스마트폰 시장이 성숙함에 따라 고성능 AP, 고화질 Display, 폴더블 폼팩터, 멀티카메라, 센서, 방수・방진, 생체 인식 등과 같은 하드웨어뿐만 아니라 플랫폼 기반의 Application, UX, Game, Media, Digital Wallet, AI, 보안 등 전반적인 소프트웨어 기반 경험 경쟁력의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다.

(국내외 시장여건 등)

1) TV산업

2026년 TV 시장 수요는 중동 전쟁 등 글로벌 경기 불확실성이 확대되면서 전년과 동등 수준인 2.1억대를 기록할 것으로 전망됩니다(출처: Omdia 2026.09).

< TV 시장점유율 추이 >

제 품	2026년 3분기	2025년	2024년
TV	29.5%	29.1%	28.3%

※ 시장점유율은 외부조사기관인 Omdia의 세계시장점유율 자료(금액 기준)를 활용하였으며,
2026년 3분기 시장점유율은 당사 추정치입니다.

2) 모바일 산업

스마트폰 시장은 보호무역 기조 확산 등 불안정한 대외환경 속에서 2024년 12.2억대에서 2025년 12.5억대 규모로 성장하였습니다. 2026년은 주요 부품 가격 상승 부담으로 시장 규모가 11.0억대 수준으로 감소할 전망이나, AI 기능 개선, 폴더블 시장 확대 등으로 프리미엄 수요는 유지될 것으로 전망됩니다. (출처: TechInsights 2026.11).태블릿 시장은 교체 주기가 성숙 단계에 진입함에 따라 2024년 1.5억대에서 2025년 1.6억대로 소폭 성장하였으나, 2026년은 부품가 상승에 따른 평균판매가격 상승으로 수요가 1.4억대 수준으로 감소할 전망입니다 (출처: TechInsights 2026.10).

< 스마트폰 시장점유율 추이 >

제 품	2026년 3분기	2025년	2024년
스마트폰	22.1%	19.2%	18.3%

※ 시장점유율은 외부조사기관인 TechInsights의 세계시장점유율 자료(수량 기준)를 활용하였습니다.

(영업의 개황 등)

1) TV산업

당사는 2006년 전세계 TV 판매 1위를 달성한 이후 2025년까지 20년 연속으로 TV 최고 자리를 지키고 있습니다. 이 기간동안 공격적으로 영업,마케팅 활동을 전개하여 시장 점유율을 2006년말 기준 14.2%에서 2025년말 기준 약 29%로 두배 증가시켰습니다.

글로벌 TV 시장은 75인치 이상 대형 TV와 $1,000 이하 보급형 TV군이 성장세를 주도하고 있습니다. 이에 따라 업체들간 경쟁이 점점 더 치열해 지고 있고, 메모리 등 재료비 상승세도 지속 중이어서 수익성 확보에 어려움이 가중되고 있습니다.

당사는 어려운 경영환경에서도 시장점유율을 확대하고 수익성을 제고하기 위해, 2026년도에는 AI TV 라인업을 기존 QLED 이상에서 Entry 라인업으로 확대하고, Micro RGB, Mini LED 등 신규 폼팩터 기반 라인업을 새롭게 출시하였습니다.

삼성 AI TV는 소비자의 일상 속 AI 동반자로서 'AI 시청 최적화'와 'AI 홈' 등 '개인화된 경험'을 제공합니다. 또한 고도화된 AI 기술을 통해 자연스러운 대화를 기반으로 사용자가 원하는 정보와 콘텐츠를 손쉽게 검색할 수 있도록 지원하고, 사용자의 질문과 요청의 맥락을 깊이 있게 이해하여, 최적화된 답변과 콘텐츠 추천을 제공함으로써 더욱 풍부하고 편리한 사용자 경험을 선사합니다.

2026년에는 신규 제품으로 Micro RGB 2개 시리즈(R95H, R85H) 와 Mini LED 2개 시리즈(M80H, M70H) 를 출시 하였으며, 대형 TV 시장 주도를 위해 98/100/115인치 등 라인업 확대와 함께 초대형 모델 판매에 더욱 주력할 예정입니다.

또한 삼성 OLED 는 S95H 상위 모델에 대해 신규 Float Layer 디자인을 적용하고, S90H 까지 Glare Free 와 165Hz 주사율을 확대 적용하면서 소비자의 OLED 시청경험
을 더욱 제고 하였습니다.

더 프레임(The Frame)은, 전년도 출시 이후 무선 One Connect(OC) 및 Neo QLED 화질로 시장 호평을 받은 더 프레임 프로(The Frame Pro)를 저반사 패널 성능 및 블랙 표현력을 한층 개선하여 신규 모델로 도입했습니다. 동 모델은 The Frame 일반 모델 대비 프리미엄 가격대에 위치함에도 불구하고, The Frame 전체 매출의 절반에
가까운 판매 비중을 기록하는 등 소비자 반응이 뜨겁습니다. 또한 소비자의 다양한 설치 환경 수요에 대응하기 위해 기존 유선 OC 방식 外 일체형 타입 모델을 추가 출시하였으며, 출시 이후 시장의 호평을 받고 있습니다. 아울러 신규 출시한 98인치 모델은 주요 유통 채널에서 핵심(Hero) 전시 제품으로 활용되며, The Frame의 'Art TV의 오리지널(The Origin of Art TV)'로서의 카테고리 리더십을 강화하고 있습니다.

또한 '삼성 아트 스토어'가 더프레임 및 25년형 Neo QLED와 QLED뿐만 아니라 26년형 Micro RGB, OLED 및 Mini LED 제품으로까지 추가 확대되어 당사 TV를 구매하는 대부분의 소비자들이 Art 경험을 즐길 수 있습니다. 삼성 아트 스토어는 삼성 TV 전용 예술작품 구독 서비스로 글로벌 유명 미술관, 박물관 등과의 협력으로 5천점 이상의 세계적인 작품을 제공해 일상에서 쉽게 예술을 접할 수 있게 합니다.

2) 모바일 산업

당사는 주력 사업인 스마트폰 시장에서 2011년 이후 지난 15년 동안 급변하는 시장 환경 속에서도 글로벌 선도 지위를 유지 중입니다. 스마트폰뿐만 아니라 전체 모바일 시장에서의 사업 위상을 강화하기 위해 태블릿과 웨어러블(스마트워치, 무선이어폰 등), 액세서리 등의 제품과 함께 Digital Health, Digital Wallet 등 컨텐츠와 서비스 부문에서도 사업 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다.

당사는 프리미엄에서 보급형까지 다양하고 경쟁력 있는 스마트폰 라인업을 활용하여 지역별 시장 상황과 경쟁 환경에 최적화된 제품 포트폴리오를 운영하고 있습니다. 특히 프리미엄 스마트폰은 생성형 AI를 적용한 검색 ・실시간 통번역 ・자동 내용 요약 ・사진 편집, Dynamic AMOLED 2X(120Hz) 지원, UWB(Ultra Wideband)를 활용한 디지털키 및 콘텐츠 공유, 초음파 방식의 온스크린 지문 인식, 야간 촬영・8K 동영상 특화 카메라 기능 등 고객이 필요로 하는 차별화된 기능을 지속해서 선보이고 있습니다.

2019년에는 세계 최초 5G 스마트폰 출시로 5G 시장 리더십을 선점하고 폴더블 디스플레이를 탑재한 Galaxy Z 폴드로 신규 시장을 개척한 데 이어, 2020년에는 상하로 접히는 Galaxy Z 플립을 출시하였습니다. Galaxy Z 플립 시리즈는 아이코닉한 디자인과 높은 휴대성으로, 여성과 젊은 세대의 Galaxy 선호도를 높이는데 기여하고 있습니다. 이후 당사만의 기술 리더십과 소비자 가치 중심의 사용성을 기반으로 폴더블 특화 경험을 강화한 신모델을 지속 출시하며 폴더블 시장을 주도하고 있습니다.

2026년 8월 출시된 Galaxy Z Fold 시리즈는 역대 가장 완성도 높은 폴더블 라인업을 통해 소비자 라이프스타일에 맞춘 혁신적인 폼팩터와 경험을 제공합니다. 'Galaxy Z Fold8 Ultra'는 시리즈 중 가장 얇고 가벼운 디자인에 트리플 카메라, 향상된 AP 성능, 대용량 배터리를 통해 프리미엄 사용자 경험을 제공합니다. 동시에 출시된 'Galaxy Z Fold8'은 새로운 화면 비율의 디자인으로 미디어 시청, 독서, 게임 등 콘텐츠에 최적화된 몰입감을 제공하면서 콤팩트한 사이즈와 가벼운 무게로 휴대성 측면에서도 차별화된 경쟁력을 제공합니다. 'Galaxy Z Flip8'은 역대 가장 얇고 가벼운 휴대성을 제공하며 단말을 펼치지 않고도 개인화된 추천을 받고 필요한 작업을 수행하거나 앱을 사용할 수 있어 AI 시대에 최적화된 사용 경험을 제공합니다.

스마트폰 외에도 대화면 디스플레이와 S Pen으로 노트 필기와 영상회의, 멀티태스킹 등 생산적인 경험을 제공하는 태블릿, 생체 센서 기술을 적용하여 더욱 고도화된 피트니스 및 웰니스 기능을 제공하는 스마트 워치와 편안한 착용감으로 맞춤형 건강정보를 제공하는 스마트링, 풍부하고 뛰어난 사운드 경험을 제공하는 무선 이어폰 등 다양한 Galaxy Ecosystem 제품군을 통해 당사 스마트폰을 사용하는 고객에게 더욱 풍부한 모바일 경험을 제공하고 있습니다.

당사는 제품과 더불어 그동안 Samsung Wallet(구 Samsung Pay), Samsung Health 등의 실용적이고 가치 있는 서비스를 제공해 왔습니다. Samsung Wallet은 결제 외에도 신분증, 티켓 등의 다양한 기능을 제공하여 실물 지갑을 대체할 수 있는 서비스로 발전시켜 나가고 있으며, Samsung Health는 새로운 폼팩터와 AI 기능 적용을 통해 통합 건강관리 플랫폼으로서의 위상을 더욱 강화해 나가고자 합니다.

뿐만 아니라, 당사는 제품 및 사업운영 전반에서 친환경 기술 혁신을 지속하고 있습니다. 갤럭시 신제품에 재활용 소재를 적용하고, 패키지에 일회성 플라스틱 소재를 제거하였으며, MX사업장에서 발생하는 매립 폐기물을 제로화하였습니다. 이러한 노력을 통해 당사는 2021년 발표한 목표인 '지구를 위한 갤럭시'를 2025년까지 달성하였습니다.

당사는 2030년까지 달성할 확장된 목표를 새롭게 수립하였으며, 재활용 소재 적용 확대 및 용수 사용량의 110%를 지역사회에 환원하고, 사업장 면적 이상의 생태계 보전 사업도 추진할 계획입니다.

당사는 앞으로도 업계 최고 수준의 R&D 역량을 바탕으로 지속적인 기술 혁신 및 철저한 미래 준비를 통해 고객에게 새로운 가치를 끊임없이 제공하겠습니다.

[DS 부문]

(산업의 특성 등)

반도체는 일반적으로 정보를 저장하고 기억하는 메모리 반도체와 연산과 추론 등 논리적인 정보처리 기능을 하는 System LSI(비메모리 반도체)로 구분됩니다.

메모리 반도체는 크게 읽고 쓸 수 있는 램(RAM) 제품과 읽기만 할 수 있는 롬(ROM) 제품으로 구분됩니다. 램(RAM)은 전원이 꺼지면 기억된 내용은 지워져 휘발성 메모리(Volatile Memory)라고 하며, 컴퓨터의 주기억장치, 응용 프로그램의 일시적 로딩(Loading), 데이터의 일시적 저장 등에 사용됩니다. 롬(ROM, Read Only Memory)은 전원이 꺼져도 Data가 지워지지 않는 비휘발성 메모리로 대표적으로 입출력 시스템이나 IC카드 등에 사용됩니다.

System LSI 제품은 응용처 등에 따라 종류가 다양하며 가장 규모가 큰 것이 PC 및 모바일 기기, 서버(Server) 등의 중앙처리 장치인 CPU(Central Processing Unit)이고 가전, 네트워크, 게임 등 다양한 분야에 적용되고 있습니다. 당사는 스마트폰, 태블릿 등 모바일용 AP 제품과 이미지센서 등을 공급하고 있습니다.

Foundry 사업은 팹리스(Fabless) 업체가 설계한 반도체를 위탁 생산해서 공급해주는사업으로, 일반 제조업의 OEM 공급과 비슷한 개념의 '수탁 반도체 제조'입니다. 반도체 공정 기술의 고도화와 투자 부담의 증가로 많은 IDM 업체가 생산 시설을 보유하지 않은 팹리스 업체로 전환하였습니다. 이에 따라 대규모 Capa를 보유 중인 5개 내외의 소수업체가 전체 Foundry 시장의 대부분을 영위하고 있습니다.

(국내외 시장여건 등)

3분기 메모리 시장은 AI 응용 중심의 수요 강세가 이어졌습니다. 특히, 본격적인 Agentic AI 도입 영향으로 AI 및 Conventional 서버향 HBM, RDIMM, 서버 SSD 등 AI 인프라 확대와 연관된 제품 위주로 수요가 확대되었습니다. 4분기에도 AI 산업 내 인프라 투자가 지속 늘어나고 있는 가운데, 신규 출시될 GPU, CPU와 연계된 제품 위주의 메모리 수요가 추가적으로 확대되고 있습니다. 또한, NAND 시장에서도 클라우드 기반 Personal AI Agent 서비스 확산에 따른 스토리지 수요 급증과 연계하여 QLC 수요가 대량으로 접수되고 있습니다.

Foundry 시장은 2나노 모바일 제품의 본격적인 양산과 더불어 AI/HPC향 프리미엄 제품의 선단 노드 전환 수요가 지속됨에 따라 공급 부족 현상이 이어지고 있으며, Mainstream 노드는 AI 주변기기(Peripheral) 수요 확대에 힘입어 수급 상황이 개선되는 추세입니다. 이러한 시장 환경 변화에 따라 Foundry 업체들은 AI 및 첨단 패키징(Adv.PKG)과 같은 고부가 사업을 중심으로 생산 능력을 확보하고 사업 포트폴리오를 최적화하는 국면에 진입하였습니다.

< DRAM 시장점유율 추이 >

제 품	2026년 3분기	2025년	2024년
DRAM	38.3%	34.0%	41.5%

※ 시장점유율은 외부조사기관인 DRAMeXchange의 세계시장점유율 자료(금액 기준)를 활용하였으며, 2026년 3분기 시장점유율은 당사 추정치입니다.

(영업의 개황 등)

메모리 사업은 지난 3분기 제한된 가용량 내에서 AI향 제품 중심으로 판매 확대에 주력했습니다. 특히, 업계 선도적인 제품 경쟁력을 갖춘 HBM4 판매를 대폭 확대하였으며, NAND의 경우 서버 SSD 수요 증가세에 적극 대응했습니다. 4분기는 당사의 증산 노력에도 불구하고 수요 성장세가 이를 지속 상회하고 있어 수요 모멘텀이 강한 AI 응용 중심의 공급 대응 기조를 지속 이어나갈 계획입니다. 특히, HBM, 서버향 DRAM 및 SSD 제품의 판매 비중을 한 단계 더 증가시켜 시장 수요에 대응할 계획입니다.

System LSI는 메모리 가격 상승 및 세트 판가 인상에 따른 스마트폰 수요 둔화를 고부가 수주 확대와 응용처 다변화로 극복하고 있습니다. SOC 사업은 하반기 주요 모델 양산과 2027년 신제품 경쟁력 제고를 통해 공급 확대를 추진 중이며, Custom SOC 사업은 신규 고객과의 협력 등으로 성장 기반을 확대하고 있습니다. 이미지 센서는 모바일 2억 화소 제품 라인업 확대를 통해 시장 내 기술 리더십을 확보 중이며, 차량 및 논모바일 시장으로 확대하고 있습니다. DDI는 폴더블을 포함한 모바일 OLED 시장 내 선도적 지위를 강화하는 한편 랩탑, 태블릿 시장에서도 OLED향을 확대 중이며, Power는 기존 모바일향 중심에서 서버향으로 응용처 다변화 중입니다.

Foundry는 시장 변화에 맞추어 노드 및 응용별 전략을 수립하여 기술/개발, 제조, 비즈니스 역량 부분의 경쟁력 강화를 추진하고 있습니다. 선단 노드는 경쟁사의 공급난 및 가격 인상이 당사의 신규 진입 기회로 작용하고 있으며, 2나노 2세대 모바일 제품 양산 시작 및 4나노 HBM B-die 제품 공급 확대 등 견조한 수요를 중심으로 매출 성장 중입니다. 추가로 2나노 AI/HPC향 대형 고객사 과제 수주도 지속됨에 따라 중장기 성장 동력을 강화하고 있습니다. Mainstream 노드는 고부가가치 제품 포트폴리오 확대를 위한 Specialty 공정 기술 확보 및 고객 수주 다변화를 추진 중으로, 수익성 개선과 노드 장기 활용이 가능한 전략을 마련하고 있습니다. 지속적인 고객 협력 및 개발/수주/생산/공급 등 전방위 경쟁력을 강화함으로써 변화하는 시장에 맞춰 사업 기회를 확대해 나가겠습니다.

[SDC]

(산업의 특성 등)

디스플레이(Display)는 각종 전자기기에 사용되는 화면표시장치를 지칭합니다. 표시방식 측면에서 표시 소자가 능동적으로 구동되는(Active Matrix) 방식이 주류이며, OLED(Organic Light Emitting Diode)와 QD-OLED(Quantum Dot-Organic Light Emitting Diode), TFT-LCD(Thin Film Transistor Liquid Crystal Display) 등이 이에 해당합니다.

OLED는 스스로 빛을 내는 유기물질을 이용한 화면표시장치로, 명암비와 색 일치율이 높고 색 재현 범위가 넓으며 응답 속도가 빠르다는 장점이 있습니다. 이러한 장점을 바탕으로 OLED 디스플레이는 멀티미디어 콘텐츠, 인터넷 사용 등 디스플레이의 성능이 중시되는 스마트폰 시장에서 채용이 빠르게 증가하였습니다. 과거에는 OLED로 고해상도의 장수명 패널을 구현하는 것에 대해 시장의 큰 우려가 있었으나, 당사는 기술적 한계를 극복하여 시장을 발전시켜 왔습니다. OLED는 LCD의 단점을 극복할 뿐만 아니라, 앞으로 폴더블, IT(태블릿/노트북), Auto 등 다양한 응용처로 확대 적용이 가능하며 앞으로 시장이 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. QD-OLED는 수나노 미터의 반도체 결정인 퀀텀닷(Quantum Dot)을 패널에 내재화해 색 재현력과 시야각을 극대화한 자발광 디스플레이로, 향후 프리미엄급 TV 및 모니터 시장을 주도할 차세대 디스플레이로 주목받고 있습니다.

(국내외 시장여건 등)

스마트폰용 디스플레이 시장은 2025년 16.1억대에서 2026년 12.3억대로 감소할 것으로 전망됩니다. 스마트폰용 OLED 디스플레이의 경우 2025년 8.2억대에서 2026년 7.7억대로 감소할 전망이며, 전체 스마트폰용 디스플레이 시장에서 OLED가 차지하는 비중은 2025년 51.0%에서 2026년 62.6%로 증가할 것으로 전망됩니다. (출처: Omdia 2026.10).

또한, 대형 디스플레이 시장은 2025년 9.1억대에서 2026년 9.1억대로 유사한 수준을 유지할 것으로 전망됩니다. (출처: Omdia 2026.09).

< 스마트폰 패널 시장점유율 추이 >

제 품	2026년 3분기	2025년	2024년
스마트폰 패널	46.9%	43.3%	41.0%

※ 시장점유율은 외부조사기관인 Omdia의 세계시장점유율 자료(금액 기준) 예측치를 활용하였으며, 2026년 3분기 시장점유율은 당사 추정치입니다.

(영업의 개황 등)

당사는 2007년 세계 최초로 OLED 제품의 상용화에 성공한 이후 현재까지 중소형 OLED 시장에서 독보적인 점유율을 유지하고 있습니다. 또한 스마트폰 외에도 폴더블, 태블릿, 워치, 노트북, Auto 등으로 제품군을 다각화하여 명실상부한 OLED 디스플레이의 선도 기업으로 자리매김하였습니다.

당사는 프리미엄부터 보급형 제품까지 최적의 제품 포트폴리오를 구축하여 소비자의 고도화되는 요구에 적극 대응하고 있으며, 차별화된 기능과 디자인의 폴더블・IT(태블릿/노트북)용 디스플레이를 지속적으로 출시하여 시장으로부터 업계 최고의 기술력을 인정받고 있습니다.

또한, 신규 8.6G IT OLED라인 양산을 통해 성장하는 IT OLED 시장을 선점하고 판매를 확대해 나갈 계획입니다. IT용 디스플레이 뿐만 아니라 Auto용, 워치용 등으로 매출 구조를 다변화하여 사업 포트폴리오 안정성을 강화해 나갈 것입니다.

대형 디스플레이 시장의 경우, TV와 모니터 프리미엄 시장에서 자발광 디스플레이 비중이 지속 증가하고 있습니다. 당사는 고해상도, 초고주사율 등 성능을 차별화하여 프리미엄 모니터용 디스플레이 시장에서 입지를 확대하였으며, 제품 라인업을 다양화하여 B2C와 B2B 모니터용 디스플레이 시장까지 판매 영역을 확대해 나갈 계획입니다.

[Harman]

(산업의 특성 등)

Harman은 전장부품(Automotive)과 라이프스타일 오디오(Lifestyle Audio) 산업에서 경쟁하고 있습니다. 이 중 전장부문이 Harman 사업의 가장 큰 비중을 차지하고 있으며 디지털 콕핏, 카오디오, 텔레매틱스 등 분야에 진출해 있습니다.

요즘 소비자들은 차량을 선택할 때 단순 이동수단 기능보다 이동시에 즐길 수 있는 차량내 경험(In-Cabin Experience)을 중요시하는 추세입니다. 이러한 소비자 니즈에 맞추어 자동차도 IT 제품처럼 SW로 업그레이드 가능한 SDV(Software Defined Vehicle)로 변화하고 있어 자동차 제조사들은 중앙집중형 전장 아키텍처 도입을 시도하고 SW 기능을 강화하는 등 많은 혁신을 추진 중입니다. 이에 따라, 전장 부품업체들의 공급제품에도 빠른 기술적 변화가 진행되고 있어, 업체간 경쟁이 치열할 것으로 예상됩니다. 이에, Harman은 자동차의 SDV로의 변화에 대응할 수 있는 SW 기술역량을 강화하고, In-Cabin Experience의 핵심 전장부품과 고성장이 예상되는 AR HUD, 디스플레이, 운전자 모니터링 등 신제품을 육성하는 한편 전자의 SW/서비스 역량을 차량에 접목하여 보다 편리하고 차별화된 사용자 경험을 제공하는데 주력할 계획입니다.

라이프스타일 오디오 산업은 컨슈머 오디오와 프로페셔널 오디오 솔루션으로 구분됩니다. 컨슈머 오디오 제품(True Wireless Stereo, Portable Speaker, Headphone 등)은 과거 단순 음원 재생기기였으나, 최근 무선 연결기술 적용 및 AI 탑재가 확산되어 기술 중심의 IT 기기로 진화하는 추세입니다. 이러한 기술 변화에 의해, IT 업체들이 컨슈머 오디오 시장에 참여하여 음향 설계 기술을 보유한 전통 오디오 업체들과 경쟁 중입니다.

컨슈머 오디오 시장은 TWS 헤드폰과 Home 오디오 및 게이밍 헤드폰 분야에서 고성장이 예상되고, 소비자들은 프리미엄 오디오를 경험(고음질/무손실 음원 등)하고자 하는 경향이 뚜렷해지고 있습니다. 이에 Harman은 고성장 분야에 사업역량과 경쟁력을 강화하고 신제품을 지속 출시하여 시장에 대응하고 있으며, 프리미엄 오디오 시장에서의 리더십 강화를 위해 B&W, Denon 및 Marantz 등의 브랜드를 보유한 미국업체 Sound United를 2025년 3분기에 인수하였습니다. 향후 Harman은 브랜드 경쟁력을 기반으로 사업 경쟁력을 지속 제고하여 컨슈머 오디오 시장에서 글로벌 1위 입지를 강화해 나갈 계획입니다.

(국내외 시장여건 등)

2026년 3분기 누계기준 전 세계 자동차 생산량은 전년 동기 대비 1.0% 감소하였습니다. 이는 중국, 유럽/중동/아프리카, 북미 지역의 생산량 감소에서 비롯되었으며, 서남아 및 중남미의 생산량 증가로 일부 상쇄되었습니다. 또한, 2026년 전 세계 생산량은 중동 전쟁, 중국의 지속적인 수요 약세, 전장부품용 DRAM 및 메모리칩 부족 등의 공급망 제약으로 인해 전년 대비 1.8% 감소할 것으로 전망됩니다(출처: S&P Global Light Vehicle Production Forecast 2026.09).

< 디지털 콕핏 시장점유율 추이 >

제 품	2026년 3분기	2025년	2024년
디지털 콕핏	13.9%	12.8%	12.5%

※ 디지털 콕핏은 인포테인먼트 시스템 등을 통해 안전한 운전 환경을 제공하는 디지털 전장부품입니다.

※ 시장점유율은 외부조사기관인 TechInsights의 자료(금액기준)를 활용하였으며,
2026년 3분기 시장점유율은 당사 추정치입니다.

(영업의 개황 등)

Harman은 전장부품 시장에서 차량내 경험의 중심이 되는 디지털 콕핏, 카오디오 분야에서 선도적 시장 입지를 유지하고 있습니다. 당사는 Harman의 선두 위상을 강화하기 위해 Harman의 전장사업에 당사의 무선통신, 디스플레이 등 IT 기술을 지속 접목시키고, 디지털 콕핏에 ADAS(Advanced Driver Assistance System, 첨단 운전자 보조 시스템) 기능을 통합한 중앙집중형 컨트롤러 제품에 사업역량을 집중하여 차량의 SDV(Software Defined Vehicle)전환을 주도하는 핵심 전장업체로 성장할 계획입니다.

Harman은 독자 보유한 음향 설계능력과 다양한 소비자층을 겨냥한 멀티 브랜드 전략을 구사하여 일반 소비자와 음악 애호가들 사이에서 오디오 전문 업체로서 브랜드 인지도 및 영향력을 확대해 왔습니다. 향후 당사와 협력을 강화하고 새로운 제품을 출시하여 오디오 산업 내에서의 위상과 입지를 더욱 강화해 나갈 예정입니다.

라. 사업부문별 요약 재무 현황

2026년(제58기) 3분기 매출은 DX 부문이 152조 7,316억원(30.5%), DS 부문이 356조 3,358억원(71.2%)이며, SDC가 22조 1,759억원(4.4%), Harman은 12조 7,224억원 (2.5%)입니다.

2026년(제58기) 3분기 영업이익은 DX 부문이 1조 3,237억원, DS 부문이 249조 3,958억원 , SDC가 2조 1,502억원, 그리고 Harman은 1조 2,442억원입니다.

(단위 : 억원, %)

부문	구 분	제58기 3분기		제57기		제56기	
		금액	비중	금액	비중	금액	비중
DX 부문	매출액	1,527,316	30.5%	1,879,673	56.3%	1,748,877	58.1%
	영업이익	13,237	0.5%	128,527	29.5%	124,399	38.0%
	총자산	3,921,150	33.8%	2,810,397	36.0%	2,596,713	36.2%
DS 부문	매출액	3,563,358	71.2%	1,301,282	39.0%	1,110,660	36.9%
	영업이익	2,493,958	98.1%	248,581	57.0%	150,945	46.1%
	총자산	6,415,350	55.3%	3,719,620	47.6%	3,430,454	47.8%
SDC	매출액	221,759	4.4%	298,417	8.9%	291,578	9.7%
	영업이익	21,502	0.8%	41,163	9.4%	37,334	11.4%
	총자산	933,992	8.0%	936,339	12.0%	821,980	11.4%
Harman	매출액	127,224	2.5%	157,833	4.7%	142,749	4.7%
	영업이익	12,442	0.5%	15,311	3.5%	13,076	4.0%
	총자산	224,382	1.9%	223,957	2.9%	209,347	2.9%

※ 각 사업부문별 요약 재무 현황은 부문 등 간 내부거래를 포함하고 있습니다. [△는 부(-)의 값임]

(공통 판매비와 관리비 및 자산의 합리적 배부 기준 적용)

- 공통 판매비와 관리비의 경우 각 제품・모델별 귀속이 확실한 직접비용(위임성 경비)은 각 제품・모델부문에 직접 귀속시키고 귀속 여부가 불분명한 공통경비는 각 배부 기준(매출액비, 인원수비 등)에 의거 적절히 배부하고 있습니다.
- 공통자산의 경우 직접 귀속이 가능한 자산(재고자산, 고정자산, 투자자산 등)은 해당 부서에 직접 귀속되나, 전사 공통관리가 필요한 자산 및 자산귀속이 불분명한 자산은 필요한 경우 합리적인 배부 기준(매출액비, 세전이익비 등)에 의거 각 부문에 배부하고 있습니다.

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제58기	제57기	제56기
	2026년 9월말	2025년 12월말	2024년 12월말
[유동자산]	414,446,231	247,684,612	227,062,266
· 현금및현금성자산	90,800,375	57,856,378	53,705,579
· 단기금융상품	123,973,901	67,965,021	58,909,334
· 기타유동금융자산	48,606	25,715	36,877
· 매출채권	106,097,351	51,127,642	43,623,073
· 재고자산	71,995,171	52,636,828	51,754,865
· 기타	21,530,827	18,073,028	19,032,538
[비유동자산]	377,395,650	319,257,498	287,469,682
· 기타비유동금융자산	26,219,169	17,575,506	11,756,681
· 관계기업 및 공동기업 투자	13,976,715	13,772,121	12,592,117
· 유형자산	234,009,261	215,304,784	205,945,209
· 무형자산	27,067,043	29,480,565	23,738,566
· 기타	76,123,462	43,124,522	33,437,109
자산총계	791,841,881	566,942,110	514,531,948
[유동부채]	133,767,049	106,411,348	93,326,299
[비유동부채]	43,963,255	24,210,425	19,013,579
부채총계	177,730,304	130,621,773	112,339,878
[지배기업 소유주지분]	605,443,984	424,313,255	391,687,603
· 자본금	897,514	897,514	897,514
· 주식발행초과금	4,403,893	4,403,893	4,403,893
· 이익잉여금	581,883,670	402,135,600	370,513,188
· 기타	18,258,907	16,876,248	15,873,008
[비지배지분]	8,667,593	12,007,082	10,504,467
자본총계	614,111,577	436,320,337	402,192,070
	2026년 1월~9월	2025년 1월~12월	2024년 1월~12월
매출액	500,626,123	333,605,938	300,870,903
영업이익	254,165,691	43,601,051	32,725,961
연결총당기순이익	193,985,871	45,206,805	34,451,351
· 지배기업 소유주지분	193,578,792	44,260,956	33,621,363
· 비지배지분	407,079	945,849	829,988
기본주당순이익(단위 : 원)	29,381	6,605	4,950
희석주당순이익(단위 : 원)	29,012	6,603	4,950
연결에 포함된 회사수	306개	308개	229개

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. [△는 부(-)의 값임]

※ 기본주당이익(보통주) 산출근거는 제56기~제57기 연결감사보고서 및 제58기 3분기 연결검토보고서 주석사항을 참고하시기 바랍니다

.

나. 요약별도재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제58기	제57기	제56기
	2026년 9월말	2025년 12월말	2024년 12월말
[유동자산]	267,696,124	101,439,429	82,320,322
·현금및현금성자산	17,010,538	12,581,632	1,653,766
·단기금융상품	53,167,476	12,332,721	10,187,991
·매출채권	146,487,171	42,081,734	33,840,357
·재고자산	41,599,853	28,051,916	29,154,115
·기타	9,431,086	6,391,426	7,484,093
[비유동자산]	267,688,439	257,462,622	242,645,805
·기타비유동금융자산	3,931,247	4,248,587	2,176,346
·종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자	59,968,254	59,498,635	57,427,196
·유형자산	169,023,885	155,360,355	151,446,870
·무형자산	10,025,672	11,233,489	10,496,956
·기타	24,739,381	27,121,556	21,098,437
자산총계	535,384,563	358,902,051	324,966,127
[유동부채]	97,272,216	72,935,381	80,157,976
[비유동부채]	12,240,736	31,636,587	8,411,494
부채총계	109,512,952	104,571,968	88,569,470
[자본금]	897,514	897,514	897,514
[주식발행초과금]	4,403,893	4,403,893	4,403,893
[이익잉여금]	418,879,075	254,566,830	233,734,316
[기타]	1,691,129	△5,538,154	△2,639,066
자본총계	425,871,611	254,330,083	236,396,657
종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법
	2026년 1월~9월	2025년 1월~12월	2024년 1월~12월
매출액	433,838,003	238,043,009	209,052,241
영업이익(손실)	237,414,133	23,603,619	12,361,034
당기순이익	178,323,283	33,686,601	23,582,565
기본주당순이익(단위 : 원)	27,065	5,027	3,472
희석주당순이익(단위 : 원)	26,725	5,026	3,472

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. [△는 부(-)의 값임]

※ 기본주당이익(보통주) 산출근거는 제56기~제57기 감사보고서 및 제58기 3분기 검토보고서 주석사항을 참고하시기 바랍니다.

2. 연결재무제표

2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표

제 58 기 3분기말 2026.09.30 현재

제 57 기말 2025.12.31 현재

(단위 : 백만원)

	제 58 기 3분기말	제 57 기말
자산		
유동자산	414,446,231	247,684,612
현금및현금성자산 (주3,26)	90,800,375	57,856,378
단기금융상품 (주3,26)	123,973,901	67,965,021
단기당기손익-공정가치금융자산 (주3,4,26)	48,606	25,715
매출채권 (주3,26)	106,097,351	51,127,642
미수금 (주3,26)	9,764,853	7,481,327
선급비용	3,986,022	3,627,172
재고자산 (주5)	71,995,171	52,636,828
기타유동자산 (주3,26)	7,779,952	6,964,529
비유동자산	377,395,650	319,257,498
기타포괄손익-공정가치금융자산 (주3,4,26)	24,648,280	16,295,005
당기손익-공정가치금융자산 (주3,4,26)	1,570,889	1,280,501
관계기업 및 공동기업 투자 (주6)	13,976,715	13,772,121
유형자산 (주7)	234,009,261	215,304,784
무형자산 (주8)	27,067,043	29,480,565
순확정급여자산 (주11)	8,052,629	4,271,547
이연법인세자산	11,189,554	18,840,559
기타비유동자산 (주3,26)	56,881,279	20,012,416
자산총계	791,841,881	566,942,110
부채		
유동부채	133,767,049	106,411,348
매입채무 (주3,26)	16,647,408	13,039,380
단기차입금 (주3,9,26)	8,582,230	17,574,980
미지급금 (주3,26)	32,803,844	21,365,657
선수금 (주14)	2,744,666	1,933,598
예수금 (주3,26)	1,065,509	1,001,885
미지급비용 (주3,14,26)	34,261,043	32,707,431
당기법인세부채	24,387,753	7,037,174
유동성장기부채 (주3,9,10,26)	1,067,406	1,177,508
충당부채 (주12)	8,652,018	7,690,559
기타유동부채 (주3,14,26)	3,555,172	2,883,176

비유동부채	43,963,255	24,210,425
사채 (주3,10,26)	6,768	7,134
장기차입금 (주3,9,26)	7,534,829	6,479,517
장기미지급금 (주3,26)	3,981,136	5,602,031
순확정급여부채 (주11)	532,296	558,520
이연법인세부채	870,512	709,226
장기충당부채 (주12)	3,565,814	2,900,411
기타비유동부채 (주3,14,26)	27,471,900	7,953,586
부채총계	177,730,304	130,621,773
자본		
지배기업 소유주지분	605,443,984	424,313,255
자본금 (주15)	897,514	897,514
우선주자본금	119,467	119,467
보통주자본금	778,047	778,047
주식발행초과금	4,403,893	4,403,893
이익잉여금 (주16)	581,883,670	402,135,600
기타자본항목 (주17)	18,258,907	16,876,248
비지배지분	8,667,593	12,007,082
자본총계	614,111,577	436,320,337
부채와자본총계	791,841,881	566,942,110

2-2. 연결 손익계산서

연결 손익계산서

제 58 기 3분기 2026.01.01 부터 2026.09.30 까지

제 57 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지

(단위 : 백만원)

	제 58 기 3분기		제 57 기 3분기	
	3개월	누적	3개월	누적
매출액 (주27)	195,253,209	500,626,123	86,061,747	239,768,567
매출원가 (주18)	59,989,357	164,148,387	52,569,620	152,649,117
매출총이익	135,263,852	336,477,736	33,492,127	87,119,450
판매비와관리비 (주18,19)	27,823,370	82,312,045	21,326,065	63,592,059
영업이익 (주27)	107,440,482	254,165,691	12,166,062	23,527,391
기타수익 (주20)	504,892	1,421,266	243,439	1,652,494
기타비용 (주20)	255,829	1,092,919	338,880	863,487
지분법이익 (주6)	358,117	841,959	280,488	558,359
금융수익 (주21)	4,594,021	19,069,385	2,903,929	11,220,665
금융비용 (주21)	14,109,461	22,604,921	1,709,475	7,642,154

법인세비용차감전순이익	98,532,222	251,800,461	13,545,563	28,453,268
법인세비용 (주22)	23,396,084	57,814,590	1,319,816	2,888,208
분기순이익	75,136,138	193,985,871	12,225,747	25,565,060
분기순이익의 귀속				
지배기업 소유주지분	75,208,134	193,578,792	12,006,461	24,968,902
비지배지분	(71,996)	407,079	219,286	596,158
주당이익 (주23)				
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	11,462	29,381	1,802	3,724
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	11,260	29,012	1,801	3,723

2-3. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 58 기 3분기 2026.01.01 부터 2026.09.30 까지

제 57 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지

(단위 : 백만원)

	제 58 기 3분기		제 57 기 3분기	
	3개월	누적	3개월	누적
분기순이익	75,136,138	193,985,871	12,225,747	25,565,060
기타포괄손익	(32,619,241)	(5,623,136)	7,945,664	587,597
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(10,226,938)	3,873,848	3,027,502	3,668,843
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 (주17)	(9,811,550)	4,539,684	3,043,521	3,708,237
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 (주17)	(318,455)	(239,413)	51,024	95,299
순확정급여부채(자산) 재측정요소 (주17)	(96,933)	(426,423)	(67,043)	(134,693)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	(22,392,303)	(9,496,984)	4,918,162	(3,081,246)
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 (주17)	(480,043)	(274,814)	107,819	(94,829)
해외사업장환산외환차이 (주17)	(22,528,499)	(9,873,198)	4,800,368	(2,972,973)
현금흐름위험회피파생상품평가손익 (주17)	616,239	651,028	9,975	(13,444)
분기총포괄손익	42,516,897	188,362,735	20,171,411	26,152,657
포괄손익의 귀속				
지배기업 소유주지분	44,035,045	187,648,341	19,531,056	25,271,574
비지배지분	(1,518,148)	714,394	640,355	881,083

2-4. 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 58 기 3분기 2026.01.01 부터 2026.09.30 까지

제 57 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지

(단위 : 백만원)

	자본의 구성요소						
	지배기업 소유주지분					비지배지분	자본의 구성요소
	자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	지배기업 소유주지분 합계		
2025.01.01 (기초자본)	897,514	4,403,893	370,513,188	15,873,008	391,687,603	10,504,467	402,192,070
분기순이익	0	0	24,968,902	0	24,968,902	596,158	25,565,060

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 (주17)	0	0	201,604	3,140,919	3,342,523	365,714	3,708,237
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 (주17)	0	0	0	129	129	341	470
해외사업장환산외환차이 (주17)	0	0	0	(2,891,865)	(2,891,865)	(81,108)	(2,972,973)
순확정급여부채(자산) 재측정요소 (주17)	0	0	0	(134,671)	(134,671)	(22)	(134,693)
현금흐름위험회피파생상품평가손익 (주17)	0	0	0	(13,444)	(13,444)	0	(13,444)
배당 (주16)	0	0	(7,355,384)	0	(7,355,384)	(86,818)	(7,442,202)
연결실체내 자본거래 등	0	0	0	0	0	(2,384)	(2,384)
연결실체의 변동	0	0	0	0	0	204,002	204,002
자기주식의 취득 (주15)	0	0	0	(8,149,295)	(8,149,295)	0	(8,149,295)
자기주식의 소각 (주17)	0	0	(3,049,040)	3,049,040	0	0	0
주식기준보상	0	0	0	549,501	549,501	0	549,501
기타	0	0	0	(2,855)	(2,855)	0	(2,855)
2025.09.30 (분기말자본)	897,514	4,403,893	385,279,270	11,420,467	402,001,144	11,500,350	413,501,494
2026.01.01 (기초자본)	897,514	4,403,893	402,135,600	16,876,248	424,313,255	12,007,082	436,320,337
분기순이익	0	0	193,578,792	0	193,578,792	407,079	193,985,871
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 (주17)	0	0	178,045	4,030,450	4,208,495	331,189	4,539,684
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 (주17)	0	0	0	(515,818)	(515,818)	1,591	(514,227)
해외사업장환산외환차이 (주17)	0	0	0	(9,807,136)	(9,807,136)	(66,062)	(9,873,198)
순확정급여부채(자산) 재측정요소 (주17)	0	0	0	(426,140)	(426,140)	(283)	(426,423)
현금흐름위험회피파생상품평가손익 (주17)	0	0	0	610,148	610,148	40,880	651,028
배당 (주16)	0	0	(8,662,695)	0	(8,662,695)	(16,622)	(8,679,317)
연결실체내 자본거래 등	0	0	0	(385,506)	(385,506)	(4,037,911)	(4,423,417)
연결실체의 변동	0	0	0	0	0	650	650
자기주식의 취득 (주15)	0	0	0	(25,778,665)	(25,778,665)	0	(25,778,665)
자기주식의 소각 (주17)	0	0	(5,346,072)	5,346,072	0	0	0
주식기준보상	0	0	0	28,309,254	28,309,254	0	28,309,254
기타	0	0	0	0	0	0	0
2026.09.30 (분기말자본)	897,514	4,403,893	581,883,670	18,258,907	605,443,984	8,667,593	614,111,577

2-5. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 58 기 3분기 2026.01.01 부터 2026.09.30 까지

제 57 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지

(단위 : 백만원)

	제 58 기 3분기	제 57 기 3분기
영업활동현금흐름	243,942,116	56,515,496
영업에서 창출된 현금흐름	259,797,686	58,020,414
분기순이익	193,985,871	25,565,060
조정 (주24)	125,996,900	37,921,850
영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (주24)	(60,185,085)	(5,466,496)
이자의 수취	4,755,626	3,580,269
이자의 지급	(193,692)	(344,050)
배당금 수입	281,256	223,938
법인세 납부액	(20,698,760)	(4,965,075)

투자활동현금흐름	(159,519,712)	(37,521,178)
단기금융상품의 순감소(증가)	(61,902,328)	6,306,471
단기당기손익-공정가치금융자산의 순감소(증가)	(22,891)	16,707
장기금융상품의 처분	4,541,598	698,743
장기금융상품의 취득	(39,264,160)	(4,773,232)
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	319,365	758,278
기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(2,892,426)	(120,722)
당기손익-공정가치금융자산의 처분	25,631	136,022
당기손익-공정가치금융자산의 취득	(167,323)	(116,223)
관계기업 및 공동기업 투자의 처분	13,102	4,123
관계기업 및 공동기업 투자의 취득	0	(325,146)
유형자산의 처분	214,697	170,177
유형자산의 취득	(58,153,127)	(37,640,726)
무형자산의 처분	3,575	13,554
무형자산의 취득	(2,474,519)	(3,420,768)
정부보조금의 수취	1,598,039	1,667,835
사업결합으로 인한 순현금유입(유출)액	13,512	(627,650)
사업양도로 인한 현금유출액	(5,849)	0
기타투자활동으로 인한 현금유출입액	(1,366,608)	(268,621)
재무활동현금흐름	(47,336,733)	(18,936,143)
단기차입금의 순증가(감소)	(8,726,234)	(3,341,647)
장기차입금의 차입	1,300,505	2,003,746
사채 및 장기차입금의 상환	(1,030,631)	(2,002,725)
배당금의지급	(8,678,680)	(7,443,837)
자기주식의 취득	(25,778,665)	(8,149,295)
비지배지분의 증감	(4,423,028)	(2,385)
외화환산으로 인한 현금의 변동	(4,141,674)	(364,271)
환율변동 효과 적용 후 현금및현금성자산의 증가(감소)	32,943,997	(306,096)
기초현금및현금성자산	57,856,378	53,705,579
분기말의 현금및현금성자산	90,800,375	53,399,483

3. 연결재무제표 주석

1. 일반적 사항 (연결)

가. 연결회사의 개요

삼성전자주식회사(이하 "회사")는 1969년 대한민국에서 설립되어 1975년에 대한민국의 증권거래소에 상장하였습니다. 회사 및 종속기업(이하 삼성전자주식회사와 그 종속기업을 일괄하여 "연결회사")의 사업은 DX 부문, DS 부문, SDC, Harman으로 구성되어 있습니다. DX(Device eXperience) 부문은 TV, 냉장고, 스마트폰, 네트워크시스템 등의 사업으로 구성되어 있으며, DS(Device Solutions) 부문은 메모리, Foundry, System LSI 등으로 구성되어 있습니다. SDC는 디스플레이 패널 사업을 영위하며, Harman은 전장부품사업 등을 영위하고 있습니다. 회사의 본점 소재지는 경기도 수원시입니다.

기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배회사인 회사는 삼성디스플레이㈜ 및 Samsung Electronics America, Inc. (SEA) 등 305개의 종속기업을 연결대상으로 하고, 삼성전기㈜ 등 35개 관계기업과 공동기업을 지분법적용대상으로 하여 연결재무제표를 작성하였습니다.

나. 종속기업 현황

당분기말 현재 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
미주	Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung International, Inc. (SII)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Mexicana S.A. de C.V (SAMEX)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Home Appliances America, LLC (SEHA)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Research America, Inc (SRA)	R&D	100.0
	SAMSUNG NEXT LLC (SNX)	해외자회사 관리	100.0
	SAMSUNG NEXT FUND LLC (SNXF)	신기술사업자, 벤처기업 투자	100.0
	Samsung HME America, Inc. (구, NeuroLogica Corp.)	의료기기 생산 및 판매	100.0
	Samsung Lennox HVAC North America, LLC	에어컨공조 판매	50.1
	Joyent, Inc.	클라우드서비스	100.0
	SmartThings, Inc.	스마트홈 플랫폼	100.0
	TeleWorld Solutions, Inc. (TWS)	네트워크장비 설치 및 최적화	100.0
	Xealth Inc.	디지털 헬스케어 플랫폼	100.0
	Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	반도체・디스플레이 패널 판매	100.0
	Samsung Federal, Inc. (SFI)	R&D	100.0
	Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS)	반도체 생산	100.0
	Samsung Oak Holdings, Inc. (SHI)	해외자회사 관리	100.0
	SEMES America, Inc.	반도체 장비 서비스	100.0
	Samsung Display America Holdings, Inc. (SDAH)	해외자회사 관리	100.0
	eMagin Corporation	디스플레이 패널 개발 및 생산	100.0
	Samsung Electronics Canada, Inc. (SECA)	전자제품 판매	100.0
	AdGear Technologies Inc.	디지털광고 플랫폼	100.0
	Sonio Corporation	소프트웨어 판매	100.0
	RAINBOW ROBOTICS USA Co., Ltd.	로봇 판매	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
미주	Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. (SEM)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Digital Appliance Mexico, SA de CV (SEDAM)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Latinoamerica(Zona Libre), S. A. (SELA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Latinoamerica Miami, Inc. (SEMI)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronica Colombia S.A. (SAMCOL)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Argentina S.A. (SEASA)	마케팅 및 서비스	100.0
	Samsung Electronics Chile Limitada (SECH)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Peru S.A.C. (SEPR)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Venezuela, C.A. (SEVEN)	마케팅 및 서비스	100.0

	Samsung Electronics Panama. S.A. (SEPA)	컨설팅	100.0
	SEMCO LLC	에어컨공조 생산 및 판매	100.0
	SEMCO Duct & Acoustical Products Inc	에어컨공조 생산 및 판매	100.0
	Woods Air Movement Ltd.	에어컨공조 생산 및 판매	100.0
	Harman International Industries, Inc.	해외자회사 관리	100.0
	Harman Becker Automotive Systems, Inc.	오디오제품 생산, 판매, R&D	100.0
	Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	오디오제품 생산, 판매	100.0
	Harman de Mexico, S. de R.L. de C.V.	오디오제품 생산	100.0
	Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman International Industries Canada Ltd.	오디오제품 판매	100.0
	Harman International Mexico, S. de R.L. de C.V.	오디오제품 판매	100.0
	Harman KG Holding, LLC	해외자회사 관리	100.0
	Harman Professional, Inc.	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Roon Labs, LLC.	오디오제품 판매	100.0
	Viper Holdings Corporation	해외자회사 관리	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
미주	DEI Holdings, Inc.	해외자회사 관리	100.0
	DEI Sales, Inc.	오디오제품 판매	100.0
	Sound United, LLC	오디오제품 판매	100.0
	Sound United Canada Inc.	오디오제품 판매	100.0
	Polk Audio, LLC	오디오제품 판매	100.0
	D&M Holdings U.S. Inc.	오디오제품 판매	100.0
	Boston Acoustics, Inc.	오디오제품 판매	100.0
	Denon Electronics (USA), LLC	오디오제품 판매	100.0
	Digital Networks North America Inc.	오디오제품 판매	100.0
	Definitive Technology, LLC	오디오제품 판매	100.0
	Equity International, LLC	오디오제품 판매	100.0
	Beijing Integrated Circuit Industry International Fund, L.P	벤처기업 투자	61.4
	China Materialia New Materials 2016 Limited Partnership	벤처기업 투자	99.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
유럽・CIS	Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Ltd. (SEL)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Semiconductor Europe Limited (SSEL)	반도체・디스플레이 패널 판매	100.0
	Samsung Electronics GmbH (SEG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Holding GmbH (SEHG)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Semiconductor Europe GmbH (SSEG)	반도체・디스플레이 패널 판매	100.0
	Samsung Electronics France S.A.S (SEF)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Italia S.P.A. (SEI)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Iberia, S.A. (SESA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Portuguesa, Unipessoal, Lda. (SEP)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd. (SEH)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS)	물류	100.0
	Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)	전자제품 판매	100.0

	Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Electronics Nordic Aktiebolag (SENA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Slovakia s.r.o (SESK)	TV・모니터 생산	100.0
	Samsung Electronics Polska, SP.Zo.o (SEPOL)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Poland Manufacturing SP.Zo.o (SEPM)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Romania LLC (SEROM)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Austria GmbH (SEAG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Switzerland GmbH (SESG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o. (SECZ)	전자제품 판매	100.0
	SAMSUNG ELECTRONICS BALTICS SIA (SEB)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Greece S.M.S.A (SEGR)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. (SEACE)	에어컨공조 판매	100.0
	Samsung Nanoradio Design Center (SNDC)	R&D	100.0
	Samsung Denmark Research Center ApS (SDRC)	R&D	100.0
	Samsung Cambridge Solution Centre Limited (SCSC)	R&D	100.0
	SAMSUNG Zhilabs, S.L.	네트워크Solution 개발, 판매	100.0
	FOODIENT LTD.	R&D	100.0
	Oxford Semantic Technologies Limited (OST)	R&D	100.0
	Sonio SAS	소프트웨어 판매, R&D	100.0
	Samsung Electronics Rus Company LLC (SERC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Rus Kaluga LLC (SERK)	TV 생산	100.0
	Samsung Electronics Ukraine Company LLC (SEUC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung R&D Institute Ukraine (SRUKR)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Central Eurasia LLP (SECE)	전자제품 판매	100.0
	Samsung R&D Institute Rus LLC (SRR)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Caucasus Co. Ltd (SECC)	마케팅	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
유럽・CIS	Samsung Electronics Uzbekistan Ltd. (SEUZ)	마케팅	100.0
	AKG Acoustics GmbH	오디오제품 생산, 판매	100.0
	Apostera UA, LLC	Connected Service Provider	100.0
	Harman Audio Iberia Espana Sociedad Limitada	오디오제품 판매	100.0
	Harman Becker Automotive Systems GmbH	오디오제품 생산, 판매, R&D	100.0
	Harman Becker Automotive Systems Italy S.R.L.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	오디오제품 생산, R&D	100.0
	Harman Belgium SA	오디오제품 판매	100.0
	Harman Finland Oy	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services GmbH	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services Poland Sp.zoo	Connected Service Provider	100.0
	Harman Consumer Nederland B.V.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Deutschland GmbH	오디오제품 판매	100.0
	Harman France SNC	오디오제품 판매	100.0
	Harman Holding GmbH & Co. KG	Management Company	100.0
	Harman Hungary Financing Ltd.	Financing Company	100.0
	Harman Inc. & Co. KG	해외자회사 관리	100.0
	Harman International Estonia OU	R&D	100.0
	Harman International Industries Limited	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman International Romania SRL	R&D	100.0

	Harman Management GmbH	해외자회사 관리	100.0
	Harman Professional Kft	오디오제품 생산, R&D	100.0
	Harman Professional Denmark ApS	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Red Bend Software SAS	소프트웨어 디자인	100.0
	Harman Connected Services OOO	Connected Service Provider	100.0
	Harman RUS CIS LLC	오디오제품 판매	100.0
	D&M Europe B.V	오디오제품 판매	100.0
	D&M Audiovisual Ltd	오디오제품 판매	100.0
	D&M France SAS	오디오제품 판매	100.0
	D&M Germany GmbH	오디오제품 판매	100.0
	B&W Group Ltd	오디오제품 생산	100.0
	B&W Group Belgium B.V	오디오제품 판매	100.0
	B&W Loudspeakers Nederland B.V	오디오제품 판매	100.0
	B&W Loudspeakers Group Espana S.A	오디오제품 판매	100.0
	B&W Loudspeakers Ltd	오디오제품 판매	100.0
	B&W Group (Schweiz) GmbH	오디오제품 판매	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
유럽・CIS	B&W Group Germany GmbH	오디오제품 판매	100.0
	B&W Group France SARL	오디오제품 판매	100.0
	Marantz Italy Srl	오디오제품 판매	51.0
	Bowers & Wilkins Ltd	오디오제품 판매	100.0
	FlaktGroup Austria GmbH	에어컨공조 판매	100.0
	Flakt Woods SA	에어컨공조 판매	100.0
	Flakt Elve NV	에어컨공조 판매	100.0
	FlaktGroup Belgium N. V.	에어컨공조 판매	100.0
	FlaktGroup CZ a. s.	에어컨공조 생산 및 판매	100.0
	FlaktGroup Holding GmbH	해외자회사 관리	100.0
	FlaktGroup Deutschland GmbH	에어컨공조 판매	100.0
	FlaktGroup Wurzen GmbH	에어컨공조 생산	100.0
	SE Electronic GmbH	에어컨공조 생산 및 판매	100.0
	Woods Air Movement GmbH	에어컨공조 판매	100.0
	FlaktGroup A/S	에어컨공조 판매	100.0
	FlaktGroup Eesti OU	에어컨공조 판매	100.0
	Ventilation Holding Finland OY	해외자회사 관리	100.0
	FlaktGroup Finland OY	에어컨공조 생산 및 판매	100.0
	FlaktGroup France SAS	에어컨공조 판매	100.0
	Woods Holdings Ltd.	해외자회사 관리	100.0
	Flakt Woods Ltd.	에어컨공조 생산 및 판매	100.0
	FlaktGroup UK Ltd.	에어컨공조 판매	100.0
	FlaktGroup Ireland Ltd.	에어컨공조 판매	100.0
	FlaktGroup Italy S. p. A.	에어컨공조 판매	100.0
	FlaktGroup Baltics UAB	에어컨공조 판매	100.0
	Flakt Woods (Luxembourg) S. a. r. l	해외자회사 관리	100.0
	Flakt Woods ACS S. a. r. l	해외자회사 관리	100.0
	FlaktGroup Latvija SIA	에어컨공조 판매	100.0
	FlaktGroup Netherlands B. V.	에어컨공조 판매	100.0
	FlaktGroup Poland Sp. Z. o. o.	에어컨공조 판매	100.0

	FlaktGroup Romania s. r. l	에어컨공조 판매	100.0
	Ventilation Holding Sweden AB	해외자회사 관리	100.0
	Fusilli HoldCo AB	해외자회사 관리	100.0
	FlaktGroup Sweden AB	에어컨공조 생산 및 판매	100.0
	Forvaltnings bolaget Ljungarum HB	해외자회사 관리	100.0
	Stromboli investissements SAS	해외자회사 관리	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
중동・아프리카	Samsung Gulf Electronics Co., Ltd. (SGE)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Turkiye (SETK)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Industry and Commerce Ltd. (SETK-P)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Levant Co., Ltd. (SELV)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Maghreb Arab (SEMAG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Egypt S.A.E (SEEG)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Israel Ltd. (SEIL)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Tunisia S.A.R.L (SETN)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Pakistan(Private) Ltd. (SEPAK)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Middle East and North Africa (SEMENA)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Electronics Saudi Arabia Ltd. (SESAR)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Semiconductor Israel R&D Center, Ltd. (SIRC)	R&D	100.0
	Corephotonics Ltd.	R&D	100.0
	Samsung Electronics South Africa(Pty) Ltd. (SSA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics South Africa Production (pty) Ltd. (SSAP)	TV・모니터 생산	100.0
	Samsung Electronics West Africa Ltd. (SEWA)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics East Africa Ltd. (SEEA)	마케팅	100.0
	FlaktWoods LLC	에어컨공조 판매	100.0
	FlaktGroup Havalandirma Sanayi A.S.	에어컨공조 생산 및 판매	100.0
	Harman Industries Holdings Mauritius Ltd.	해외자회사 관리	100.0
	Red Bend Ltd.	오디오제품 생산	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
아시아 (중국 제외)	Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Electronics Singapore Pte. Ltd. (SESP)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Malaysia Electronics (SME) Sdn. Bhd. (SME)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Display (M) Sdn. Bhd. (SDMA)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics (M) Sdn. Bhd. (SEMA)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Vina Electronics Co., Ltd. (SAVINA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	통신제품 생산	100.0
	Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV)	디스플레이 패널 생산	100.0
	PT Samsung Electronics Indonesia (SEIN)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	PT Samsung Telecommunications Indonesia (STIN)	전자제품 판매 및 서비스	100.0
	Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	전자제품 생산 및 판매	91.8
	Laos Samsung Electronics Sole Co., Ltd (LSE)	마케팅	100.0

	Samsung Electronics Philippines Corporation (SEPCO)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Australia Pty. Ltd. (SEAU)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics New Zealand Limited (SENZ)	전자제품 판매	100.0
	Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Red Brick Lane Marketing Solutions Pvt. Ltd.	마케팅	100.0
	Samsung Display Noida Private Limited (SDN)	디스플레이 패널 생산	100.0
	Samsung R&D Institute India-Bangalore Private Limited (SRI-Bangalore)	R&D	100.0
	Samsung R&D Institute BanglaDesh Limited (SRBD)	R&D	100.0
	Samsung Nepal Services Pvt, Ltd (SNSL)	서비스	100.0
	Samsung Japan Corporation (SJC)	반도체・디스플레이 패널 판매	100.0
	Samsung R&D Institute Japan Co. Ltd. (SRJ)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Japan Co., Ltd. (SEJ)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Semiconductor Asia Holdings Pte. Ltd. (SSAH)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Vietnam Semiconductor (SVS)	반도체 생산	100.0
	FlaktGroup India Private Ltd.	에어컨공조 생산 및 판매	100.0
	FlaktGroup Singapore Pte. Ltd.	에어컨공조 판매	100.0
	Harman International (India) Private Limited	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman International Industries PTY Ltd.	해외자회사 관리	100.0
	Harman International (Thailand) Co., Ltd.	오디오제품 생산, 판매	100.0
	Harman International Japan Co., Ltd.	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman Singapore Pte. Ltd.	오디오제품 판매	100.0
	D&M Holdings, Inc.	오디오제품 생산, 판매, R&D	100.0
	Sound United Australia Pty Ltd	R&D	100.0
	Sound United Sales & Marketing Australia Pty Limited	오디오제품 판매	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
중국	Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd. (SEHK)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd. (SET)	전자제품 판매	100.0
	Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd. (SSEC)	가전제품 생산	88.3
	Samsung Suzhou Electronics Export Co., Ltd. (SSEC-E)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd. (SESC)	R&D	100.0
	Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (TSTC)	통신제품 생산	90.0
	Beijing Samsung Telecom R&D Center (SRC-Beijing)	R&D	100.0
	Samsung Electronics China R&D Center (SRC-Nanjing)	R&D	100.0
	Samsung Mobile R&D Center China-Guangzhou (SRC-Guangzhou)	R&D	100.0
	Samsung R&D Institute China-Shenzhen (SRC-Shenzhen)	R&D	100.0
	Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	반도체・디스플레이 패널 판매	100.0
	Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)	반도체 생산	100.0
	Samsung SemiConductor Xian Co., Ltd. (SSCX)	반도체・디스플레이 패널 판매	100.0
	Samsung Electronics Suzhou Semiconductor Co., Ltd. (SESS)	반도체 임가공	100.0
	Tianjin Samsung LED Co., Ltd. (TSLED)	LED 생산	100.0
	Samsung Semiconductor (China) R&D Co., Ltd. (SSCR)	R&D	100.0
	Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDD)	디스플레이 패널 생산	100.0
	Samsung Display Tianjin Co., Ltd. (SDT)	디스플레이 패널 생산	95.0

	SEMES (XIAN) Co., Ltd.	반도체・FPD 장비 서비스	100.0
	Samsung Semiconductor Investment L.P. I	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	Harman (China) Technologies Co., Ltd.	오디오제품 생산	100.0
	Harman (Suzhou) Audio and Infotainment Systems Co., Ltd.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd.	오디오제품 생산, R&D	100.0
	Harman Commercial (Shanghai) Co., Ltd.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Holding Limited	오디오제품 판매	100.0
	Harman International (China) Holdings Co., Ltd.	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman Technology (Shenzhen) Co., Ltd.	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Sound United Hong Kong Limited	해외자회사 관리	100.0
	Sound Electronics (Shenzhen) Co. Ltd.	R&D	100.0
	D&M Sales & Marketing (H.K) Ltd.	오디오제품 판매	100.0
	D&M Digital Audio Trading (Shanghai) Ltd.	해외자회사 관리	100.0
	Marantz Shanghai Trading Ltd.	해외자회사 관리	100.0
	D&M Shanghai Electronics Ltd.	오디오제품 판매	100.0
	D&M Sales & Marketing Taiwan Ltd.	오디오제품 판매	100.0
	Bowers & Wilkins Trading Zhuhai Company Ltd.	오디오제품 생산	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
국내	삼성디스플레이㈜	디스플레이 패널 생산 및 판매	89.2
	에스유머티리얼스㈜	디스플레이 패널 부품 생산	50.0
	스테코㈜	반도체 부품 생산	70.0
	세메스㈜	반도체・FPD 장비 생산, 판매	91.5
	삼성전자서비스㈜	전자제품 수리 서비스	99.3
	삼성전자서비스씨에스㈜	고객상담서비스	100.0
	삼성전자판매㈜	전자제품 판매	100.0
	삼성전자로지텍㈜	종합물류대행	100.0
	삼성메디슨㈜	의료기기 생산 및 판매	68.5
	㈜희망별숲	식품 제조 가공	100.0
	㈜미래로시스템	반도체 소프트웨어 개발 및 공급	99.9
	㈜하만인터내셔널코리아	소프트웨어 개발 및 공급	100.0
	㈜레인보우로보틱스	로봇・로봇 부품 생산, 판매	35.0
	디앤엠세일즈앤마케팅코리아㈜	오디오제품 판매	100.0
	플랙트그룹코리아㈜	에어컨공조 생산 및 판매	100.0
	SVIC 21호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 22호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 26호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 28호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 32호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 33호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 42호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 43호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 45호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 52호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 55호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 56호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 57호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 62호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0

	SVIC 67호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 74호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 76호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	73.3
	SVIC 78호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 82호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	반도체성장 전문투자형 사모 투자신탁	반도체산업 투자	66.7
	시스템반도체 상생 전문투자형 사모 투자신탁	반도체산업 투자	62.5
	반도체 생태계 일반 사모 투자신탁	반도체산업 투자	66.7

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

다. 당분기 및 전기의 주요 연결대상 종속기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.

(1) 당분기

(단위 : 백만원)

기업명(*1)	당분기말		당분기			
	자산	부채	3개월		누 적	
			매출액	분기순이익	매출액	분기순이익
Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	103,425,464	94,861,987	81,067,186	367,466	184,906,570	449,054
Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	100,888,984	67,976,377	10,934,943	468,449	31,764,376	1,760,532
삼성디스플레이㈜	79,057,351	8,487,863	6,662,837	(647,813)	19,116,830	2,345,329
Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	38,795,345	238,848	-	4,840,397	-	5,546,867
Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS)	38,319,098	27,643,891	833,548	(1,467)	2,698,365	(7,108)
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	35,395,663	34,463,254	426,527	(54,403)	1,370,064	(105,577)
Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	30,348,058	28,696,494	31,151,743	469,338	83,795,061	1,217,622
Harman과 그 종속기업(*2)	22,438,246	6,627,354	4,332,247	607,825	12,703,454	1,023,213
Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)	16,614,275	1,058,133	2,321,668	238,078	7,264,245	835,195
Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	15,048,119	6,054,548	14,135,724	752,632	38,142,252	2,353,471
Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL)	11,505,413	4,357,842	5,739,756	71,795	16,001,809	661,124
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH)	9,756,860	3,983,353	-	12,987	-	(39,514)
Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV)	9,032,146	3,873,977	8,698,526	536,188	22,258,899	1,537,652
Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV)	8,544,577	2,700,063	5,795,191	160,792	16,314,269	751,120
Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	5,463,737	2,680,005	1,628,693	(306,441)	5,859,475	(449,541)
Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC)	5,223,953	955,194	2,517,764	188,551	6,681,329	424,192
Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd. (SET)	5,047,712	4,659,114	6,830,811	37,372	16,879,954	88,122
Samsung Japan Corporation (SJC)	4,948,755	4,499,475	3,587,797	5,281	7,684,876	(1,355)

Samsung SemiConductor Xian Co., Ltd. (SSCX)	4,241,423	3,980,261	4,253,844	33,019	11,139,435	93,312
Samsung Semiconductor Europe GmbH (SSEG)	3,503,674	3,473,137	4,006,239	(2,089)	8,942,773	21,556
Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	3,332,916	2,225,591	1,654,234	(39,860)	4,911,206	44,409
Samsung International, Inc. (SII)	2,997,286	817,304	1,957,471	67,425	5,321,655	331,610
세메스㈜	2,905,210	779,383	803,996	99,889	2,133,737	258,842
Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. (SEM)	2,686,637	1,193,713	1,227,492	51,252	3,894,799	133,326
Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS)	2,670,261	2,058,335	4,043,081	19,514	12,612,249	423,619

(*1) 상기 요약 재무정보는 각 종속기업의 별도재무제표 기준입니다.

(*2) Harman International Industries, Inc. 및 그 종속기업이 포함된 중간지배기업의 연결재무정보입니다.

(2) 전기

(단위 : 백만원)

기업명(*1)	전기말		전분기			
	자산	부채	3개월		누 적	
			매출액	분기순이익	매출액	분기순이익
삼성디스플레이㈜	76,710,079	8,779,728	7,100,773	1,614,941	17,421,583	3,933,433
Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	52,966,362	20,138,323	10,788,733	179,871	31,145,709	1,119,688
Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	35,742,415	350,888	-	345,406	-	4,924,384
Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS)	29,787,509	18,505,380	768,315	1,874,372	3,065,125	2,298,265
Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	27,146,631	18,644,812	15,149,414	124,996	37,869,874	298,493
Harman과 그 종속기업(*2)	22,395,744	6,618,051	3,942,196	185,915	11,166,779	798,213
Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)	16,042,066	1,114,773	2,225,019	168,781	6,639,592	702,336
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	14,604,846	13,562,847	756,013	1,695	2,133,542	(14,092)
Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	14,049,410	4,454,771	9,366,682	800,658	29,043,687	2,001,116
Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL)	10,369,065	2,967,992	4,919,662	570,025	14,490,919	1,356,650
Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	9,474,930	8,969,730	8,267,104	117,342	20,612,820	311,213
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH)	9,351,798	2,995,765	-	34,855	-	150,285
Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV)	7,996,205	2,551,991	5,673,131	205,749	13,602,681	607,978
Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV)	7,975,597	2,450,249	7,167,695	606,976	18,922,604	1,420,288
Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC)	5,263,351	886,695	1,772,871	82,853	5,783,065	339,969
Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	4,815,175	1,617,379	1,648,921	(144,509)	5,335,466	(225,849)
Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	3,174,054	2,025,539	1,631,978	(67,520)	4,863,771	61,682
Samsung International, Inc. (SII)	2,658,926	683,405	2,113,026	53,239	5,601,956	176,737
세메스㈜	2,637,216	768,123	567,950	53,866	1,667,688	131,481
Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	2,324,358	621,508	1,183,562	(15,783)	3,926,331	141,828

Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. (SEM)	2,267,579	813,376	1,012,972	(21,004)	3,321,907	122,037
Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd. (SET)	2,115,046	1,784,638	1,905,337	24,060	5,195,247	42,343
Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS)	2,072,011	1,816,197	4,164,723	213,097	12,846,933	454,030
Samsung Japan Corporation (SJC)	1,967,890	1,619,589	1,119,516	8,304	2,800,527	18,066
Samsung Electronics GmbH (SEG)	1,855,724	1,779,446	1,504,632	(40,721)	4,800,211	(38,932)

(*1) 상기 요약 재무정보는 각 종속기업의 별도재무제표 기준입니다.

(*2) Harman International Industries, Inc. 및 그 종속기업이 포함된 중간지배기업의 연결재무정보입니다.

라. 연결대상범위의 변동

당분기 중 연결재무제표 작성대상범위의 변동 내용은 다음과 같습니다.

구분	지역	기업명	사유
신규연결	아시아 (중국제외)	Samsung Semiconductor Asia Holdings Pte. Ltd. (SSAH)	설립
		Samsung Vietnam Semiconductor (SVS)	설립
	국내	SVIC 78호 신기술투자조합	설립
		플랙트그룹코리아㈜	설립
		SVIC 82호 신기술투자조합	설립
연결제외	유럽・CIS	B&W Group Finland Oy	청산
		B&W Group (Logistics) Ltd	청산
		FlaktGroup Switzerland SA	청산
	미주	D&M Premium Sound Solutions, LLC	합병
		Marantz America, LLC	합병
		D&M Sales & Marketing Americas, LLC	합병
		The Speaker Company	합병
	중국	B&W Group Asia Limited	청산

2. 중요한 회계처리방침 (연결)

2.1. 재무제표 작성기준

연결회사의 2026년 9월 30일로 종료하는 9개월 보고기간에 대한 분기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 분기연결재무제표는 보고기간종료일인 2026년 9월 30일 현재 유효한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

가. 연결회사가 채택한 제・개정 기준서

연결회사는 2026년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 주요 제・개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.

- 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정

실무에서 제기된 의문에 대응하고 새로운 요구사항을 포함하기 위해 기업회계기준서제1109호 '금융상품'과 제1107호 '금융상품: 공시'가 개정되었습니다. 주요 개정사항은 다음과 같으며 해당 기준서

의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

・ 특정 기준을 충족하는 경우, 결제일 전에 전자지급시스템을 통해 금융부채가 결제된 것으로(제거된 것으로) 간주할 수 있도록 허용
・ 금융자산이 원리금 지급만으로 구성되어 있는지의 기준을 충족하는지 평가하기 위한 지침을 명확히 하고 추가
・ 계약상 현금흐름의 시기나 금액을 변경시키는 계약조건이 기업에 미치는 영향과 기업이 노출되는 정도를 금융상품의 각 종류별로 공시
・ 기타포괄손익-공정가치금융자산(지분상품)에 대한 추가 공시

나. 연결회사가 적용하지 않은 제・개정 기준서

제정 또는 공표됐으나 2026년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 않았고, 연결회사가 조기 적용하지 않은 주요 제・개정 기준서는 다음과 같습니다.

- 기업회계기준서 제1118호 '재무제표 표시와 공시' 제정

기업회계기준서 제1118호 '재무제표 표시와 공시'는 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시'를 대체합니다. 이 기준서는 2027년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용하며 조기 적용을 허용하나, 연결회사는 분기연결재무제표 작성 시
새로운 기준서를 조기 적용하지 않았습니다.

기업회계기준서 제1118호는 보다 구조화된 손익계산서와 정보의 세분화를 요구합니다. 연결회사는 기업회계기준서 제1118호의 도입이 연결재무제표에 미칠 것으로 예상되는 영향을 분석 중에 있습니다.

최초 적용기간의 예상되는 영향은 아래에 기술되어 있으며, 2027년 1월 1일에 새로운 기준서를 적용함에 따른 실제 영향은 다음의 사유로 달라질 수 있습니다.

・ 연결회사는 절차와 통제의 변경에 대한 설계와 평가를 완료하지 않았고,
・ 이 기준서에 따라 작성되는 최초의 연차재무제표를 발행할 때까지 새로운 회계정책은 변경될 수 있습니다.

[손익계산서의 구조]

기업회계기준서 제1118호는 모든 수익과 비용을 영업 범주, 투자 범주, 재무 범주, 법인세 범주, 중단영업 범주라는 다섯 가지 범주 중 하나로 분류하도록 요구합니다. 수익과 비용의 범주별 분류는 기업의 주된 사업활동에 따라 달라집니다. 연결회사는 자산 투자 또는 고객에게 금융을 제공하는 것과 같은 특정한 사업활동을 주된 사업활동으로 평가하지 않았습니다.

기업회계기준서 제1118호의 적용으로 연결회사의 당기순이익이나 순자산은 변경되지 않을 것입니다. 그러나 연결회사는 새롭게 정의된 두 개의 중간합계인 '영업이익'과 '재무손익및법인세비용차감전손익'을 표시해야 하며, 영업이익 중간합계는 현재 연결회사가 표시하는 영업이익과는 다릅니다. 연결회사는 현재 입수 가능한 정보에 기초하여 기업회계기준서 제1118호의 적용 영향에 대한 전반적인 예비 평가를 수행하였으며, 그 결과 다음과 같은 잠재적 영향이 식별되었습니다.

• 지분법손익은 현재 분기연결손익계산서에 '영업이익' 아래, '금융수익' 및 '금융비용' 위에 표시하고 있습니다. 지분법을 적용하여 회계처리하는 투자자산에서 발생하는 수익과 비용은 기업회계기준서 제1118호에 따라 항상 투자 범주로 분류됩니다. 따라서 연결회사의 지분법손익은 투자 범주로 분류하여 표시될 예정입니다.

• 이자수익과 이자비용은 연결회사의 현재 회계정책에 따라 일반적으로 금융수익과 금융비용으로 표시하고 있습니다. 기업회계기준서 제1118호는 투자 범주와 재무 범주로 분류되는 수익과 비용에 대한 구체적인 지침을 제공하며, 기업회계기준서 제1118호에 따라

- 연결회사가 보유한 특정 금융자산에서 발생하는 이자수익(예: 현금및현금성자산에서 발생하는 이자수익)은 투자 범주로 분류하여 표시될 예정입니다.

- 특정 부채에서 발생하는 이자비용(당기손익-공정가치로 측정하지 않는 금융부채에서 발생하는 이자비용)은 재무 범주로 분류하여 표시될 예정입니다.

• 현재 외환거래 및 환산으로 인해 발생한 외환차이는 금융수익 및 금융비용으로 표시되고 있습니다. 기업회계기준서 제1118호에 따르면 외환차이는 해당 외환차이를 발생시킨 항목에서 발생하는 수익과 비용이 해당되는 범주와 동일한 범주로 분류해야 합니다. 연결회사는 외환차이가 영업, 투자 및 재무 범주로 분류될 수 있다고 판단하였습니다. 예를 들면, 매입채무에 대한 외환차이는 영업 범주로 분류될 것입니다.

• 현금흐름위험회피수단으로 지정된 금융상품에서 발생하는 손익 중 효과적인 위험회피 부분은 기타포괄손익으로 인식하고 있으며, 위험회피에 효과적이지 않은 부분은 당기손익으로 인식하여 금융수익 및 금융비용으로 표시하고 있습니다. 기업회계기준서 제1118호에 따라 당기손익으로 인식되는 위험회피수단 관련 손익은 해당 금융상품을 사용하여 관리하고자 하는 위험의 영향을 받는 수익 또는 비용이 분류되는 범주와 동일한 범주로 분류해야 합니다.

기업회계기준서 제1118호에서 영업비용은 성격별, 기능별 또는 혼합 표시 방식을 사용하여 별도 표시항목으로 분류하고 표시합니다. 연결회사는 혼합 표시 방식을 사용하는 것이 영업비용의 가장 유용한 구조화된 요약 정보를 제공할 것으로 판단하였습니다.

[경영진이 정의한 성과측정치(MPM)]

경영진이 정의한 성과측정치(MPM)는 연결재무제표와 구분하여 공개적인 의사소통에 사용되는 수익과 비용의 중간합계로 기업 전체의 재무성과 측면에 대한 경영진의 견해를 재무제표 이용자에게 전달합니다. 연결회사는 MPM에 관한 구체적인 정보를 연결재무제표에서 하나의 주석으로 공시해야 합니다.

연결회사는 MPM을 식별할 때 관련성이 있는 공개적인 의사소통이 무엇인지 결정하기 위한 프로세스를 개발하였습니다. MPM은 연결재무제표와 동일한 보고기간과 관련되어 있습니다. 따라서 연결회사가 기업회계기준서 제1118호를 채택한 이후 공시할 MPM은 2027년 중간 보고기간과 관련하여 연결회사가 발표하는 공개적인 의사소통을 기초로 결정될 예정입니다.

[통합과 세분화의 원칙]

기업회계기준서 제1118호는 연결재무제표(즉, 주요 연결재무제표와 주석)에서 정보를 유형별로 구

분하여 표시하는 방법에 대해 강화된 원칙을 제공합니다. 또한 주요 연결재무제표에 표시되거나 주석에 공시되는 항목에 명칭을 부여하고 설명하는 방식에 대한 지침도 도입했습니다.

연결회사는 유사하거나 다른 특성을 기준으로 항목들을 통합하고 세분화하기 위해 평가하고 있습니다. 이 평가를 바탕으로 주요 연결재무제표에는 유용한 구조화된 요약 정보를 제공하는 항목들을 표시하고, 주석에는 추가적인 중요한 정보를 공시할 예정입니다.

또한, 연결회사는 현재 '기타'로 표시된 항목들을 검토하고 있으며 향후 더욱 유용한 명칭을 사용할 예정입니다.

[타기준서 개정]

기업회계기준서 제1118호의 제정으로 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표' 기준서가 개정되었습니다. 간접법으로 영업활동 현금흐름을 표시할 때, 새롭게 정의된 '영업이익' 중간합계를 간접법의 출발점으로 사용해야 합니다. 연결회사는 현재 영업활동 현금흐름의 출발점으로 '당기순이익'을 사용하고 있습니다.

이에 따라 간접법의 출발점에 대한 조정항목 중 일부가 변경될 것입니다. 예를 들어, 지분법적용대상 기업의 이익(손실) 중 연결회사의 지분 상당액은 출발점인 영업이익에 포함되지 않으므로 더 이상 조정 항목이 아닙니다. 이러한 지분법적용대상 기업으로부터 수취한 현금 배당금은 투자활동 현금흐름에 포함됩니다.

또한 기업회계기준서 제1007호 개정사항은 이자 및 배당 현금흐름의 분류에 관한 구체적인 지침을 제공합니다. 연결회사는 이 지침에 따라 이자의 수취 및 배당금 수입에 따른 현금흐름을 영업활동이 아닌 투자활동으로, 이자의 지급에 따른 현금흐름을 영업활동이 아닌 재무활동으로 분류할 예정입니다. 배당금의 지급은 기존과 동일하게 재무활동으로 분류됩니다.

2.2. 회계정책

분기연결재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책과 계산방법은 주석 2.1에서 설명하는 제・개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 2025년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해 글로벌최저한세를 고려하여 추정한 가중평균연간 법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

2.3. 중요한 회계추정 및 가정

분기연결재무제표 작성시 연결회사의 경영진은 회계정책의 적용과 보고되는 자산・부채의 장부금액 및 이익・비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.

분기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 2025년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

3. 범주별 금융상품 (연결)

금융자산의 범주별 공시

당분기말 (단위 : 백만원)

		상각후원가 측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	당기손익-공정가치 측정 금융자산	기타금융자산	금융자산의 범주 합계
금융자산 합계		381,865,129	24,648,280	1,892,283	39,556	408,445,248
금융자산 합계	현금및현금성자산	90,800,375	0	0	0	90,800,375
	단기금융상품	123,973,901	0	0	0	123,973,901
	단기당기손익-공정가치금융자산	0	0	48,606	0	48,606
	매출채권	106,097,351	0	0	0	106,097,351
	기타포괄손익-공정가치금융자산	0	24,648,280	0	0	24,648,280
	당기손익-공정가치금융자산	0	0	1,570,889	0	1,570,889
	기타금융자산	60,993,502	0	272,788	39,556	61,305,846

전기말 (단위 : 백만원)

		상각후원가 측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	당기손익-공정가치 측정 금융자산	기타금융자산	금융자산의 범주 합계
금융자산 합계		197,410,443	16,295,005	1,433,732	46,503	215,185,683
금융자산 합계	현금및현금성자산	57,856,378	0	0	0	57,856,378
	단기금융상품	67,965,021	0	0	0	67,965,021
	단기당기손익-공정가치금융자산	0	0	25,715	0	25,715
	매출채권	51,127,642	0	0	0	51,127,642
	기타포괄손익-공정가치금융자산	0	16,295,005	0	0	16,295,005
	당기손익-공정가치금융자산	0	0	1,280,501	0	1,280,501
	기타금융자산	20,461,402	0	127,516	46,503	20,635,421

당기 및 전기 기타금융자산에 대한 각주

기타금융자산은 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

금융부채의 범주별 공시

당분기말 (단위 : 백만원)

		상각후원가 측정 금융부채	당기손익-공정가치 측정금융부채	기타금융부채	금융부채의 범주 합계
금융부채 합계		79,949,453	316,934	12,459,660	92,726,047
금융부채 합계	매입채무	16,647,408	0	0	16,647,408
	단기차입금	635,923	0	7,946,307	8,582,230
	미지급금	31,392,220	0	0	31,392,220
	유동성장기부채	9,230	0	1,058,176	1,067,406
	사채	6,768	0	0	6,768
	장기차입금	4,100,696	0	3,434,133	7,534,829
	장기미지급금	3,217,465	0	0	3,217,465
	기타금융부채	23,939,743	316,934	21,044	24,277,721

전기말 (단위 : 백만원)

		상각후원가 측정 금융부채	당기손익-공정가치 측정금융부채	기타금융부채	금융부채의 범주 합계
금융부채 합계		55,079,566	52,293	22,308,662	77,440,521
금융부채 합계	매입채무	13,039,380	0	0	13,039,380
	단기차입금	163,310	0	17,411,670	17,574,980
	미지급금	19,913,847	0	0	19,913,847
	유동성장기부채	9,070	0	1,168,438	1,177,508
	사채	7,134	0	0	7,134
	장기차입금	2,806,481	0	3,673,036	6,479,517
	장기미지급금	4,861,818	0	0	4,861,818
	기타금융부채	14,278,526	52,293	55,518	14,386,337

당기 및 전기 기타금융부채에 대한 각주

기타금융부채는 담보부차입금과 위험회피수단인 파생상품, 기업회계기준서 제1109호의 금융부채의 범주로 분류되지 않는 리스부채 등을 포함하고 있습니다.

4. 공정가치금융자산 (연결)

기타포괄손익-공정가치 측정 항목으로 지정된 지분상품 투자의 공정가치에 대한 공시

당분기말 (단위 : 백만원)

	금융자산의 범주
	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
	지분상품
금융자산	24,648,280

전기말 (단위 : 백만원)

	금융자산의 범주
	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
	지분상품
금융자산	16,295,005

당기손익-공정가치측정금융자산의 공시

당분기말 (단위 : 백만원)

	금융자산의 범주		금융자산의 범주 합계
	당기손익인식금융자산		
	채무상품	지분상품	
유동 당기손익-공정가치금융자산	48,606		48,606
비유동 당기손익-공정가치금융자산	775,985	794,904	1,570,889

전기말 (단위 : 백만원)

	금융자산의 범주		금융자산의 범주 합계
	당기손익인식금융자산		
	채무상품	지분상품	
유동 당기손익-공정가치금융자산	25,715		25,715
비유동 당기손익-공정가치금융자산	689,033	591,468	1,280,501

당기손익-공정가치측정금융자산의 공시, 합계

당분기말 (단위 : 백만원)

	금융자산의 범주
	당기손익인식금융자산
	채무상품 및 지분상품
금융자산	1,619,495

전기말 (단위 : 백만원)

	금융자산의 범주
	당기손익인식금융자산
	채무상품 및 지분상품
금융자산	1,306,216

공정가치금융자산 중 상장주식 세부내역에 대한 공시

당분기말 (단위 : 백만원)

	측정																	
	취득원가									공정가치								
	금융자산의 종류								금융자산의 종류 합계	금융자산의 종류								금융자산의 종류 합계
	공정가치로 측정하는 금융자산									공정가치로 측정하는 금융자산								
	상장주식									상장주식								
	삼성중공업㈜	㈜호텔신라	㈜아이마켓코리아	㈜원익홀딩스	㈜원익아이피에스	Wacom Co., Ltd.	Corning Incorporated	기타		삼성중공업㈜	㈜호텔신라	㈜아이마켓코리아	㈜원익홀딩스	㈜원익아이피에스	Wacom Co., Ltd.	Corning Incorporated	기타	
금융자산	932,158	13,957	324	30,821	32,428	23,933	3,383,540	612,578	5,029,739	2,640,337	78,886	5,276	92,884	486,796	62,343	14,202,996	1,553,048	19,122,566

전기말 (단위 : 백만원)

	측정																	
	취득원가									공정가치								
	금융자산의 종류								금융자산의 종류 합계	금융자산의 종류								금융자산의 종류 합계
	공정가치로 측정하는 금융자산									공정가치로 측정하는 금융자산								
	상장주식									상장주식								
	삼성중공업㈜	㈜호텔신라	㈜아이마켓코리아	㈜원익홀딩스	㈜원익아이피에스	Wacom Co., Ltd.	Corning Incorporated	기타		삼성중공업㈜	㈜호텔신라	㈜아이마켓코리아	㈜원익홀딩스	㈜원익아이피에스	Wacom Co., Ltd.	Corning Incorporated	기타	
금융자산										3,230,057	89,410	5,101	171,343	251,357	62,347	8,543,509	999,612	13,352,736

공정가치금융자산 중 상장주식의 보유주식수 및 지분율에 대한 공시

	금융자산의 종류

	공정가치로 측정하는 금융자산						
	상장주식						
	삼성중공업㈜	㈜호텔신라	㈜아이마켓코리아	㈜원익홀딩스	㈜원익아이피에스	Wacom Co., Ltd.	Corning Incorporated
보유주식수(단위: 주)	134,027,281	2,004,717	647,320	3,518,342	3,701,872	8,398,400	68,000,000
보유지분율	0.152	0.051	0.019	0.046	0.075	0.062	0.079
지분율에 대한 설명	총발행보통주식수 기준 지분율입니다.	총발행보통주식수 기준 지분율입니다.	총발행보통주식수 기준 지분율입니다.	총발행보통주식수 기준 지분율입니다.	총발행보통주식수 기준 지분율입니다.	총발행보통주식수 기준 지분율입니다.	총발행보통주식수 기준 지분율입니다.

5. 재고자산 (연결)

재고자산 세부내역

당분기말 (단위 : 백만원)

		평가전금액	재고자산 평가충당금	장부금액 합계
재고자산		77,370,260	(5,375,089)	71,995,171
재고자산	제품 및 상품	17,034,744	(1,183,712)	15,851,032
	반제품 및 재공품	36,324,587	(2,745,945)	33,578,642
	원재료 및 저장품	22,524,936	(1,445,432)	21,079,504
	미착품	1,485,993	0	1,485,993

전기말 (단위 : 백만원)

		평가전금액	재고자산 평가충당금	장부금액 합계
재고자산		58,478,593	(5,841,765)	52,636,828
재고자산	제품 및 상품	13,982,644	(1,703,543)	12,279,101
	반제품 및 재공품	26,775,342	(2,998,412)	23,776,930
	원재료 및 저장품	16,411,422	(1,139,810)	15,271,612
	미착품	1,309,185	0	1,309,185

6. 관계기업 및 공동기업 투자 (연결)

가. 당분기 및 전분기 중 관계기업 및 공동기업 투자의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전분기
기초	13,772,121	12,592,117
취득	-	388,764
처분	(18,782)	(4,123)
이익 중 지분해당액	841,959	558,359
기타(*)	(618,583)	(238,281)
분기말	13,976,715	13,296,836

(*) 기타는 배당, 손상, 계정재분류 등으로 구성되어 있습니다.

나. 보고기간종료일 현재 주요 관계기업 및 공동기업 투자 현황은 다음과 같습니다.

(1) 관계기업 투자

기업명	관계의 성격	지분율(%)(*1)	주사업장	결산월
삼성전기㈜(*2)	수동소자, 회로부품, 모듈 등 전자부품의 생산 및 공급	23.7	한국	12월
삼성에스디에스㈜	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합・관리 등 IT 서비스 및 물류서비스 제공	22.6	한국	12월
삼성바이오로직스㈜(*3)	신사업 투자	31.2	한국	12월
삼성에피스홀딩스㈜(*3)	신사업 투자	31.2	한국	12월
삼성SDI㈜(*4)	2차전지 등 전자부품의 생산 및 공급	19.4	한국	12월
㈜제일기획(*5)	광고 대행업	25.2	한국	12월

(*1) 총발행보통주식수 기준 지분율입니다.

(*2) 유통보통주식수 기준 지분율은 24.3%입니다.

(*3) 유통보통주식수 기준 지분율은 31.3%입니다.

(*4) 유통보통주식수 기준 지분율은 20.3%입니다.

(*5) 유통보통주식수 기준 지분율은 28.7%입니다.

(2) 공동기업 투자

기업명	관계의 성격	지분율(%)(*)	주사업장	결산월
삼성코닝어드밴스드글라스(유)	기타 산업용 유리제품 생산 및 공급	50.0	한국	12월

(*) 총발행보통주식수 기준 지분율입니다.

다. 보고기간종료일 현재 관계기업 및 공동기업 투자 내역은 다음과 같습니다.

(1) 관계기업 투자

(단위 : 백만원)

기 업 명	당분기말			전기말		
	취득원가	순자산가액(*)	장부금액	취득원가	순자산가액(*)	장부금액
삼성전기㈜	359,237	2,403,589	2,404,942	359,237	2,234,671	2,249,353
삼성에스디에스㈜	147,963	2,274,262	2,288,934	147,963	2,239,882	2,253,776
삼성바이오로직스㈜	1,410,104	2,715,417	3,895,527	1,410,104	2,328,487	3,509,028
삼성에피스홀딩스㈜	185,788	1,933,626	743,789	185,788	1,810,442	671,358
삼성SDI㈜	1,614,403	4,561,323	2,669,079	1,614,403	4,268,204	3,003,653
㈜제일기획	506,162	434,852	735,356	506,162	450,813	752,070
기타	608,356	809,486	1,009,668	627,138	936,015	1,089,589
계	4,832,013	15,132,555	13,747,295	4,850,795	14,268,514	13,528,827

(*) 순자산가액은 지분해당액 기준입니다.

(2) 공동기업 투자

(단위 : 백만원)

기 업 명	당분기말			전기말		
	취득원가	순자산가액(*)	장부금액	취득원가	순자산가액(*)	장부금액
삼성코닝어드밴스드글라스(유)	215,000	150,835	150,815	215,000	148,065	148,044
기타	259,994	78,167	78,605	259,994	85,408	95,250
계	474,994	229,002	229,420	474,994	233,473	243,294

(*) 순자산가액은 지분해당액 기준입니다.

라. 당분기 및 전분기 중 지분법평가 내역은 다음과 같습니다.

(1) 당분기

(단위 : 백만원)

기 업 명	기초	지분법평가 내역			분기말
		지분법손익	지분법자본변동	기타증감액(*)	
삼성전기㈜	2,249,353	239,222	(42,054)	(41,579)	2,404,942
삼성에스디에스㈜	2,253,776	101,966	(11,072)	(55,736)	2,288,934
삼성바이오로직스㈜	3,509,028	402,992	(16,493)	-	3,895,527
삼성에피스홀딩스㈜	671,358	75,483	(3,052)	-	743,789
삼성SDI㈜	3,003,653	26,132	(360,706)	-	2,669,079
㈜제일기획	752,070	39,142	(20,139)	(35,717)	735,356
삼성코닝어드밴스드글라스(유)	148,044	2,771	-	-	150,815
기타	1,184,839	(45,749)	(60,711)	9,894	1,088,273
계	13,772,121	841,959	(514,227)	(123,138)	13,976,715

(*) 기타증감액은 취득, 처분, 배당 등으로 구성되어 있습니다.

(2) 전분기

(단위 : 백만원)

기 업 명	기초	지분법평가 내역			분기말
		지분법손익	지분법자본변동	기타증감액(*)	
삼성전기㈜	2,067,669	118,651	11,226	(31,848)	2,165,698
삼성에스디에스㈜	2,120,417	131,649	(10,319)	(50,669)	2,191,078
삼성바이오로직스㈜	3,406,062	400,271	91	-	3,806,424
삼성SDI㈜	2,923,991	(160,241)	(13,138)	358,336	3,108,948
㈜제일기획	718,561	41,249	320	(35,717)	724,413
삼성코닝어드밴스드글라스(유)	143,178	3,628	-	-	146,806
기타	1,212,239	23,152	12,290	(94,212)	1,153,469
계	12,592,117	558,359	470	145,890	13,296,836

(*) 기타증감액은 취득, 처분, 배당 등으로 구성되어 있습니다.

마. 주요 관계기업 및 공동기업 투자의 요약 재무정보 등은 다음과 같습니다.

(1) 주요 관계기업

(단위 : 백만원)

구 분	당분기					
	삼성전기㈜	삼성에스디에스㈜	삼성바이오로직스㈜	삼성에피스홀딩스㈜	삼성SDI㈜	㈜제일기획
Ⅰ. 요약 재무정보(연결재무제표 기준)						
요약 재무상태표:						
유동자산	9,010,516	10,696,882	5,444,469	2,596,287	11,249,797	2,520,387
비유동자산	8,153,666	4,053,389	7,225,681	5,608,215	30,326,617	650,772
유동부채	5,243,310	2,450,376	2,695,163	1,855,319	9,796,181	1,302,363
비유동부채	1,403,999	1,899,023	1,285,710	166,216	6,855,020	335,229
비지배지분	253,851	332,565	-	-	2,009,749	16,895
요약 포괄손익계산서:						
매출	10,429,596	10,843,205	4,068,355	1,287,701	12,218,884	3,131,125
계속영업손익(*)	1,032,995	447,962	1,291,002	281,529	608,661	136,519
세후중단영업손익(*)	245	-	-	-	-	-
기타포괄손익(*)	(180,251)	(192,566)	(52,835)	(7,440)	279,629	(67,183)

총포괄손익(*)	852,989	255,396	1,238,167	274,089	888,290	69,336
Ⅱ. 배당						
배당	41,579	55,736	-	-	-	35,717

(*) 지배기업의 소유주에 귀속될 손익입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	전기					
	삼성전기㈜	삼성에스디에스㈜	삼성바이오로직스㈜	삼성에피스홀딩스㈜	삼성SDI㈜	㈜제일기획
Ⅰ. 요약 재무정보(연결재무제표 기준)						
요약 재무상태표(전기말):						
유동자산	7,097,623	9,405,729	4,408,367	1,880,001	8,739,929	2,880,955
비유동자산	7,498,273	4,047,975	6,652,375	5,835,583	33,515,410	706,862
유동부채	3,819,497	2,331,827	2,532,917	1,401,268	9,794,853	1,627,926
비유동부채	979,054	858,977	1,076,714	525,244	8,890,373	371,841
비지배지분	255,582	346,793	-	-	2,127,239	15,708
요약 포괄손익계산서(전분기):						
매출	8,412,314	10,393,066	4,248,399	-	9,408,044	3,347,174
계속영업손익(*)	483,831	577,254	1,274,399	-	(608,223)	143,891
세후중단영업손익(*)	(528)	-	-	-	283,029	-
기타포괄손익(*)	48,076	(46,913)	342	-	507,326	8,747
총포괄손익(*)	531,379	530,341	1,274,741	-	182,132	152,638
Ⅱ. 배당(전분기)						
배당	31,848	50,669	-	-	13,463	35,717

(*) 지배기업의 소유주에 귀속될 손익입니다.

(2) 주요 공동기업

(단위 : 백만원)

구 분	삼성코닝어드밴스드글라스(유)	
	당분기	전기
Ⅰ. 요약 재무정보		
요약 재무상태표:		
유동자산	93,089	102,100
비유동자산	235,515	224,966
유동부채	25,599	30,316
비유동부채	1,335	621
요약 포괄손익계산서:		
매출	133,154	181,377
계속영업손익(*)	5,542	9,730
총포괄손익(*)	5,542	9,730
Ⅱ. 배당		
배당	-	-

(*) 분기 9개월 기준 금액입니다.

(3) 개별적으로 중요하지 않은 관계기업과 공동기업의 손익 중 연결회사의 지분 해당액은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기		전분기	
	관계기업	공동기업	관계기업	공동기업
분기순손익	(47,815)	2,066	21,282	1,870
기타포괄손익	(51,219)	(9,492)	6,401	5,889

총포괄손익	(99,034)	(7,426)	27,683	7,759

바. 보고기간종료일 현재 시장성 있는 주요 관계기업 투자주식의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주, 백만원)

기 업 명	당분기말		전기말
	주식수	시장가치	시장가치
삼성전기㈜	17,693,084	26,769,636	4,511,736
삼성에스디에스㈜	17,472,110	3,826,392	2,996,467
삼성바이오로직스㈜	14,449,944	20,099,872	24,492,655
삼성에피스홀딩스㈜	7,767,364	2,687,508	5,771,151
삼성SDI㈜	15,663,968	8,066,944	4,221,439
㈜제일기획	29,038,075	544,174	609,800

사. 기타사항

증권선물위원회는 연결회사의 관계기업인 삼성바이오로직스㈜가 Biogen Therapeutics Inc.와 합작 투자한 삼성바이오에피스㈜ 지분에 대한 회계처리와 관련하여, 합작계약 약정사항의 재무제표 주석 미기재를 이유로 담당임원 해임권고, 검찰 고발, 감사인 지정 등의 조치(이하 "1차 처분")를 2018년 7월 12일에 의결하였으며, 연결대상 범위 회계처리 오류 등 회계기준 위반을 이유로 과징금 80억원 부과, 대표이사 해임권고, 재무제표 재작성, 검찰 고발 등의 조치(이하 "2차 처분")를 2018년 11월 14일에의결하였습니다.

이에 대하여 삼성바이오로직스㈜는 회계처리의 정당성을 입증하기 위하여 위 처분의취소를 구하는 소송(이하 "본안 소송")을 서울행정법원에 제기하였고, 현재 소송을 진행 중입니다. 1차 처분의 취소를 구하는 소송과 관련하여, 서울행정법원은 2020년 9월 24일 증권선물위원회가 부과한 행정 처분을 취소한다고 판결하고 항소심 판결 선고 시까지 위 처분의 효력을 정지하는 결정을 하였으나, 2020년 10월 16일 증권선물위원회는 1심 판결에 항소하였습니다. 서울고등법원은 2025년 6월 11일 증권선물위원회의 항소를 기각하였고, 증권선물위원회는 2025년 6월 30일 위 판결에 상고하였으나 대법원은 2025년 9월 25일 상고를 기각하여 취소청구 전부인용이 확정되었습니다. 2차 처분의 취소를 구하는 소송과 관련하여, 서울행정법원은 2024년 8월 14일 증권선물위원회가 부과한 행정처분을 취소한다고 판결하였으나, 증권선물위원회는 2024년 8월 28일 항소하여 현재 서울고등법원에서 소송이 진행 중입니다.

또한, 삼성바이오로직스㈜는 위 처분에 대한 효력정지신청서를 서울행정법원에 제출하였으며, 법원은 2019년 1월 22일(2차 처분)과 2019년 2월 19일(1차 처분)에 본안 소송의 판결시까지 처분의 효력을 정지하는 결정을 선고하였습니다. 이에 증권선물위원회는 위 집행정지 결정에 대하여 즉시 항고하였으며, 서울고등법원은 2019년 5월 13일(2차 처분), 2019년 5월 24일(1차 처분) 항고를 기각하였습니다. 이에 증권선물위원회는 2019년 5월 23일(2차 처분), 2019년 6월 10일(1차 처분) 재항고 하였으며, 대법원은 2019년 9월 6일(2차 처분), 2019년 10월 11일(1차 처분) 재항고를 기각하여 효력정지 결정이 확정되었습니다.

향후 행정소송의 결과를 예측하기 어려우나 소송 결과에 따라 삼성바이오로직스㈜가
삼성바이오에피스㈜ 지분에 관한 과거 회계처리를 수정하여 재무제표를 재작성하게 될 경우, 이로 인해 연결회사의 2015년부터 2022년까지 보고기간의 지분법손익, 관계기업투자주식, 이익잉여금과 2016년 일부 지분 처분이익 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 다만, 현재로서는 삼성바이오로직스㈜와 증권선물위원회 간의 행정소송에 대한 종결 시기와 그 결과를 예측할 수 없으므로, 연결회사의 당분기 재무제표에 이를 반영하기 어렵습니다.

7. 유형자산 (연결)

유형자산(사용권자산 포함)의 변동 내용에 대한 공시

당분기 (단위 : 백만원)

	공시금액
기초 유형자산	215,304,784
일반취득 및 자본적지출, 유형자산	57,916,585

사업결합을 통한 취득, 유형자산	0
감가상각비, 유형자산	(35,482,069)
유형자산의 처분, 폐기 및 손상	(337,774)
매각예정분류, 유형자산	0
기타 변동을 통한 증가(감소), 유형자산	(3,392,265)
분기말 유형자산	234,009,261

전분기 (단위 : 백만원)

	공시금액
기초 유형자산	205,945,209
일반취득 및 자본적지출, 유형자산	33,148,977
사업결합을 통한 취득, 유형자산	152,286
감가상각비, 유형자산	(32,248,891)
유형자산의 처분, 폐기 및 손상	(384,556)
매각예정분류, 유형자산	(22,527)
기타 변동을 통한 증가(감소), 유형자산	(1,729,421)
분기말 유형자산	204,861,077

기타 변동에 대한 각주, 유형자산

기타는 환율변동에 의한 증감액 등을 포함하고 있습니다.

감가상각비의 기능별 배분

당분기 (단위 : 백만원)

	매출원가	판매비와관리비 등	성격별 비용의 기능별 배분 합계
감가상각비, 유형자산	30,438,750	5,043,319	35,482,069

전분기 (단위 : 백만원)

	매출원가	판매비와관리비 등	성격별 비용의 기능별 배분 합계
감가상각비, 유형자산	28,327,335	3,921,556	32,248,891

사용권자산에 대한 양적 정보 공시

당분기말 (단위 : 백만원)

	유형자산
사용권자산	4,985,808

전기말 (단위 : 백만원)

	유형자산
사용권자산	5,388,707

사용권자산의 추가와 감가상각비에 대한 공시

당분기 (단위 : 백만원)

	유형자산
사용권자산의 추가	972,551
감가상각비, 사용권자산	(1,008,690)

전분기 (단위 : 백만원)

	유형자산
사용권자산의 추가	972,950
감가상각비, 사용권자산	(939,829)

8. 무형자산 (연결)

무형자산 및 영업권의 변동내역에 대한 공시

당분기 (단위 : 백만원)

	공시금액
기초 무형자산	29,480,565
개별취득, 무형자산	1,126,444
사업결합을 통한 취득, 무형자산	0
상각, 무형자산	(2,654,854)
처분, 폐기 및 손상, 무형자산	(17,587)
매각예정분류, 무형자산	0
기타, 무형자산	(867,525)
분기말 무형자산	27,067,043

전분기 (단위 : 백만원)

	공시금액
기초 무형자산	23,738,566
개별취득, 무형자산	3,237,638
사업결합을 통한 취득, 무형자산	2,368,983
상각, 무형자산	(2,445,669)
처분, 폐기 및 손상, 무형자산	(169,793)
매각예정분류, 무형자산	(389,075)
기타, 무형자산	128,478
분기말 무형자산	26,469,128

기타 변동에 대한 각주, 무형자산

기타는 환율변동에 의한 증감액 등을 포함하고 있습니다.

무형자산상각비의 기능별 배분

당분기 (단위 : 백만원)

	매출원가	판매비와관리비 등	성격별 비용의 기능별 배분 합계
무형자산상각비	1,750,977	903,877	2,654,854

전분기 (단위 : 백만원)

	매출원가	판매비와관리비 등	성격별 비용의 기능별 배분 합계
무형자산상각비	1,658,846	786,823	2,445,669

9. 차입금 (연결)

단기차입금에 대한 세부 정보

당분기말 (단위 : 백만원)

	차입금 명칭						차입금 명칭 합계
	담보부차입금			무담보차입금			
	거래상대방						
	우리은행 등			씨티은행 등			
	범위		범위 합계	범위		범위 합계	
	하위범위	상위범위		하위범위	상위범위		
연이자율	0.015	0.158		0.000	0.400		
단기차입금			7,946,307			635,923	8,582,230
차입금에 대한 기술			담보부차입금과 관련하여 매출채권을 담보로 제공하였습니다.				

전기말 (단위 : 백만원)

	차입금 명칭						차입금 명칭 합계
	담보부차입금			무담보차입금			
	거래상대방						
	우리은행 등			씨티은행 등			
	범위		범위 합계	범위		범위 합계	
	하위범위	상위범위		하위범위	상위범위		
연이자율							
단기차입금			17,411,670			163,310	17,574,980
차입금에 대한 기술			담보부차입금과 관련하여 매출채권을 담보로 제공하였습니다.				

유동성장기차입금에 대한 세부 정보

당분기말 (단위 : 백만원)

	차입금 명칭		차입금 명칭 합계
	은행차입금	리스 부채	
	거래상대방		

	BNP 등			CSSD 등	
	범위		범위 합계	범위 합계	
	하위범위	상위범위			
연이자율	0.033	0.053		0.053	
유동성장기차입금			2,461	1,058,176	1,060,637

전기말 (단위 : 백만원)

	차입금 명칭				차입금 명칭 합계
	은행차입금			리스 부채	
	거래상대방				
	BNP 등			CSSD 등	
	범위		범위 합계	범위 합계	
	하위범위	상위범위			
연이자율					
유동성장기차입금			1,977	1,168,438	1,170,415

장기차입금에 대한 세부 정보

당분기말 (단위 : 백만원)

	차입금 명칭				차입금 명칭 합계
	은행차입금			리스 부채	
	거래상대방				
	한국산업은행 등			CSSD 등	
	범위		범위 합계	범위 합계	
	하위범위	상위범위			
연이자율	0.026	0.074		0.053	
장기차입금			4,100,696	3,434,133	7,534,829

전기말 (단위 : 백만원)

	차입금 명칭				차입금 명칭 합계
	은행차입금			리스 부채	
	거래상대방				
	한국산업은행 등			CSSD 등	
	범위		범위 합계	범위 합계	
	하위범위	상위범위			
연이자율					
장기차입금			2,806,014	3,673,503	6,479,517

리스부채 이자비용에 대한 공시

당분기 (단위 : 백만원)

	공시금액
리스부채에 대한 이자비용	185,515

리스부채 이자비용에 대한 설명	리스부채의 연이자율은 가중평균증분차입이자율입니다.

전분기 (단위 : 백만원)

	공시금액
리스부채에 대한 이자비용	179,625
리스부채 이자비용에 대한 설명	리스부채의 연이자율은 가중평균증분차입이자율입니다.

10. 사채 (연결)

사채에 대한 세부 정보 공시

당분기말 (단위 : 백만원)

	차입금 명칭		
	US$ denominated Straight Bonds		
	장부금액		장부금액 합계
	총장부금액	할인발행차금	
발행일			1997-10-02
만기상환일			2027-10-01
연이자율			0.077
명목금액, 기초통화금액(USD) [USD, 천]			10,000
사채	13,584	(47)	13,537
차감: 유동성사채			(6,769)
비유동성사채			6,768
사채에 대한 기술			10년 거치 20년 분할상환되며 이자는 6개월마다 후급됩니다.

전기말 (단위 : 백만원)

	차입금 명칭		
	US$ denominated Straight Bonds		
	장부금액		장부금액 합계
	총장부금액	할인발행차금	
발행일			
만기상환일			
연이자율			
명목금액, 기초통화금액(USD) [USD, 천]			10,000
사채	14,349	(122)	14,227
차감: 유동성사채			(7,093)
비유동성사채			7,134

사채에 대한 기술			10년 거치 20년 분할상환되며 이자는 6개월마다 후급됩니다.

11. 순확정급여부채(자산) (연결)

확정급여제도에 대한 공시

당분기말 (단위 : 백만원)

	전부 또는 부분적으로 기금이 적립되는 확정급여제도	전부 기금이 적립되지 않는 확정급여제도	확정급여제도의 기금 적립약정 합계
확정급여채무, 현재가치	16,732,327	498,468	17,230,795
사외적립자산의 공정가치			(24,751,128)
순확정급여부채(자산) 계			(7,520,333)

전기말 (단위 : 백만원)

	전부 또는 부분적으로 기금이 적립되는 확정급여제도	전부 기금이 적립되지 않는 확정급여제도	확정급여제도의 기금 적립약정 합계
확정급여채무, 현재가치	16,370,236	484,816	16,855,052
사외적립자산의 공정가치			(20,568,079)
순확정급여부채(자산) 계			(3,713,027)

당기손익에 포함되는 퇴직급여비용에 대한 공시

당분기 (단위 : 백만원)

	매출원가	판매비와관리비	성격별 비용의 기능별 배분 합계
당기근무원가, 확정급여제도			1,120,698
순이자비용(수익), 확정급여제도			(125,150)
과거근무원가, 확정급여제도			715,006
기타비용, 확정급여제도			(15)
퇴직급여비용 합계, 확정급여제도	738,038	972,501	1,710,539

전분기 (단위 : 백만원)

	매출원가	판매비와관리비	성격별 비용의 기능별 배분 합계
당기근무원가, 확정급여제도			1,134,852
순이자비용(수익), 확정급여제도			(98,862)
과거근무원가, 확정급여제도			(145)
기타비용, 확정급여제도			5,092

퇴직급여비용 합계, 확정급여제도	437,050	603,887	1,040,937

당분기 및 전분기 중 확정급여제도 관련 비용에 대한 각주

과거근무원가에는 평균임금 범위 변경 판결에 따라 확정급여제도에 미치는 영향이 포함되어 있습니다.

12. 충당부채 (연결)

충당부채에 대한 공시

(단위 : 백만원)

	판매보증	기술사용료	장기성과급	기타	충당부채 합계
기초	2,607,036	2,218,998	782,262	4,982,674	10,590,970
순전입(환입)	749,228	1,663,654	252,594	2,281,320	4,946,796
사용	(988,784)	(755,765)	(172,086)	(654,659)	(2,571,294)
기타	(129,306)	(218,943)	(335,914)	(64,477)	(748,640)
기말	2,238,174	2,907,944	526,856	6,544,858	12,217,832
충당부채의 성격에 대한 기술	연결회사는 출고한 제품에 대한 품질보증, 교환, 하자보수 및 그에 따른 사후 서비스 등으로 인하여 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 보증기간 및 과거 경험률 등을 기초로 추정하여 충당부채로 설정하고 있습니다.	연결회사는 협상 진행 중인 기술사용계약과 관련하여 향후 지급이 예상되는 기술사용료를 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다. 지급시기 및 금액은 협상결과에 따라 변동될 수 있습니다.	연결회사는 임원을 대상으로 부여연도를 포함한 향후 3년간의 경영실적에 따라 성과급을 지급하는 장기성과 인센티브를 부여하였는 바, 향후 지급이 예상되는 금액의 경과기간 해당분을 충당부채로 계상하고 있습니다. 당분기중 일부를 주식으로 지급하기로 한 약정에 따라 기타자본으로 대체하였습니다.	연결회사는 생산 및 판매 중단한 제품에 대하여 향후 부담할 것으로 예상되는 비용 등을 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다.연결회사는 온실가스 배출과 관련하여 해당 이행연도분 배출권의 장부금액과 이를 초과하는 배출량에 대해 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다.	

기타 변동에 대한 기술, 기타충당부채

기타는 계정재분류 및 환율변동에 의한 증감액 등을 포함하고 있습니다.

무상할당 배출권의 수량에 대한 공시

	2026년(당기 이행연도)
무상할당 배출권 (톤(tCO2-eq))	21,010,000
배출량 추정치 (톤(tCO2-eq))	18,790,000

온실가스 배출권의 변동내역 대한 공시

당분기 (단위 : 백만원)

	공시금액
기초 배출권	3,137
증가	1,680
사용	0
기말 배출권	4,817

전분기 (단위 : 백만원)

	공시금액
기초 배출권	3,137
증가	0
사용	0
기말 배출권	3,137

배출부채의 증감내역에 대한 공시

당분기 (단위 : 백만원)

	공시금액
기초배출부채	150
순전입	144
사용	(181)
기말배출부채	113

전분기 (단위 : 백만원)

	공시금액
기초배출부채	174
순전입	34
사용	(78)
기말배출부채	130

13. 우발부채와 약정사항 (연결)

법적소송우발부채에 대한 공시

	법적소송우발부채
의무의 성격에 대한 기술, 우발부채	당분기말 현재 연결회사는 다수의 회사 등과 정상적인 영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 및 규제기관의 조사 등이 진행 중에 있습니다.
유출될 경제적효익의 금액과 시기에 대한 불확실성 정도, 우발부채	이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 연결회사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 연결회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

약정에 대한 공시

(단위 : 백만원)

	약정의 유형		
	사업결합	매입약정	공급계약
		발생하지 않은 유무형자산의 취득	
약정 금액		26,312,625	
약정에 대한 설명	당분기말 현재 연결회사는 독일 ZF 프리드리히스하펜(ZF Friedrichshafen AG)의 ADAS(Advanced Driver Assistance System) 사업에 대한 인수를 진행 중이며, 인수절차는 2026년 중 완료할 예정입니다 (계약체결일: 2025년 12월 23일).	당분기말 현재 발생하지 않은 유・무형자산의 취득을 위한 약정액은 26,312,625백만원입니다.	당분기말 현재 연결회사는 복수의 글로벌 고객사들과 메모리반도체 공급에 대한 다년계약을 체결하고 있습니다. 해당 계약과 관련한 수주총액, 납품기간 등 거래조건은 고객사 수요 및 사업 경과에 따라 변동될 수 있습니다.

14. 계약부채 (연결)

계약부채에 대한 공시

당분기말 (단위 : 백만원)

	공시금액
계약부채	24,147,546

전기말 (단위 : 백만원)

	공시금액
계약부채	13,978,566

계약부채에 대한 기술

계약부채는 선수금, 미지급비용, 기타유동부채 등에 포함되어 있습니다.

15. 자본금 (연결)

주식의 분류에 대한 공시

(단위 : 백만원)

	보통주	우선주	주식의 종류 합계

회사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수(단위: 주)			25,000,000,000
주당 액면가액(원)			100
발행주식 액면 총액(백만원)	584,628	80,237	664,865
납입자본금(백만원)			897,514
자본금에 대한 설명			발행주식의 액면총액은 664,865백만원(보통주 584,628백만원, 우선주 80,237백만원)으로 이익소각으로 인하여 납입자본금 897,514백만원과 상이합니다.
각 종류별 주식에 부여된 권리, 우선권 및 제한사항			보고기간종료일 현재 회사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 250억주(1주의 액면금액: 100원)이며, 회사에는 보통주 외 비누적적 우선주가 있습니다. 이 우선주는 의결권이 없고 액면금액을 기준으로 보통주의 배당보다 연 1%의 금전배당을 추가로 받을 수 있습니다.

주식에 대한 공시

당분기말

	보통주	우선주
기초 유통주식수(단위: 주)	5,827,808,935	802,371,203
자기주식 취득주식수(단위: 주)	(121,265,072)	0
자기주식 지급주식수(단위: 주)	12,063,951	0
기말 유통주식수(단위: 주)	5,718,607,814	802,371,203
소각주식 수를 제외한 발행주식수(단위: 주)	5,846,278,608	802,371,203

유통주식수에 대한 기술	보고기간종료일 현재 회사가 발행한 보통주 및 우선주의 수(소각 주식수 제외)는 각각 5,846,278,608주와 802,371,203주이며, 유통주식수는 자기주식 취득으로 인하여 발행주식의 총수와 차이가 있습니다.	보고기간종료일 현재 회사가 발행한 보통주 및 우선주의 수(소각 주식수 제외)는 각각 5,846,278,608주와 802,371,203주이며, 유통주식수는 자기주식 취득으로 인하여 발행주식의 총수와 차이가 있습니다.

전기말

	보통주	우선주
기초 유통주식수(단위: 주)	5,940,082,550	818,836,700
자기주식 취득주식수(단위: 주)	(118,314,495)	(16,465,497)
자기주식 지급주식수(단위: 주)	6,040,880	0
기말 유통주식수(단위: 주)	5,827,808,935	802,371,203
소각주식 수를 제외한 발행주식수(단위: 주)		
유통주식수에 대한 기술		

주식의 소각 및 지급에 대한 공시

(단위 : 백만원)

	보통주	우선주	주식의 종류 합계
지급한 주식 수(단위: 주)	12,063,951	0	
지급한 주식의 취득원가	1,467,979		
이사회 결의일, 주식 지급			2026년 1월 23일, 1월 28일, 3월 18일, 7월 7일, 7월 11일
소각한 주식 수(단위: 주)	73,359,314	13,603,461	86,962,775
소각한 주식의 취득원가			5,346,072
이사회 결의일, 주식 소각			2026년 3월 30일

16. 연결이익잉여금 (연결)

이익잉여금에 대한 공시

당분기말 (단위 : 백만원)

		공시금액
이익잉여금		581,883,670
이익잉여금	임의적립금 등	258,182,802
	연결미처분이익잉여금	323,700,868

전기말 (단위 : 백만원)

		공시금액
이익잉여금		402,135,600
이익잉여금	임의적립금 등	238,481,469
	연결미처분이익잉여금	163,654,131

배당금에 대한 공시

당분기 (단위 : 백만원)

	배당의 구분								
	분기배당								
	1분기			2분기			3분기		
	주식의 종류		주식의 종류 합계	주식의 종류		주식의 종류 합계	주식의 종류		주식의 종류 합계
	보통주	우선주		보통주	우선주		보통주	우선주	
배당기준일			2026-03-31			2026-06-30			2026-09-30
배당받을 주식(단위: 주)	5,792,563,304	802,371,203		5,764,191,903	802,371,203		5,718,607,814	802,371,203	
보통주 주당 배당률 (액면가 기준)	3.72			3.74			46.01		
우선주 주당 배당률 (액면가 기준)		3.72			3.74			46.01	
배당금	2,154,834	298,482	2,453,316	2,155,808	300,087	2,455,895	26,311,315	3,691,710	30,003,025

전분기 (단위 : 백만원)

	배당의 구분								
	분기배당								
	1분기			2분기			3분기		
	주식의 종류		주식의 종류 합계	주식의 종류		주식의 종류 합계	주식의 종류		주식의 종류 합계
	보통주	우선주		보통주	우선주		보통주	우선주	
배당기준일			2025-03-31			2025-06-30			2025-09-30
배당받을 주식(단위: 주)	5,892,637,922	812,249,664		5,876,745,450	809,337,676		5,828,224,765	802,437,676	
보통주 주당 배당률 (액면가 기준)	3.65			3.67			3.70		
우선주 주당 배당률 (액면가 기준)		3.65			3.67			3.70	
배당금	2,150,813	296,471	2,447,284	2,156,766	297,027	2,453,793	2,156,443	296,902	2,453,345

17. 기타자본항목 (연결)

기타자본구성요소

당분기말 (단위 : 백만원)

		공시금액
기타자본구성요소		18,258,907
기타자본구성요소	기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	10,179,713
	관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익누계액에 대한 지분	245,009
	해외사업장환산외환차이	9,810,950
	순확정급여부채(자산) 재측정요소	(3,934,333)
	자기주식	(25,570,974)
	주식기준보상	27,207,085
	기타	321,457

전기말 (단위 : 백만원)

		공시금액

기타자본구성요소		16,876,248
기타자본구성요소	기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	6,149,263
	관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익누계액에 대한 지분	760,827
	해외사업장환산외환차이	19,618,086
	순확정급여부채(자산) 재측정요소	(3,508,193)
	자기주식	(6,606,360)
	주식기준보상	365,810
	기타	96,815

자기주식에 대한 공시

당분기말 (단위 : 백만원)

	보통주	우선주
자기주식수(단위: 주)	127,670,794	0
자기주식	25,570,974	0

전기말 (단위 : 백만원)

	보통주	우선주
자기주식수(단위: 주)	91,828,987	13,603,461
자기주식	5,892,428	713,932

주식기준보상약정에 대한 공시

(단위 : 백만원)

	주식결제 성과인센티브	임직원 주식보상(우수인력)	임직원 주식보상(DX부문 및 CSS사업팀)	임직원 주식보상(DS부문)	주식결제 장기성과급	성과연동 주식보상

주식기준보상약정에 대한 기술	연결회사는 임직원을 대상으로 성과인센티브 중 일부를 2026년 1월에 양도제한주식(RSA)으로 지급하기로 약정하였으며, 이에 따라 지급한 보통주 6,524,129주의 약정일 현재 공정가치 1,047,102백만원을 '미지급비용'에서 '기타자본항목'으로 대체 및 '급여'로 인식하였습니다. 해당 주식보상은 당분기 중 지급완료하였습니다. 또한 전기말 기준 미교부 상태인 양도제한주식(RSA) 보통주 1,176,383주에 대한 정산이 당분기 중 완료되었습니다.	연결회사는 우수인력에 대한 리텐션 및 동기부여를 목적으로 보통주 1,781,329주를 지급하기로 약정하였으며, 이에 따라 약정일 현재 공정가치 371,594백만원을 '복리후생비' 및 '기타자본항목'으로 인식하였습니다. 해당 주식보상은 당분기 중 일부 지급되었으며 2028년에 지급완료될 예정입니다. 또한 전기말 기준 동일한 목적으로 약정하였으나 미교부 상태인 보통주 1,574,685주 중 1,569,895주에 대한 정산이 당분기 중 완료되었습니다.	연결회사는 2026년 5월 27일 노사합의에 따라 DX 부문 및 CSS 사업팀 직원에게 보통주를 부여하기로 약정하였으며, 이에 따라 지급 예정인 보통주의 약정일 현재 공정가치 332,715백만원을 '급여' 및 '기타자본항목'으로 인식하였습니다. 해당 주식보상은 당분기 중 지급완료하였습니다.	연결회사는 2026년 사업성과의 일정 비율에 해당하는 양도제한 보통주를 DS부문 임직원들에게 지급하는 약정에 합의하였으며, 세부조건은 협의중입니다. 해당 주식보상 약정은 2026년 최종 성과 확정 후 지급될 예정입니다.	연결회사는 임원 등의 장기성과급 중 일부를 주식으로 지급하기로 약정하였으며, 이에 따라 보통주 1,195,593주의 약정일 현재 공정가치 291,801백만원을 '급여' 및 '기타자본항목'으로 인식하였습니다. 해당 주식보상은 당분기 중 일부 지급되었으며 2028년에 지급 완료될 예정입니다. 한편, 전기말 기준 동일한 목적으로 약정하였으나 미교부 상태인 보통주 778,984주에 대한 정산이 당분기 중 완료되었습니다.	연결회사는 삼성전자주식회사와 삼성디스플레이㈜의 임직원을 대상으로 성과연동주식보상제도(PSU)를 운영하고 있습니다. 당분기 중 연결회사가 이 제도와 관련하여 인식한 비용은 776,784백만원입니다.
주식기준보상약정의 결제방식에 대한 기술	주식결제	주식결제	주식결제	주식결제	주식결제	주식결제, 현금결제
주식기준보상약정의 부여일	2026년 1월		2026년 5월 27일			
주식기준보상약정의 지급일	당분기 중 지급 완료	당분기 중 일부 지급되었으며, 2028년에 지급완료될 예정	당분기 중 지급완료	2026년 최종 성과 확정 후 지급될 예정	당분기 중 일부 지급되었으며, 2028년에 지급 완료될 예정	
주식기준보상약정에 따라 부여된 금융상품의 수량(단위 : 주)	6,524,129	1,781,329			1,195,593	
약정일 현재 공정가치	1,047,102	371,594	332,715		291,801	
종업원 주식기준보상거래로부터의 비용						776,784

전기말 기준 미교부 상태인 금융상품의 수량(단위: 주)	1,176,383	1,574,685			778,984	
전기말 기준 미교부상태인 금융상품 중 당분기 정산완료된 수량(단위: 주)	1,176,383	1,569,895			778,984	

18. 비용의 성격별 분류 (연결)

비용의 성격별 분류 공시

당분기 (단위 : 백만원)

		장부금액	
		공시금액	
		3개월	누적
성격별 비용		87,812,725	246,460,431
성격별 비용	제품과 재공품의 감소(증가)	(2,155,640)	(13,373,643)
	원재료 등의 사용액 및 상품 매입액 등	28,951,035	80,829,962
	급여	20,996,652	57,079,134
	퇴직급여	402,730	2,332,964
	감가상각비	11,888,700	35,482,069
	무형자산상각비	874,089	2,654,854
	복리후생비	2,018,252	6,569,988
	유틸리티비	2,604,693	7,313,456
	외주용역비	2,289,945	6,925,931
	광고선전비	1,223,671	3,583,601
	판매촉진비	1,945,016	5,928,897
	기타 비용	16,773,582	51,133,218

전분기 (단위 : 백만원)

		장부금액	
		공시금액	
		3개월	누적
성격별 비용		73,895,686	216,241,177
성격별 비용	제품과 재공품의 감소(증가)	224,656	1,183,250
	원재료 등의 사용액 및 상품 매입액 등	27,627,829	79,368,099
	급여	7,900,476	25,330,965

	퇴직급여	364,920	1,202,815
	감가상각비	10,961,595	32,248,891
	무형자산상각비	857,453	2,445,669
	복리후생비	1,778,514	5,666,204
	유틸리티비	2,447,495	6,869,507
	외주용역비	2,268,862	6,666,525
	광고선전비	1,629,563	4,427,743
	판매촉진비	2,150,212	6,209,533
	기타 비용	15,684,111	44,621,976

성격별 비용에 대한 기술

연결손익계산서 상 매출원가와 판매비와관리비를 합한 금액입니다.

19. 판매비와관리비 (연결)

판매비와관리비에 대한 공시

당분기 (단위 : 백만원)

			장부금액	
			공시금액	
			3개월	누적
판매비와관리비 합계			27,823,370	82,312,045
판매비와관리비 합계	경상연구개발비를 제외한 판매비와관리비 소계		13,398,635	40,525,304
	경상연구개발비를 제외한 판매비와관리비 소계	급여	3,213,535	9,639,604
		퇴직급여	82,352	593,454
		지급수수료	2,764,527	7,961,483
		감가상각비	465,075	1,400,718
		무형자산상각비	232,851	701,282
		광고선전비	1,223,671	3,583,601
		판매촉진비	1,945,016	5,928,897
		운반비	780,111	2,101,714
		서비스비	654,048	2,606,749
		기타판매비와관리비	2,037,449	6,007,802
	경상연구개발비-연구개발 총지출액		14,424,735	41,786,741

전분기 (단위 : 백만원)

			장부금액	
			공시금액	
			3개월	누적
판매비와관리비 합계			21,326,065	63,592,059
판매비와관리비 합	경상연구개발비를 제외한 판매비와관		12,502,015	36,715,978

계	리비 소계			
	경상연구개발비를 제외한 판매비와관리비 소계	급여	2,188,011	6,655,962
		퇴직급여	41,751	244,095
		지급수수료	2,551,751	7,551,216
		감가상각비	424,401	1,287,103
		무형자산상각비	203,264	589,957
		광고선전비	1,629,563	4,427,743
		판매촉진비	2,150,212	6,209,533
		운반비	606,519	1,831,895
		서비스비	948,502	2,660,354
		기타판매비와관리비	1,758,041	5,258,120
	경상연구개발비-연구개발 총지출액		8,824,050	26,876,081

20. 기타수익 및 기타비용 (연결)

기타수익 및 기타비용

당분기 (단위 : 백만원)

		장부금액	
		공시금액	
		3개월	누적
기타수익		504,892	1,421,266
기타수익	배당금수익	78,259	148,224
	임대료수익	36,797	110,645
	유형자산처분이익	53,705	139,584
	기타	336,131	1,022,813
기타비용		255,829	1,092,919
기타비용	유형자산처분손실	33,352	110,920
	기부금	66,303	130,702
	기타	156,174	851,297

전분기 (단위 : 백만원)

		장부금액	
		공시금액	
		3개월	누적
기타수익		243,439	1,652,494
기타수익	배당금수익	26,684	93,555
	임대료수익	37,586	113,531
	유형자산처분이익	32,490	85,379
	기타	146,679	1,360,029
기타비용		338,880	863,487

기타비용	유형자산처분손실	18,041	39,235
	기부금	26,445	110,376
	기타	294,394	713,876

21. 금융수익 및 금융비용 (연결)

금융수익 및 금융비용

당분기 (단위 : 백만원)

			장부금액	
			공시금액	
			3개월	누적
금융수익 합계			4,594,021	19,069,385
금융수익 합계	이자수익		2,283,842	5,117,310
	이자수익	상각후원가로 측정하는 금융자산의 이자수익	2,283,791	5,117,154
		당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 이자수익	51	156
	외환차이		4,264,140	13,254,466
	파생상품관련이익		(1,953,961)	697,609
금융비용 합계			14,109,461	22,604,921
금융비용 합계	이자비용		291,663	766,335
	이자비용	상각후원가 측정 금융부채 이자비용	235,012	416,819
		기타 금융부채 이자비용	56,651	349,516
	외환차이		13,614,606	21,158,586
	파생상품관련손실		203,192	680,000

전분기 (단위 : 백만원)

			장부금액	
			공시금액	
			3개월	누적
금융수익 합계			2,903,929	11,220,665
금융수익 합계	이자수익		1,172,233	3,462,777
	이자수익	상각후원가로 측정하는 금융자산의 이자수익	1,172,177	3,462,611
		당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 이자수익	56	166

	외환차이		1,615,092	6,535,151
	파생상품관련이익		116,604	1,222,737
금융비용 합계			1,709,475	7,642,154
금융비용 합계	이자비용		115,924	440,541
	이자비용	상각후원가 측정 금융부채 이자비용	12,386	47,682
		기타 금융부채 이자비용	103,538	392,859
	외환차이		1,438,617	6,446,654
	파생상품관련손실		154,934	754,959

금융수익 및 금융비용에 대한 기술

연결회사는 외화거래 및 환산으로 발생한 외환차이를 금융수익 및 금융비용으로 인식하고 있습니다
.

22. 법인세비용 (연결)

평균유효세율과 적용세율간의 조정

	공시금액
법인세비용 인식에 대한 기술	법인세비용은 전체 회계연도에 대해 글로벌최저한세를 고려하여 추정한 최선의 가중평균연간법인세율로 인식하였습니다. 당분기말 현재 2026년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상평균연간법인세율은 23.0%입니다.
2026년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상 평균 연간법인세율	0.230

23. 주당이익 (연결)

주당이익

당분기 (단위 : 백만원)

		주식의 종류			
		보통주		우선주	
		3개월	누적	3개월	누적
지배회사지분 분기순이익		75,208,134	193,578,792	75,208,134	193,578,792
기본주당이익					
기본주당이익	지배기업의 보통주에 귀속되는 분기순이익	65,986,917	169,961,497		
	지배기업의 우선주에 귀속되는 분기순			9,221,217	23,617,295

	이익				
	가중평균유통보통주식수(단위: 주)	5,757,215,600	5,784,809,795		
	가중평균유통우선주식수(단위: 주)			802,371,203	802,371,203
	기본주당이익(단위 : 원)	11,462	29,381	11,492	29,434
희석주당순이익					
희석주당순이익	희석효과를 포함한 지배기업의 보통주에 귀속되는 분기순이익	66,079,235	170,197,945		
	희석효과를 포함한 우선주에 귀속되는 분기순이익			9,128,899	23,380,847
	가중평균희석유통보통주식수(단위: 주)	5,868,590,512	5,866,395,793		
	가중평균희석유통우선주식수(단위: 주)			802,371,203	802,371,203
	희석주당이익(단위 : 원)	11,260	29,012	11,377	29,140

전분기 (단위 : 백만원)

		주식의 종류			
		보통주		우선주	
		3개월	누적	3개월	누적
지배회사지분 분기순이익		12,006,461	24,968,902	12,006,461	24,968,902
기본주당이익					
기본주당이익	지배기업의 보통주에 귀속되는 분기순이익	10,552,774	21,945,760		
	지배기업의 우선주에 귀속되는 분기순이익			1,453,687	3,023,142
	가중평균유통보통주식수(단위: 주)	5,855,461,456	5,893,762,660		
	가중평균유통우선주식수(단위: 주)			806,314,121	811,986,953
	기본주당이익(단위 : 원)	1,802	3,724	1,803	3,723
희석주당순이익					
희석주당순이익	희석효과를 포함한 지배기업의 보통주	10,553,383	21,946,616		

	에 귀속되는 분기순이익				
	희석효과를 포함한 우선주에 귀속되는 분기순이익			1,453,078	3,022,286
	가중평균희석유통보통주식수(단위: 주)	5,858,733,256	5,895,411,133		
	가중평균희석유통우선주식수(단위: 주)			806,314,121	811,986,953
	희석주당이익(단위: 원)	1,801	3,723	1,802	3,722

가중평균 희석성 잠재적보통주에 대한 공시

당분기

	보통주
보통주식수 주식기준보상약정의 잠재적 효과(단위: 주)	81,585,998

전분기

	보통주
보통주식수 주식기준보상약정의 잠재적 효과(단위: 주)	1,648,474

기본 및 희석주당이익의 계산을 위한 분모의 조정에 대한 기술

희석주당이익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균 유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다. 연결회사가 보유한 희석성 잠재적보통주 중 성과연동주식보상(Performance Stock Units)으로 인한 주식수는 당분기말 현재 기준주가가 약정 후 3년 경과 시점의 기준주가와 같다고 가정할 경우 임직원에게 지급될 주식수로 계산되며, 반희석효과가 있을 경우 희석주당이익 계산에 포함되지 않습니다.

24. 현금흐름표 (연결)

현금흐름의 회계정책에 대한 기술

연결회사는 영업활동 현금흐름을 간접법으로 작성하였습니다. 당분기 및 전분기 중 영업활동 현금흐름 관련 조정 내역 및 영업활동으로 인한 자산부채의 변동은 다음과 같습니다.

영업활동현금흐름

당분기 (단위 : 백만원)

		공시금액
조정내역 계		125,996,900
조정내역 계	법인세비용	57,814,590

	금융수익	(8,314,421)
	금융비용	7,803,654
	퇴직급여	2,332,964
	감가상각비	35,482,069
	무형자산상각비	2,654,854
	대손상각비(환입)	(16,333)
	배당금수익	(148,224)
	지분법이익	(841,959)
	유형자산처분이익	(139,584)
	유형자산처분손실	110,920
	재고자산평가손실(환입) 등	993,651
	기타	28,264,719
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동		(60,185,085)
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	매출채권의 감소(증가)	(68,249,764)
	미수금의 감소(증가)	(1,190,636)
	장단기선급비용의 감소(증가)	(9,464)
	재고자산의 감소(증가)	(22,541,875)
	매입채무의 증가(감소)	15,155,582
	장단기미지급금의 증가(감소)	(616,423)
	선수금의 증가(감소)	1,137,906
	예수금의 증가(감소)	99,156
	미지급비용의 증가(감소)	3,036,264
	장단기충당부채의 증가(감소)	2,375,502
	퇴직금의 지급	(2,630,872)
	기타	13,249,539

전분기 (단위 : 백만원)

		공시금액
조정내역 계		37,921,850
조정내역 계	법인세비용	2,888,208
	금융수익	(5,372,833)
	금융비용	2,096,840
	퇴직급여	1,202,815
	감가상각비	32,248,891
	무형자산상각비	2,445,669
	대손상각비(환입)	43,214
	배당금수익	(93,555)
	지분법이익	(558,359)
	유형자산처분이익	(85,379)
	유형자산처분손실	39,235

	재고자산평가손실(환입) 등	2,934,148
	기타	132,956
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동		(5,466,496)
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	매출채권의 감소(증가)	(6,284,570)
	미수금의 감소(증가)	1,277,900
	장단기선급비용의 감소(증가)	8,808
	재고자산의 감소(증가)	(1,505,823)
	매입채무의 증가(감소)	1,607,051
	장단기미지급금의 증가(감소)	(1,224,276)
	선수금의 증가(감소)	29,878
	예수금의 증가(감소)	(15,975)
	미지급비용의 증가(감소)	632,574
	장단기충당부채의 증가(감소)	(693,270)
	퇴직금의 지급	(1,493,546)
	기타	2,194,753

리스부채와 관련한 현금유출액에 대한 공시

당분기 (단위 : 백만원)

	공시금액
리스부채에 대한 원금 상환, 재무활동에서 생기는 현금유출	1,030,468
리스부채에 대한 이자비용, 영업활동에서 생기는 현금유출	185,515

전분기 (단위 : 백만원)

	공시금액
리스부채에 대한 원금 상환, 재무활동에서 생기는 현금유출	959,796
리스부채에 대한 이자비용, 영업활동에서 생기는 현금유출	179,625

25. 재무위험관리 (연결)

금융상품에서 발생하는 위험의 성격과 정도에 대한 공시

	위험 유형					
	시장위험			신용위험	유동성 위험	위험 유형 합계
	환위험	이자율위험	지분가격위험			
위험에 대한 노출 정도에 대한 기술	연결회사는 글로벌 영업활동을 수행함	이자율변동위험은 시장금리 변동으로	연결회사는 전략적 목적 등으로 기타	연결회사의 금융자산 장부금액은 손	유동성위험이란 연결회사가 금융부채	연결회사의 재무위험관리의 주요 대

	에 따라 기능통화와 다른 통화로도 거래를 하고 있어 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 환율변동위험에 노출되는 주요 통화로는 USD, EUR 등이 있습니다.	인해 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로서, 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯됩니다.	포괄손익-공정가치금융자산 및 당기손익-공정가치금융자산으로 분류된 지분상품에 투자하고 있습니다.	상차손 차감 후 금액으로 연결회사의 신용위험 최대노출액은 금융자산 장부금액과 동일합니다.	와 관련된 모든 의무를 이행하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다.	상인 자산은 현금 및현금성자산, 단기금융상품, 매출채권, 기타포괄손익-공정가치금융자산 등으로 구성되어 있으며, 부채는 매입채무, 차입금 등으로 구성되어 있습니다.

위험관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 기술	연결회사는 통화별 자산과 부채규모를 일치하는 수준으로 유지하여 환율변동 영향을최소화하는 데 주력하고 있습니다. 이를 위해 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 금융거래 발생시 기능통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시킴으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있으나, 일부 발생된 환포지션은 채권매각, 선물환 등을 활용하여 환변동영향을 축소하고 있습니다. 이는 연결회사가 노출된 환율변동위험을 감소시키지만 완전히 제거하지는 않을 수 있습니다. 또한, 연결회사는 효율적인 환율변동 위험 관리를 위해 환위험을 주기적으로 모니터링 및 평가하고 있으며 투기적 외환거래는 엄격히 금지하고 있습니다.	연결회사는 내부자금 공유를 통해 외부차입금을 최소화하여 이자율 변동으로 인한 금융비용과 불확실성을 최소화하고 있습니다.	직·간접적 투자수단을 이용하고 있습니다.	신용위험은 통상적인 거래 및 투자 활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소를 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정·관리하고 있습니다. 그리고 위험국가에 소재한 거래처의 매출채권은 보험한도 내에서 적절하게 위험이 관리되고 있습니다. 신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당 거래는 현금 및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 연결회사는 국제 신용등급이 높은 은행(S&P A 이상)에 대해서만 거래를 하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 기존에 거래가 없는 금융기관과의 신규 거래는 해당 기관에 대한	연결회사의 주요 유동성 공급원은 영업에서 창출한 현금 및 자본시장 및 금융기관에서 조달한 자금이며, 주요 유동성 수요는 생산, 연구개발을 위한 투자를 비롯해, 운전자본, 배당 등에 있습니다. 대규모 투자가 많은 연결회사의 사업 특성상 적정 유동성의 유지가 매우 중요합니다. 연결회사는 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 산정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지·관리하고 있습니다. 연결회사는 권역별로 Cash Pooling을 구축하여 권역 내 개별 법인의 자금이 부족한 경우에도 유동성위험에 효율적으로 대응하고 있습니다. Cash Pooling은 자금 부족 회사와 자금 잉여 회사간 자금을 공유하는 시스템으로 개별회사의 유동성위험을 최소화하고 자금운용 부담을 경감시키며, 금융비용을 절감하는 등의 효과가 있습니다. 또한 대규모 유동성이 필요한 경우	연결회사는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험, 유동성위험 등을 최소화하는데 중점을 두고 재무위험을 관리하고 있으며, 이를 위해 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링 및 대응하고 있습니다. 재무위험은 글로벌 재무관리기준을 수립하고 고객과 거래선에 대한 주기적인 재무위험 측정, 환헷지 및 자금수지 점검 등을 통해 관리하고 있습니다. 한편, 해외 주요 권역별로 지역금융센터(미국, 영국, 싱가포르, 중국, 브라질, 아랍에미리트)에서 환율변동 모니터링 및 환거래 대행을 통해 환율변동위험을 관리하고 있으며, 권역내 자금을 통합운용하여 유동성위험에 대응하고 있습니다. 연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해관계자에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 건전한 자본구조를 유지하는 것입니다

				건전성 평가 등을 거쳐 시행하고 있습니다. 연결회사가 체결하는 금융계약은 부채비율 제한 조항, 담보제공, 차입금 회수 등의 제약조건이 없는 계약을 위주로 체결하고 있으며, 기타의 경우 별도의 승인을 받아 거래하고 있습니다.	를 대비하여 본사의 지급보증을 통해 해외 종속기업이 활용할 수 있는 차입한도를 확보하고 있으며, 보고기간종료일 현재 국제신용평가기관인 Moody's로부터 Aa2, S&P로부터 AA- 등 투자적격 등급을 부여받고 있어, 필요시 자본시장을 통해 적기에 자금조달이 가능합니다.	. 연결회사는 신용등급, 부채비율 등의 지표를 이용하여 자본위험을 관리하고 있습니다.

보고기간 말 현재 노출된 주가변동의 각 유형별 민감도 분석

당분기 (단위 : 백만원)

	위험 유형
	시장위험
	지분가격위험
	금융자산의 종류
	기타포괄손익-공정가치금융자산 및 당기손익-공정가치금융자산으로 분류된 지분상품
시장위험의 각 유형별 민감도분석 기술	지분상품(상장주식)의 주가가 1% 변동할 경우 기타포괄손익(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
시장변수 상승 시 당기손익 증가	1,100
시장변수 하락 시 당기손익 감소	1,100
시장변수 상승 시 기타포괄손익 증가	190,125
시장변수 하락 시 기타포괄손익 감소	190,125

전분기 (단위 : 백만원)

	위험 유형
	시장위험
	지분가격위험
	금융자산의 종류
	기타포괄손익-공정가치금융자산 및 당기손익-공정가치금융자산으로 분류된 지분상품

시장위험의 각 유형별 민감도분석 기술	지분상품(상장주식)의 주가가 1% 변동할 경우 기타포괄손익(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
시장변수 상승 시 당기손익 증가	1,141
시장변수 하락 시 당기손익 감소	1,141
시장변수 상승 시 기타포괄손익 증가	120,100
시장변수 하락 시 기타포괄손익 감소	120,100

부채비율에 대한 공시

당분기말 (단위 : 백만원)

	공시금액
부채	177,730,304
자본	614,111,577
부채비율	0.289
자본관리를 위한 기업의 목적, 정책 및 절차에 대한 비계량적 정보	연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해관계자에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 건전한 자본구조를 유지하는 것입니다. 연결회사는 신용등급, 부채비율 등의 지표를 이용하여 자본위험을 관리하고 있습니다.

전기말 (단위 : 백만원)

	공시금액
부채	130,621,773
자본	436,320,337
부채비율	0.299
자본관리를 위한 기업의 목적, 정책 및 절차에 대한 비계량적 정보	연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해관계자에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 건전한 자본구조를 유지하는 것입니다. 연결회사는 신용등급, 부채비율 등의 지표를 이용하여 자본위험을 관리하고 있습니다.

26. 공정가치측정 (연결)

금융자산의 공시

당분기말 (단위 : 백만원)

	현금및현금성자산	단기금융상품	당기손익-공정가치측정 금융자산	매출채권	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	기타	금융자산의 종류 합계
금융자산	90,800,375	123,973,901	1,619,495	106,097,351	24,648,280	61,305,846	408,445,248

금융자산, 공정가치			1,619,495		24,648,280	312,344	
공정가치 공시대상에서 제외한 사유	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.		장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.		장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 일부 금융자산 60,993,502백만원은 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	

전기말 (단위 : 백만원)

	현금및현금성자산	단기금융상품	당기손익-공정가치측정 금융자산	매출채권	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	기타	금융자산의 종류 합계
금융자산	57,856,378	67,965,021	1,306,216	51,127,642	16,295,005	20,635,421	215,185,683
금융자산, 공정가치			1,306,216		16,295,005	174,019	
공정가치 공시대상에서 제외한 사유	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.		장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.		장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 일부 금융자산 20,461,402백만원은 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	

금융부채의 공시

당분기말 (단위 : 백만원)

	매입채무	단기차입금	미지급금	장기차입금	사채	기타	금융부채의 종류 합계
금융부채	16,647,408	8,582,230	34,609,685	8,595,466	13,537	24,277,721	92,726,047
금융부채, 공정가치					14,874	337,978	

공정가치 공시대상에서 제외한 사유	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다. 리스부채는 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시'에 따라 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.		장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 일부 금융부채 23,939,743백만원은 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	

전기말 (단위 : 백만원)

	매입채무	단기차입금	미지급금	장기차입금	사채	기타	금융부채의 종류 합계
금융부채	13,039,380	17,574,980	24,775,665	7,649,932	14,227	14,386,337	77,440,521
금융부채, 공정가치					15,431	107,811	
공정가치 공시대상에서 제외한 사유	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다. 리스부채는 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시'에 따라 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.		장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 일부 금융부채 14,278,526백만원은 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	

자산의 공정가치측정에 대한 공시

당분기말 (단위 : 백만원)

	측정											
	공정가치											
	자산의 분류											
	당기손익-공정가치측정 금융자산				기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산				기타			
	공정가치 서열체계의 수준			공정가치 서열체계의 수준 합계	공정가치 서열체계의 수준			공정가치 서열체계의 수준 합계	공정가치 서열체계의 수준			공정가치 서열체계의 수준 합계
	수준 1	수준 2	수준 3		수준 1	수준 2	수준 3		수준 1	수준 2	수준 3	
자산	110,045	48,606	1,460,844	1,619,495	19,012,521	0	5,635,759	24,648,280	0	192,743	119,601	312,344

전기말 (단위 : 백만원)

	측정
	공정가치

	자산의 분류											
	당기손익-공정가치측정 금융자산				기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산				기타			
	공정가치 서열체계의 수준			공정가치 서열체계	공정가치 서열체계의 수준			공정가치 서열체계	공정가치 서열체계의 수준			공정가치 서열체계
	수준 1	수준 2	수준 3	의 수준 합계	수준 1	수준 2	수준 3	의 수준 합계	수준 1	수준 2	수준 3	의 수준 합계
자산	146,034	25,715	1,134,467	1,306,216	13,206,702	0	3,088,303	16,295,005	0	116,860	57,159	174,019

부채의 공정가치측정에 대한 공시

당분기말 (단위 : 백만원)

	측정							
	공정가치							
	부채의 분류							
	사채				기타			
	공정가치 서열체계의 수준			공정가치 서열체계	공정가치 서열체계의 수준			공정가치 서열체계
	수준 1	수준 2	수준 3	의 수준 합계	수준 1	수준 2	수준 3	의 수준 합계
부채	0	14,874	0	14,874	0	337,978	0	337,978

전기말 (단위 : 백만원)

	측정							
	공정가치							
	부채의 분류							
	사채				기타			
	공정가치 서열체계의 수준			공정가치 서열체계	공정가치 서열체계의 수준			공정가치 서열체계
	수준 1	수준 2	수준 3	의 수준 합계	수준 1	수준 2	수준 3	의 수준 합계
부채	0	15,431	0	15,431	0	107,811	0	107,811

금융상품의 공정가치측정에 대한 공시

	수준 1	수준 2	수준 3
공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 자산	동일한 자산에 대한 시장 공시가격	시장에서 관측가능한 투입변수를 활용한 공정가치 (단, '수준 1'에 포함된 공시가격은 제외)	관측가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치
공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 부채	동일한 부채에 대한 시장 공시가격	시장에서 관측가능한 투입변수를 활용한 공정가치 (단, '수준 1'에 포함된 공시가격은 제외)	관측가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치

평가기법 및 투입변수에 대한 기술

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며, 이러한 상품은 '수준 1'에 포함됩니다. '수준 1'에 포함된 상품은 대부분 기타포괄손익-공정가치금융자산으로 분류된 상장주식으로 구성됩니다.
활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 가치평가기법을 사용하여 측정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업고유정보는 최소한으로 사용됩니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 '수준 2'에 포함됩니다. '수준 2'에 포함된 상품은 파생상품, 사채 등이 있습니다.
만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 '수준 3'에 포함됩니다.
연결회사는 '수준 3'으로 분류되는 공정가치 측정을 포함하여 재무보고 목적의 공정가치를 측정하고 있습니다. 재무보고 일정에 맞추어 공정가치 평가 과정 및 그 결과에 대해 협의하고 있고, 공정가치 '수준' 간 이동을 발생시키는 사건이나 상황의 변동이 일어난 보고기간종료일에 '수준' 변동을 인식하고 있습니다.
금융상품의 공정가치를 측정하는 데 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.
- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격
- 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액을 현재가치로 할인하여 측정
나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법, 이항분포 모형 등의 기타 가치평가기법을 사용합니다. 유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타채권의 경우 장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다.
연결회사는 공정가치 서열체계에서 '수준 2'로 분류되는 통화선도, 회사채, 국공채, 금융채 등에 대하여 미래현금흐름을 적정이자율로 할인하는 현재가치법을 사용하고 있습니다.

수준 3으로 분류된 주요 금융상품에 대하여 사용된 가치평가기법 및 투입변수에 대한 공시

(단위 : 백만원)

	측정				
	공정가치				
	자산의 분류				
	공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산				기타금융자산
	삼성벤처투자㈜	㈜미코세라믹스	TCL China Star Optoelectronics Technology Co. Ltd. (CSOT)	China Star Optoelectronics Semiconductor Display Technology Ltd (CSOSDT)	지분 풋옵션
	공정가치 서열체계의 수준				
	공정가치 서열체계 수준 3				
자산	45,525	80,867	1,356,827	571,309	119,601
공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 자산	현금흐름할인법	현금흐름할인법 등	현금흐름할인법	현금흐름할인법	이항모형

공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 자산	영구성장률, 가중평균자본비용	영구성장률, 가중평균자본비용	영구성장률, 가중평균자본비용	영구성장률, 가중평균자본비용	무위험 이자율, 가격 변동성

자산의 공정가치측정에 사용된 관측가능하지 않은 투입변수에 대한 공시, 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산

	측정							
	공정가치							
	자산의 분류							
	공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산							
	삼성벤처투자㈜		㈜미코세라믹스		TCL China Star Optoelectronics Technology Co. Ltd. (CSOT)		China Star Optoelectronics Semiconductor Display Technology Ltd (CSOSDT)	
	공정가치측정에 사용된 평가기법							
	현금흐름할인법							
	관측할 수 없는 투입변수							
	영구성장률, 투입변수	가중평균자본비용, 측정 투입변수	영구성장률, 투입변수	가중평균자본비용, 측정 투입변수	영구성장률, 투입변수	가중평균자본비용, 측정 투입변수	영구성장률, 투입변수	가중평균자본비용, 측정 투입변수
유의적이지만 관측할 수 없는 투입변수, 자산	0.010	0.119	0.000	0.116	0.000	0.101	0.000	0.101

자산의 공정가치측정에 사용된 관측가능하지 않은 투입변수에 대한 공시, 기타 금융자산

	측정			
	공정가치			
	자산의 분류			
	기타금융자산			
	지분 풋옵션			
	공정가치측정에 사용된 평가기법			
	이항모형			
	관측할 수 없는 투입변수			
	무위험 이자율, 측정 투입변수		가격 변동성, 측정 투입변수	
	범위			
	하위범위	상위범위	하위범위	상위범위
유의적이지만 관측할 수 없는 투입변수, 자산	0.033	0.045	0.198	0.727

수준 3에 해당하는 금융상품의 변동 내역에 대한 공시

당분기 (단위 : 백만원)

	공정가치 서열체계의 수준
	수준 3
	자산의 분류
	공정가치로 측정하는 금융자산
기초	4,279,929
매입	3,059,751
매도	(263,988)
당기손익으로 인식된 손익	228,421
기타포괄손익으로 인식된 손익	207,510
기타	(295,420)
기말	7,216,203

전분기 (단위 : 백만원)

	공정가치 서열체계의 수준
	수준 3
	자산의 분류
	공정가치로 측정하는 금융자산
기초	4,406,446
매입	234,642
매도	(218,871)
당기손익으로 인식된 손익	589,047
기타포괄손익으로 인식된 손익	60,633
기타	(1,036,798)
기말	4,035,099

금융상품의 민감도분석 방법에 대한 기술

금융상품의 민감도분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에 따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다.

관측할 수 없는 투입변수의 변동으로 인한 공정가치측정의 민감도분석 공시, 자산

(단위 : 백만원)

	측정				
	공정가치				
	자산의 분류				
	기타포괄손익-공정가치금융자산			기타	
	관측할 수 없는 투입변수		관측할 수 없는 투입변수 합계	관측할 수 없는 투입변수	관측할 수 없는 투입변수 합계
	영구성장률, 투입변수	가중평균자본비용, 측정 투입변수		가격 변동성	

관측할 수 없는 투입변수의 가능성이 어느 정도 있는 증가율, 자산	0.01	0.01		0.05	
관측할 수 없는 투입변수의 가능성이 어느 정도 있는 감소율, 자산	0.01	0.01		0.05	
기타포괄손익(세전)으로 인식된, 가능성이 어느 정도 있고 대체할 수 있는 가정을 반영하기 위한 하나 이상의 관측할 수 없는 투입변수의 변동으로 인한 공정가치 측정치의 증가, 자산			555,475		
기타포괄손익(세전)으로 인식된, 가능성이 어느 정도 있고 대체할 수 있는 가정을 반영하기 위한 하나 이상의 관측할 수 없는 투입변수의 변동으로 인한 공정가치 측정치의 감소, 자산			(377,247)		
당기손익(세전)으로 인식된, 가능성이 어느 정도 있고 대체할 수 있는 가정을 반영하기 위한 하나 이상의 관측할 수 없는 투입변수의 변동으로 인한 공정가치 측정치의 증가, 자산					16,714

당기손익(세전)으로 인식된, 가능성이 어느 정도 있고 대체할 수 있는 가정을 반영하기 위한 하나 이상의 관측할 수 없는 투입변수의 변동으로 인한 공정가치 측정치의 감소, 자산					(16,496)

27. 부문별 보고 (연결)

보고부문을 식별하기 위하여 사용한 요소에 대한 기술

연결회사는 전략적 의사결정을 수립하는 경영진(경영위원회)에게 보고되는 사업 단위를 기준으로 보고부문을 결정하고 있습니다. 경영위원회는 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 부문의 영업이익을 기준으로 검토하고 있습니다. 매출은 대부분 재화의 매출로 구성되어 있습니다. 연결회사의 보고부문은 조직 및 수익을 창출하는 제품의 유형을 기준으로 식별되었으며, 보고기간종료일 현재 보고부문은 DX 부문, DS 부문, SDC, Harman 등으로 구성되어 있습니다.

보고부문 사이의 거래에 대한 회계처리 방법에 대한 기술

당분기와 전분기의 보고부문의 부문별 정보는 감가상각비, 무형자산상각비, 영업이익의 내부거래조정이 배분된 후로 작성되었으며, 보고부문별 자산과 부채는 경영위원회에 정기적으로 제공되지 않아 포함하지 않았습니다.

영업부문에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	부문의 합계											
	영업부문								내부거래 조정 등		부문의 합계 합계	
	부문								부문 합계			
	보고부문											
	DX 부문		DS 부문		SDC		Harman					
	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적
매출액	52,054,489	152,731,608	147,104,100	356,335,814	7,997,332	22,175,854	4,328,313	12,722,413	(16,231,025)	(43,339,566)	195,253,209	500,626,123
감가상각비	661,013	2,043,363	10,274,881	30,958,965	809,049	2,048,453	100,602	302,286	0	0	11,888,700	35,482,069
무형자산상각비	486,889	1,493,752	210,121	631,320	61,215	181,393	48,419	148,149	0	0	874,089	2,654,854
영업이익	(825,216)	1,323,661	106,536,477	249,395,770	1,106,855	2,150,208	607,353	1,244,179	0	0	107,440,482	254,165,691
보고부문에 대한 기술											기타는 별도로 표시하지 않았습니다.	기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

전분기

(단위 : 백만원)

	부문의 합계											
	영업부문								내부거래 조정 등		부문의 합계 합계	
	부문								부문 합계			
	보고부문											
	DX 부문		DS 부문		SDC		Harman					
	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적
매출액	48,375,095	143,662,466	33,116,786	86,122,879	8,101,525	20,348,428	3,953,656	11,203,022	(7,485,315)	(21,568,228)	86,061,747	239,768,567
감가상각비	659,436	1,979,493	9,575,775	28,055,033	596,025	1,814,475	87,941	261,667	0	0	10,961,595	32,248,891
무형자산상각비	479,271	1,318,111	208,885	621,010	58,526	174,691	49,312	150,703	0	0	857,453	2,445,669

영업이익	3,469,279	11,516,884	6,991,305	8,446,981	1,224,809	2,160,326	420,571	1,211,239	0	0	12,166,062	23,527,391
보고부문에 대한 기술											기타는 별도로 표시하지 않았습니다.	기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

제품과 용역에 대한 공시

당분기 (단위 : 백만원)

	제품과 용역								제품과 용역 합계	
	TV, 모니터 등		스마트폰 등		메모리		디스플레이 패널			
	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적
매출액	7,230,262	22,675,828	37,285,759	107,084,352	140,693,887	336,314,110	7,997,332	22,175,854	195,253,209	500,626,123
주요 제품별 매출액에 대한 기술									기타는 별도로 표시하지 않았습니다.	기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

전분기 (단위 : 백만원)

	제품과 용역								제품과 용역 합계	
	TV, 모니터 등		스마트폰 등		메모리		디스플레이 패널			
	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적
매출액	7,315,001	22,082,407	33,541,024	98,179,494	26,690,323	66,937,858	8,101,525	20,348,428	86,061,747	239,768,567
주요 제품별 매출액에 대한 기술									기타는 별도로 표시하지 않았습니다.	기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

지역에 대한 공시

당분기 (단위 : 백만원)

	부문의 합계												부문의 합계 합계	
	영업부문										연결실체 내 내부거래조정			
	지역										지역 합계			
	국내		외국											
			미주		유럽		아시아 및 아프리카		중국					
	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적
순매출액	14,864,661	40,499,862	100,565,573	243,931,649	16,961,428	47,993,072	19,739,793	53,645,344	43,121,754	114,556,196	0	0	195,253,209	500,626,123
비유동자산	196,609,759	196,609,759	40,001,687	40,001,687	8,480,173	8,480,173	9,387,974	9,387,974	9,202,144	9,202,144	(2,605,433)	(2,605,433)	261,076,304	261,076,304
비유동자산에 대한 기술													금융상품, 이연법인세자산, 관계기업 및 공동기업 투자 등이 제외된 금액입니다.	금융상품, 이연법인세자산, 관계기업 및 공동기업 투자 등이 제외된 금액입니다.

전분기 (단위 : 백만원)

	부문의 합계												부문의 합계 합계	
	영업부문										연결실체 내 내부거래조정			
	지역										지역 합계			
	국내		외국											
			미주		유럽		아시아 및 아프리카		중국					
	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적
순매출액	12,701,513	34,732,845	33,905,849	93,344,828	12,970,753	38,978,504	13,888,040	40,913,396	12,595,592	31,798,994	0	0	86,061,747	239,768,567
비유동자산	176,532,657	176,532,657	28,546,440	28,546,440	7,339,815	7,339,815	9,528,791	9,528,791	9,971,359	9,971,359	(588,857)	(588,857)	231,330,205	231,330,205

비유동자산에 대한 기술													금융상품, 이연법인세자산, 관계기업 및 공동기업 투자 등이 제외된 금액입니다.	금융상품, 이연법인세자산, 관계기업 및 공동기업 투자 등이 제외된 금액입니다.

28. 특수관계자와의 거래 (연결)

특수관계자거래에 대한 공시

당분기 (단위 : 백만원)

	특수관계자의 범주									
	모든 특수관계자의 합계									
	관계기업 및 공동기업					그 밖의 특수관계자		대규모기업집단		
	삼성에스디에스㈜	삼성전기㈜	삼성SDI㈜	㈜제일기획	기타	삼성물산㈜	기타	삼성이앤에이㈜	㈜에스원	기타
매출 등, 특수관계자거래	127,385	71,280	57,572	38,312	929,012	6,649	104,904	1,008	4,564	186,212
비유동자산 처분, 특수관계자거래	0	0	0	0	177	113	0	0	0	0
매입 등, 특수관계자거래	1,684,820	568,425	582,679	696,836	9,824,305	137,339	1,244,707	20,718	430,710	326,537
비유동자산 매입, 특수관계자거래	178,423	0	0	174	200,140	4,734,630	2,081,092	2,611,229	48,604	1,319,795
특수관계의 성격에 대한 기술								기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.	기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.	기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

전분기 (단위 : 백만원)

	특수관계자의 범주									
	모든 특수관계자의 합계									
	관계기업 및 공동기업					그 밖의 특수관계자		대규모기업집단		
	삼성에스디에스㈜	삼성전기㈜	삼성SDI㈜	㈜제일기획	기타	삼성물산㈜	기타	삼성이앤에이㈜	㈜에스원	기타
매출 등, 특수관계자거래	93,823	55,331	76,588	38,053	1,024,615	7,921	417,451	4,714	15,295	173,341
비유동자산 처분, 특수관계자거래	61	0	0	0	794	20	0	0	0	0
매입 등, 특수관계자거래	1,623,175	862,155	521,840	700,429	9,594,085	130,880	1,111,780	18,387	412,163	396,073
비유동자산 매입, 특수관계자거래	200,819	0	11,372	2,389	89,938	2,070,825	1,578,611	1,088,782	49,038	349,100

특수관계의 성격에 대한 기술								기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.	기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.	기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

특수관계자거래에 대한 공시, 합계

당분기 (단위 : 백만원)

	특수관계자의 범주		
	모든 특수관계자의 합계		
	관계기업 및 공동기업	그 밖의 특수관계자	대규모기업집단
매출 등, 특수관계자거래	1,223,561	111,553	191,784
비유동자산 처분, 특수관계자거래	177	113	0
매입 등, 특수관계자거래	13,357,065	1,382,046	777,965
비유동자산 매입, 특수관계자거래	378,737	6,815,722	3,979,628
특수관계의 성격에 대한 기술			기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

전분기 (단위 : 백만원)

	특수관계자의 범주		
	모든 특수관계자의 합계		
	관계기업 및 공동기업	그 밖의 특수관계자	대규모기업집단
매출 등, 특수관계자거래	1,288,410	425,372	193,350
비유동자산 처분, 특수관계자거래	855	20	0
매입 등, 특수관계자거래	13,301,684	1,242,660	826,623

비유동자산 매입, 특수관계자거래	304,518	3,649,436	1,486,920
특수관계의 성격에 대한 기술			기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

특수관계자거래의 채권·채무 잔액에 대한 공시

당분기말 (단위 : 백만원)

	특수관계자의 범주									
	모든 특수관계자의 합계									
	관계기업 및 공동기업					그 밖의 특수관계자		대규모기업집단		
	삼성에스디에스㈜	삼성전기㈜	삼성SDI㈜	㈜제일기획	기타	삼성물산㈜	기타	삼성이앤에이㈜	㈜에스원	기타
채권 등, 특수관계자거래	33,565	5,308	124,617	648	169,345	204,938	20,135	244	1,132	57,169
채무 등, 특수관계자거래	623,528	58,296	87,372	332,686	1,150,421	3,306,508	393,664	1,539,577	49,759	693,329
특수관계자거래의 채권,채무의 조건에 대한 설명	채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.
특수관계의 성격에 대한 기술								기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.	기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.	기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

전기말 (단위 : 백만원)

	특수관계자의 범주									
	모든 특수관계자의 합계									
	관계기업 및 공동기업					그 밖의 특수관계자		대규모기업집단		
	삼성에스디에스㈜	삼성전기㈜	삼성SDI㈜	㈜제일기획	기타	삼성물산㈜	기타	삼성이앤에이㈜	㈜에스원	기타
채권 등, 특수관계자거래	26,493	4,096	121,347	120	315,891	205,547	18,651	296	1,644	19,622
채무 등, 특수관계자거래	652,534	112,204	76,659	450,825	1,367,822	1,885,196	251,265	1,217,432	62,500	288,498
특수관계자거래의 채권,채무의 조건에 대한 설명	채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.

특수관계의 성격에 대한 기술								기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.	기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.	기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

특수관계자에 대한 채권 채무에 대한 공시, 합계

당분기말 (단위 : 백만원)

	특수관계자의 범주		
	모든 특수관계자의 합계		
	관계기업 및 공동기업	그 밖의 특수관계자	대규모기업집단
채권 등, 특수관계자거래	333,483	225,073	58,545
채무 등, 특수관계자거래	2,252,303	3,700,172	2,282,665
특수관계자거래의 채권,채무의 조건에 대한 설명	채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.
특수관계의 성격에 대한 기술			기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

전기말 (단위 : 백만원)

	특수관계자의 범주		
	모든 특수관계자의 합계		
	관계기업 및 공동기업	그 밖의 특수관계자	대규모기업집단
채권 등, 특수관계자거래	467,947	224,198	21,562
채무 등, 특수관계자거래	2,660,044	2,136,461	1,568,430
특수관계자거래의 채권,채무의 조건에 대한 설명	채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.

특수관계의 성격에 대한 기술			기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

연결회사는 당분기말 현재 삼성생명㈜, 삼성화재해상보험㈜에 확정급여형 퇴직급여제도에 가입되어 있습니다.

확정급여형 퇴직급여제도에 대한 공시, 특수관계자 거래

당분기말 (단위 : 백만원)

	삼성생명㈜	삼성화재해상보험㈜
사외적립자산 공정가치, 특수관계자 거래	23,988,052	546,171

전기말 (단위 : 백만원)

	삼성생명㈜	삼성화재해상보험㈜
사외적립자산 공정가치, 특수관계자 거래	19,784,116	490,107

특수관계자 자금거래에 관한 공시

당분기 (단위 : 백만원)

	특수관계자의 범주
	모든 특수관계자의 합계
	관계기업 및 공동기업
현금출자, 출자금 납입	0
현금출자, 출자금 회수	18,782

전분기 (단위 : 백만원)

	특수관계자의 범주
	모든 특수관계자의 합계
	관계기업 및 공동기업
현금출자, 출자금 납입	325,146
현금출자, 출자금 회수	4,123

특수관계자 기타 거래에 관한 공시

당분기 (단위 : 백만원)

	특수관계자의 범주
	모든 특수관계자의 합계

	관계기업 및 공동기업과 그 밖의 특수관계자	대규모기업집단
지급결의한 배당금, 특수관계자거래	1,407,154	114,719
리스 이용 계약, 특수관계자거래	11,776	
리스이용자로서 리스, 특수관계자거래	27,913	

전분기 (단위 : 백만원)

	특수관계자의 범주	
	모든 특수관계자의 합계	
	관계기업 및 공동기업과 그 밖의 특수관계자	대규모기업집단
지급결의한 배당금, 특수관계자거래	1,205,459	96,695
리스 이용 계약, 특수관계자거래	30,052	
리스이용자로서 리스, 특수관계자거래	39,214	

배당과 관련한 미지급금에 대한 공시, 특수관계자거래

(단위 : 백만원)

	특수관계자의 범주	
	모든 특수관계자의 합계	
	관계기업 및 공동기업과 그 밖의 특수관계자	대규모기업집단
배당과 관련한 미지급금, 특수관계자거래	0	0

특수관계자간의 금융상품 거래에 대한 공시

(단위 : 백만원)

	삼성생명㈜
금융상품매입, 특수관계자거래	1,943,692

금융상품 예치에 대한 공시, 특수관계자 거래

(단위 : 백만원)

	삼성생명㈜
예치된 금융상품, 특수관계자거래	1,943,692

주요 경영진에 대한 보상에 대한 공시

당분기 (단위 : 백만원)

	당해 기업이나 당해 기업의 지배기업의 주요 경영진
단기급여	13,855
퇴직급여	299
기타 장기급여	4,759

전분기 (단위 : 백만원)

	당해 기업이나 당해 기업의 지배기업의 주요 경영진
단기급여	5,625
퇴직급여	383
기타 장기급여	4,332

자기주식 매입 및 소각에 관한 공시, 특수관계자 거래

(단위 : 백만원)

	삼성SDI㈜
자기주식 취득, 삼성디스플레이㈜	4,450,000
자기주식 소각, 삼성디스플레이㈜	4,450,000

29. 보고기간 후 사건 (연결)

수정을 요하지 않는 보고기간후사건에 대한 공시

	자기주식 거래
수정을 요하지 않는 보고기간후사건의 성격에 대한 기술	연결회사는 2026년 8월 21일 이사회 결의에 따라 주식보상에 사용할 목적으로 자기주식을 취득하였으며, 보고기간종료일 이후 보통주 9,056,305주(취득가액 2,471,212백만원)를 취득하였습니다.

4. 재무제표

4-1. 재무상태표

재무상태표

제 58 기 3분기말 2026.09.30 현재

제 57 기말 2025.12.31 현재

(단위 : 백만원)

	제 58 기 3분기말	제 57 기말

자산		
유동자산	267,696,124	101,439,429
현금및현금성자산 (주3,26)	17,010,538	12,581,632
단기금융상품 (주3,26)	53,167,476	12,332,721
매출채권 (주3,26)	146,487,171	42,081,734
미수금 (주3,26)	3,742,574	2,146,762
선급비용	1,640,850	1,474,647
재고자산 (주5)	41,599,853	28,051,916
기타유동자산 (주3,26)	4,047,662	2,770,017
비유동자산	267,688,439	257,462,622
기타포괄손익-공정가치금융자산 (주3,4,26)	3,931,247	4,248,587
종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자 (주6)	59,968,254	59,498,635
유형자산 (주7)	169,023,885	155,360,355
무형자산 (주8)	10,025,672	11,233,489
순확정급여자산 (주11)	5,930,583	3,367,162
이연법인세자산	12,723,178	19,320,422
기타비유동자산 (주3,26)	6,085,620	4,433,972
자산총계	535,384,563	358,902,051
부채		
유동부채	97,272,216	72,935,381
매입채무 (주3,26)	21,214,568	14,247,155
단기차입금 (주3,9,26)	6,263,855	15,375,658
미지급금 (주3,26)	29,265,489	21,165,572
선수금 (주14)	542,988	450,101
예수금 (주3,26)	523,085	495,432
미지급비용 (주3,14,26)	12,219,420	11,031,657
당기법인세부채	19,681,268	3,811,821
유동성장기부채 (주3,9,10,26)	220,997	268,801
충당부채 (주12)	6,924,756	5,724,412
기타유동부채 (주3,14,26)	415,790	364,772
비유동부채	12,240,736	31,636,587
사채 (주3,10,26)	6,768	7,134
장기차입금 (주3,9,26)	4,718,965	23,399,087
장기미지급금 (주3,26)	3,701,239	5,223,964
장기충당부채 (주12)	2,948,215	2,226,960
기타비유동부채 (주3,14,26)	865,549	779,442
부채총계	109,512,952	104,571,968
자본		
자본금 (주15)	897,514	897,514

우선주자본금	119,467	119,467
보통주자본금	778,047	778,047
주식발행초과금	4,403,893	4,403,893
이익잉여금 (주16)	418,879,075	254,566,830
기타자본항목 (주17)	1,691,129	(5,538,154)
자본총계	425,871,611	254,330,083
부채와자본총계	535,384,563	358,902,051

4-2. 손익계산서

손익계산서

제 58 기 3분기 2026.01.01 부터 2026.09.30 까지

제 57 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지

(단위 : 백만원)

	제 58 기 3분기		제 57 기 3분기	
	3개월	누적	3개월	누적
매출액 (주27)	175,287,109	433,838,003	62,799,068	173,099,333
매출원가 (주18)	54,950,826	145,060,338	43,352,596	127,710,118
매출총이익	120,336,283	288,777,665	19,446,472	45,389,215
판매비와관리비 (주18,19)	17,568,888	51,363,532	11,505,386	34,788,024
영업이익 (주27)	102,767,395	237,414,133	7,941,086	10,601,191
기타수익 (주20)	378,251	2,700,446	2,906,570	8,973,815
기타비용 (주20)	84,452	233,011	23,397	119,295
금융수익 (주21)	2,897,455	9,548,027	929,216	4,698,947
금융비용 (주21)	11,817,962	17,021,401	1,051,849	4,297,353
법인세비용차감전순이익	94,140,687	232,408,194	10,701,626	19,857,305
법인세비용 (주22)	22,822,628	54,084,911	33,053	49,515
분기순이익	71,318,059	178,323,283	10,668,573	19,807,790
주당이익 (주23)				
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	10,869	27,065	1,601	2,954
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	10,677	26,725	1,601	2,953

4-3. 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 58 기 3분기 2026.01.01 부터 2026.09.30 까지

제 57 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지

(단위 : 백만원)

	제 58 기 3분기		제 57 기 3분기	
	3개월	누적	3개월	누적

분기순이익	71,318,059	178,323,283	10,668,573	19,807,790
기타포괄손익	(526,952)	(649,649)	595,202	1,138,828
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(526,952)	(649,649)	595,202	1,138,828
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 (주17)	(425,675)	(229,512)	666,620	1,267,890
순확정급여부채(자산) 재측정요소 (주17)	(101,277)	(420,137)	(71,418)	(129,062)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	0	0	0	0
분기총포괄손익	70,791,107	177,673,634	11,263,775	20,946,618

4-4. 자본변동표

자본변동표

제 58 기 3분기 2026.01.01 부터 2026.09.30 까지

제 57 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지

(단위 : 백만원)

	자본의 구성요소				
	자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	자본의 구성요소
2025.01.01 (기초자본)	897,514	4,403,893	233,734,316	(2,639,066)	236,396,657
분기순이익	0	0	19,807,790	0	19,807,790
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 (주17)	0	0	5,055	1,262,835	1,267,890
순확정급여부채(자산) 재측정요소 (주17)	0	0	0	(129,062)	(129,062)
배당 (주16)	0	0	(7,355,384)	0	(7,355,384)
자기주식의 취득 (주15)	0	0	0	(8,149,295)	(8,149,295)
자기주식 소각 (주15)	0	0	(3,049,040)	3,049,040	0
주식기준보상 (주17)	0	0	0	549,501	549,501
기타	0	0	0	(2,855)	(2,855)
2025.09.30 (분기말자본)	897,514	4,403,893	243,142,737	(6,058,902)	242,385,242
2026.01.01 (기초자본)	897,514	4,403,893	254,566,830	(5,538,154)	254,330,083
분기순이익	0	0	178,323,283	0	178,323,283
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 (주17)	0	0	(2,271)	(227,241)	(229,512)
순확정급여부채(자산) 재측정요소 (주17)	0	0	0	(420,137)	(420,137)
배당 (주16)	0	0	(8,662,695)	0	(8,662,695)
자기주식의 취득 (주15)	0	0	0	(25,778,665)	(25,778,665)
자기주식 소각 (주15)	0	0	(5,346,072)	5,346,072	0
주식기준보상 (주17)	0	0	0	28,309,254	28,309,254
기타	0	0	0	0	0
2026.09.30 (분기말자본)	897,514	4,403,893	418,879,075	1,691,129	425,871,611

4-5. 현금흐름표

현금흐름표

제 58 기 3분기 2026.01.01 부터 2026.09.30 까지

제 57 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지

(단위 : 백만원)

	제 58 기 3분기	제 57 기 3분기
영업활동현금흐름	156,492,025	51,532,619
영업에서 창출된 현금흐름	173,754,450	44,992,890

분기순이익	178,323,283	19,807,790
조정 (주24)	115,840,730	23,074,370
영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (주24)	(120,409,563)	2,110,730
이자의 수취	502,147	236,770
이자의 지급	(578,739)	(457,060)
배당금 수입	443,612	8,646,400
법인세 납부액	(17,629,445)	(1,886,381)
투자활동현금흐름	(89,809,934)	(22,881,284)
단기금융상품의 순감소(증가)	(41,014,795)	10,137,857
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	1,634	26,339
장기금융상품의 취득	(1,136,305)	0
종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 처분	41,523	146,732
종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 취득	(504,672)	(686,802)
유형자산의 처분	629,655	125,691
유형자산의 취득	(45,650,414)	(29,446,488)
무형자산의 처분	247	2,303
무형자산의 취득	(2,183,353)	(3,176,144)
정부보조금의 수취	8,264	0
기타투자활동으로 인한 현금유출입액	(1,718)	(10,772)
재무활동현금흐름	(62,252,418)	(19,381,765)
단기차입금의 순증가(감소)	(8,916,308)	(3,696,926)
사채 및 장기차입금의 차입	1,300,000	2,000,000
사채 및 장기차입금의 상환	(20,193,387)	(2,179,058)
배당금의 지급	(8,664,058)	(7,356,486)
자기주식의 취득	(25,778,665)	(8,149,295)
외화환산으로 인한 현금의 변동	(767)	(997)
환율변동 효과 적용 후 현금및현금성자산의 증가(감소)	4,428,906	9,268,573
기초현금및현금성자산	12,581,632	1,653,766
분기말의 현금및현금성자산	17,010,538	10,922,339

5. 재무제표 주석

1. 일반적 사항

삼성전자주식회사(이하 "회사")는 1969년 대한민국에서 설립되어 1975년에 대한민국의 증권거래소에 상장하였습니다. 회사의 사업은 DX 부문, DS 부문으로 구성되어있습니다. DX(Device eXperience) 부문은 TV, 냉장고, 스마트폰, 네트워크시스템 등의 사업으로 구성되어 있으며, DS(Device Solutions) 부문은 메모리, Foundry, System LSI 등으로 구성되어 있습니다. 회사의 본점 소재지는 경기도 수원시입니다.

회사의 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표입니다.

2. 중요한 회계처리방침

2.1. 재무제표 작성기준

회사의 2026년 9월 30일로 종료하는 9개월 보고기간에 대한 분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 분기재무제표는 보고기간종료일인 2026년 9월 30일 현재 유효한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

가. 회사가 채택한 제・개정 기준서

회사는 2026년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 주요 제・개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.

- 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정

실무에서 제기된 의문에 대응하고 새로운 요구사항을 포함하기 위해 기업회계기준서제1109호 '금융상품'과 제1107호 '금융상품: 공시'가 개정되었습니다. 주요 개정사항은 다음과 같으며 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 특정 기준을 충족하는 경우, 결제일 전에 전자지급시스템을 통해 금융부채가 결제된 것으로(제거된 것으로) 간주할 수 있도록 허용
- 금융자산이 원리금 지급만으로 구성되어 있는지의 기준을 충족하는지 평가하기 위한 지침을 명확히 하고 추가
- 계약상 현금흐름의 시기나 금액을 변경시키는 계약조건이 기업에 미치는 영향과 기업이 노출되는 정도를 금융상품의 각 종류별로 공시
- 기타포괄손익-공정가치금융자산(지분상품)에 대한 추가 공시

나. 회사가 적용하지 않은 제・개정 기준서

제정 또는 공표됐으나 2026년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지않았고, 회사가 조기 적용하지 않은 주요 제・개정 기준서는 다음과 같습니다.

- 기업회계기준서 제1118호 '재무제표 표시와 공시' 제정

기업회계기준서 제1118호 '재무제표 표시와 공시'는 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시'를 대체합니다. 이 기준서는 2027년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용하며 조기 적용을 허용하나, 회사는 분기재무제표 작성 시
새로운 기준서를 조기 적용하지 않았습니다.

기업회계기준서 제1118호는 보다 구조화된 손익계산서와 정보의 세분화를 요구합니다. 회사는 기업회계기준서 제1118호의 도입이 재무제표에 미칠 것으로 예상되는 영향을 분석 중에 있습니다.

최초 적용기간의 예상되는 영향은 아래에 기술되어 있으며, 2027년 1월 1일에 새로운 기준서를 적용함에 따른 실제 영향은 다음의 사유로 달라질 수 있습니다.

- 회사는 절차와 통제의 변경에 대한 설계와 평가를 완료하지 않았고,
- 이 기준서에 따라 작성되는 최초의 연차재무제표를 발행할 때까지 새로운 회계정책은 변경될 수 있습니다.

[손익계산서의 구조]

기업회계기준서 제1118호는 모든 수익과 비용을 영업 범주, 투자 범주, 재무 범주, 법인세 범주, 중단영업 범주라는 다섯 가지 범주 중 하나로 분류하도록 요구합니다. 수익과 비용의 범주별 분류는 기업의 주된 사업활동에 따라 달라집니다. 회사는 자산 투자 또는 고객에게 금융을 제공하는 것과 같은 특정한 사업활동을 주된 사업활동으로 평가하지 않았습니다.
기업회계기준서 제1118호의 적용으로 회사의 당기순이익이나 순자산은 변경되지 않을 것입니다. 그러나 회사는 새롭게 정의된 두 개의 중간합계인 '영업이익'과 '재무손익및법인세비용차감전손익'을 표시해야 하며, 영업이익 중간합계는 현재 회사가 표시하는 영업이익과는 다릅니다. 회사는 현재 입수 가능한 정보에 기초하여 기업회계기준서 제1118호의 적용 영향에 대한 전반적인 예비 평가를 수행하였으며, 그 결과 다음과 같은 잠재적 영향이 식별되었습니다.

- 이자수익과 이자비용은 회사의 현재 회계정책에 따라 일반적으로 금융수익과 금융비용으로 표시하고 있습니다. 기업회계기준서 제1118호는 투자 범주와 재무 범주로 분류되는 수익과 비용에 대한 구체적인 지침을 제공하며, 기업회계기준서 제1118호에 따라

  - 회사가 보유한 특정 금융자산에서 발생하는 이자수익(예: 현금및현금성자산에서 발생하는 이자수익)은 투자 범주로 분류하여 표시될 예정입니다.

  - 특정 부채에서 발생하는 이자비용(당기손익-공정가치로 측정하지 않는 금융부채에서 발생하는 이자비용)은 재무 범주로 분류하여 표시될 예정입니다.

- 현재 외환거래 및 환산으로 인해 발생한 외환차이는 금융수익 및 금융비용으로 표시되고 있습니다. 기업회계기준서 제1118호에 따르면 외환차이는 해당 외환차이를 발생시킨 항목에서 발생하는 수익과 비용이 해당되는 범주와 동일한 범주로 분류해야 합니다. 회사는 외환차이가 영업, 투자 및 재무 범주로 분류될 수 있다고 판단하였습니다. 예를 들면, 매입채무에 대한 외환차이는 영업 범주로 분류될 것입니다.

- 현금흐름위험회피수단으로 지정된 금융상품에서 발생하는 손익 중 효과적인 위험회피 부분은 기타포괄손익으로 인식하고 있으며, 위험회피에 효과적이지 않은 부분은 당기손익으로 인식하여 금융수익 및 금융비용으로 표시하고 있습니다. 기업회계기준서 제1118호에 따라 당기손익으로 인식되는 위험회피수단 관련 손익은 해당 금융상품을 사용하여 관리하고자 하는 위험의 영향을 받는 수익 또는 비용이 분류되는 범주와 동일한 범주로 분류해야 합니다.

기업회계기준서 제1118호에서 영업비용은 성격별, 기능별 또는 혼합 표시 방식을 사용하여 별도 표시항목으로 분류하고 표시합니다. 회사는 혼합 표시 방식을 사용하는 것이 영업비용의 가장 유용한 구조화된 요약 정보를 제공할 것으로 판단하였습니다.

[경영진이 정의한 성과측정치(MPM)]

경영진이 정의한 성과측정치(MPM)는 재무제표와 구분하여 공개적인 의사소통에 사용되는 수익과 비용의 중간합계로 기업 전체의 재무성과 측면에 대한 경영진의 견해를 재무제표 이용자에게 전달합니다. 회사는 MPM에 관한 구체적인 정보를 재무제표에서 하나의 주석으로 공시해야 합니다.

회사는 MPM을 식별할 때 관련성이 있는 공개적인 의사소통이 무엇인지 결정하기 위한 프로세스를 개발하였습니다. MPM은 재무제표와 동일한 보고기간과 관련되어 있습니다. 따라서 회사가 기업회계기준서 제1118호를 채택한 이후 공시할 MPM은 2027년 중간 보고기간과 관련하여 회사가 발표하는 공개적인 의사소통을 기초로 결정될 예정입니다.

[통합과 세분화의 원칙]

기업회계기준서 제1118호는 재무제표(즉, 주요 재무제표와 주석)에서 정보를 유형별로 구분하여 표시하는 방법에 대해 강화된 원칙을 제공합니다. 또한 주요 재무제표에표시되거나 주석에 공시되는 항목에 명칭을 부여하고 설명하는 방식에 대한 지침도 도입했습니다.

회사는 유사하거나 다른 특성을 기준으로 항목들을 통합하고 세분화하기 위해 평가하고 있습니다. 이 평가를 바탕으로 주요 재무제표에는 유용한 구조화된 요약 정보를제공하는 항목들을 표시하고, 주석에는 추가적인 중요한 정보를 공시할 예정입니다.

또한, 회사는 현재 '기타'로 표시된 항목들을 검토하고 있으며 향후 더욱 유용한 명칭을 사용할 예정입니다.

[타기준서 개정]

기업회계기준서 제1118호의 제정으로 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표' 기준서가 개정되었습니다. 간접법으로 영업활동 현금흐름을 표시할 때, 새롭게 정의된 '영업이익' 중간합계를 간접법의 출발점으로 사용해야 합니다. 회사는 현재 영업활동 현금흐름의 출발점으로 '당기순이익'을 사용하고 있습니다.

이에 따라 간접법의 출발점에 대한 조정항목 중 일부가 변경될 것입니다. 예를 들어, 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자에서 발생한 배당금수익은 출발점인 영업이익에 포함되지 않으므로 더 이상 조정 항목이 아닙니다. 이러한 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자로부터 수취한 현금 배당금은 투자활동 현금흐름에 포함됩니다.

또한 기업회계기준서 제1007호 개정사항은 이자 및 배당 현금흐름의 분류에 관한 구체적인 지침을 제공합니다. 회사는 이 지침에 따라 이자의 수취 및 배당금 수입에 따른 현금흐름을 영업활동이 아닌 투자활동으로, 이자의 지급에 따른 현금흐름을 영업활동이 아닌 재무활동으로 분류할 예정입니다. 배당금의 지급은 기존과 동일하게 재무활동으로 분류됩니다.

2.2. 회계정책

분기재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책과 계산방법은 주석 2.1에서 설명하는 제・개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 2025년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해 글로벌최저한세를 고려하여 추정한 가중평균연간 법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

2.3. 중요한 회계추정 및 가정

분기재무제표 작성시 회사의 경영진은 회계정책의 적용과 보고되는 자산·부채의 장부금액 및 이익·비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.

분기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 2025년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

3. 범주별 금융상품

금융자산의 범주별 공시

당분기말 (단위 : 백만원)

		상각후원가 측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	금융자산의 범주 합계
금융자산 합계		225,916,088	3,931,247	229,847,335
금융자산 합계	현금및현금성자산	17,010,538	0	17,010,538
	단기금융상품	53,167,476	0	53,167,476
	매출채권	146,487,171	0	146,487,171
	기타포괄손익-공정가치금융자산	0	3,931,247	3,931,247
	기타금융자산	9,250,903	0	9,250,903

전기말 (단위 : 백만원)

		상각후원가 측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	금융자산의 범주 합계
금융자산 합계		72,508,543	4,248,587	76,757,130
금융자산 합계	현금및현금성자산	12,581,632	0	12,581,632
	단기금융상품	12,332,721	0	12,332,721
	매출채권	42,081,734	0	42,081,734
	기타포괄손익-공정가치금융자산	0	4,248,587	4,248,587
	기타금융자산	5,512,456	0	5,512,456

금융부채의 범주별 공시

당분기말 (단위 : 백만원)

		상각후원가 측정 금융부채	기타금융부채	금융부채의 범주 합계
금융부채 합계		62,968,910	7,097,048	70,065,958
금융부채 합계	매입채무	21,214,568	0	21,214,568
	단기차입금	0	6,263,855	6,263,855
	미지급금	29,100,548	0	29,100,548
	유동성장기부채	6,769	214,228	220,997
	사채	6,768	0	6,768
	장기차입금	4,100,000	618,965	4,718,965
	장기미지급금	3,109,488	0	3,109,488
	기타금융부채	5,430,769	0	5,430,769

전기말 (단위 : 백만원)

		상각후원가 측정 금융부채	기타금융부채	금융부채의 범주 합계
금융부채 합계		66,959,491	16,236,453	83,195,944
금융부채 합계	매입채무	14,247,155	0	14,247,155
	단기차입금	0	15,375,658	15,375,658
	미지급금	20,822,393	0	20,822,393
	유동성장기부채	7,093	261,708	268,801
	사채	7,134	0	7,134
	장기차입금	22,800,000	599,087	23,399,087
	장기미지급금	4,639,493	0	4,639,493
	기타금융부채	4,436,223	0	4,436,223

당기 및 전기 기타금융부채에 대한 각주

기타금융부채는 담보부차입금과 기업회계기준서 제1109호의 금융부채의 범주로 분류되지 않는 리스부채 등을 포함하고 있습니다.

4. 공정가치금융자산

기타포괄손익-공정가치 측정 항목으로 지정된 지분상품 투자의 공정가치에 대한 공시

당분기말 (단위 : 백만원)

	금융자산의 범주
	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
	지분상품
금융자산	3,931,247

전기말 (단위 : 백만원)

	금융자산의 범주

	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
	지분상품
금융자산	4,248,587

공정가치금융자산 중 상장주식 세부내역에 대한 공시

당분기말 (단위 : 백만원)

| | 측정 | | |

당분기말 (단위 : 백만원)

		평가전금액	재고자산 평가충당금	장부금액 합계
재고자산		44,887,099	(3,287,246)	41,599,853
재고자산	제품 및 상품	5,886,587	(636,182)	5,250,405
	반제품 및 재공품	30,930,791	(2,058,905)	28,871,886
	원재료 및 저장품	7,462,774	(592,159)	6,870,615
	미착품	606,947	0	606,947

전기말 (단위 : 백만원)

		평가전금액	재고자산 평가충당금	장부금액 합계
재고자산		32,210,803	(4,158,887)	28,051,916
재고자산	제품 및 상품	5,147,484	(1,269,403)	3,878,081
	반제품 및 재공품	22,182,027	(2,487,276)	19,694,751
	원재료 및 저장품	4,342,662	(402,208)	3,940,454
	미착품	538,630	0	538,630

6. 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자

가. 당분기 및 전분기 중 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전분기
기초장부금액	59,498,635	57,427,196
취득	504,672	1,860,346
처분	(35,053)	(146,730)
분기말장부금액	59,968,254	59,140,812

나. 보고기간종료일 현재 주요 관계기업 투자 현황은 다음과 같습니다.

(종속기업 현황은 주석 28 참조)

기업명	관계의 성격	지분율 (%)(*1)	주사업장	결산월
삼성전기㈜(*2)	수동소자, 회로부품, 모듈 등 전자부품의 생산 및 공급	23.7	한국	12월
삼성에스디에스㈜	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합・관리 등 IT 서비스 및 물류서비스 제공	22.6	한국	12월
삼성바이오로직스㈜(*3)	신사업 투자	31.2	한국	12월
삼성에피스홀딩스㈜(*3)	신사업 투자	31.2	한국	12월
삼성SDI㈜(*4)	2차전지 등 전자부품의 생산 및	19.4	한국	12월

	공급			
㈜제일기획(*5)	광고 대행업	25.2	한국	12월

(*1) 총발행보통주식수 기준 지분율입니다.
(*2) 유통보통주식수 기준 지분율은 24.3%입니다.
(*3) 유통보통주식수 기준 지분율은 31.3%입니다.
(*4) 유통보통주식수 기준 지분율은 20.3%입니다.
(*5) 유통보통주식수 기준 지분율은 28.7%입니다.

다. 보고기간종료일 현재 시장성 있는 관계기업 투자주식의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주, 백만원)

구 분	당분기말			전기말	
	주식수	시장가치	장부금액	시장가치	장부금액
삼성전기㈜	17,693,084	26,769,636	445,244	4,511,736	445,244
삼성에스디에스㈜	17,472,110	3,826,392	560,827	2,996,467	560,827
삼성바이오로직스㈜	14,449,944	20,099,872	1,410,104	24,492,655	1,410,104
삼성에피스홀딩스㈜	7,767,364	2,687,508	185,788	5,771,151	185,788
삼성SDI㈜	15,663,968	8,066,944	1,614,403	4,221,439	1,614,403
㈜제일기획	29,038,075	544,174	491,599	609,800	491,599

7. 유형자산

유형자산(사용권자산 포함)의 변동 내용에 대한 공시

당분기 (단위 : 백만원)

	공시금액
기초 유형자산	155,360,355
일반취득 및 자본적지출, 유형자산	43,371,241
감가상각비, 유형자산	(29,067,750)
유형자산의 처분, 폐기 및 손상	(422,459)
기타 변동을 통한 증가(감소), 유형자산	(217,502)
분기말 유형자산	169,023,885

전분기 (단위 : 백만원)

	공시금액
기초 유형자산	151,446,870
일반취득 및 자본적지출, 유형자산	24,326,178
감가상각비, 유형자산	(26,063,220)
유형자산의 처분, 폐기 및 손상	(131,349)

기타 변동을 통한 증가(감소), 유형자산	(131,673)
분기말 유형자산	149,446,806

감가상각비의 기능별 배분

당분기 (단위 : 백만원)

	매출원가	판매비와관리비 등	성격별 비용의 기능별 배분 합계
감가상각비, 유형자산	25,655,580	3,412,170	29,067,750

전분기 (단위 : 백만원)

	매출원가	판매비와관리비 등	성격별 비용의 기능별 배분 합계
감가상각비, 유형자산	23,625,743	2,437,477	26,063,220

사용권자산에 대한 양적 정보 공시

당분기말 (단위 : 백만원)

	유형자산
사용권자산	1,402,068

전기말 (단위 : 백만원)

	유형자산
사용권자산	1,479,088

사용권자산의 추가와 감가상각비에 대한 공시

당분기 (단위 : 백만원)

	유형자산
사용권자산의 추가	171,193
감가상각비, 사용권자산	(244,133)

전분기 (단위 : 백만원)

	유형자산
사용권자산의 추가	132,676
감가상각비, 사용권자산	(236,944)

8. 무형자산

무형자산에 대한 세부 정보 공시

당분기 (단위 : 백만원)

	공시금액

기초 무형자산	11,233,489
개별취득, 무형자산	952,522
상각, 무형자산	(2,170,848)
처분, 폐기, 손상, 무형자산	(13,249)
기타, 무형자산	23,758
분기말 무형자산	10,025,672

전분기 (단위 : 백만원)

	공시금액
기초 무형자산	10,496,956
개별취득, 무형자산	3,109,412
상각, 무형자산	(2,035,080)
처분, 폐기, 손상, 무형자산	(19,766)
기타, 무형자산	16,515
분기말 무형자산	11,568,037

무형자산상각비의 기능별 배분

당분기 (단위 : 백만원)

	매출원가	판매비와관리비 등	성격별 비용의 기능별 배분 합계
무형자산상각비	1,627,651	543,197	2,170,848

전분기 (단위 : 백만원)

	매출원가	판매비와관리비 등	성격별 비용의 기능별 배분 합계
무형자산상각비	1,533,373	501,707	2,035,080

9. 차입금

단기차입금에 대한 세부 정보

당분기말 (단위 : 백만원)

	차입금 명칭		
	담보부차입금		
	거래상대방		
	우리은행 등		
	범위		범위 합계
	하위범위	상위범위	
연이자율	0.015	0.158	
단기차입금			6,263,855
차입금에 대한 기술			담보부차입금과 관련하여 매출채권을 담보로 제공하였습니다.

전기말 (단위 : 백만원)

	차입금 명칭		
	담보부차입금		
	거래상대방		
	우리은행 등		
	범위		범위 합계
	하위범위	상위범위	
연이자율			
단기차입금			15,375,658
차입금에 대한 기술			담보부차입금과 관련하여 매출채권을 담보로 제공하였습니다.

유동성장기차입금에 대한 세부 정보

당분기말 (단위 : 백만원)

	차입금 명칭
	리스 부채
	거래상대방
	-
연이자율	0.026
유동성장기차입금	214,228

전기말 (단위 : 백만원)

	차입금 명칭
	리스 부채
	거래상대방
	-
연이자율	
유동성장기차입금	261,708

장기차입금에 대한 세부 정보

당분기말 (단위 : 백만원)

	차입금 명칭								차입금 명칭 합계
	리스 부채	무담보차입금	은행차입금						
	거래상대방	거래상대방	거래상대방						
	-	삼성디스플레이㈜	한국산업은행			한국산업은행 등			
	범위 합계	범위 합계	범위		범위 합계	범위		범위 합계	
			하위범위	상위범위		하위범위	상위범위		
최종 만기일		2026.05.29			2035.04.30			2031.09.16	
연이자율	0.026	0.039	0.029	0.031		0.038	0.045		

장기차입금	618,965	0			3,600,000			500,000	4,718,965

전기말 (단위 : 백만원)

	차입금 명칭								차입금 명칭 합계
	리스 부채	무담보차입금	은행차입금						
	거래상대방	거래상대방	거래상대방						
	-	삼성디스플레이㈜	한국산업은행			한국산업은행 등			
	범위 합계	범위 합계	범위		범위 합계	범위		범위 합계	
			하위범위	상위범위		하위범위	상위범위		
최종 만기일									
연이자율									
장기차입금	599,087	20,000,000			2,800,000			0	23,399,087

리스부채 이자비용에 대한 공시

당분기 (단위 : 백만원)

	공시금액
리스부채에 대한 이자비용	16,801
리스부채 이자비용에 대한 설명	리스부채와 관련하여 연이자율은 가중평균증분차입이자율이며, 당분기 중 발생한 이자비용은 16,801백만원(전분기: 19,855백만원)입니다.

전분기 (단위 : 백만원)

	공시금액
리스부채에 대한 이자비용	19,855
리스부채 이자비용에 대한 설명	리스부채와 관련하여 연이자율은 가중평균증분차입이자율이며, 전분기 중 발생한 이자비용은 19,855백만원입니다.

10. 사채

사채에 대한 세부 정보 공시

당분기말 (단위 : 백만원)

	차입금 명칭		
	US$ denominated Straight Bonds		
	장부금액		장부금액 합계
	총장부금액	할인발행차금	
발행일			1997-10-02
만기상환일			2027-10-01
연이자율			0.077
명목금액, 기초통화금액 (USD) [USD, 천]			10,000
사채	13,584	(47)	13,537
차감: 유동성사채			(6,769)

비유동성사채			6,768
사채에 대한 기술			10년 거치 20년 분할상환되며 이자는 6개월마다 후급됩니다.

전기말 (단위 : 백만원)

	차입금 명칭		
	US$ denominated Straight Bonds		
	장부금액		장부금액 합계
	총장부금액	할인발행차금	
발행일			
만기상환일			
연이자율			
명목금액, 기초통화금액(USD) [USD, 천]			10,000
사채	14,349	(122)	14,227
차감: 유동성사채			(7,093)
비유동성사채			7,134
사채에 대한 기술			10년 거치 20년 분할상환되며 이자는 6개월마다 후급됩니다.

11. 순확정급여부채(자산)

확정급여제도에 대한 공시

당분기말 (단위 : 백만원)

	전부 또는 부분적으로 기금이 적립되는 확정급여제도	전부 기금이 적립되지 않는 확정급여제도	확정급여제도의 기금 적립약정 합계
확정급여채무, 현재가치	12,977,959	11,189	12,989,148
사외적립자산의 공정가치			(18,919,731)
순확정급여부채(자산) 계			(5,930,583)

전기말 (단위 : 백만원)

	전부 또는 부분적으로 기금이 적립되는 확정급여제도	전부 기금이 적립되지 않는 확정급여제도	확정급여제도의 기금 적립약정 합계
확정급여채무, 현재가치	12,682,447	10,934	12,693,381
사외적립자산의 공정가치			(16,060,543)
순확정급여부채(자산) 계			(3,367,162)

당기손익에 포함되는 퇴직급여비용에 대한 공시

당분기 (단위 : 백만원)

	매출원가	판매비와관리비 등	성격별 비용의 기능별 배분 합계
당기근무원가, 확정급여제도			838,521
과거근무원가, 확정급여제도			531,637
순이자비용(수익), 확정급여제도			(116,928)
퇴직급여비용 합계, 확정급여제도	517,898	735,332	1,253,230

전분기 (단위 : 백만원)

	매출원가	판매비와관리비 등	성격별 비용의 기능별 배분 합계
당기근무원가, 확정급여제도			865,364
과거근무원가, 확정급여제도			0
순이자비용(수익), 확정급여제도			(86,054)
퇴직급여비용 합계, 확정급여제도	322,472	456,838	779,310

당분기 및 전분기 중 확정급여제도 관련 비용에 대한 각주

과거근무원가에는 평균임금 범위 변경 판결에 따라 확정급여제도에 미치는 영향이 포함되어 있습니다.

12. 충당부채

충당부채에 대한 공시

(단위 : 백만원)

	판매보증	기술사용료	장기성과급	기타	충당부채 합계
기초	665,411	2,218,998	588,887	4,478,076	7,951,372
순전입(환입)	355,553	1,663,654	167,840	2,240,955	4,428,002
사용	(410,519)	(755,765)	(104,106)	(633,592)	(1,903,982)
기타	0	(218,943)	(327,958)	(55,520)	(602,421)
기말	610,445	2,907,944	324,663	6,029,919	9,872,971

충당부채의 성격에 대한 기술	회사는 출고한 제품에 대한 품질보증, 교환, 하자보수 및 그에 따른 사후서비스 등으로 인하여 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 보증기간 및 과거 경험률 등을 기초로 추정하여 충당부채로 설정하고 있습니다.	회사는 협상 진행 중인 기술사용계약과 관련하여 향후 지급이 예상되는 기술사용료를 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다. 지급시기 및 금액은 협상결과에 따라 변동될 수 있습니다.	회사는 임원을 대상으로 부여연도를 포함한 향후 3년간의 경영실적에 따라 성과급을 지급하는 장기성과 인센티브를 부여한 바, 향후 지급이 예상되는 금액의 경과 기간 해당분을 충당부채로 계상하고 있습니다. 당분기중 일부를 주식으로 지급하기로 한 약정에 따라 기타자본으로 대체하였습니다.	회사는 생산 및 판매 중단한 제품에 대하여 향후 부담할 것으로 예상되는 비용 등을 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다. 회사는 온실가스 배출과 관련하여 해당 이행연도분 배출권의 장부금액과 이를 초과하는 배출량에 대해 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다.	

기타 변동에 대한 기술, 기타충당부채

기타는 계정재분류 및 환율변동에 의한 증감액 등을 포함하고 있습니다.

무상할당 배출권의 수량에 대한 공시

	2026년(당기 이행연도)
무상할당 배출권 (톤(tCO2-eq))	17,180,000
배출량 추정치 (톤(tCO2-eq))	14,670,000

온실가스 배출권의 변동내역 대한 공시

당분기 (단위 : 백만원)

	공시금액
기초 배출권	3,137
증가	1,680
사용	0
기말 배출권	4,817

전분기 (단위 : 백만원)

	공시금액
기초 배출권	3,137
증가	0
사용	0
기말 배출권	3,137

배출부채에 대한 각주

당분기 및 전분기 중 회사가 재무제표에 인식한 배출부채는 없습니다.

13. 우발부채와 약정사항

보증 관련 우발부채, 비 PF 우발부채에 대한 공시

(단위 : 백만원)

	지급보증의 구분				
	제공한 지급보증				제공받은 지급보증
	해외종속기업 (SETK) 자금조달 등을 위한 채무보증	해외종속기업(기타) 자금조달 등을 위한 채무보증	해외종속기업 자금조달 등을 위한 채무보증 합계	해외종속기업 계약이행을 위한 지급보증	해외종속기업 계약이행을 위한 지급보증
피보증처명	SETK	기타			
보증처	BNP 외	기타			
채무보증한도	1,204,901	9,902,245	11,107,146	536,661	
차입금	189,814	0	189,814		
지급보증에 대한 비고(설명)				당분기말 현재 회사가 해외종속기업의 계약이행을 위하여 제공하고 있는 지급보증 한도액은 536,661백만원입니다.	당분기말 현재 회사가 특수관계자로부터 제공받고 있는 담보 및 지급보증은 없습니다.
보증종료일	2027-06-13				

보증 관련 우발부채, 비 PF 우발부채에 대한 공시, 외화금액

	지급보증의 구분
	제공한 지급보증
	해외종속기업 자금조달 등을 위한 채무보증 합계
기업의(으로의) 보증한도 (비 PF), USD [USD, 천]	8,176,639
차입금(사채 포함), USD [USD, 천]	139,733

법적소송우발부채에 대한 공시

	법적소송우발부채
의무의 성격에 대한 기술, 우발부채	당분기말 현재 다수의 회사 등과 정상적인 영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 및 규제기관의 조사 등이 진행 중에 있습니다.

유출될 경제적효익의 금액과 시기에 대한 불확실성 정도, 우발부채	이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 회사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

분할과 관련된 연대채무 사실에 대한 기술

회사와 삼성디스플레이㈜ 등은 분할된 삼성디스플레이㈜ 등의 분할 전 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다.

약정에 대한 공시

(단위 : 백만원)

	약정의 유형
	매입약정
	발생하지 않은 유무형자산의 취득
약정 금액	21,530,062
약정에 대한 설명	당분기말 현재 발생하지 않은 유・무형자산의 취득을 위한 약정액은 21,530,062백만원입니다.

14. 계약부채

계약부채에 대한 공시

당분기말 (단위 : 백만원)

	공시금액
계약부채	3,210,681

전기말 (단위 : 백만원)

	공시금액
계약부채	2,433,647

계약부채에 대한 기술

계약부채는 선수금, 미지급비용, 기타유동부채 등에 포함되어 있습니다.

15. 자본금

주식의 분류에 대한 공시

(단위 : 백만원)

	보통주	우선주	주식의 종류 합계
회사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수(단위: 주)			25,000,000,000
주당 액면가액(원)			100

발행주식 액면 총액(백만원)	584,628	80,237	664,865
납입자본금(백만원)			897,514
자본금에 대한 설명			발행주식의 액면총액은 664,865백만원(보통주 584,628백만원, 우선주 80,237백만원)으로 이익소각으로 인하여 납입자본금 897,514백만원과 상이합니다.
각 종류별 주식에 부여된 권리, 우선권 및 제한사항			보고기간종료일 현재 회사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 250억주(1주의 액면금액: 100원)이며, 회사에는 보통주 외 비누적적 우선주가 있습니다. 이 우선주는 의결권이 없고 액면금액을 기준으로 보통주의 배당보다 연 1%의 금전배당을 추가로 받을 수 있습니다.

주식에 대한 공시

당분기말

	보통주	우선주
기초 유통주식수(단위: 주)	5,827,808,935	802,371,203
자기주식 취득주식수(단위: 주)	(121,265,072)	0
자기주식 지급주식수(단위: 주)	12,063,951	0
기말 유통주식수(단위: 주)	5,718,607,814	802,371,203
소각주식 수를 제외한 발행주식수(단위: 주)	5,846,278,608	802,371,203

유통주식수에 대한 기술	보고기간종료일 현재 회사가 발행한 보통주 및 우선주의 수(소각 주식수 제외)는 각각 5,846,278,608주와 802,371,203주이며, 유통주식수는 자기주식 취득으로 인하여 발행주식의 총수와 차이가 있습니다. 한편, 발행주식의 액면총액은 664,865백만원(보통주 584,628백만원, 우선주 80,237백만원)으로 이익소각으로 인하여 납입자본금 897,514백만원과 상이합니다.	보고기간종료일 현재 회사가 발행한 보통주 및 우선주의 수(소각 주식수 제외)는 각각 5,846,278,608주와 802,371,203주이며, 유통주식수는 자기주식 취득으로 인하여 발행주식의 총수와 차이가 있습니다. 한편, 발행주식의 액면총액은 664,865백만원(보통주 584,628백만원, 우선주 80,237백만원)으로 이익소각으로 인하여 납입자본금 897,514백만원과 상이합니다.

전기말

	보통주	우선주
기초 유통주식수(단위: 주)	5,940,082,550	818,836,700
자기주식 취득주식수(단위: 주)	(118,314,495)	(16,465,497)
자기주식 지급주식수(단위: 주)	6,040,880	0
기말 유통주식수(단위: 주)	5,827,808,935	802,371,203
소각주식 수를 제외한 발행주식수(단위: 주)		
유통주식수에 대한 기술		

주식의 소각 및 지급에 대한 공시

(단위 : 백만원)

	보통주	우선주	주식의 종류 합계
지급한 주식 수(단위: 주)	12,063,951	0	
지급한 주식의 취득원가	1,467,979		
이사회 결의일, 주식 지급			2026년 1월 23일, 1월 28일, 3월 18일, 7월 7일, 7월 11일
소각한 주식 수(단위: 주)	73,359,314	13,603,461	86,962,775
소각한 주식의 취득원가			5,346,072
이사회 결의일, 주식 소각			2026년 3월 30일

16. 이익잉여금

이익잉여금에 대한 공시

당분기말 (단위 : 백만원)

		공시금액

이익잉여금		418,879,075
이익잉여금	법정적립금	450,789
	임의적립금 등	418,428,286

전기말 (단위 : 백만원)

		공시금액
이익잉여금		254,566,830
이익잉여금	법정적립금	450,789
	임의적립금 등	254,116,041

배당금에 대한 공시

당분기 (단위 : 백만원)

	배당의 구분								
	분기배당								
	1분기			2분기			3분기		
	주식의 종류		주식의 종류 합계	주식의 종류		주식의 종류 합계	주식의 종류		주식의 종류 합계
	보통주	우선주		보통주	우선주		보통주	우선주	
배당기준일			2026-03-31			2026-06-30			2026-09-30
배당받을 주식(단위: 주)	5,792,563,304	802,371,203		5,764,191,903	802,371,203		5,718,607,814	802,371,203	
보통주 주당 배당률 (액면가 기준)	3.72			3.74			46.01		
우선주 주당 배당률 (액면가 기준)		3.72			3.74			46.01	
배당금	2,154,834	298,482	2,453,316	2,155,808	300,087	2,455,895	26,311,315	3,691,710	30,003,025

전분기 (단위 : 백만원)

	배당의 구분								
	분기배당								
	1분기			2분기			3분기		
	주식의 종류		주식의 종류 합계	주식의 종류		주식의 종류 합계	주식의 종류		주식의 종류 합계
	보통주	우선주		보통주	우선주		보통주	우선주	
배당기준일			2025-03-31			2025-06-30			2025-09-30
배당받을 주식 (단위: 주)	5,892,637,922	812,249,664		5,876,745,450	809,337,676		5,828,224,765	802,437,676	
보통주 주당 배당률 (액면가 기준)	3.65			3.67			3.70		
우선주 주당 배당률 (액면가 기준)		3.65			3.67			3.70	
배당금	2,150,813	296,471	2,447,284	2,156,766	297,027	2,453,793	2,156,443	296,902	2,453,345

17. 기타자본항목

기타자본구성요소

당분기말 (단위 : 백만원)

		공시금액

기타자본구성요소		1,691,129
기타자본구성요소	기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	1,802,983
	순확정급여부채(자산) 재측정요소	(3,508,373)
	자기주식	(25,570,974)
	주식기준보상	27,207,085
	기타	1,760,408

전기말 (단위 : 백만원)

		공시금액
기타자본구성요소		(5,538,154)
기타자본구성요소	기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	2,030,224
	순확정급여부채(자산) 재측정요소	(3,088,236)
	자기주식	(6,606,360)
	주식기준보상	365,810
	기타	1,760,408

자기주식에 대한 공시

당분기말 (단위 : 백만원)

	보통주	우선주
자기주식수(단위: 주)	127,670,794	0
자기주식	25,570,974	0

전기말 (단위 : 백만원)

	보통주	우선주
자기주식수(단위: 주)	91,828,987	13,603,461
자기주식	5,892,428	713,932

주식기준보상약정에 대한 공시

(단위 : 백만원)

	주식결제 성과인센티브	임직원 주식보상(우수인력)	임직원 주식보상(DX부문 및 CSS 사업팀)	임직원 주식보상(DS부문)	주식결제 장기성과급	성과연동 주식보상

주식기준보상약정에 대한 기술	회사는 임직원을 대상으로 성과인센티브 중 일부를 2026년 1월에 양도제한주식(RSA)으로 지급하기로 약정하였으며, 이에 따라 지급한 보통주 6,524,129주의 약정일 현재 공정가치 1,047,102백만원을 '미지급비용'에서 '기타자본항목'으로 대체 및 '급여'로 인식하였습니다. 해당 주식보상은 당분기 중 지급완료하였습니다. 또한 전기말 기준 미교부 상태인 양도제한주식(RSA) 보통주 1,176,383주에 대한 정산이 당분기 중 완료되었습니다.	회사는 우수인력에 대한 리텐션 및 동기부여를 목적으로 보통주 1,781,329주를 지급하기로 약정하였으며, 이에 따라 약정일 현재 공정가치 371,594백만원을 '복리후생비' 및 '기타자본항목'으로 인식하였습니다. 해당 주식보상은 당분기 중 일부 지급되었으며 2028년에 지급완료될 예정입니다. 또한 전기말 기준 동일한 목적으로 약정하였으나 미교부 상태인 보통주 1,574,685주중 1,569,895주에 대한 정산이 당분기 중 완료되었습니다.	회사는 2026년 5월 27일 노사합의에 따라 DX 부문 및 CSS 사업팀 직원에게 보통주를 부여하기로 약정하였으며, 이에 따라 지급 예정인 보통주의 약정일 현재 공정가치 332,715백만원을 '급여' 및 '기타자본항목'으로 인식하였습니다. 해당 주식보상은 당분기 중 지급완료하였습니다.	회사는 2026년 사업성과의 일정 비율에 해당하는 양도제한 보통주를 DS부문 임직원들에게 지급하는 약정에 합의하였으며, 세부조건은 협의중입니다. 해당 주식보상 약정은 2026년 최종 성과 확정 후 지급될 예정입니다.	회사는 임원 등의 장기성과급 중 일부를 주식으로 지급하기로 약정하였으며, 이에 따라 보통주 1,195,593주의 약정일 현재 공정가치 291,801백만원을 '급여' 및 '기타자본항목'으로 인식하였습니다. 해당 주식보상은 당분기 중 일부 지급되었으며 2028년에 지급완료될 예정입니다. 한편 전기말 기준 동일한 목적으로 약정하였으나 미교부 상태인 보통주 778,984주에대한 정산이 당분기 중 완료되었습니다.	회사는 임직원을 대상으로 성과연동 주식보상제도(PSU)를 운영하고 있습니다. 당분기 중 회사가 이 제도와 관련하여 인식한 비용은 440,431백만원입니다.
주식기준보상약정의 결제방식에 대한 기술	주식결제	주식결제	주식결제	주식결제	주식결제	주식결제
주식기준보상약정의 부여일	2026년 1월		2026년 05월 27일			
주식기준보상약정의 지급일	당분기 중 지급완료	당분기 중 일부 지급되었으며 2028년 지급완료될 예정	당분기 중 지급완료	2026년 최종 성과 확정 후 지급될 예정	당분기 중 일부 지급되었으며 2028년 지급완료될 예정	
주식기준보상약정에 따라 부여된 금융상품의 수량(단위 : 주)	6,524,129	1,781,329			1,195,593	
약정일 현재 공정가치	1,047,102	371,594	332,715		291,801	
종업원 주식기준보상거래로부터의 비용						440,431

전기말 기준 미교부 상태인 금융상품의 수량(단위: 주)	1,176,383	1,574,685			778,984	
전기말 기준 미교부상태인 금융상품 중 당분기 정산완료된 수량(단위: 주)	1,176,383	1,569,895			778,984	

18. 비용의 성격별 분류

비용의 성격별 분류 공시

당분기 (단위 : 백만원)

		장부금액	
		공시금액	
		3개월	누적
성격별 비용		72,519,714	196,423,870
성격별 비용	제품과 재공품의 감소(증가)	(2,071,252)	(10,549,459)
	원재료 등의 사용액 및 상품 매입액 등	30,652,080	79,779,980
	급여	16,275,951	42,041,870
	퇴직급여	256,269	1,439,001
	감가상각비	9,851,059	29,067,750
	무형자산상각비	715,397	2,170,848
	복리후생비	1,003,164	3,370,974
	유틸리티비	1,842,835	5,116,303
	외주용역비	1,157,096	3,623,011
	광고선전비	344,691	1,076,742
	판매촉진비	344,224	1,241,977
	기타 비용	12,148,200	38,044,873

전분기 (단위 : 백만원)

		장부금액	
		공시금액	
		3개월	누적
성격별 비용		54,857,982	162,498,142
성격별 비용	제품과 재공품의 감소(증가)	757,785	2,551,461
	원재료 등의 사용액 및 상품 매입액 등	24,502,820	72,999,183
	급여	3,360,639	11,792,553

	퇴직급여	261,173	782,445
	감가상각비	9,039,033	26,063,220
	무형자산상각비	722,454	2,035,080
	복리후생비	892,104	2,946,073
	유틸리티비	1,721,131	4,782,696
	외주용역비	1,274,900	3,927,942
	광고선전비	468,027	1,236,589
	판매촉진비	472,330	1,341,107
	기타 비용	11,385,586	32,039,793

성격별 비용에 대한 기술

손익계산서 상 매출원가와 판매비와관리비를 합한 금액입니다.

19. 판매비와관리비

판매비와관리비에 대한 공시

당분기 (단위 : 백만원)

			장부금액	
			공시금액	
			3개월	누적
판매비와관리비 합계			17,568,888	51,363,532
판매비와관리비 합계	경상연구개발비를 제외한 판매비와관리비 소계		4,645,941	14,521,987
	경상연구개발비를 제외한 판매비와관리비 소계	급여	1,500,316	4,294,655
		퇴직급여	46,057	251,363
		지급수수료	1,007,329	2,841,470
		감가상각비	136,137	392,747
		무형자산상각비	123,808	367,022
		광고선전비	344,691	1,076,742
		판매촉진비	344,224	1,241,977
		운반비	240,740	620,364
		서비스비	251,374	1,443,708
		기타판매비와관리비	651,265	1,991,939
	경상연구개발비-연구개발 총지출액		12,922,947	36,841,545

전분기 (단위 : 백만원)

			장부금액	
			공시금액	
			3개월	누적
판매비와관리비 합계			11,505,386	34,788,024
판매비와관리비 합	경상연구개발비를 제외한 판매비와관		3,986,514	11,651,468

계	리비 소계			
	경상연구개발비를 제외한 판매비와관리비 소계	급여	641,877	1,991,691
		퇴직급여	43,750	130,698
		지급수수료	980,001	2,885,245
		감가상각비	122,674	368,313
		무형자산상각비	117,878	335,319
		광고선전비	468,027	1,236,589
		판매촉진비	472,330	1,341,107
		운반비	159,979	472,762
		서비스비	402,812	1,003,572
		기타판매비와관리비	577,186	1,886,172
	경상연구개발비-연구개발 총지출액		7,518,872	23,136,556

20. 기타수익 및 기타비용

기타수익 및 기타비용

당분기 (단위 : 백만원)

		장부금액	
		공시금액	
		3개월	누적
기타수익		378,251	2,700,446
기타수익	배당금수익	51,169	1,962,471
	임대료수익	44,292	131,216
	유형자산처분이익	178,111	297,158
	기타	104,679	309,601
기타비용		84,452	233,011
기타비용	유형자산처분손실	24,928	82,325
	기부금	40,638	79,044
	기타	18,886	71,642

전분기 (단위 : 백만원)

		장부금액	
		공시금액	
		3개월	누적
기타수익		2,906,570	8,973,815
기타수익	배당금수익	2,741,890	8,545,569
	임대료수익	43,709	132,251
	유형자산처분이익	25,178	94,530
	기타	95,793	201,465
기타비용		23,397	119,295

기타비용	유형자산처분손실	4,491	13,896
	기부금	7,632	68,007
	기타	11,274	37,392

21. 금융수익 및 금융비용

금융수익 및 금융비용

당분기 (단위 : 백만원)

			장부금액	
			공시금액	
			3개월	누적
금융수익 합계			2,897,455	9,548,027
금융수익 합계	이자수익		447,928	845,962
	이자수익	상각후원가로 측정하는 금융자산의 이자수익	447,928	845,962
	외환차이		2,449,527	8,702,065
	파생상품관련이익		0	0
금융비용 합계			11,817,962	17,021,401
금융비용 합계	이자비용		28,549	520,358
	이자비용	상각후원가 측정 금융부채 이자비용	11,304	181,335
		기타 금융부채 이자비용	17,245	339,023
	외환차이		11,789,413	16,501,043

전분기 (단위 : 백만원)

			장부금액	
			공시금액	
			3개월	누적
금융수익 합계			929,216	4,698,947
금융수익 합계	이자수익		38,978	147,650
	이자수익	상각후원가로 측정하는 금융자산의 이자수익	38,978	147,650
	외환차이		890,238	3,887,074
	파생상품관련이익		0	664,223
금융비용 합계			1,051,849	4,297,353
금융비용 합계	이자비용		211,020	572,819
	이자비용	상각후원가 측정 금융부채 이자비용	143,462	315,467
		기타 금융부채 이	67,558	257,352

		자비용		
	외환차이		840,829	3,724,534

금융수익 및 금융비용에 대한 기술

회사는 외화거래 및 환산으로 발생한 외환차이를 금융수익 및 금융비용으로 인식하고 있습니다.

22. 법인세비용

평균유효세율과 적용세율간의 조정

	공시금액
법인세비용 인식에 대한 기술	법인세비용은 전체 회계연도에 대해 글로벌최저한세를 고려하여 추정한 최선의 가중평균연간법인세율로 인식하였습니다. 당분기말 현재 2026년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상평균연간법인세율은 23.3%입니다.
2026년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상 평균 연간법인세율	0.233

23. 주당이익

주당이익

당분기 (단위 : 백만원)

		주식의 종류			
		보통주		우선주	
		3개월	누적	3개월	누적
분기순이익		71,318,059	178,323,283	71,318,059	178,323,283
기본주당이익					
기본주당이익	보통주에 귀속되는 분기순이익	62,572,678	156,564,231		
	우선주에 귀속되는 분기순이익			8,745,381	21,759,052
	가중평균유통보통주식수(단위: 주)	5,757,215,600	5,784,809,795		
	가중평균유통우선주식수(단위: 주)			802,371,203	802,371,203
	기본주당이익(단위 : 원)	10,869	27,065	10,899	27,118
희석주당순이익					
희석주당순이익	희석효과를 포함한 보통주에 귀속되는 분기순이익	62,657,052	156,777,945		
	희석효과를 포함한			8,661,007	21,545,338

	우선주에 귀속되는 분기순이익				
	가중평균희석유통보통주식수(단위: 주)	5,868,590,512	5,866,395,793		
	가중평균희석유통우선주식수(단위: 주)			802,371,203	802,371,203
	희석주당이익(단위: 원)	10,677	26,725	10,794	26,852

전분기 (단위 : 백만원)

		주식의 종류			
		보통주		우선주	
		3개월	누적	3개월	누적
분기순이익		10,668,573	19,807,790	10,668,573	19,807,790
기본주당이익					
기본주당이익	보통주에 귀속되는 분기순이익	9,376,860	17,409,597		
	우선주에 귀속되는 분기순이익			1,291,713	2,398,193
	가중평균유통보통주식수(단위: 주)	5,855,461,456	5,893,762,660		
	가중평균유통우선주식수(단위: 주)			806,314,121	811,986,953
	기본주당이익(단위: 원)	1,601	2,954	1,602	2,953
희석주당순이익					
희석주당순이익	희석효과를 포함한 보통주에 귀속되는 분기순이익	9,377,383	17,410,300		
	희석효과를 포함한 우선주에 귀속되는 분기순이익			1,291,190	2,397,490
	가중평균희석유통보통주식수(단위: 주)	5,858,733,256	5,895,411,133		
	가중평균희석유통우선주식수(단위: 주)			806,314,121	811,986,953
	희석주당이익(단위: 원)	1,601	2,953	1,601	2,953

가중평균 희석성 잠재적보통주에 대한 공시

당분기

	보통주
보통주식수 주식기준보상약정의 잠재적 효과(단위: 주)	81,585,998

전분기

	보통주
보통주식수 주식기준보상약정의 잠재적 효과(단위: 주)	1,648,474

기본 및 희석주당이익의 계산을 위한 분모의 조정에 대한 기술

희석주당이익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균 유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다. 회사가 보유한 희석성 잠재적보통주 중 성과연동 주식보상(Performance Stock Units)으로 인한 주식수는 당분기말 현재 기준주가가 약정 후 3년 경과 시점의 기준주가와 같다고 가정할 경우 임직원에게 지급될 주식수로 계산되며, 반희석효과가 있을 경우 희석주당이익 계산에 포함되지 않습니다.

24. 현금흐름표

현금흐름의 회계정책에 대한 기술

회사는 영업활동 현금흐름을 간접법으로 작성하였습니다. 당분기 및 전분기 중 영업활동 현금흐름 관련 조정 내역 및 영업활동으로 인한 자산부채의 변동은 다음과 같습니다.

영업활동현금흐름

당분기 (단위 : 백만원)

		공시금액
조정내역 계		115,840,730
조정내역 계	법인세비용	54,084,911
	금융수익	(2,028,873)
	금융비용	5,324,523
	퇴직급여	1,439,001
	감가상각비	29,067,750
	무형자산상각비	2,170,848
	대손상각비(환입)	(47,303)
	배당금수익	(1,962,471)
	유형자산처분이익	(297,158)
	유형자산처분손실	82,325
	재고자산평가손실환입	(222,067)
	재고자산평가손실	0
	기타	28,229,244
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동		(120,409,563)
영업활동으로 인한 자산 부채의	매출채권의 감소(증가)	(108,385,423)

변동	미수금의 감소(증가)	(420,014)
	장단기선급비용의 감소(증가)	37,384
	재고자산의 감소(증가)	(13,281,281)
	매입채무의 증가(감소)	7,351,839
	장단기미지급금의 증가(감소)	(3,197,698)
	선수금의 증가(감소)	92,887
	예수금의 증가(감소)	27,653
	미지급비용의 증가(감소)	1,426,461
	장단기충당부채의 증가(감소)	2,524,020
	퇴직금의 지급	(1,784,980)
	기타	(4,800,411)

전분기 (단위 : 백만원)

		공시금액
조정내역 계		23,074,370
조정내역 계	법인세비용	49,515
	금융수익	(1,214,086)
	금융비용	1,282,665
	퇴직급여	782,445
	감가상각비	26,063,220
	무형자산상각비	2,035,080
	대손상각비(환입)	46,906
	배당금수익	(8,545,569)
	유형자산처분이익	(94,530)
	유형자산처분손실	13,896
	재고자산평가손실환입	0
	재고자산평가손실	2,136,878
	기타	517,950
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동		2,110,730
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	매출채권의 감소(증가)	(2,176,630)
	미수금의 감소(증가)	1,345,780
	장단기선급비용의 감소(증가)	34,552
	재고자산의 감소(증가)	1,389,206
	매입채무의 증가(감소)	4,835,689
	장단기미지급금의 증가(감소)	(3,873,628)
	선수금의 증가(감소)	(46,586)
	예수금의 증가(감소)	28,329
	미지급비용의 증가(감소)	496,686
	장단기충당부채의 증가(감소)	(359,903)
	퇴직금의 지급	(1,127,229)

	기타	1,564,464

리스부채와 관련한 현금유출액에 대한 공시

당분기 (단위 : 백만원)

	공시금액
리스부채에 대한 원금 상환, 재무활동에서 생기는 현금유출	193,387
리스부채에 대한 이자비용, 영업활동에서 생기는 현금유출	16,801

전분기 (단위 : 백만원)

	공시금액
리스부채에 대한 원금 상환, 재무활동에서 생기는 현금유출	189,058
리스부채에 대한 이자비용, 영업활동에서 생기는 현금유출	19,855

25. 재무위험관리

금융상품에서 발생하는 위험의 성격과 정도에 대한 공시

	위험 유형					위험 유형 합계
	시장위험			신용위험	유동성 위험	
	환위험	이자율위험	지분가격위험			
위험에 대한 노출 정도에 대한 기술	회사는 글로벌 영업활동을 수행함에 따라 기능통화와 다른 통화로도 거래를 하고 있어 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 환율변동위험에 노출되는 주요 통화로는 USD, EUR 등이 있습니다.	이자율변동위험은 시장금리 변동으로 인해 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로서, 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯됩니다.	회사는 전략적 목적 등으로 기타포괄손익-공정가치 금융자산으로 분류된 지분상품에투자하고 있습니다.	회사의 금융자산 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 회사의 신용위험 최대노출액은 금융자산 장부금액과 동일합니다.	유동성위험이란 회사가 금융부채와 관련된 모든 의무를 이행하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다.	회사의 재무위험관리의 주요 대상인 자산은 현금및현금성자산, 단기금융상품, 매출채권, 기타포괄손익-공정가치금융자산 등으로 구성되어 있으며, 부채는 매입채무, 차입금 등으로 구성되어 있습니다.

위험관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 기술	회사는 통화별 자산과 부채규모를 일치하는 수준으로 유지하여 환율변동 영향을 최소화하는데 주력하고 있습니다. 이를 위해 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 금융거래 발생시 기능통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시킴으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있으나, 일부 발생된 환포지션은 채권매각, 선물환 등을 활용하여 환변동영향을 축소하고 있습니다. 이는 회사가 노출된 환율변동위험을 감소시키지만 완전히 제거하지는 않을 수 있습니다. 또한, 회사는 효율적인 환율변동위험 관리를 위해 환위험을 주기적으로 모니터링 및 평가하고 있으며 투기적 외환거래는 엄격히 금지하고 있습니다.	회사는 내부자금 공유를 통해 외부 차입금을 최소화하여 이자율 변동으로 인한 금융비용과 불확실성을 최소화하고 있습니다.	직·간접적 투자수단을 이용하고 있습니다.	신용위험은 통상적인 거래 및 투자 활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소를 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정·관리하고 있습니다. 그리고 위험국가에 소재한 거래처의 매출채권은 보험한도 내에서 적절하게 위험이 관리되고 있습니다. 신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당 거래는 현금 및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 회사는 국제신용등급이 높은 은행(S&P A 이상)에 대해서만 거래를 하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 기존에 거래가 없는 금융기관과의 신규 거래는 해당 기관에 대한 건전	회사의 주요 유동성 공급원은 영업에서 창출한 현금 및 자본시장 및 금융기관에서 조달한 자금이며, 주요 유동성 수요는 생산, 연구개발을 위한 투자를 비롯해, 운전자본, 배당 등에 있습니다. 대규모 투자가 많은 회사 사업 특성상적정 유동성의 유지가 매우 중요합니다. 회사는 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 산정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지·관리하고 있습니다. 회사는 권역별로 Cash Pooling을 구축하여 권역 내 개별 법인의 자금이 부족한 경우에도 유동성 위험에 효율적으로 대응하고 있습니다. Cash Pooling은 자금 부족 회사와 자금 잉여 회사간 자금을 공유하는 시스템으로 개별회사의 유동성 위험을 최소화하고 자금운용부담을 경감시키며, 금융비용을 절감하는 등의 효과가 있습니다. 또한, 대규모 유동성이 필요한 경우에 대비하여 본사의 지급보증을 통	회사는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험, 유동성위험 등을 최소화하는데 중점을 두고 재무위험을 관리하고 있으며, 이를 위해 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링 및 대응하고 있습니다. 재무위험은 글로벌 재무관리기준을 수립하고 고객과 거래선에 대한 주기적인 재무위험 측정, 환헷지 및 자금수지 점검 등을 통해 관리하고 있습니다. 한편, 해외 주요 권역별로 지역금융센터(미국, 영국, 싱가포르, 중국, 브라질, 아랍에미리트)에서 환율변동 모니터링 및 환거래 대행을 통해 환율변동위험을 관리하고 있으며, 권역내 자금을 통합운용하여 유동성위험에 대응하고 있습니다. 회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해관계자에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 건전한 자본구조를 유지하는 것입니다. 회사는

				성 평가 등을 거쳐 시행하고 있습니다. 회사가 체결하는 금융계약은 부채비율 제한 조항, 담보 제공, 차입금 회수 등의 제약조건이 없는 계약을 위주로 체결하고 있으며, 기타의 경우 별도의 승인을 받아 거래하고 있습니다.	해 해외 종속기업이 활용할 수 있는 차입한도를 확보하고 있으며, 보고기간종료일 현재 국제신용평가기관인 Moody's로부터 Aa2, S&P로부터 AA- 등 투자적격 등급을 부여받고 있어, 필요시 자본시장을 통해 적기에 자금조달이 가능합니다.	신용등급, 부채비율 등의 지표를 이용하여 자본위험을 관리하고 있습니다.

보고기간 말 현재 노출된 주가변동의 각 유형별 민감도 분석

당분기 (단위 : 백만원)

	위험 유형
	시장위험
	지분가격위험
	금융자산의 종류
	기타포괄손익-공정가치금융자산 및 당기손익-공정가치금융자산으로 분류된 지분상품
시장위험의 각 유형별 민감도분석 기술	보고기간종료일 현재 지분상품(상장주식)의 주가가 1% 변동할 경우 기타포괄손익 (법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 37,911백만원 입니다.
시장변수 상승 시 기타포괄손익 증가	37,911
시장변수 하락 시 기타포괄손익 감소	37,911

전분기 (단위 : 백만원)

	위험 유형
	시장위험
	지분가격위험
	금융자산의 종류
	기타포괄손익-공정가치금융자산 및 당기손익-공정가치금융자산으로 분류된 지분상품
시장위험의 각 유형별 민감도분석 기술	보고기간종료일 현재 지분상품(상장주식)의 주가가 1% 변동할 경우 기타포괄손익 (법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 37,563백만원 입니다.
시장변수 상승 시 기타포괄손익 증가	37,563
시장변수 하락 시 기타포괄손익 감소	37,563

부채비율에 대한 공시

당분기말 (단위 : 백만원)

	공시금액
부채	109,512,952
자본	425,871,611
부채비율	0.257
자본관리를 위한 기업의 목적, 정책 및 절차에 대한 비계량적 정보	회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해관계자에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 건전한 자본구조를 유지하는 것입니다. 회사는 신용등급, 부채비율 등의 지표를 이용하여 자본위험을 관리하고 있습니다.

전기말 (단위 : 백만원)

	공시금액
부채	104,571,968
자본	254,330,083
부채비율	0.411
자본관리를 위한 기업의 목적, 정책 및 절차에 대한 비계량적 정보	회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해관계자에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 건전한 자본구조를 유지하는 것입니다. 회사는 신용등급, 부채비율 등의 지표를 이용하여 자본위험을 관리하고 있습니다.

26. 공정가치측정

금융자산의 공시

당분기말 (단위 : 백만원)

	현금및현금성자산	단기금융상품	매출채권	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	기타	금융자산의 종류 합계
금융자산	17,010,538	53,167,476	146,487,171	3,931,247	9,250,903	229,847,335
금융자산, 공정가치				3,931,247		
공정가치 공시대상에서 제외한 사유	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.		장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치로 금융자산 9,250,903백만원은 공정가치 공시에서 제외하였습니다.	

전기말 (단위 : 백만원)

	현금및현금성자산	단기금융상품	매출채권	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	기타	금융자산의 종류 합계
금융자산	12,581,632	12,332,721	42,081,734	4,248,587	5,512,456	76,757,130
금융자산, 공정가치				4,248,587		
공정가치 공시대상에서 제외한 사유	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.		장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치로 금융자산 5,512,456백만원은 공정가치 공시에서 제외하였습니다.	

금융부채의 공시

당분기말 (단위 : 백만원)

	매입채무	단기차입금	미지급금	장기차입금	사채	기타	금융부채의 종류 합계
금융부채	21,214,568	6,263,855	32,210,036	4,933,193	13,537	5,430,769	70,065,958
금융부채, 공정가치					14,874		
공정가치 공시대상에서 제외한 사유	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다. 리스부채는 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시'에 따라 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.		장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	

전기말 (단위 : 백만원)

	매입채무	단기차입금	미지급금	장기차입금	사채	기타	금융부채의 종류 합계
금융부채	14,247,155	15,375,658	25,461,886	23,660,795	14,227	4,436,223	83,195,944
금융부채, 공정가치					15,431		

공정가치 공시대상에서 제외한 사유	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다. 리스부채는 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시'에 따라 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.		장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	

자산의 공정가치측정에 대한 공시

당분기말 (단위 : 백만원)

	측정			
	공정가치			
	자산의 분류			
	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산			
	공정가치 서열체계의 수준			공정가치 서열체계의 수준 합계
	수준 1	수준 2	수준 3	
자산	3,791,140	0	140,107	3,931,247

전기말 (단위 : 백만원)

	측정			
	공정가치			
	자산의 분류			
	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산			
	공정가치 서열체계의 수준			공정가치 서열체계의 수준 합계
	수준 1	수준 2	수준 3	
자산	4,130,048	0	118,539	4,248,587

부채의 공정가치측정에 대한 공시

당분기말 (단위 : 백만원)

	측정			
	공정가치			
	부채의 분류			
	사채			
	공정가치 서열체계의 수준			공정가치 서열체계의 수준 합계
	수준 1	수준 2	수준 3	

부채	0	14,874	0	14,874

전기말 (단위 : 백만원)

	측정			
	공정가치			
	부채의 분류			
	사채			
	공정가치 서열체계의 수준			공정가치 서열체계의 수준 합계
	수준 1	수준 2	수준 3	
부채	0	15,431	0	15,431

금융상품의 공정가치측정에 대한 공시

	수준 1	수준 2	수준 3
공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 자산	동일한 자산이나 부채에 대한 시장 공시가격	시장에서 관측가능한 투입변수를 활용한 공정가치 (단, '수준 1'에 포함된 공시가격은 제외)	관측가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치
공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 부채	동일한 자산이나 부채에 대한 시장 공시가격	시장에서 관측가능한 투입변수를 활용한 공정가치 (단, '수준 1'에 포함된 공시가격은 제외)	관측가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치

평가기법 및 투입변수에 대한 기술

금융상품의 공정가치를 측정하는 데 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.
- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격
- 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액을 현재가치로 할인하여 측정
나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름할인법 등의 기타 가치평가기법을 사용합니다.유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타채권의 경우 장부금액을 공정가치의 합리적인근사치로 추정하고 있습니다.

회사는 공정가치 서열체계에서 '수준 2'로 분류되는 통화선도, 회사채, 국공채, 금융채 등에 대하여 미래현금흐름을 적정이자율로 할인하는 현재가치법을 사용하고 있습니다.

수준 3으로 분류된 주요 금융상품에 대하여 사용된 가치평가기법 및 투입변수에 대한 공시

(단위 : 백만원)

	측정	
	공정가치	
	자산의 분류	
	공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산	
	삼성벤처투자㈜	㈜미코세라믹스

	공정가치 서열체계의 수준	
	공정가치 서열체계 수준 3	
자산	45,525	80,867
공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 자산	현금흐름할인법	현금흐름할인법 등
공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 자산	영구성장률, 가중평균자본비용	영구성장률, 가중평균자본비용

자산의 공정가치측정에 사용된 관측가능하지 않은 투입변수에 대한 공시

	측정			
	공정가치			
	자산의 분류			
	공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산			
	삼성벤처투자㈜		㈜미코세라믹스	
	공정가치측정에 사용된 평가기법			
	현금흐름할인법			
	관측할 수 없는 투입변수			
	영구성장률, 투입변수	가중평균자본비용, 측정 투입변수	영구성장률, 투입변수	가중평균자본비용, 측정 투입변수
유의적이지만 관측할 수 없는 투입변수, 자산	0.010	0.119	0.000	0.116

수준 3에 해당하는 금융상품의 변동 내역에 대한 공시

당분기 (단위 : 백만원)

	공정가치 서열체계의 수준
	수준 3
	자산의 분류
	공정가치로 측정하는 금융자산
기초	118,539
매도	(1,797)
당기손익으로 인식된 손익	0
기타포괄손익으로 인식된 손익	23,365
기타	0
기말	140,107

전분기 (단위 : 백만원)

	공정가치 서열체계의 수준

	수준 3
	자산의 분류
	공정가치로 측정하는 금융자산
기초	477,847
매도	0
당기손익으로 인식된 손익	600,606
기타포괄손익으로 인식된 손익	10,338
기타	(974,287)
기말	114,504

금융상품의 민감도분석 방법에 대한 기술

금융상품의 민감도분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에 따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다.

관측할 수 없는 투입변수의 변동으로 인한 공정가치측정의 민감도분석 공시, 자산

(단위 : 백만원)

	측정		
	공정가치		
	자산의 분류		
	기타포괄손익-공정가치측정기타금융자산		
	관측할 수 없는 투입변수		관측할 수 없는 투입변수 합계
	영구성장률, 투입변수	가중평균자본비용, 측정투입변수	
관측할 수 없는 투입변수의 가능성이 어느 정도 있는 증가율, 자산	0.01	0.01	
관측할 수 없는 투입변수의 가능성이 어느 정도 있는 감소율, 자산	0.01	0.01	
기타포괄손익(세전)으로 인식된, 가능성이 어느 정도 있고 대체할 수 있는 가정을 반영하기 위한 하나 이상의 관측할 수 없는 투입변수의 변동으로 인한 공정가치 측정치의 증가, 자산			11,572

기타포괄손익(세전)으로 인식된, 가능성이 어느 정도 있고 대체할 수 있는 가정을 반영하기 위한 하나 이상의 관측할 수 없는 투입변수의 변동으로 인한 공정가치 측정치의 감소, 자산			(6,210)

27. 부문별 보고

보고부문을 식별하기 위하여 사용한 요소에 대한 기술

회사는 전략적 의사결정을 수립하는 경영진(경영위원회)에게 보고되는 사업 단위를 기준으로 보고부문을 결정하고 있습니다. 경영위원회는 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 부문의 영업이익을 기준으로 검토하고 있습니다.

보고부문 사이의 거래에 대한 회계처리 방법에 대한 기술

매출은 대부분 재화의 매출로 구성되어 있습니다. 회사의 보고부문은 조직 및 수익을창출하는 제품의 유형을 기준으로 식별되었으며, 보고기간종료일 현재 보고부문은 DX 부문, DS 부문 등으로 구성되어 있습니다.

보고부문별 자산과 부채는 경영위원회에 정기적으로 제공되지 않아 포함하지 않았습니다.

영업부문에 대한 공시

당분기 (단위 : 백만원)

	부문의 합계				부문의 합계 합계	
	영업부문					
	DX 부문		DS 부문			
	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적
매출액	39,807,255	107,185,607	144,891,278	352,407,585	175,287,109	433,838,003
감가상각비	167,624	478,128	9,640,010	28,460,401	9,851,059	29,067,750
무형자산상각비	451,254	1,381,167	196,268	589,072	715,397	2,170,848
영업이익	(2,740,607)	(8,803,931)	105,505,515	246,213,079	102,767,395	237,414,133
보고부문에 대한 기술					기타는 별도로 표시하지 않았습니다.	기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

전분기 (단위 : 백만원)

	부문의 합계				부문의 합계 합계	
	영업부문					
	DX 부문		DS 부문			
	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적
매출액	32,317,461	95,341,381	32,963,938	84,696,800	62,799,068	173,099,333
감가상각비	151,299	449,564	8,845,220	25,475,141	9,039,033	26,063,220
무형자산상각비	465,948	1,280,955	195,048	572,971	722,454	2,035,080
영업이익	1,527,764	4,616,926	6,412,535	5,982,043	7,941,086	10,601,191

보고부문에 대한 기술					기타는 별도로 표시하지 않았습니다.	기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

28. 특수관계자와의 거래

당분기말 현재 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

지역	기업명	업종	지분율(%)(*)
미주	Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung International, Inc. (SII)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Mexicana S.A. de C.V (SAMEX)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Home Appliances America, LLC (SEHA)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Research America, Inc (SRA)	R&D	100.0
	SAMSUNG NEXT LLC (SNX)	해외자회사 관리	100.0
	SAMSUNG NEXT FUND LLC (SNXF)	신기술사업자, 벤처기업 투자	100.0
	Samsung HME America, Inc. (구, NeuroLogica Corp.)	의료기기 생산 및 판매	100.0
	Samsung Lennox HVAC North America, LLC	에어컨공조 판매	50.1
	Joyent, Inc.	클라우드서비스	100.0
	SmartThings, Inc.	스마트홈 플랫폼	100.0
	TeleWorld Solutions, Inc. (TWS)	네트워크장비 설치 및 최적화	100.0
	Xealth Inc.	디지털 헬스케어 플랫폼	100.0
	Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	반도체・디스플레이 패널 판매	100.0
	Samsung Federal, Inc. (SFI)	R&D	100.0
	Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS)	반도체 생산	100.0
	Samsung Oak Holdings, Inc. (SHI)	해외자회사 관리	100.0
	SEMES America, Inc.	반도체 장비 서비스	100.0
	Samsung Display America Holdings, Inc. (SDAH)	해외자회사 관리	100.0
	eMagin Corporation	디스플레이 패널 개발 및 생산	100.0
	Samsung Electronics Canada, Inc. (SECA)	전자제품 판매	100.0
	AdGear Technologies Inc.	디지털광고 플랫폼	100.0
	Sonio Corporation	소프트웨어 판매	100.0
	RAINBOW ROBOTICS USA Co., Ltd.	로봇 판매	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율(%)(*)
미주	Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	전자제품 생산 및 판매	100.0

	Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. (SEM)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Digital Appliance Mexico, SA de CV (SEDAM)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Latinoamerica(Zona Libre), S. A. (SELA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Latinoamerica Miami, Inc. (SEMI)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronica Colombia S.A. (SAMCOL)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Argentina S.A. (SEASA)	마케팅 및 서비스	100.0
	Samsung Electronics Chile Limitada (SECH)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Peru S.A.C. (SEPR)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Venezuela, C.A. (SEVEN)	마케팅 및 서비스	100.0
	Samsung Electronics Panama. S.A. (SEPA)	컨설팅	100.0
	SEMCO LLC	에어컨공조 생산 및 판매	100.0
	SEMCO Duct & Acoustical Products Inc	에어컨공조 생산 및 판매	100.0
	Woods Air Movement Ltd.	에어컨공조 생산 및 판매	100.0
	Harman International Industries, Inc.	해외자회사 관리	100.0
	Harman Becker Automotive Systems, Inc.	오디오제품 생산, 판매, R&D	100.0
	Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	오디오제품 생산, 판매	100.0
	Harman de Mexico, S. de R.L. de C.V.	오디오제품 생산	100.0
	Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman International Industries Canada Ltd.	오디오제품 판매	100.0
	Harman International Mexico, S. de R.L. de C.V.	오디오제품 판매	100.0
	Harman KG Holding, LLC	해외자회사 관리	100.0
	Harman Professional, Inc.	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Roon Labs, LLC.	오디오제품 판매	100.0
	Viper Holdings Corporation	해외자회사 관리	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
미주	DEI Holdings, Inc.	해외자회사 관리	100.0
	DEI Sales, Inc.	오디오제품 판매	100.0
	Sound United, LLC	오디오제품 판매	100.0
	Sound United Canada Inc.	오디오제품 판매	100.0
	Polk Audio, LLC	오디오제품 판매	100.0
	D&M Holdings U.S. Inc.	오디오제품 판매	100.0
	Boston Acoustics, Inc.	오디오제품 판매	100.0
	Denon Electronics (USA), LLC	오디오제품 판매	100.0

	Digital Networks North America Inc.	오디오제품 판매	100.0
	Definitive Technology, LLC	오디오제품 판매	100.0
	Equity International, LLC	오디오제품 판매	100.0
	Beijing Integrated Circuit Industry International Fund, L.P	벤처기업 투자	61.4
	China Materialia New Materials 2016 Limited Partnership	벤처기업 투자	99.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율(%)(*)
유럽・CIS	Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Ltd. (SEL)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Semiconductor Europe Limited (SSEL)	반도체・디스플레이 패널 판매	100.0
	Samsung Electronics GmbH (SEG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Holding GmbH (SEHG)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Semiconductor Europe GmbH (SSEG)	반도체・디스플레이 패널 판매	100.0
	Samsung Electronics France S.A.S (SEF)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Italia S.P.A. (SEI)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Iberia, S.A. (SESA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Portuguesa, Unipessoal, Lda. (SEP)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd. (SEH)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS)	물류	100.0
	Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Electronics Nordic Aktiebolag (SENA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Slovakia s.r.o (SESK)	TV・모니터 생산	100.0
	Samsung Electronics Polska, SP.Zo.o (SEPOL)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Poland Manufacturing SP.Zo.o (SEPM)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Romania LLC (SEROM)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Austria GmbH (SEAG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Switzerland GmbH (SESG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o. (SECZ)	전자제품 판매	100.0
	SAMSUNG ELECTRONICS BALTICS SIA (SEB)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Greece S.M.S.A (SEGR)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Air Conditioner Europe	에어컨공조 판매	100.0

	B.V. (SEACE)		
	Samsung Nanoradio Design Center (SNDC)	R&D	100.0
	Samsung Denmark Research Center ApS (SDRC)	R&D	100.0
	Samsung Cambridge Solution Centre Limited (SCSC)	R&D	100.0
	SAMSUNG Zhilabs, S.L.	네트워크Solution 개발, 판매	100.0
	FOODIENT LTD.	R&D	100.0
	Oxford Semantic Technologies Limited (OST)	R&D	100.0
	Sonio SAS	소프트웨어 판매, R&D	100.0
	Samsung Electronics Rus Company LLC (SERC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Rus Kaluga LLC (SERK)	TV 생산	100.0
	Samsung Electronics Ukraine Company LLC (SEUC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung R&D Institute Ukraine (SRUKR)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Central Eurasia LLP (SECE)	전자제품 판매	100.0
	Samsung R&D Institute Rus LLC (SRR)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Caucasus Co. Ltd (SECC)	마케팅	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율(%)(*)
유럽・CIS	Samsung Electronics Uzbekistan Ltd. (SEUZ)	마케팅	100.0
	AKG Acoustics GmbH	오디오제품 생산, 판매	100.0
	Apostera UA, LLC	Connected Service Provider	100.0
	Harman Audio Iberia Espana Sociedad Limitada	오디오제품 판매	100.0
	Harman Becker Automotive Systems GmbH	오디오제품 생산, 판매, R&D	100.0
	Harman Becker Automotive Systems Italy S.R.L.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	오디오제품 생산, R&D	100.0
	Harman Belgium SA	오디오제품 판매	100.0
	Harman Finland Oy	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services GmbH	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services Poland Sp.zoo	Connected Service Provider	100.0
	Harman Consumer Nederland B.V.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Deutschland GmbH	오디오제품 판매	100.0
	Harman France SNC	오디오제품 판매	100.0

	Harman Holding GmbH & Co. KG	Management Company	100.0
	Harman Hungary Financing Ltd.	Financing Company	100.0
	Harman Inc. & Co. KG	해외자회사 관리	100.0
	Harman International Estonia OU	R&D	100.0
	Harman International Industries Limited	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman International Romania SRL	R&D	100.0
	Harman Management GmbH	해외자회사 관리	100.0
	Harman Professional Kft	오디오제품 생산, R&D	100.0
	Harman Professional Denmark ApS	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Red Bend Software SAS	소프트웨어 디자인	100.0
	Harman Connected Services OOO	Connected Service Provider	100.0
	Harman RUS CIS LLC	오디오제품 판매	100.0
	D&M Europe B.V	오디오제품 판매	100.0
	D&M Audiovisual Ltd	오디오제품 판매	100.0
	D&M France SAS	오디오제품 판매	100.0
	D&M Germany GmbH	오디오제품 판매	100.0
	B&W Group Ltd	오디오제품 생산	100.0
	B&W Group Belgium B.V	오디오제품 판매	100.0
	B&W Loudspeakers Nederland B.V	오디오제품 판매	100.0
	B&W Loudspeakers Group Espana S.A	오디오제품 판매	100.0
	B&W Loudspeakers Ltd	오디오제품 판매	100.0
	B&W Group (Schweiz) GmbH	오디오제품 판매	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율(%)(*)
유럽・CIS	B&W Group Germany GmbH	오디오제품 판매	100.0
	B&W Group France SARL	오디오제품 판매	100.0
	Marantz Italy Srl	오디오제품 판매	51.0
	Bowers & Wilkins Ltd	오디오제품 판매	100.0
	FlaktGroup Austria GmbH	에어컨공조 판매	100.0
	Flakt Woods SA	에어컨공조 판매	100.0
	Flakt Elve NV	에어컨공조 판매	100.0
	FlaktGroup Belgium N. V.	에어컨공조 판매	100.0
	FlaktGroup CZ a. s.	에어컨공조 생산 및 판매	100.0
	FlaktGroup Holding GmbH	해외자회사 관리	100.0
	FlaktGroup Deutschland GmbH	에어컨공조 판매	100.0
	FlaktGroup Wurzen GmbH	에어컨공조 생산	100.0
	SE Electronic GmbH	에어컨공조 생산 및 판매	100.0
	Woods Air Movement GmbH	에어컨공조 판매	100.0
	FlaktGroup A/S	에어컨공조 판매	100.0
	FlaktGroup Eesti OU	에어컨공조 판매	100.0
	Ventilation Holding Finland OY	해외자회사 관리	100.0

	FlaktGroup Finland OY	에어컨공조 생산 및 판매	100.0
	FlaktGroup France SAS	에어컨공조 판매	100.0
	Woods Holdings Ltd.	해외자회사 관리	100.0
	Flakt Woods Ltd.	에어컨공조 생산 및 판매	100.0
	FlaktGroup UK Ltd.	에어컨공조 판매	100.0
	FlaktGroup Ireland Ltd.	에어컨공조 판매	100.0
	FlaktGroup Italy S. p. A.	에어컨공조 판매	100.0
	FlaktGroup Baltics UAB	에어컨공조 판매	100.0
	Flakt Woods (Luxembourg) S. a. r. l	해외자회사 관리	100.0
	Flakt Woods ACS S. a. r. l	해외자회사 관리	100.0
	FlaktGroup Latvija SIA	에어컨공조 판매	100.0
	FlaktGroup Netherlands B. V.	에어컨공조 판매	100.0
	FlaktGroup Poland Sp. Z. o. o.	에어컨공조 판매	100.0
	FlaktGroup Romania s. r. l	에어컨공조 판매	100.0
	Ventilation Holding Sweden AB	해외자회사 관리	100.0
	Fusilli HoldCo AB	해외자회사 관리	100.0
	FlaktGroup Sweden AB	에어컨공조 생산 및 판매	100.0
	Forvaltnings bolaget Ljungarum HB	해외자회사 관리	100.0
	Stromboli investissements SAS	해외자회사 관리	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율(%)(*)
중동・아프리카	Samsung Gulf Electronics Co., Ltd. (SGE)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Turkiye (SETK)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Industry and Commerce Ltd. (SETK-P)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Levant Co., Ltd. (SELV)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Maghreb Arab (SEMAG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Egypt S.A.E (SEEG)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Israel Ltd. (SEIL)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Tunisia S.A.R.L (SETN)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Pakistan(Private) Ltd. (SEPAK)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Middle East and North Africa (SEMENA)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Electronics Saudi Arabia Ltd. (SESAR)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Semiconductor Israel R&D Center, Ltd. (SIRC)	R&D	100.0
	Corephotonics Ltd.	R&D	100.0
	Samsung Electronics South Africa(Pty) Ltd. (SSA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics South Africa Production	TV・모니터 생산	100.0

	(pty) Ltd. (SSAP)		
	Samsung Electronics West Africa Ltd. (SEWA)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics East Africa Ltd. (SEEA)	마케팅	100.0
	FlaktWoods LLC	에어컨공조 판매	100.0
	FlaktGroup Havalandirma Sanayi A.S.	에어컨공조 생산 및 판매	100.0
	Harman Industries Holdings Mauritius Ltd.	해외자회사 관리	100.0
	Red Bend Ltd.	오디오제품 생산	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
아시아 (중국 제외)	Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Electronics Singapore Pte. Ltd. (SESP)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Malaysia Electronics (SME) Sdn. Bhd. (SME)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Display (M) Sdn. Bhd. (SDMA)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics (M) Sdn. Bhd. (SEMA)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Vina Electronics Co., Ltd. (SAVINA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	통신제품 생산	100.0
	Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV)	디스플레이 패널 생산	100.0
	PT Samsung Electronics Indonesia (SEIN)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	PT Samsung Telecommunications Indonesia (STIN)	전자제품 판매 및 서비스	100.0
	Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	전자제품 생산 및 판매	91.8
	Laos Samsung Electronics Sole Co., Ltd (LSE)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Philippines Corporation (SEPCO)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Australia Pty. Ltd. (SEAU)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics New Zealand Limited (SENZ)	전자제품 판매	100.0
	Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Red Brick Lane Marketing Solutions Pvt. Ltd.	마케팅	100.0
	Samsung Display Noida Private Limited (SDN)	디스플레이 패널 생산	100.0
	Samsung R&D Institute India-Bangalore Private Limited (SRI-Bangalore)	R&D	100.0
	Samsung R&D Institute BanglaDesh Limited (SRBD)	R&D	100.0
	Samsung Nepal Services Pvt, Ltd (SNSL)	서비스	100.0

	Samsung Japan Corporation (SJC)	반도체・디스플레이 패널 판매	100.0
	Samsung R&D Institute Japan Co. Ltd. (SRJ)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Japan Co., Ltd. (SEJ)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Semiconductor Asia Holdings Pte. Ltd. (SSAH)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Vietnam Semiconductor (SVS)	반도체 생산	100.0
	FlaktGroup India Private Ltd.	에어컨공조 생산 및 판매	100.0
	FlaktGroup Singapore Pte. Ltd.	에어컨공조 판매	100.0
	Harman International (India) Private Limited	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman International Industries PTY Ltd.	해외자회사 관리	100.0
	Harman International (Thailand) Co., Ltd.	오디오제품 생산, 판매	100.0
	Harman International Japan Co., Ltd.	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman Singapore Pte. Ltd.	오디오제품 판매	100.0
	D&M Holdings, Inc.	오디오제품 생산, 판매, R&D	100.0
	Sound United Australia Pty Ltd	R&D	100.0
	Sound United Sales & Marketing Australia Pty Limited	오디오제품 판매	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율(%)(*)
중국	Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd. (SEHK)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd. (SET)	전자제품 판매	100.0
	Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd. (SSEC)	가전제품 생산	88.3
	Samsung Suzhou Electronics Export Co., Ltd. (SSEC-E)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd. (SESC)	R&D	100.0
	Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (TSTC)	통신제품 생산	90.0
	Beijing Samsung Telecom R&D Center (SRC-Beijing)	R&D	100.0
	Samsung Electronics China R&D Center (SRC-Nanjing)	R&D	100.0
	Samsung Mobile R&D Center China-Guangzhou (SRC-Guangzhou)	R&D	100.0
	Samsung R&D Institute China-Shenzhen (SRC-Shenzhen)	R&D	100.0
	Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	반도체・디스플레이 패널 판매	100.0
	Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd.	반도체 생산	100.0

	(SCS)		
	Samsung SemiConductor Xian Co., Ltd. (SSCX)	반도체・디스플레이 패널 판매	100.0
	Samsung Electronics Suzhou Semiconductor Co., Ltd. (SESS)	반도체 임가공	100.0
	Tianjin Samsung LED Co., Ltd. (TSLED)	LED 생산	100.0
	Samsung Semiconductor (China) R&D Co., Ltd. (SSCR)	R&D	100.0
	Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDD)	디스플레이 패널 생산	100.0
	Samsung Display Tianjin Co., Ltd. (SDT)	디스플레이 패널 생산	95.0
	SEMES (XIAN) Co., Ltd.	반도체・FPD 장비 서비스	100.0
	Samsung Semiconductor Investment L.P. I	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	Harman (China) Technologies Co., Ltd.	오디오제품 생산	100.0
	Harman (Suzhou) Audio and Infotainment Systems Co., Ltd.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd.	오디오제품 생산, R&D	100.0
	Harman Commercial (Shanghai) Co., Ltd.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Holding Limited	오디오제품 판매	100.0
	Harman International (China) Holdings Co., Ltd.	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman Technology (Shenzhen) Co., Ltd.	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Sound United Hong Kong Limited	해외자회사 관리	100.0
	Sound Electronics (Shenzhen) Co. Ltd.	R&D	100.0
	D&M Sales & Marketing (H.K) Ltd.	오디오제품 판매	100.0
	D&M Digital Audio Trading (Shanghai) Ltd.	해외자회사 관리	100.0
	Marantz Shanghai Trading Ltd.	해외자회사 관리	100.0
	D&M Shanghai Electronics Ltd.	오디오제품 판매	100.0
	D&M Sales & Marketing Taiwan Ltd.	오디오제품 판매	100.0
	Bowers & Wilkins Trading Zhuhai Company Ltd.	오디오제품 생산	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율(%)(*)
국내	삼성디스플레이㈜	디스플레이 패널 생산 및 판매	89.2
	에스유머티리얼스㈜	디스플레이 패널 부품 생산	50.0
	스테코㈜	반도체 부품 생산	70.0
	세메스㈜	반도체・FPD 장비 생산, 판매	91.5
	삼성전자서비스㈜	전자제품 수리 서비스	99.3
	삼성전자서비스씨에스㈜	고객상담서비스	100.0
	삼성전자판매㈜	전자제품 판매	100.0

	삼성전자로지텍㈜	종합물류대행	100.0
	삼성메디슨㈜	의료기기 생산 및 판매	68.5
	㈜희망별숲	식품 제조 가공	100.0
	㈜미래로시스템	반도체 소프트웨어 개발 및 공급	99.9
	㈜하만인터내셔널코리아	소프트웨어 개발 및 공급	100.0
	㈜레인보우로보틱스	로봇・로봇 부품 생산, 판매	35.0
	디앤엠세일즈앤마케팅코리아㈜	오디오제품 판매	100.0
	플랙트그룹코리아㈜	에어컨공조 생산 및 판매	100.0
	SVIC 21호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 22호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 26호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 28호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 32호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 33호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 42호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 43호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 45호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 52호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 55호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 56호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 57호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 62호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 67호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 74호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 76호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	73.3

	SVIC 78호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 82호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	반도체성장 전문투자형 사모 투자신탁	반도체산업 투자	66.7
	시스템반도체 상생 전문투자형 사모 투자신탁	반도체산업 투자	62.5
	반도체 생태계 일반 사모 투자신탁	반도체산업 투자	66.7

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

특수관계자거래에 대한 공시

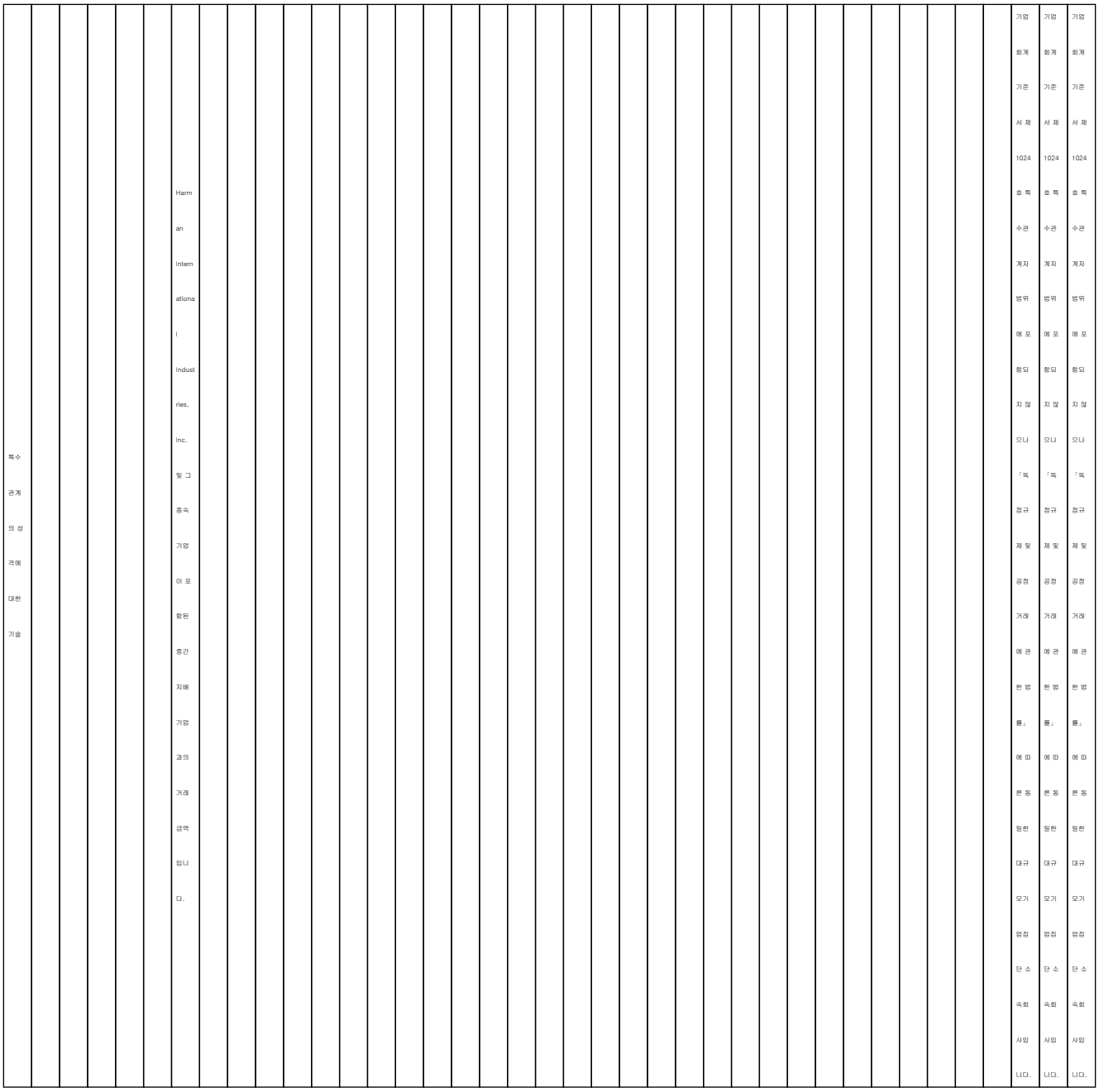
당분기

(단위 : 백만원)

	특수관계자의 범주																																
	모든 특수관계자의 합계																																
	모든 종속기업의 합계																									관계기업 및 공동기업					그 밖의 특수관계자		대규모기업집단		
	삼성디스플레이㈜	Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS)	Harman과 그 종속기업	Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)	Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL)	Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH)	Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV)	Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV)	Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC)	Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd. (SET)	Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	Samsung International, Inc. (SII)	세메스㈜	Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS)	Samsung Semiconductor Xian Co., Ltd. (SSCX)	Samsung Semiconductor Europe GmbH (SSEG)	Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. (SEM)	Samsung Japan Corporation (SJC)	Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)	기타	삼성에스디에스㈜	삼성전기㈜	삼성SDI㈜	㈜제일기획	기타	삼성물산㈜	기타	삼성이앤에이㈜	㈜에스원	기타
매출 등, 특수관계자 거래	366,497	23,302,815	182,120,212	49	118	10,850	992,735	46,206	4,651,104	80,881,647	4,815,134	0	379,916	1,165,136	587,315	2,869,072	15,438,493	3,274,919	545,728	8,933	5,439,592	10,923,129	8,696,872	2,939,956	7,300,208			52,766,245	126,082	50,112	41,658	37,603	505,602	2,184	22,298	772	2,515	146,428
비유동자산 처분, 특수관계자 거래	0	30	0	0	286,377	0	0	55,110	377	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	1,121	0	0	0	0	0			9,247	0	0	0	0	177	113	0	0	0	0
매입 등, 특수관계자 거래	560,825	217,510	732,211	0	2,698,374	35,063	9,913	7,264,245	31,485,765	0	5,311,557	0	18,316,198	0	6,034,773	960	1,239	76,750	5,280,749	1,408,374	1,713	0	1,447	3,901	98,773			11,939,429	1,538,860	299,830	273,240	633,881	571,530	34,488	505,508	20,321	362,587	219,831

| | | |

	삼성디스플레이㈜	Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS)	Harman과 그 종속기업	Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)	Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL)	Samsung Electronics Europe Holding Coöperatief U.A. (SEEH)	Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV)	Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV)	Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC)	Samsung Electronics Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd. (SET)	Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	Samsung International, Inc. (SII)	세메스㈜	Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS)	Samsung Semiconductor Xian Co., Ltd. (SSCX)	Samsung Semiconductor Europe GmbH (SSEG)	Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. (SEM)	Samsung Japan Corporation (SJC)	Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)	기타	삼성에스디에스㈜	삼성전기㈜	삼성SDI㈜	㈜제일기획	기타	삼성물산㈜	기타	삼성이앤에이㈜	㈜에스원	기타
매출 등, 특수관계자 거래	375,211	24,003,933	35,425,164	34	7,212	2,582	1,536,166	4,277,911	2,466,793	19,901,306	2,968,408	0	1,294,855	1,053,155	399,713	1,202,501	4,763,980	1,583,423	245,857	5,514	4,824,324			2,471,086	2,403,508	2,223,145	641,674	44,696,299	92,747	40,692	56,343	37,476	531,092	1,061	341,105	4,225	13,247	142,748
비유동자산 처분, 특수관계자 거래	0	0	0	0	0	0	0	40,160	276	0	0	0	58	0	946	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	16,458	61	0	0	0	794	20	0	0	0	0
매입 등, 특수관계자 거래	1,141,902	264,415	703,126	13,413	3,065,141	40,860	8,386	6,639,592	19,836,631	0	4,668,354	0	13,145,022	0	5,110,991	4,515	852	84,525	5,513,162	1,302,188	8,515			6,762	89,435	1,892,951	829	10,195,142	1,493,953	536,534	261,148	646,087	538,324	30,094	491,669	17,223	344,192	208,190
비유동자산 매입, 특수관계자 거래	0	0	0	0	0	0	0	12,449	340	0	27,472	0	219	0	28	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	13,094	192,190	0	11,372	2,389	8,615	1,759,279	52,625	1,039,960	40,973	303,083



특수관계자거래에 대한 공시, 합계

당분기 (단위 : 백만원)

	특수관계자의 범주			
	모든 특수관계자의 합계			
	모든 종속기업의 합계	관계기업 및 공동기업	그 밖의 특수관계자	대규모기업집단
매출 등, 특수관계자거래	409,522,881	761,057	24,482	149,715
비유동자산 처분, 특수관계자거래	352,312	177	113	0
매입 등, 특수관계자거래	91,479,769	3,317,341	539,996	602,739

비유동자산 매입, 특수관계자거래	64,687	178,618	4,343,025	3,416,673
특수관계의 성격에 대한 기술				기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

전분기 (단위 : 백만원)

	특수관계자의 범주			
	모든 특수관계자의 합계			
	모든 종속기업의 합계	관계기업 및 공동기업	그 밖의 특수관계자	대규모기업집단
매출 등, 특수관계자거래	158,773,754	758,350	342,166	160,220
비유동자산 처분, 특수관계자거래	57,898	855	20	0
매입 등, 특수관계자거래	73,736,709	3,476,046	521,763	569,605
비유동자산 매입, 특수관계자거래	53,602	214,566	1,811,904	1,384,016
특수관계의 성격에 대한 기술				기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

특수관계자거래의 채권·채무 잔액에 대한 공시

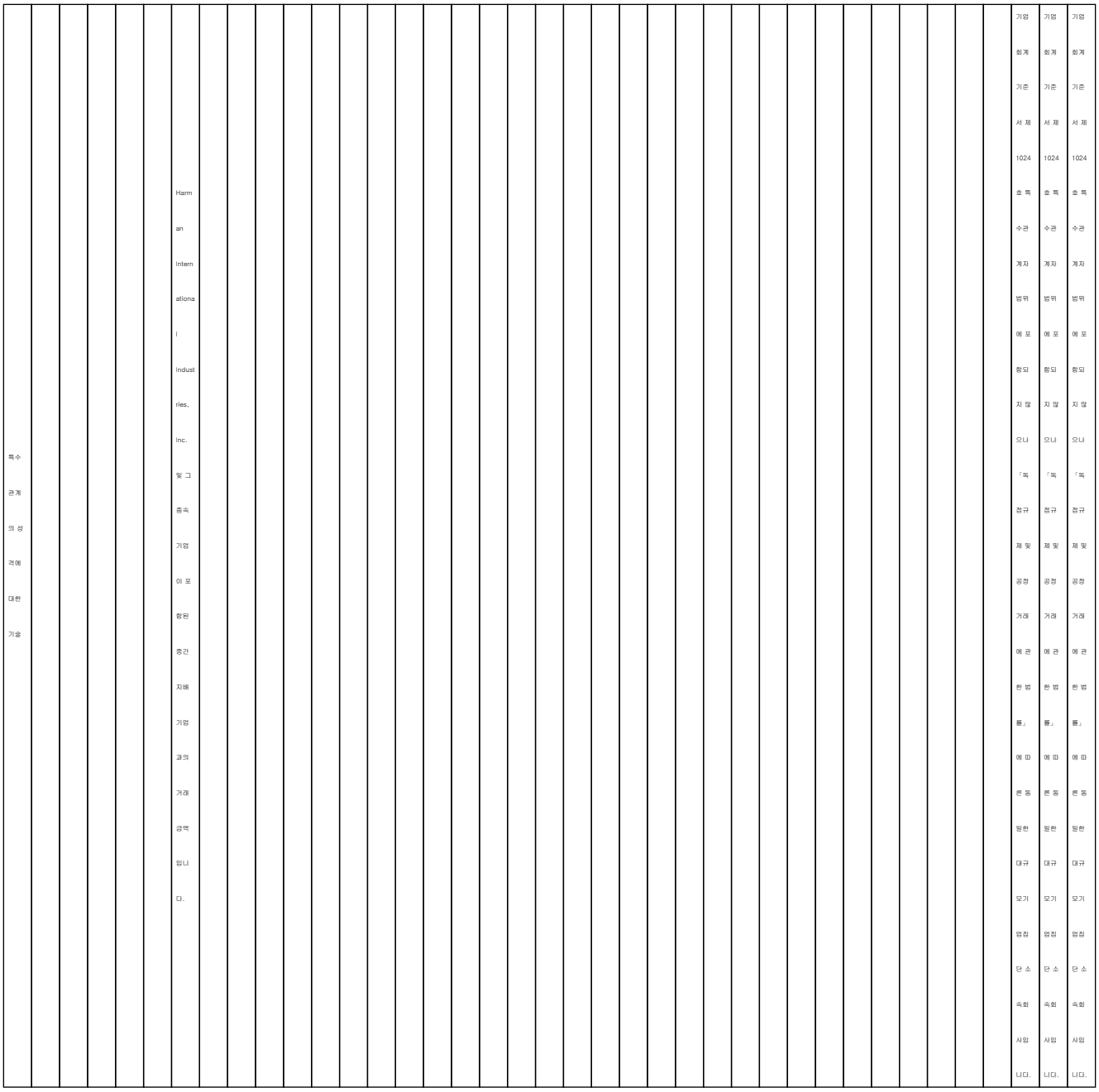
당분기말 (단위 : 백만원)

	특수관계자의 범주			
	모든 특수관계자의 합계			
	모든 종속기업의 합계	관계기업 및 공동기업	그 밖의 특수관계자	대규모기업집단

	삼성디스플레이㈜	Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS)	Harman과 그 종속기업	Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)	Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL)	Samsung Electronics Europe Holding Coöperatief U.A. (SEEH)	Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV)	Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV)	Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC)	Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd. (SET)	Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	Samsung International, Inc. (SII)	세메스㈜	Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS)	Samsung Semiconductor Xian Co., Ltd. (SSCX)	Samsung Semiconductor Europe GmbH (SSEG)	Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. (SEM)	Samsung Japan Corporation (SJC)	Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	Samsung Electronics GmbH (SEG)	기타	삼성에스디에스㈜	삼성전기㈜	삼성SDI㈜	㈜제일기획	기타	삼성물산㈜	기타	삼성이앤에이㈜	㈜에스원	기타
채권 등, 특수관계자 거래	23,414	8,030,153	75,215,039	1,111	33,358	11,599	102,564	47,476	3,031,160	27,793,358	1,985,447	371	1,487,386	152,000	87,401	1,313,675	3,051,267	264,594	84,481	85,998	1,010,467	2,819,809	3,251,995	304,742	3,162,888			11,356,334	33,364	3,776	120,492	599	86,566	182,078	14,447	192	912	2,485
채무 등, 특수관계자 거래	61,503	2,240,564	195,688	0	156,694	9,132	1,141	401,110	7,772,927	8,903	1,658,394	0	4,508,576	0	748,816	6,503	100,409	31,636	413,568	793,048	569	381	14,825	5,107	67,278			1,785,970	575,376	22,046	26,802	320,519	99,647	2,742,623	207,546	1,531,125	38,793	644,317
특수관계자거래의 채권,채무의 조건에 대한 설명	종속기업 채권에 대하여 인식된 손상당금 없음 니다. 채무보증 관련 스부채가 포함된 금액입니다.

| | | |

	삼성디스플레이㈜	Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS)	Harman과 그 종속기업	Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)	Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL)	Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH)	Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV)	Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV)	Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC)	Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd. (SET)	Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	Samsung International, Inc. (SII)	세메스㈜	Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS)	Samsung Semiconductor Xian Co., Ltd. (SSCX)	Samsung Semiconductor Europe GmbH (SSEG)	Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. (SEM)	Samsung Japan Corporation (SJC)	Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	Samsung Electronics GmbH (SEG)	기타	삼성에스디에스㈜	삼성전기㈜	삼성SDI㈜	㈜제일기획	기타	삼성물산㈜	기타	삼성이앤에이㈜	㈜에스원	기타
채권 등, 특수관계자 거래	52,814	2,161,468	17,075,167	2,090	6,536	4,487	142,708	66,784	1,160,571	8,168,594	841,800	1,721	515,417	111,701	108,414	290,367	473,249	145,685	275,082	94,204	328,563			67,872	795,141	130,685	40,555	7,311,079	26,250	2,474	120,664	54	168,932	182,715	14,535	260	1,238	3,652
채무 등, 특수관계자 거래	158,345	967,625	238,368	0	183,567	17,164	271,131	1,864,110	3,620,502	6,277	1,909,955	0	2,365,410	0	579,428	3,585	123,449	34,066	162,601	847,790	926,490			33,614	57,326	261,094	5,844	2,756,367	611,133	55,018	32,385	435,498	221,149	1,795,005	133,003	1,190,006	49,080	228,548
특수관계자 거래의 채권,채무의 조건에 대한 설명	종속기업 채권에 대하여 인식된 손상당금 없음 니다. 채무보증 관리 스부 채가 보함된 금액 입니다.



특수관계자에 대한 채권 채무에 대한 공시, 합계

당분기말 (단위 : 백만원)

	특수관계자의 범주			
	모든 특수관계자의 합계			
	모든 종속기업의 합계	관계기업 및 공동기업	그 밖의 특수관계자	대규모기업집단
채권 등, 특수관계자거래	144,708,087	244,797	196,525	3,589
채무 등, 특수관계자거래	20,982,742	1,044,390	2,950,169	2,214,235

특수관계자거래의 채권,채무의 조건에 대한 설명	종속기업 채권에 대하여 인식된 손실충당금은 없습니다. 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.
특수관계의 성격에 대한 기술				기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

전기말 (단위 : 백만원)

	특수관계자의 범주			
	모든 특수관계자의 합계			
	모든 종속기업의 합계	관계기업 및 공동기업	그 밖의 특수관계자	대규모기업집단
채권 등, 특수관계자거래	40,372,754	318,374	197,250	5,150
채무 등, 특수관계자거래	17,394,108	1,355,183	1,928,008	1,467,634
특수관계자거래의 채권,채무의 조건에 대한 설명	종속기업 채권에 대하여 인식된 손실충당금은 없습니다. 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.
특수관계의 성격에 대한 기술				기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

회사는 당분기말 현재 삼성생명㈜에 확정급여형 퇴직급여제도에 가입되어 있습니다.

확정급여형 퇴직급여제도에 대한 공시, 특수관계자 거래

당분기말 (단위 : 백만원)

	삼성생명㈜
사외적립자산 공정가치, 특수관계자 거래	18,917,510

전기말 (단위 : 백만원)

	삼성생명㈜
사외적립자산 공정가치, 특수관계자 거래	16,058,161

특수관계자 자금거래에 관한 공시

당분기 (단위 : 백만원)

	특수관계자의 범주	
	모든 특수관계자의 합계	
	종속기업	관계기업 및 공동기업
현금출자, 출자금 납입	504,672	0
현금출자, 출자금 회수	41,523	0

전분기 (단위 : 백만원)

	특수관계자의 범주	
	모든 특수관계자의 합계	
	종속기업	관계기업 및 공동기업
현금출자, 출자금 납입	378,621	308,181
현금출자, 출자금 회수	146,732	0

종속기업 차입금에 대한 공시

(단위 : 백만원)

	특수관계자의 범주
	모든 특수관계자의 합계
	모든 종속기업의 합계
차입금 상환	20,000,000

종속기업, 관계기업 및 공동기업에 대한 대여 및 차입 사실에 대한 기술

회사는 당분기 및 전분기 중 종속기업에 대여한 내역은 없으며, 당분기 및 전분기중 종속기업으로부터 차입한 금액은 없습니다. 당분기 중 종속기업으로부터의 차입금 중 20,000,000백만원을 상환하였습니다. 또한, 당분기 및 전분기 중 관계기업 및 공동기업에게 대여 및 차입한 내역은 없습니다.

특수관계자 기타 거래에 관한 공시

당분기 (단위 : 백만원)

	특수관계자의 범주
	모든 특수관계자의 합계

	종속기업, 관계기업 및 공동기업과 그 밖의 특수관계자	대규모기업집단
지급결의한 배당금, 특수관계자거래	1,407,154	114,719
리스 이용 계약, 특수관계자거래	8,620	
리스이용자로서 리스, 특수관계자거래	36,575	

전분기 (단위 : 백만원)

	특수관계자의 범주	
	모든 특수관계자의 합계	
	종속기업, 관계기업 및 공동기업과 그 밖의 특수관계자	대규모기업집단
지급결의한 배당금, 특수관계자거래	1,205,459	96,695
리스 이용 계약, 특수관계자거래	87,052	
리스이용자로서 리스, 특수관계자거래	49,568	

배당과 관련한 미지급금에 대한 공시, 특수관계자거래

(단위 : 백만원)

	특수관계자의 범주	
	모든 특수관계자의 합계	
	종속기업, 관계기업 및 공동기업과 그 밖의 특수관계자	대규모기업집단
배당과 관련한 미지급금, 특수관계자거래	0	0

특수관계자 채무에 대한 채무보증 제공 사실에 대한 기술

회사는 보고기간종료일 현재 특수관계자의 채무에 대하여 채무보증을 제공하고 있습니다(주석 13 참조).

주요 경영진에 대한 보상에 대한 공시

당분기 (단위 : 백만원)

	당해 기업이나 당해 기업의 지배기업의 주요 경영진
단기급여	13,855
퇴직급여	299
기타 장기급여	4,759

전분기 (단위 : 백만원)

	당해 기업이나 당해 기업의 지배기업의 주요 경영진
단기급여	5,625
퇴직급여	383
기타 장기급여	4,332

29. 보고기간 후 사건

수정을 요하지 않는 보고기간후사건에 대한 공시

	자기주식 거래
수정을 요하지 않는 보고기간후사건의 성격에 대한 기술	회사는 2026년 8월 21일 이사회 결의에 따라 주식보상에 사용할 목적으로 자기주식을 취득하였으며, 보고기간종료일 이후 보통주 9,056,305주(취득가액 2,471,212백만원)를 취득하였습니다.

6. 배당에 관한 사항

6-1. 회사의 배당정책에 관한 사항

가. 배당 목표 결정시 사용하는 재무지표 및 산출방법

당사는 제품 및 사업 경쟁력 강화와 함께 주주환원을 통하여 주주가치를 제고할 수 있도록 지속적으로 노력하고 있습니다. 당사는 2021~2023년의 주주환원 정책에 따라 3년간 잉여현금흐름(Free Cash Flow)의 50%를 재원으로 활용하여 정규 배당을 연간 총 9.8조원 수준으로 실시하였습니다.

나. 향후 배당 수준의 방향성

당사는 2024년 1월에 2024~2026년의 주주환원 정책을 발표하였습니다. 이에 따라 당사는 2024년부터 2026년까지 3년간 발생하는 잉여현금흐름의 50%를 재원으로 활용하여 연간 9.8조원 수준의 정규배당을 유지하되, 정규배당 이후에도 잔여 재원이 발생하는 경우에 추가로 환원할 계획입니다.

당사는 주주가치 제고를 위하여 분기배당 제도를 도입하고 지난 10년간 연간 정규배당 금액을 분기별로 균등하게 분기배당과 결산배당 형태로 지급하고 있는데, 2025년 결산배당시 세제개편과 예상 배당재원을 감안하여 1.3조원 규모의 추가 배당을 실시한 바 있습니다. 또한, 당사는 2024년부터 2026년까지의 주주환원 정책 대상 기간 종료 이전이라도 M&A 추진, 현금규모 등을 감안하여 탄력적으로 새로운 주주환원 정책을 발표하고 시행할 수 있습니다.

당사는 2024년 11월에 향후 1년간 총 10조원 규모의 자기주식 분할 매입 계획을 발표하고, 이 중 3조원은 주주가치 제고를 목적으로 매입 후 2025년 2월에 소각하였습니다. 또한

2025년 2월과 7월에 주주가치 제고 및 임직원 보상 등 목적으로 약 3조원과 약 4조원 총 7조원 규모의 자기주식 취득을 결정하였고, 2025년 9월에 취득을 완료했습니다. 이와 같이 2025년 중에 매입한 자기주식 중 임직원 보상 목적을 제외한 5.3조원 규모의 자기주식 전량을 2026년 4월에 소각하였습니다.

당사는 2026년 8월 21일에 2026년 주주환원 예상 규모 및 시행 방안 계획을 발표하였습니다. 2026년 주주환원 잔여 재원(3년간 총 FCF 50%에서 2024년~2025년 시행한 29.3조원 차감)은 약 90~110조원 규모로 예상되고, 2026년 3분기에는 정규 분기배당을 포함해 30조원 규모의 현금배당을 시행하기로 2026년 10월 29일 이사회에서 결의하였습니다. 2026년 결산 후 2027년 1월말 개최 예정인 이사회에서 나머지 주주환원의 규모 및 구체적인 시행 방안을 최종 결정하여 별도 발표할 계획이고, 나머지 주주환원은 현금배당과 자기주식 매입/소각을 종합적으로 고려하여 시행할 예정입니다.

다. 배당 제한 관련 정책

해당사항 없습니다.

6-2. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항

가. 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부

구분	결산배당	분기・중간배당
정관상 배당액 결정 기관	주주총회	이사회
정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부	X	X
배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획	검토중	검토중

나. 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황

구분	결산월	배당여부	배당액 확정일	배당기준일	배당 예측가능성 제공여부	비고
결산배당	2025년 12월	O	2026년 03월 18일	2025년 12월 31일	X	-
결산배당	2024년 12월	O	2025년 03월 19일	2024년 12월 31일	X	-
결산배당	2023년 12월	O	2024년 03월 20일	2023년 12월 31일	X	-

※ 당사는 3년 단위(2024~2026년)의 주주환원 정책을 발표하고 연간 동일한 금액(약 9.8조원)에 대해
분기 단위로 정규배당을 실시하여 실질적인 예측가능성을 제공하고 있으며, 2025년 결산배당시 세제개편과 예상 배당재원을 감안하여 1.3조원 규모의 추가 배당을 실시한 바 있습니다.

6-3. 기타 참고사항

[주요 배당지표] (단위 : 원, 백만원, %, 주)

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기
		제58기 3분기	제57기	제56기
주당액면가액(원)		100	100	100
(연결)당기순이익(백만원)		193,578,792	44,260,956	33,621,363
(별도)당기순이익(백만원)		178,323,283	33,686,601	23,582,565
(연결)주당순이익(원)		29,381	6,605	4,950
현금배당금총액(백만원)		34,912,235	11,107,906	9,810,767
주식배당금총액(백만원)		-	-	-
(연결)현금배당성향(%)		18.0	25.1	29.2
현금배당수익률(%)	보통주	1.9	1.5	2.7
	우선주	2.5	1.9	3.3
주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-
	우선주	-	-	-
주당 현금배당금(원)	보통주	5,347	1,668	1,446
	우선주	5,347	1,669	1,447
주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-
	우선주	-	-	-

※ (연결)당기순이익은 연결당기순이익의 지배기업 소유주지분 귀속분입니다.

※ (연결)주당순이익은 보통주 기본주당이익입니다. 기본주당이익 산출근거는 'III. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 중 '주당이익' 항목을 참고하시기 바랍니다.

※ 현금배당금총액의 자세한 내용은 'III. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 중 '연결이익잉여금' 항목을 참고하시기 바랍니다. 분기 배당금은

제58기 1분기 2,453,316백만원(주당 372원), 2분기 2,455,895백만원(주당 374원), 3분기 30,003,024백만원(주당 4,601원)이며,

제57기 1분기 2,447,284백만원(주당 365원), 2분기 2,453,793백만원(주당 367원), 3분기 2,453,345백만원(주당 370원)이며,

제56기 1분기 2,452,154백만원(주당 361원), 2분기 2,452,154백만원(주당 361원), 3분기 2,452,154백만원(주당 361원)입니다.

[과거 배당 이력]

(단위: 회, %)

연속 배당횟수		평균 배당수익률	
분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간
48	45	2.0	2.1

※ 연속 배당횟수는 당기 분기배당 및 최근사업연도 결산배당을 포함하고 있습니다.

※ 중간배당은 1999년(제31기)부터 연속 배당 시작하였고, 분기배당은 2017년(제49기)부터 연속 배당중이며, 결산배당은 1981년(제13기)부터 연속 배당 중입니다.

※ 평균 배당수익률은 보통주 배당수익률입니다. 우선주에 대한 최근 3년간 평균 배당수익률은 2.5%, 최근 5년간 평균 배당수익률은 2.5%입니다.

※ 최근 3년간은 2023년(제55기)부터 2025년(제57기)까지 기간이며, 최근 5년간은 2021년(제53기)부터

2025년(제57기)까지 기간입니다. 2026년(제58기) 3분기 배당수익률은 상기 '주요 배당지표'를 참고하시기 바랍니다(보통주 1.9%, 우선주 2.5%).

7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

당사는 공시대상기간 중 지분증권의 발행 실적이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2026년 09월 30일) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급 (평가기관)	만기일	상환 여부	주관회사
삼성전자㈜	회사채	공모	1997.10.02	135,840	7.7%	Aa2 (Moody's), AA- (S&P)	2027.10.01	일부상환	Goldman Sachs 등
합 계	-	-	-	135,840	-	-	-	-	-

나. 기업어음증권 미상환 잔액

해당사항 없습니다.

(기준일 : 2026년 09월 30일) (단위 : 백만원)

잔여만기		10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년 초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 전자단기사채 미상환 잔액

해당사항 없습니다.

(기준일 : 2026년 09월 30일) (단위 : 백만원)

잔여만기		10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 09월 30일) (단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모	6,792	6,792	-	-	-	-	-	13,584
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	6,792	6,792	-	-	-	-	-	13,584

※ 미상환잔액은 기준일 환율을 적용하였습니다.

마. 신종자본증권 미상환 잔액

해당사항 없습니다.

(기준일 : 2026년 09월 30일) (단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 15년이하	15년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 조건부자본증권 미상환 잔액

해당사항 없습니다.

(기준일 : 2026년 09월 30일) (단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등(삼성전자)

(작성기준일 : 2026년 09월 30일) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사
US$ 100,000,000 7.7% Debenture	1997.10.02	2027.10.01	135,840	1997.10.02	The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.

(이행현황기준일 : 2026년 09월 30일)

재무비율 유지현황	계약내용	해당사항 없음
	이행현황	해당사항 없음
담보권설정 제한현황	계약내용	순유형자산의 10% 미만
	이행현황	계약내용 이행 중 (해당 자산에 대해 담보권 설정 없음)
자산처분 제한현황	계약내용	(보증인이) 자산의 전부 또는 대부분을 처분하려면 본채권에 대한 의무사항 승계 등 조건을 충족시켜야 함
	이행현황	계약내용 이행 중 (2026년 3분기 중 처분 자산은 전체의 0.0%)
지배구조변경 제한현황	계약내용	해당사항 없음
	이행현황	해당사항 없음
이행상황보고서 제출현황	이행현황	해당사항 없음

※ 발행액은 기준일 환율을 적용하였습니다.

※ 사채관리계약 체결일은 Fiscal Agency Agreement 체결일로서, The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.는 Fiscal Agent의 지위에 있습니다.

※ 담보권설정 제한자산인 순유형자산은 생산설비 및 본사 보유주식입니다.

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근 재무제표의 작성기준일입니다.

※ 지배구조변경 제한현황은 공시서류 작성기준일입니다.

7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

공시대상기간 중 공시대상인 자금조달 실적이 없습니다.

8. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항

(1) 재무제표 재작성

해당사항 없습니다.

(2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항

(㈜도우인시스 지분매각)

종속기업 삼성디스플레이㈜는 OLED 산업 내 경쟁구도가 갈수록 심화되고 있는 상황에서 본연의 사업과 R&D에 집중하기 위해 2024년 1월 31일자로 SVIC 29호 신기술투자조합 및 SVIC 48호 신기술투자조합이 보유한 ㈜도우인시스 지분 56.8%를 ㈜뉴파워프라즈마 등 3개사에 매각하였습니다.

(레인보우로보틱스㈜ 지분인수)

당사는 2024년 12월 31일 이사회 결의를 통해 레인보우로보틱스㈜의 최대주주로부터 394만주(20.3%)의 지분을 취득하는 콜옵션 행사를 결의하였으며, 2025년 3월 12일에 지분 인수 절차를 완료하였습니다. 향후 당사가 보유한 AI 및 소프트웨어기술과레인보우로보틱스㈜의 로봇기술을 접목하여 첨단 미래 로봇개발을 신속하고 체계적으로 준비해나갈 예정입니다.

(Sound United 지분인수)

종속기업 Harman International Industries, Inc.는 오디오 경쟁력 강화를 위해 2025년 9월 23일자로 Masimo Corporation (대표자: Katie Szyman, 소재지: Irvine, USA)의 오디오사업 법인(Sound United) 지분 100%를 인수하였습니다. 향후 당사는 오디오 전문기업 하만의 브랜드 경쟁력을 공고히 하고, 모바일과 TV 등 당사 사업과도 시너지를 확대하여 오디오 사업을 핵심 사업 중 하나로 지속 육성할 계획입니다.

(FlaktGroup 지분인수)

당사는 글로벌 중앙공조 경쟁력 강화를 위해 2025년 11월 6일자로 FlaktGroup Holding GmbH(대표자: David Dorney, 소재지: Herne, Germany)의 지분 100%를 인수하였습니다. 향후 당사는 AI・데이터센터 등에 수요가 큰 중앙공조 전문기업인 FlaktGroup과의 시너지로 고성장 중인 글로벌 공조시장에서 사업영역을 확장하고, 이를 미래 성장동력으로 적극 육성할 계획입니다.

(Xealth, Inc. 지분인수)

당사는 디지털 헬스케어 경쟁력 강화를 위해 2025년 10월 16일자로 미국의 디지털 헬스케어 전문기업 Xealth, Inc.(대표자 : Mike McSherry, 소재지 : Seattle, WA, USA)의 지분 100%를 인수하였습니다. 향후 Xealth의 미국내 병원 500여개와 디지털 헬스케어 솔루션 회사 70여개를 기반으로 한 플랫폼과 당사의 모바일・웨어러블 기술을 결합하여 환자와 의료진을 연결하는 '커넥티드 케어(Connected Care)' 생태계를 구축하고 삼성헬스 플랫폼의 글

로벌 경쟁력을 지속적으로 강화해 나갈 계획입니다.

(3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항

(자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리)

해당사항 없습니다.

(중요한 소송사건)

당사는 다수의 회사 등과 정상적인 영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 및 규제기관의 조사 등이 진행 중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 당사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

(채무보증 내역)

1) 국내채무보증

해당사항 없습니다.

2) 해외채무보증

(단위 : 천US$, %)

법인명 (채무자)	관계	채권자	내용	목적	보증시작일	보증종료일	채무보증한도		채무금액			이자율
							기초	기말	기초	증감	기말	
SEA	계열회사	BOA 외	지급보증	운영자금	2025-11-09	2027-06-13	1,278,000	3,575,000	-	-	-	-
SEM	계열회사	BBVA 외	지급보증	운영자금	2025-11-09	2027-08-19	715,000	580,000	-	-	-	-
SAMCOL	계열회사	Citibank 외	지급보증	운영자금	2025-11-09	2027-06-13	180,000	111,000	-	-	-	-
SEDA	계열회사	BRADESCO 외	지급보증	운영자금	2025-11-09	2027-09-30	329,000	1,071,000	-	-	-	-
SECH	계열회사	Citibank 외	지급보증	운영자금	2025-12-17	2027-06-13	64,000	50,000	-	-	-	-
SEPR	계열회사	BBVA 외	지급보증	운영자금	2025-12-17	2027-06-13	150,000	127,000	-	-	-	-
SSA	계열회사	SCB 외	지급보증	운영자금	2025-11-09	2027-06-13	286,000	122,000	-	-	-	-
SEMAG	계열회사	Citibank 외	지급보증	운영자금	2025-12-17	2026-12-16	46,000	16,000	-	-	-	-
SETK	계열회사	BNP 외	지급보증	운영자금	2025-11-09	2027-06-13	947,000	887,000	11,639	128,114	139,753	36.78%
SETK-P	계열회사	BNP 외	지급보증	운영자금	2025-11-09	2026-12-16	70,000	70,000	-	-	-	-
SECE	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2025-12-17	2026-12-16	114,000	15,000	-	-	-	-
SEEG	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2026-06-14	2027-06-13	85,000	30,000	-	-	-	-
SEIN	계열회사	BNP 외	지급보증	운영자금	2025-11-09	2027-06-13	70,000	70,000	-	-	-	-
SJC	계열회사	Mizuho Bank 외	지급보증	운영자금	2025-11-09	2027-05-31	809,211	492,639	-	-	-	-
SEUC	계열회사	Credit Agricole	지급보증	운영자금	2025-11-09	2026-11-08	115,000	-	-	-	-	-
SEDAM	계열회사	Santander	지급보증	운영자금	2025-11-09	2027-06-13	537,000	150,000	-	-	-	-
SECA	계열회사	BoA	지급보증	운영자금	2025-11-09	2026-11-08	72,000	19,000	-	-	-	-
SELA	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2025-12-17	2026-12-16	90,000	60,000	-	-	-	-
SEEH	계열회사	Citibank 외	지급보증	운영자금	2025-11-01	2027-09-05	938,400	233,000	-	-	-	-
SELV	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2025-12-17	2026-12-16	10,000	10,000	-	-	-	-
SEIL	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2025-12-17	2026-12-16	15,600	-	-	-	-	-
SAPL	계열회사	Citibank 외	지급보증	운영자금	2025-11-09	2026-12-16	404,000	35,000	-	-	-	-
SAVINA	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2026-06-14	2027-06-13	51,000	51,000	-	-	-	-
SEV	계열회사											
SEVT	계열회사											
SEHC	계열회사											
SCIC	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2026-06-14	2027-06-13	270,000	10,000	-	-	-	-
SESP	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2025-11-09	2026-11-08	30,000	10,000	-	-	-	-
SME	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2025-11-09	2026-11-08	110,000	100,000	-	-	-	-
SAMEX	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2025-12-17	2026-12-16	5,000	5,000	-	-	-	-
SEASA	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2025-12-17	2026-12-16	2,000	2,000	-	-	-	-
SSAP	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2025-11-09	2026-11-08	35,000	10,000	-	-	-	-
SEPM	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2026-06-14	2027-06-13	35,000	-	-	-	-	-
SESAR	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2026-06-14	2027-06-13	20,000	20,000	-	-	-	-
SEUZ	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2025-12-17	2026-12-16	20,000	-	-	-	-	-
Flakt	계열회사	BNP	지급보증	운영자금	2026-03-16	2026-11-08	-	60,000	-	-	-	-

법인명 (채무자)	관계	채권자	내용	목적	보증 시작일	보증 종료일	채무보증한도		채무금액			이자율
							기초	기말	기초	증감	기말	

SDN	계열회사	SIEL	지급보증	운영자금 등	2026-02-19	2029-02-19	556,979	364,640	473,432	△108,792	364,640	7.83%
Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	계열회사	SocGen	지급보증	운영자금	2025-11-09	2026-11-08	15,000	-	-	-	-	-
Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	계열회사											
Harman International Japan Co., Ltd.	계열회사	MUFG	지급보증	운영자금	2025-11-09	2026-11-08	25,000	25,000	-	-	-	-
Harman International Industries Limited	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2026-06-14	2027-06-13	30,000	30,000	-	-	-	-
Harman International Industries Inc.	계열회사	JP Morgan	지급보증	운영자금	2026-06-14	2027-06-13	100,000	100,000	-	-	-	-
Harman Holding Ltd, Hong Kong	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2026-06-14	2027-06-13	30,000	30,000	-	-	-	-
SAS	계열회사	Epcor	지급보증	운영자금 등	2022-04-26	채무소멸시	275,000	275,000	-	-	-	-
SEA	계열회사	US Government	지급보증	보조금	2024-12-20	채무소멸시	6,435,000	6,435,000	-	-	-	-
합 계							15,370,190	15,251,279	485,071	19,322	504,393	-

※ 연결 기준입니다. SDN 건은 삼성디스플레이㈜, SAS 건은 SEA가 각각 채무보증인입니다. [△는 부(-)의 값임]

※ 건별 채무보증금액이 자기자본의 0.1% 이상 2.5% 미만인 경우 경영위원회, 2.5% 이상인 경우 이사회 의결을 통해 결정됩니다.

또한 종속기업인 삼성디스플레이㈜의 경우 건별 채무보증금액이 100억원 이상인 경우 이사회 의결을 통해 결정됩니다.

※ 상기 채무보증에 대하여 당사가 보증하는 채무보증의 대가로 종속기업별 채무보증 만기, 일반적인 신용공여 조건의 이율 등을

감안하여 수수료를 수취하고 있습니다.

당사는 2025년 중 $1,199천의 수수료를 청구하여, 2026년 수취하였습니다.

한편 삼성디스플레이㈜는 SDN에게 2025년 중 $2,841천의 수수료를 청구하여 2026년 수취하였습니다.

※ SEA의 US Government 채무는 SAS가 반도체 보조금 계약 불이행시 미 상무부에 반환해야하는 금액에 대한 모법인의 지급보증 계약입니다.

☞ 우발채무 등에 관한 사항은 'III. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석'을 참조하시기 바랍니다.

(4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항

(감사보고서상 강조사항과 핵심감사사항)

구 분	강조사항 등	핵심감사사항
제58기 3분기	해당사항 없음	해당사항 없음
제57기	해당사항 없음	(연결재무제표) 1. 건설중인자산의 감가상각개시시점 평가 2. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감의 정확성과 완전성 (별도재무제표) 1. 건설중인자산의 감가상각개시시점 평가 2. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감의 정확성과 완전성
제56기	해당사항 없음	(연결재무제표) 1. 건설중인자산의 감가상각개시시점 평가 2. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감의 정확성과 완전성 (별도재무제표) 1. 건설중인자산의 감가상각개시시점 평가 2. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감의 정확성과 완전성

나. 대손충당금(손실충당금) 설정 현황

(1) 계정과목별 대손충당금(손실충당금) 설정내역

(단위 : 백만원, %)

구 분	계정과목	채권 금액	대손충당금 (손실충당금)	대손충당 설정률
제58기 3분기말	매출채권	106,615,033	517,682	0.5%
	단기대여금	14,274	261	1.8%
	미수금	9,800,026	35,173	0.4%
	선급금	1,622,746	3,912	0.2%
	장기매출채권	754,879	3,385	0.4%
	장기미수금	517,852	1,336	0.3%
	장기선급금	4,442,365	12,608	0.3%
	장기대여금	240,804	1,023	0.4%
	합 계	124,007,979	575,380	0.5%
제57기말	매출채권	51,702,078	574,436	1.1%
	단기대여금	19,121	279	1.5%
	미수금	7,522,132	40,805	0.5%
	선급금	1,500,422	5,227	0.3%
	장기매출채권	464,435	313	0.1%
	장기미수금	830,274	1,510	0.2%
	장기선급금	4,026,670	9,170	0.2%
	장기대여금	136,703	898	0.7%
	합 계	66,201,835	632,638	1.0%
제56기말	매출채권	44,044,074	421,001	1.0%
	단기대여금	119,558	94,051	78.7%
	미수금	9,707,716	84,742	0.9%
	선급금	1,366,329	4,573	0.3%
	장기매출채권	27,641	-	0.0%
	장기미수금	784,030	203	0.0%
	장기선급금	5,997,761	6,802	0.1%
	장기대여금	141,149	911	0.6%
	합 계	62,188,258	612,285	1.0%

※ 연결 기준입니다.

※ 채권 금액은 현재가치할인차금 차감 후 금액입니다.

(2) 대손충당금(손실충당금) 변동 현황

(단위 : 백만원)

구 분	제58기 3분기	제57기	제56기
기초 대손충당금(손실충당금)	632,638	612,285	528,063
순대손처리액(①-②+③)	51,289	150,107	△22,558
① 대손처리액(상각채권액) 등	29,495	142,603	10,834
② 상각채권회수액	-	-	-
③ 기타증감액	21,794	7,504	△33,392
대손상각비 계상(환입)액	△5,969	170,460	61,664
기말 대손충당금(손실충당금)	575,380	632,638	612,285

※ 연결 기준입니다. [△는 부(-)의 값임]

(3) 매출채권 관련 대손충당금(손실충당금) 설정 방침

(설정방침)

- 매출채권과 기타채권 잔액에 대하여 과거의 대손경험률과 장래의 대손예상액을 고려하는 기대신용손실모형을 적용하여 대손충당금(손실충당금) 설정

(대손경험률 및 대손예상액 산정근거)

- 대손경험률: 과거 3개년 평균 채권잔액에 대한 신용손실 경험 등을 근거로 연령별 대손경험률을 산정하여 설정
- 대손예상액: 채무자의 파산, 강제집행, 사망, 실종 등으로 회수가 불투명한 채권의 경우 회수가능성, 담보설정여부 등과 채무자의 신용정보 및 미래 전망을 고려하여 합리적인 대손예상액 설정

[대손 설정 기준]

상 황	설정률
분 쟁	25%
수금의뢰	50%
소 송	75%
부 도	100%

(대손 처리 기준)

매출채권 등에 대해 다음과 같은 사유 발생 시 실대손처리
- 파산, 부도, 강제집행, 사업의 폐지, 채무자의 사망, 실종 등으로 인해 채권의 회수 불능이 객관적으로 입증된 경우
- 소송에 패소하였거나 법적 청구권이 소멸한 경우
- 외부 채권회수 전문기관이 회수가 불가능하다고 통지한 경우
- 담보설정 부실채권, 보험Cover 채권은 담보물을 처분하거나 보험사로부터 보험금을 수령한 경우
- 회수에 따른 비용이 채권금액을 초과하는 경우

(4) 경과기간별 매출채권 잔액 현황

(기준일 : 2026년 9월 30일) (단위 : 백만원, %)

구 분	6월 이하	6월 초과 1년 이하	1년 초과 3년 이하	3년 초과	계
금 액	107,123,342	26,401	96,490	123,679	107,369,912
구성비율	99.8%	0.0%	0.1%	0.1%	100.0%

※ 연결 기준입니다.

※ 매출채권 잔액은 현재가치할인차금 차감 후 금액입니다.

다. 재고자산 현황

(1) 사업부문별 재고자산의 보유 현황

(단위 : 백만원, %, 회)

부문	계정과목	제58기 3분기말	제57기말	제56기말
DX 부문	제품 및 상품	9,553,264	7,435,663	7,198,304
	반제품 및 재공품	1,213,488	1,059,652	1,130,657
	원재료 및 저장품	15,297,946	10,735,674	10,352,671
	미착품	1,262,242	1,157,612	1,231,092
	소 계	27,326,940	20,388,601	19,912,724
DS 부문	제품 및 상품	4,793,254	3,308,507	5,394,407
	반제품 및 재공품	31,276,069	22,074,106	21,091,920
	원재료 및 저장품	4,218,337	3,376,739	3,134,003
	미착품	47,789	46,567	68,244
	소 계	40,335,449	28,805,919	29,688,574
SDC	제품 및 상품	381,854	491,293	458,697
	반제품 및 재공품	1,070,052	630,600	151,553
	원재료 및 저장품	1,072,816	847,793	575,119
	미착품	24,242	11,080	15,672
	소 계	2,548,964	1,980,766	1,201,041
Harman	제품 및 상품	974,378	1,122,098	916,269
	반제품 및 재공품	104,427	117,851	108,241
	원재료 및 저장품	1,001,800	855,096	680,564
	미착품	725,658	382,940	401,238
	소 계	2,806,263	2,477,985	2,106,312
총 계	제품 및 상품	15,851,032	12,279,101	13,842,276
	반제품 및 재공품	33,578,642	23,776,930	22,340,482
	원재료 및 저장품	21,079,504	15,271,612	14,146,279
	미착품	1,485,993	1,309,185	1,425,828
	소 계	71,995,171	52,636,828	51,754,865
총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산합계÷기말자산총계×100]		9.1%	9.3%	10.1%
재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}]		3.5회	3.9회	3.6회

※ 당사 연결 기준입니다.

(2) 재고자산의 실사내역 등

(실사내역)

- 5월말 및 11월말 기준으로 매년 2회 재고자산 실사 실시
- 재고조사 시점과 기말시점의 재고자산 변동내역은 해당 기간 전체 재고의 입출고 내역을 확인하여 재무상태표일 기준 재고자산의 실재성을 확인

(실사방법)

- 사내보관재고: 폐창식 전수조사 실시
  ※ 반도체 및 디스플레이 패널 라인 재고 및 자동화창고보관 SVC자재는 표본조사
- 사외보관재고: 제3자 보관재고, 운송 중인 재고는 전수로 물품보유확인서 또는 장치보관확인서 징구 및 표본조사 병행
- 외부감사인은 당사의 기말 재고실사에 입회·확인하고 일부 항목은 표본 추출하여 그 실재성 및 완전성 확인

(장기체화재고 등 내역)

재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우 저가법 등을 사용하여 재고자산의 장부금액을 결정하고 있으며, 2026년 3분기말 현재 재고자산에 대한 평가내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2026년 9월 30일) (단위 : 백만원)

계정과목	취득원가	보유금액	평가충당금	기말잔액
제품 및 상품	17,034,744	17,034,744	△1,183,712	15,851,032
반제품 및 재공품	36,324,587	36,324,587	△2,745,945	33,578,642
원재료 및 저장품	22,524,936	22,524,936	△1,445,432	21,079,504
미착품	1,485,993	1,485,993	-	1,485,993
합 계	77,370,260	77,370,260	△5,375,089	71,995,171

※ 당사 연결 기준입니다. [△는 부(-)의 값임]

라. 수주계약 현황

2026년 3분기말 현재 당사 재무제표에 중요한 영향을 미치는 장기공급계약 수주거래는 없습니다.

마. 공정가치평가 내역

(1) 금융상품의 공정가치평가 방법

[금융자산]

(분류)

당사는 금융자산을 공정가치 측정 금융자산(기타포괄손익 또는 당기손익에 공정가치변동 인식), 상각후원가 측정 금융자산으로 분류합니다.

금융자산은 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에근거하여 분류합니다.

공정가치로 측정하는 금융자산의 손익은 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다. 채무상품에 대한 투자는 해당 자산을 보유하는 사업모형에 따라 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다. 당사는 금융자산을 관리하는 사업모형을 변경하는 경우에만 채무상품을 재분류합니다.

단기매매항목이 아닌 지분상품에 대한 투자는 최초 인식시점에 후속적인 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 것을 지정하는 취소불가능한 선택을 할 수 있습니다. 지정되지 않은 지분상품에 대한 투자의 공정가치 변동은 당기손익으로 인식합니다.

(측정)

당사는 최초 인식시점에 금융자산을 공정가치로 측정하며, 당기손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 경우에 해당 금융자산의 취득이나 해당 금융부채의 발행과 직접 관련되는 거래원가는 공정가치에 가산합니다. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 거래원가는 당기손익으로 비용처리합니다.

내재파생상품을 포함하는 복합계약은 계약상 현금흐름이 원금과 이자로만 구성되어 있는지를 결정할 때 해당 복합계약 전체를 고려합니다.

1) 채무상품

금융자산의 후속적인 측정은 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상현금흐름 특성에 근거합니다. 당사는 채무상품을 다음의 세 범주로 분류합니다.

① 상각후원가 측정 금융자산
사업모형이 계약상 현금흐름을 수취하기 위해 보유하는 것이고, 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있는 경우, 금융자산은 상각후원가로 측정합니다. 상각후원가로 측정하는 금융자산으로서 위험회피관계의 적용 대상이 아닌 금융자산의 손익은해당 금융자산을 제거하거나 손상할 때 당기손익으로 인식합니다. 유효이자율법에 따라 인식하는 금융자산의 이자수익은 '금융수익'에 포함됩니다.

② 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
사업모형이 계약상 현금흐름의 수취와 금융자산의 매도 둘 모두를 위해 보유하는 것이고, 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있는 경우, 금융자산은 기타포괄손익-공정가치로 측정합니다. 손상차손(환입)과 이자수익 및 외환손익을 제외하고는, 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 손익은 기타포괄손익으로 인식합니다. 금융자산을 제거할 때에는 인식한 기타포괄손익누계액을 자본에서 당기손익으로재분류합니다. 유효이자율법에 따라 인식하는 금융자산의 이자수익은 '금융수익'에 포함됩니다. 외환손익은 '금융수익' 또는 '금융비용'으로 표시하고 손상차손은 '기타비용'으로 표시합니다.

③ 당기손익-공정가치 측정 금융자산
상기 상각후원가 측정이나 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 채무상품은 당기손익-공정가치로 측정됩니다. 위험회피관계가 적용되지 않는 당기손익-공정가치 측정 채무상품의 손익은 당기손익으로 인식하고 발생한 기간에 손익계산서에
'기타수익' 또는 '기타비용'으로 표시합니다.

2) 지분상품

당사는 모든 지분상품에 대한 투자를 후속적으로, 공정가치로 측정합니다. 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 것을 선택한 지분상품에 대해 기타포괄손익으로 인식한 금액은 해당 지분상품을 제거할 때에도 당기손익으로 재분류하지 않고 제거되는 시점에 자본에 누적된 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익을 이익잉여금으로 대체합니다. 이러한 지분상품에 대한 배당수익은 당사가 배당을 받을 권리가 확정된 때에 손익계산서에 '기타수익'으로 인식합니다.

당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 공정가치 변동은 손익계산서에 '기타수익' 또는 '기타비용'으로 표시합니다.

(손상)

당사는 미래전망정보에 근거하여, 상각후원가로 측정하거나 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품에 대한 기대신용손실을 평가합니다. 손상 방식은 신용위험의 유의적인 증가 여부에 따라 결정됩니다. 단, 매출채권에 대해 당사는 채권의 최초 인식시점부터 전체기간 기대신용손실을 인식하는 간편법을 적용합니다.

(인식과 제거)

금융자산의 정형화된 매입 또는 매도는 매매일에 인식하거나 제거합니다. 금융자산은 현금흐름에 대한 계약상 권리가 소멸하거나 금융자산을 양도하고 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전한 경우에 제거됩니다. 당사가 금융자산을 양도한 경우라도 채무자의 채무불이행시의 소구권 등으로 양도한 금융자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 당사가 보유하는 경우에는 이를 제거하지 않고 그 양도자산 전체를 계속하여 인식하되, 수취한 대가를 금융부채로 인식합니다. 해당 금융부채는 재무상태표에 '차입금'으로 분류하고 있습니다.

(금융상품의 상계)

금융자산과 부채는 인식한 자산과 부채에 대해 법적으로 집행가능한 상계권리를 현재 보유하고 있고, 순액으로 결제하거나 자산을 실현하는 동시에 부채를 결제할 의도를 가지고 있을 때 상계하여 재무상태표에 순액으로 표시합니다. 법적으로 집행가능한 상계권리는 미래사건에 좌우되지 않으며, 정상적인 사업과정의 경우와 채무불이행의 경우 및 지급불능이나 파산의 경우에도 집행가능한 것을 의미합니다.

[금융부채]

(분류 및 측정)

모든 금융부채는 다음을 제외하고는 후속적으로 상각후원가로 측정되도록 분류합니다.

1) 당기손익-공정가치 측정 금융부채
   파생상품부채를 포함한 이러한 부채는 후속적으로 공정가치로 측정합니다.
2) 금융자산의 양도가 제거 조건을 충족하지 못하거나 지속적 관여 접근법이 적용
   되는 경우에 생기는 금융부채
   이러한 금융부채는 상기 금융자산의 내용을 적용하여 측정합니다.
3) 금융보증계약
   최초 인식 시 공정가치로 측정되며, 이후에 이러한 계약의 발행자는 해당 계약을
   후속적으로 다음 중 큰 금액으로 측정합니다.
   - 기대신용손실에 따라 산정한 손실충당금
   - 최초 인식금액에서 기준서 제1115호에 따라 인식한 이익누계액을 차감한 금액
4) 시장이자율보다 낮은 이자율로 대출하기로 한 약정
   최초 인식 후에 이러한 약정의 발행자는 후속적으로 해당 약정을 다음 중 큰 금액
   으로 측정합니다.
   - 기대신용손실에 따라 산정한 손실충당금
   - 최초 인식금액에서 기준서 제1115호에 따라 인식한 이익누계액을 차감한 금액
5) 기준서 제1103호를 적용하는 사업결합에서 취득자가 인식하는 조건부 대가
   이러한 조건부 대가는 후속적으로 당기손익-공정가치로 측정합니다.

(제거)

금융부채는 계약상 의무가 이행, 취소 또는 만료되어 소멸되거나 기존 금융부채의 조건이 실질적으로 변경된 경우에 재무상태표에서 제거됩니다. 소멸하거나 제3자에게 양도한 금융부채의 장부금액과 지급한 대가(양도한 비현금자산이나 부담한 부채를 포함)의 차액은 당기손익으로 인식합니다.

[파생상품]

당사는 파생상품의 계약에 따라 발생된 권리와 의무를 공정가액으로 평가하여 자산과 부채로 계상하고, 동 계약으로부터 발생한 손익은 발생시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다. 다만, 요건을 충족한 현금흐름위험회피와 해외사업장에 대한 순투자에 대한 위험회피금액은 자본항목으로 이연하고 있습니다.

당사는 재고자산의 가격 변동 위험 등을 회피하기 위한 현금흐름 위험회피회계를 적용하고 있습니다. 현금흐름위험회피 대상으로 지정되어 적용요건을 충족하는 파생상품의 공정가치 변동 중 위험회피에 효과적인 부분은 기타포괄손익으로 인식하고, 비효과적인 부분은 '금융수익' 또는 '금융비용'으로 인식하고 있습니다.

(2) 범주별 금융상품 내역

1) 제58기 3분기말

(단위 : 백만원)

금융자산	상각후원가 측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	당기손익-공정가치 측정 금융자산	기타금융자산(*)	계
현금및현금성자산	90,800,375	-	-	-	90,800,375
단기금융상품	123,973,901	-	-	-	123,973,901
단기당기손익-공정가치금융자산	-	-	48,606	-	48,606
매출채권	106,097,351	-	-	-	106,097,351
기타포괄손익-공정가치금융자산	-	24,648,280	-	-	24,648,280
당기손익-공정가치금융자산	-	-	1,570,889	-	1,570,889
기타	60,993,502	-	272,788	39,556	61,305,846
계	381,865,129	24,648,280	1,892,283	39,556	408,445,248

(*) 기타금융자산은 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

금융부채	상각후원가 측정 금융부채	당기손익-공정가치 측정 금융부채	기타금융부채(*)	계
매입채무	16,647,408	-	-	16,647,408
단기차입금	604,653	-	7,977,577	8,582,230
미지급금	31,392,220	-	-	31,392,220
유동성장기부채	9,230	-	1,058,176	1,067,406
사채	6,768	-	-	6,768
장기차입금	4,100,696	-	3,434,133	7,534,829
장기미지급금	3,217,465	-	-	3,217,465
기타	23,939,743	316,934	21,044	24,277,721
계	79,918,183	316,934	12,490,930	92,726,047

(*) 기타금융부채는 담보부차입금과 위험회피수단인 파생상품, 기업회계기준서 제1109호의 금융부채의 범주로

분류되지 않는 리스부채 등을 포함하고 있습니다.

2) 제57기말

(단위 : 백만원)

금융자산	상각후원가 측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	당기손익-공정가치 측정 금융자산	기타금융자산(*)	계
현금및현금성자산	57,856,378	-	-	-	57,856,378
단기금융상품	67,965,021	-	-	-	67,965,021
단기당기손익-공정가치금융자산	-	-	25,715	-	25,715
매출채권	51,127,642	-	-	-	51,127,642
기타포괄손익-공정가치금융자산	-	16,295,005	-	-	16,295,005
당기손익-공정가치금융자산	-	-	1,280,501	-	1,280,501
기타	20,461,402	-	127,516	46,503	20,635,421
계	197,410,443	16,295,005	1,433,732	46,503	215,185,683

(*) 기타금융자산은 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

금융부채	상각후원가 측정 금융부채	당기손익-공정가치 측정 금융부채	기타금융부채(*)	계
매입채무	13,039,380	-	-	13,039,380
단기차입금	163,310	-	17,411,670	17,574,980
미지급금	19,913,847	-	-	19,913,847
유동성장기부채	9,070	-	1,168,438	1,177,508
사채	7,134	-	-	7,134
장기차입금	2,806,481	-	3,673,036	6,479,517
장기미지급금	4,861,818	-	-	4,861,818
기타	14,278,526	52,293	55,518	14,386,337
계	55,079,566	52,293	22,308,662	77,440,521

(*) 기타금융부채는 담보부차입금과 위험회피수단인 파생상품, 기업회계기준서 제1109호의 금융부채의 범주로

분류되지 않는 리스부채 등을 포함하고 있습니다.

(3) 금융상품의 공정가치 측정내역

(금융상품의 장부금액과 공정가치)

(단위 : 백만원)

구 분	제58기 3분기말		제57기말	
	장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
금융자산:				
현금및현금성자산	90,800,375	(*1)	57,856,378	(*1)
단기금융상품	123,973,901	(*1)	67,965,021	(*1)
단기당기손익-공정가치금융자산	48,606	48,606	25,715	25,715
매출채권	106,097,351	(*1)	51,127,642	(*1)
기타포괄손익-공정가치금융자산	24,648,280	24,648,280	16,295,005	16,295,005
당기손익-공정가치금융자산	1,570,889	1,570,889	1,280,501	1,280,501
기타(*2)	61,305,846	312,344	20,635,421	174,019
계	408,445,248		215,185,683	
금융부채:				
매입채무	16,647,408	(*1)	13,039,380	(*1)
단기차입금	8,582,230	(*1)	17,574,980	(*1)
미지급금	31,392,220	(*1)	19,913,847	(*1)
유동성장기부채	1,067,406	7,314	1,177,508	7,556
- 유동성장기차입금	1,060,637	(*1)(*3)	1,170,415	(*1)(*3)
- 유동성사채	6,769	7,314	7,093	7,556
사채	6,768	7,560	7,134	7,875
장기차입금	7,534,829	(*1)(*3)	6,479,517	(*1)(*3)
장기미지급금	3,217,465	(*1)	4,861,818	(*1)
기타(*2)	24,277,721	337,978	14,386,337	107,811
계	92,726,047		77,440,521	

(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

(*2) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 일부 금융자산 60,993,502백만원(전기말: 20,461,402백만원) 및 금융부채 23,939,743백만원(전기말: 14,278,526백만원)은 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

(*3) 리스부채는 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시'에 따라 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

(공정가치로 측정 및 공시되는 금융상품의 공정가치 서열체계)

(단위 : 백만원)

구 분	제58기 3분기말			
	수준 1	수준 2	수준 3	계
금융자산:				
단기당기손익-공정가치금융자산	-	48,606	-	48,606
기타포괄손익-공정가치금융자산	19,012,521	-	5,635,759	24,648,280
당기손익-공정가치금융자산	110,045	-	1,460,844	1,570,889
기타	-	192,743	119,601	312,344
금융부채:				
유동성사채	-	7,314	-	7,314
사채	-	7,560	-	7,560
기타	-	337,978	-	337,978

(단위 : 백만원)

구 분	제57기말			
	수준 1	수준 2	수준 3	계
금융자산:				
단기당기손익-공정가치금융자산	-	25,715	-	25,715
기타포괄손익-공정가치금융자산	13,206,702	-	3,088,303	16,295,005
당기손익-공정가치금융자산	146,034	-	1,134,467	1,280,501
기타	-	116,860	57,159	174,019
금융부채:				
유동성사채	-	7,556	-	7,556
사채	-	7,875	-	7,875
기타	-	107,811	-	107,811

공정가치 측정의 투입변수 특징에 따른 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다.

- '수준 1': 동일한 자산이나 부채에 대한 시장 공시가격
- '수준 2': 시장에서 관측가능한 투입변수를 활용한 공정가치
  (단, '수준 1'에 포함된 공시가격은 제외)
- '수준 3': 관측가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며, 이러한 상품은 '수준 1'에 포함됩니다. '수준 1'에 포함된 상품은 대부분 기타포괄손익-공정가치금융자산으로 분류된 상장주식으로 구성됩니다.

활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 가치평가기법을 사용하여 측정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업고유정보는 최소한으로 사용됩니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 '수준 2'에 포함됩니다. '수준 2'에포함된 상품은 파생상품, 사채 등이 있습니다.

만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 '수준 3'에 포함됩니다.

당사는 '수준 3'으로 분류되는 공정가치 측정을 포함하여 재무보고 목적의 공정가치를 측정하고 있습니다. 재무보고 일정에 맞추어 공정가치 평가 과정 및 그 결과에 대해 협의하고 있고, 공정가치 '수준' 간 이동을 발생시키는 사건이나 상황의 변동이 일어난 보고기간종료일에 '수준' 변동을 인식하고 있습니다.

금융상품의 공정가치를 측정하는 데 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.
- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격
- 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여
  해당 금액을 현재가치로 할인하여 측정

나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법, 이항분포 모형 등의 기타 가치평가기법을 사용합니다. 유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타채권의 경우 장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다.

(가치평가기법 및 투입변수)

당사는 공정가치 서열체계에서 '수준 2'로 분류되는 회사채, 국공채, 금융채 등에 대하여 미래현금흐름을 적정이자율로 할인하는 현재가치법을 사용하고 있습니다.

2026년 3분기말 현재 '수준 3'으로 분류된 주요 금융상품에 대하여 사용된 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	공정가치	가치평가기법	'수준 3' 투입변수	투입변수 범위
기타포괄손익-공정가치금융자산:				
삼성벤처투자㈜	45,525	현금흐름할인법	영구성장률	1.0%
			가중평균자본비용	11.9%
㈜미코세라믹스	80,867	현금흐름할인법 등	영구성장률	0.0%
			가중평균자본비용	11.6%
TCL China Star Optoelectronics Technology Co. Ltd. (CSOT)	1,356,827	현금흐름할인법	영구성장률	0.0%
			가중평균자본비용	10.1%
China Star Optoelectronics Semiconductor Display Technology Ltd (CSOSDT)	571,309	현금흐름할인법	영구성장률	0.0%
			가중평균자본비용	10.1%
기타:				
지분 풋옵션	119,601	이항모형	무위험 이자율	3.9%~4.5%, 3.3%
			가격 변동성	72.7%, 19.8%

[△는 부(-)의 값임]

('수준 3'에 해당하는 금융상품의 변동내역)

(단위 : 백만원)

금융자산	제58기 3분기	제57기
기초	4,279,929	4,406,446
매입	3,059,751	282,682
매도	△263,988	△316,873
당기손익으로 인식된 손익	228,421	660,343
기타포괄손익으로 인식된 손익	207,510	272,770
기타	△295,420	△1,025,439
기말	7,216,203	4,279,929

[△는 부(-)의 값임]

('수준 3'으로 분류된 반복적인 공정가치 측정치의 민감도분석)

금융상품의 민감도분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에 따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다.

2026년 3분기말 현재 '수준 3'으로 분류되는 주요 금융상품의 투입변수의 변동에 따른 손익효과(자본은 법인세효과 반영전)에 대한 민감도분석 결과는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	유리한 변동 효과		불리한 변동 효과	
	당기손익	자본	당기손익	자본
기타포괄손익-공정가치금융자산(*1)	-	555,475	-	△377,247
기타(*2)	16,714	-	△16,496	-

※ 지분상품은 주요 관측불가능한 투입변수인 영구성장률 및 가중평균자본비용을 1% 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.

※ 기타는 주요 관측불가능한 투입변수인 가격 변동성을 5% 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.

[△는 부(-)의 값임]

(4) 유형자산 재평가내역

당사는 공시대상기간 중 유형자산 재평가내역이 없습니다.

Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항

이사의 경영진단 및 분석의견은 기업공시서식 작성기준에 따라 분·반기보고서에 기재하지 않습니다.(사업보고서에 기재 예정)

2. 개요

이사의 경영진단 및 분석의견은 기업공시서식 작성기준에 따라 분·반기보고서에 기재하지 않습니다.(사업보고서에 기재 예정)

3. 재무상태 및 영업실적

이사의 경영진단 및 분석의견은 기업공시서식 작성기준에 따라 분·반기보고서에 기재하지 않습니다.(사업보고서에 기재 예정)

4. 유동성 및 자금조달과 지출

이사의 경영진단 및 분석의견은 기업공시서식 작성기준에 따라 분·반기보고서에 기재하지 않습니다.(사업보고서에 기재 예정)

5. 부외거래

이사의 경영진단 및 분석의견은 기업공시서식 작성기준에 따라 분·반기보고서에 기재하지 않습니다.(사업보고서에 기재 예정)

6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

이사의 경영진단 및 분석의견은 기업공시서식 작성기준에 따라 분·반기보고서에 기재하지 않습니다.(사업보고서에 기재 예정)

V. 회계감사인의 감사의견 등

1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 감사의견 등

삼정회계법인은 당사의 제 56기, 제57기 감사 및 제58기 3분기 검토를 수행하였고, 감사 관련하여 제56기, 제57기 감사의견은 적정이며, 제58기 3분기 검토 결과 재무제표에 한국채택국제회계기준 제1034호(중간재무보고)에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 않았습니다.

한편, 당사의 감사 대상 종속기업은 공시대상기간 중 모두 적정의견을 받았습니다.

[회계감사인의 명칭 및 감사의견]

사업연도	구분	감사인	감사의견	의견변형사유	계속기업 관련 중요한 불확실성	강조사항	핵심감사사항
제58기 3분기 (당분기)	감사보고서	삼정회계법인	-	-	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
	연결감사 보고서	삼정회계법인	-	-	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
제57기 (전기)	감사보고서	삼정회계법인	적정의견	-	해당사항 없음	해당사항 없음	1. 건설중인자산의 감가상각개시시점 평가 2. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감의 정확성과 완전성
	연결감사 보고서	삼정회계법인	적정의견	-	해당사항 없음	해당사항 없음	1. 건설중인자산의 감가상각개시시점 평가 2. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감의 정확성과 완전성
제56기 (전전기)	감사보고서	삼정회계법인	적정의견	-	해당사항 없음	해당사항 없음	1. 건설중인자산의 감가상각개시시점 평가 2. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감의 정확성과 완전성
	연결감사 보고서	삼정회계법인	적정의견	-	해당사항 없음	해당사항 없음	1. 건설중인자산의 감가상각개시시점 평가 2. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감의 정확성과 완전성

※ 회계감사인의 내부회계관리제도 감사의견은 '27.2월에 보고 예정입니다. (사업보고서에 기재 예정)

[감사용역 체결 현황]

(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역		실제수행내역	
			보수	시간	보수	시간
제58기 3분기 (당기)	삼정회계법인	분・반기 재무제표 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사 별도 및 연결 내부회계관리제도 감사	8,100	81,000	4,906	49,059
제57기 (전기)	삼정회계법인	분・반기 재무제표 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사 별도 및 연결 내부회계관리제도 감사	8,100	81,000	8,100	80,174
제56기 (전전기)	삼정회계법인	분・반기 재무제표 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사 별도 및 연결 내부회계관리제도 감사	7,800	78,000	7,800	76,830

(제58기 3분기 일정)

구 분		일 정
제58기 1분기	사전검토	2026.03.09 ~ 2026.03.27
	본검토	2026.04.07 ~ 2026.05.14
제58기 2분기	사전검토	2026.06.08 ~ 2026.06.26
	본검토	2026.07.06 ~ 2026.08.13
제58기 3분기	사전검토	2026.09.07 ~ 2026.09.25
	본검토	2026.10.06 ~ 2026.11.13

※ 별도・연결 재무제표 검토에 대한 일정입니다.

[비감사용역 체결 현황]

(단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고
제58기 3분기(당분기)	-	-	-	-	-
제57기(전기)	-	-	-	-	-
제56기(전전기)	2017.02	세무자문업무(해외종속기업)	2024.01~2024.06	43	삼정회계법인
	2018.09	세무자문업무(해외종속기업)	2024.01~2024.05	-	삼정회계법인
	2019.05	세무자문업무(해외종속기업)	2024.01~2024.06	73	삼정회계법인

[네트워크 회계법인과의 비감사용역 계약체결 현황]

해당사항 없습니다.

사업연도	네트워크 회계법인명	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고
제58기 3분기(당분기)	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
제57기(전기)	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
제56기(전전기)	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

[내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과]

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용
1	2026.01.28	· 감사위원회: 위원 3명 · 회사: 감사위원회 사무국장 · 감사인: 업무수행이사 외 4명	대면회의	· 연간 회계감사 진행 상황 · 핵심 감사사항 등 중점 감사사항 · 내부회계관리제도 감사 진행 상황 · 횡령 등 자금부정을 예방, 적발하기 위한 통제에 대한 내부회계관리제도 감사 결과 보고 · 기타 감사종료단계 필수 커뮤니케이션 사항
2	2026.04.29	· 감사위원회: 위원 3명 · 회사: 감사위원회 사무국장 · 감사인: 업무수행이사 외 4명	대면회의	· 분기 검토 경과 보고 · 연간 회계감사 계획 · 내부회계관리제도 감사 계획 · 횡령 등 자금부정을 예방, 적발하기 위한 통제에 대한 내부회계관리제도 감사 계획 보고 · 기타 감사계획단계 필수 커뮤니케이션 사항
3	2026.07.29	· 감사위원회: 위원 3명 · 회사: 감사위원회 사무국장 · 감사인: 업무수행이사 외 4명	대면회의	· 분기 검토 경과 보고 · 연간 회계감사 진행 상황 · 핵심 감사사항 선정 계획 · 기타 감사계획단계 필수 커뮤니케이션 사항
4	2026.10.28	· 감사위원회: 위원 3명 · 회사: 감사위원회 사무국장 · 감사인: 업무수행이사 외 4명	대면회의	· 분기 검토 경과 보고 · 연간 회계감사 진행 상황 · 핵심 감사사항 선정 계획 · 기타 감사계획단계 필수 커뮤니케이션 사항

[조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보]

해당사항 없습니다.

나. 회계감사인의 변경

제58기 3분기말(당분기말) 현재 당사의 종속기업은 305개이며, 당분기 중 설립된 Samsung Semiconductor Asia Holdings Pte. Ltd.는 KPMG를 회계감사인으로 신규 선임하였습니다. 이 외 종속기업의 회계감사인 신규 선임 및 변경내역은 없으며, 종속기업의 회계감사인 변경 및 신규 선임은 각 회사의 결정에 의한 것입니다.

제57기말(전기말) 당사의 종속기업은 총 308개이며, 당기 중 해외 종속기업 중 Harman Belgium SA 외 6개 종속기업은 PwC에서 KPMG로, Samsung Electronics Rus Kaluga LLC 가 TeDO에서 B1으로 회계감사인을 변경하였습니다. 국내 종속기업 중 스테코㈜와 삼성메디슨㈜은 삼일회계법인에서 삼정회계법인으로 회계감사인을 변경하였으며, SVIC 21호 신기술투자조합 외 15개 종속기업은 삼정회계법인에서 안진회계법인으로 회계감사인을 변경하였습니다. 당기 중 설립된 SVIC 74호 신기술투자조합 및 SVIC 76호 신기술투자조합은 안진회계법인을 회계감사인으로 신규 선임하였습니다. 종속기업의 회계감사인 변경 및 신규 선임은 각 회사의 결정에 의한 것입니다.

[제57기 종속기업의 회계감사인 변경 현황]

종속기업명	변경전 회계감사인	변경후 회계감사인
스테코㈜	삼일회계법인(PwC)	삼정회계법인(KPMG)
삼성메디슨㈜	삼일회계법인(PwC)	삼정회계법인(KPMG)
SVIC 21호 신기술투자조합	삼정회계법인(KPMG)	안진회계법인(Deloitte)
SVIC 22호 신기술투자조합	삼정회계법인(KPMG)	안진회계법인(Deloitte)
SVIC 26호 신기술투자조합	삼정회계법인(KPMG)	안진회계법인(Deloitte)
SVIC 28호 신기술투자조합	삼정회계법인(KPMG)	안진회계법인(Deloitte)
SVIC 32호 신기술투자조합	삼정회계법인(KPMG)	안진회계법인(Deloitte)
SVIC 33호 신기술투자조합	삼정회계법인(KPMG)	안진회계법인(Deloitte)
SVIC 37호 신기술투자조합	삼정회계법인(KPMG)	안진회계법인(Deloitte)
SVIC 42호 신기술투자조합	삼정회계법인(KPMG)	안진회계법인(Deloitte)
SVIC 43호 신기술투자조합	삼정회계법인(KPMG)	안진회계법인(Deloitte)
SVIC 45호 신기술투자조합	삼정회계법인(KPMG)	안진회계법인(Deloitte)
SVIC 52호 신기술투자조합	삼정회계법인(KPMG)	안진회계법인(Deloitte)
SVIC 55호 신기술투자조합	삼정회계법인(KPMG)	안진회계법인(Deloitte)
SVIC 56호 신기술투자조합	삼정회계법인(KPMG)	안진회계법인(Deloitte)
SVIC 57호 신기술투자조합	삼정회계법인(KPMG)	안진회계법인(Deloitte)
SVIC 62호 신기술투자조합	삼정회계법인(KPMG)	안진회계법인(Deloitte)
SVIC 67호 신기술투자조합	삼정회계법인(KPMG)	안진회계법인(Deloitte)
Samsung Electronics Rus Kaluga LLC	TeDO	B1
Harman Belgium SA	PwC	KPMG
Harman Connected Services AB.	PwC	KPMG
Harman Finland Oy	PwC	KPMG
Harman Inc. & Co. KG	PwC	KPMG
Harman International Romania SRL	PwC	KPMG
Harman Connected Services Corp. India Pvt. Ltd.	PwC	KPMG

Harman International (India) Private Limited	PwC	KPMG

제56기말(전전기말) 현재 당사의 종속기업은 228개이며, 당기 중 해외 종속기업 중 Harman International Industires, Inc. 외 16개 종속기업은 PwC에서 KPMG로 회계감사인을 변경하였으며, 국내 종속기업 중 ㈜하만인터내셔널코리아는 삼일회계법인(PwC)에서 삼정회계법인(KPMG)으로 회계감사인을 변경하였습니다. 전기 중 설립된 SVIC 67호 신기술투자조합은 삼정회계법인(KPMG)을, Samsung Electronics Middle east and North Africa는 KPMG를 회계감사인으로 신규 선임하였습니다. 또한, 전전기 중 신규 인수한 eMagin Corporation은 삼정회계법인(KPMG)을 회계감사인으로 신규 선임하였고, 전전기 중 설립된 종속기업 Samsung Federal Inc.는 KPMG를 회계감사인으로 신규 선임하였습니다. 종속기업의 회계감사인 변경 및 신규 선임은 각 회사의 결정에 의한 것입니다.

[제56기 종속기업의 회계감사인 변경 현황]

종속기업명	변경전 회계감사인	변경후 회계감사인
㈜하만인터내셔널코리아	삼일회계법인(PwC)	삼정회계법인(KPMG)
Harman International Industires, Inc.	PwC	KPMG
Harman (China) Technologies Co., Ltd.	PwC	KPMG
Harman (Suzhou) Audio and Infotainment Systems Co., Ltd.	PwC	KPMG
Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd.	PwC	KPMG
Harman Commercial (Shanghai) Co., Ltd.	PwC	KPMG
Harman Connected Services Solutions (Chengdu) Co., Ltd.	PwC	KPMG
Harman Holding Limited	PwC	KPMG
Harman International (China) Holdings Co., Ltd.	PwC	KPMG
Harman Technology (Shenzhen) Co., Ltd.	PwC	KPMG
Harman Becker Automotive Systems GmbH	PwC	KPMG
Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	PwC	KPMG
Harman Connected Services GmbH	PwC	KPMG
Harman Consumer Nederland B.V.	PwC	KPMG
Harman Deutschland GmbH	PwC	KPMG
Harman Holding Gmbh & Co. KG	PwC	KPMG
Harman Hungary Financing Ltd.	PwC	KPMG
Harman Professional Kft	PwC	KPMG

2. 내부통제에 관한 사항

내부통제에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기・사업보고서에 기재 예정)

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

이사회에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기·사업보고서에 기재 예정)

2. 감사제도에 관한 사항

감사제도에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기·사업보고서에 기재 예정)

3. 주주총회 등에 관한 사항

주주총회 등에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기·사업보고서에 기재 예정)

VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2026년 09월 30일) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말		
			주식수	지분율	주식수	지분율	
삼성생명보험㈜	최대주주 본인	보통주	503,904,843	8.51	497,660,185	8.51	시간외매매
삼성생명보험㈜	최대주주 본인	우선주	43,950	0.01	43,950	0.01	-
삼성생명보험㈜ (특별계정)	최대주주 본인	보통주	4,424,328	0.07	3,338,773	0.06	장내 매매
삼성생명보험㈜ (특별계정)	최대주주 본인	우선주	159,926	0.02	74,881	0.01	장내 매매
삼성물산㈜	계열회사	보통주	298,818,100	5.05	298,818,100	5.11	-
삼성화재해상보험㈜	계열회사	보통주	88,058,948	1.49	86,967,675	1.49	시간외매매
삼성복지재단	출연 재단	보통주	4,484,150	0.08	4,484,150	0.08	-
삼성문화재단	출연 재단	보통주	1,880,750	0.03	1,880,750	0.03	-
삼성생명공익재단	출연 재단	보통주	1,250	0.00	1,250	0.00	-
홍라희	최대주주의 특수관계인	보통주	87,978,700	1.49	72,978,700	1.25	시간외매매
홍라희	최대주주의 특수관계인	우선주	206,633	0.03	0	0.00	시간외매매
이재용	최대주주의 특수관계인	보통주	97,414,196	1.65	97,414,196	1.67	-
이재용	최대주주의 특수관계인	우선주	137,757	0.02	137,757	0.02	-
이부진	계열회사 임원	보통주	41,745,681	0.71	41,745,681	0.71	-
이부진	계열회사 임원	우선주	137,755	0.02	137,755	0.02	-
이서현	계열회사 임원	보통주	45,574,190	0.77	45,574,190	0.78	-
이서현	계열회사 임원	우선주	137,755	0.02	137,755	0.02	-
전영현	계열회사 임원	보통주	17,000	0.00	43,256	0.00	자사주 상여금
노태문	계열회사 임원	보통주	50,679	0.00	124,280	0.00	자사주 상여금 장내 매매
김용관	계열회사 임원	보통주	0	0.00	42,148	0.00	신규 선임 자사주 상여금
신제윤	계열회사 임원	보통주	0	0.00	210	0.00	장내 매매
허은녕	계열회사 임원	보통주	0	0.00	200	0.00	장내 매매
조혜경	계열회사 임원	보통주	500	0.00	800	0.00	장내 매매
이혁재	계열회사 임원	보통주	200	0.00	348	0.00	장내 매매
송재혁	계열회사 임원	보통주	13,373	0.00	0	0.00	이사 사임
계		보통주	1,174,366,888	19.84	1,151,074,892	19.69	-
		우선주	823,776	0.10	532,098	0.07	-

※ 관계는「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」제3조 제1항에 기재되어 있는 관계를 참고하여 기재하였습니다.

※ 보통주는 의결권이 있으며, 우선주는 의결권이 없습니다.

(단, 보통주 일부는 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한되어 있습니다.)

※ 장내매매, 시간외매매 외 지분율 변동은 자사주 매입 및 소각에 따른 변동입니다.

※ 2026년 9월 30일 기준입니다. 작성기준일 이후 변동은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)의

'주식등의대량보유상황보고서(일반)' 등을 참고하시기 바랍니다.

※ 2026년 10월 12일에 최대주주의 특수관계인(이재용)이 최대주주의 특수관계인(홍라희)으로부터 장외거래로 주식을 매수했습니다. 자세한 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)의 2026년 9월 9일자 '임원・주요주주 특정증권등 거래계획보고서' 및 10월 13일자 '최대주주등 소유주식 변동신고서' 등을 참고하시기 바랍니다.

※ 2026년 11월 12일에 최대주주의 특수관계인(이재용)이 최대주주의 특수관계인(홍라희)으로부터 주식을 증여 받았습니다.

자세한 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)의 2026년 10월 13일자 '임원・주요주주 특정증권등 거래계획보고서' 및

11월 13일자 '최대주주등 소유주식 변동신고서' 등을 참고하시기 바랍니다.

2. 최대주주 관련 사항

가. 최대주주의 개요

(1) 최대주주(삼성생명보험㈜)의 기본정보

1) 법적・상업적 명칭: 삼성생명보험㈜ (Samsung Life Insurance Co., Ltd.)

2) 설립일자: 1957년 4월 24일

3) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

주소: 서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동)
전화번호: 1588-3114
홈페이지: www.samsunglife.com

4) 최대주주(삼성생명보험㈜)의 대표이사・업무집행자・최대주주

(단위 : 명, %)

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)	
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
삼성생명보험㈜	101,758	홍원학	0.00	-	-	삼성물산㈜	19.34
		-	-	-	-	-	-

※ 2026년 9월 30일 보통주 기준입니다.

5) 최대주주(삼성생명보험㈜)의 대표이사・업무집행자・최대주주의 변동내역

변동일	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)	
	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
2024.03.21	홍원학	0.00	-	-	-	-

※ 2024년 3월 21일 전영묵 대표이사가 사임하고, 홍원학 사내이사가 대표이사로 선임되었습니다.

(2) 최대주주(삼성생명보험㈜)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분	
법인 또는 단체의 명칭	삼성생명보험㈜
자산총계	421,709,568
부채총계	298,622,731
자본총계	123,086,837
매출액	42,150,306
영업이익	2,918,116
당기순이익	2,791,577

※ 재무현황은 2026년 9월 30일, 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준입니다.

(3) 최대주주(삼성생명보험㈜)의 사업현황 등

삼성생명보험㈜은 인보험 및 그와 관련된 재보험계약 등을 주요 영업목적으로 하는 생명보험회사로, 보험업법 및 기타 법령 등에 근거하여 사업을 영위하고 있습니다.
또한, 주요 종속기업인 삼성카드㈜는 여신전문금융업(신용카드업・시설대여업・할부금융업 등)을 영위하는 여신전문금융회사로, 여신전문금융업법 및 기타 관계법령에 근거하여 사업을 영위하고 있습니다.

☞ 최대주주에 대한 자세한 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 삼성생명보험㈜의 사업(분・반기)보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래

해당사항 없습니다.

다. 최대주주의 최대주주의 개요

(1) 최대주주의 최대주주(삼성물산㈜)의 기본정보

1) 법적・상업적 명칭: 삼성물산㈜ (Samsung C&T Corporation)

2) 설립일자 및 존속기간

1963년 12월 23일에 동화부동산주식회사로 시작하여, 2014년 7월 제일모직주식회사로 사명을 변경하였습니다. 또한 1938년 3월 1일 설립된 삼성상회를 모태로 1951년 1월에 설립된 삼성물산주식회사와의 합병을 통하여 2015년 9월 2일(합병등기일) 삼성물산주식회사로 사명을 변경하였습니다.

3) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

주소: 서울특별시 강동구 상일로6길 26(상일동)
전화번호: 02-2145-5114
홈페이지: www.samsungcnt.com

4) 최대주주의 최대주주(삼성물산㈜)의 대표이사・업무집행자・최대주주

(단위 : 명, %)

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)	
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
삼성물산㈜	197,249	오세철	0.00	-	-	이재용	22.01
		이재언	0.00	-	-	-	-
		송규종	0.00	-	-	-	-

※ 2026년 9월 30일, 보통주 기준입니다.

5) 최대주주의 최대주주(삼성물산㈜)의 대표이사・업무집행자・최대주주의 변동내역

(단위 : %)

변동일	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)	
	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
2024.03.15	고정석	-	-	-	-	-
2024.03.15	이재언	0.00	-	-	-	-
2024.04.19	-	-	-	-	이재용	19.06
2025.02.05	-	-	-	-	이재용	19.93
2026.01.02	-	-	-	-	이재용	21.00
2026.03.13	-	-	-	-	이재용	22.01
2026.03.19	정해린	-	-	-	-	-
2026.03.20	송규종	0.00	-	-	-	-
2026.04.29	-	-	-	-	이재용	22.01

※ 2024년 3월 15일 고정석 대표이사가 사임하고, 이재언 대표이사가 선임되었습니다.

※ 2024년 4월 19일 자기주식 소각(보통주 7,807,563)으로 인하여 최대주주의 지분율(보통주)이 변동(18.26%→19.06%)되었습니다.

※ 2025년 2월 5일 자기주식 소각(보통주 7,807,563)으로 인하여 최대주주의 지분율(보통주)이 변동(19.06%→19.93%)되었습니다.

※ 2026년 1월 2일 홍라희(증여자)와 이재용(수증자)간 지분 증여(보통주 1,808,577)로 최대주주의 지분율(보통주)이 변동(19.93%→21.00%)되었습니다.

※ 2026년 3월 13일 자기주식 소각(보통주 7,807,563)으로 인하여 최대주주의 지분율(보통주)이 변동(21.00%→22.01%)되었습니다.

※ 2026년 3월 19일 정해린 대표이사가 사임하고, 2026년 3월 20일 송규종 대표이사가 취임하였습니다.

※ 2026년 4월 29일 자기주식 소각(보통주 1,400)으로 인하여 최대주주의 지분율(보통주)이 변동(22.01%→22.01%)되었습니다.

(2) 최대주주의 최대주주(삼성물산㈜)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분	
법인 또는 단체의 명칭	삼성물산㈜
자산총계	140,723,169
부채총계	44,231,824
자본총계	96,491,345
매출액	34,468,914
영업이익	2,894,912
당기순이익	2,802,279

※ 재무현황은 2026년 9월 30일, 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준입니다.

(3) 최대주주의 최대주주(삼성물산㈜)의 사업현황 등

삼성물산㈜은 국내외의 건축, 토목, 플랜트, 주택 분야의 사업을 영위하고 있는 건설부문과 자원개발, 철강, 화학, 산업소재, 섬유 등 다양한 방면에서 국제무역을 하고 있는 상사부문, 의류 수입 및 판매사업을 하는 패션부문, 조경사업과 에버랜드(드라이파크), 캐리비안베이(워터파크), 골프장 및 전문급식, 식자재유통사업(삼성웰스토리)을 영위 운영하는 리조트부문, 바이오의약품 위탁생산사업 및 바이오시밀러 사업으로 구성되어 있습니다.

☞ 최대주주의 최대주주에 대한 자세한 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 삼성물산㈜의 사업(분・반기)보고서를 참조하시기 바랍니다.

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 등기임원

(기준일 : 2026년 09월 30일) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원 여부	상근 여부	담당 업무	주요경력	소유주식수		최대주주와의 관계	재직기간	임기 만료일
								의결권 있는 주식	의결권 없는 주식			
전영현	남	1960.12	부회장	사내이사	상근	· 대표이사 (DS부문 경영전반 총괄)	· KAIST 전자공학 박사 · 삼성전자 DS부문장 겸) 메모리사업부장	43,256	-	계열회사 임원	19개월	2028.03.18
노태문	남	1968.09	사장	사내이사	상근	· 대표이사 (DX부문 경영전반 총괄)	· 포항공대 전자전기공학 박사 · 삼성전자 DX부문장 겸) MX사업부장, RX사업추진실장, 품질혁신위원장, AI혁신위원장, B2B통합오퍼링위원장	124,280	-	계열회사 임원	55개월	2028.03.15
김용관	남	1963.12	사장	사내이사	상근	· DS부문 경영전략총괄	· Arizona State대(썬더버드) MBA · 삼성전자 DS부문 경영전략총괄	42,148	-	계열회사 임원	7개월	2029.03.17
신제윤	남	1958.03	이사	독립이사	비상근	· 이사회 의장 · 감사위원회 위원장 · 독립이사 후보추천위원회 위원장 · 보상위원회 위원장 · 지속가능경영 위원회 위원	· 서울대 경제학 학사 · 금융위원회 위원장	210	-	계열회사 임원	31개월	2027.03.28
김준성	남	1967.10	이사	독립이사	비상근	· 독립이사 후보추천위원회 위원 · 내부거래위원회 위원 · 보상위원회 위원 · 지속가능경영위원회 위원장	· Carnegie Mellon대 경제학/산업공학 학사 · 싱가포르 투자청 토탈리턴그룹 이사	-	-	계열회사 임원	55개월	2028.03.15
허은녕	남	1964.08	이사	독립이사	비상근	· 내부거래위원회 위원장 · 감사위원회 위원 · 독립이사 후보추천위원회 위원 · 지속가능경영위원회 위원 · (비상설) 특별위원회 대표위원	· Pennsylvania State대 자원경제학 박사 · 서울대 공과대학 교수	200	-	계열회사 임원	47개월	2028.03.17

조혜경	여	1964.07	이사	독립이사	비상근	· 감사위원회 위원 · 보상위원회 위원 · 지속가능경영위원회 위원	· 서울대 로봇공학 박사 · 한성대 AI응용학과 교수	800	-	계열회사 임원	31개월	2027.03.19
이혁재	남	1965.02	이사	독립이사	비상근	· 내부거래위원회 위원 · 지속가능경영 위원회 위원	· Purdue대 전자컴퓨터공학 박사 · 서울대 전기정보공학부 교수	348	-	계열회사 임원	19개월	2028.03.18

※ 최대주주와의 관계는「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」제3조 제1항에 기재되어 있는 관계를 참고하여 기재하였습니다.

※ 등기임원 소유주식수는 작성기준일 현재 기준이며, 작성기준일 이후 변동은 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)의 '임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서'

등을 참고하시기 바랍니다.

※ 2025년 1월 31일 제1차 이사회에서 김한조 독립이사가 독립이사 후보추천위원회 위원으로 선임되었으며

2025년 2월 14일 보상위원회 위원장으로 선임되었습니다.

※ 2025년 3월 19일 주주총회에서 전영현 사내이사, 송재혁 사내이사, 이혁재 독립이사가 신규 선임되었고 노태문 사내이사, 김준성 독립이사,

허은녕 독립이사, 유명희 독립이사가 재선임되었으며, 신제윤 독립이사, 유명희 독립이사가 감사위원회 위원으로 선임되었습니다.

당일 개최된 이사회를 통해 전영현 사내이사, 노태문 사내이사, 송재혁 사내이사가 경영위원회 위원으로 선임되었고,

김준성 독립이사가 내부거래위원회, 보상위원회, 지속가능경영위원회 위원으로 선임되었으며,

허은녕 독립이사는 독립이사 후보추천위원회, 내부거래위원회, 보상위원회, 지속가능경영위원회 위원으로 선임되었고

유명희 독립이사는 독립이사 후보추천위원회, 지속가능경영위원회 위원으로 선임되었으며,

이혁재 독립이사는 내부거래위원회, 지속가능경영위원회 위원으로 선임되었습니다.

※ 2025년 3월 19일 김한조 독립이사의 임기가 만료되었습니다.

※ 2025년 3월 25일 한종희 (전)대표이사(2022년 3월 선임)는 대표이사직과 사내이사직을 퇴임하였습니다.

※ 2025년 4월 25일 전영현 사내이사가 경영위원회 위원장으로 선임되었습니다.

※ 2025년 4월 28일 신제윤 독립이사가 감사위원회, 보상위원회 위원장으로, 허은녕 독립이사가 내부거래위원회 위원장으로 선임되었습니다.

※ 2025년 4월 29일 김준성 독립이사가 지속가능경영위원회 위원장으로 선임되었습니다.

※ 2025년 7월 31일 김준성 독립이사가 독립이사 후보추천위원회 위원으로 선임되었습니다.

※ 2026년 3월 18일 주주총회에서 김용관 사내이사가 신규 선임되었고, 감사위원회 위원이 되는 독립이사로 허은녕 독립이사가 재선임되었습니다.

당일 개최된 이사회를 통해, 김용관 사내이사가 경영위원회 위원으로 선임되었고, 허은녕 독립이사가 독립이사 후보추천위원회,

내부거래위원회, 지속가능경영위원회 위원으로 선임되었으며, 조혜경 독립이사는 보상위원회 위원으로 선임되었습니다.

※ 2026년 4월 29일 허은녕 독립이사가 내부거래위원회 위원장으로 선임되었습니다.

※ 2026년 4월 30일 제8차 이사회에서 계열회사와 관련하여 발생할 수 있는 주요 사안에 대한 심의 검토를 목적으로 하는

독립이사 전원으로 구성된 비상설의 특별위원회를 설치하고 2026년 7월 30일 허은녕 대표위원이 제12차 이사회에서

특별위원회 활동 결과보고 후 운영기준에 따라 해산되었습니다.

나. 등기임원의 타회사 임원겸직 현황

(기준일 : 2026년 9월 30일)

겸 직 자		겸 직 회 사		
성 명	직 위	기업명	직 위	재임 기간
김준성	독립이사	Novo holdings A/S	독립이사	2025년~현재
조혜경	독립이사	현대건설	독립이사	2021년~현재

다. 미등기임원 현황

(기준일 : 2026년 9월 30일) (단위 : 개월)

성명	성별	출생 연월	직위	상근 여부	담당업무	주요경력	학력	최대주주 와의 관계	재직 기간
이재용	남	1968.06	회장	상근	회장	COO	Harvard Univ.(박사수료)	최대주주의 특수관계인	
정현호	남	1960.03	부회장	상근	회장 보좌역	사업지원T/F장	Harvard Univ.(석사)	계열회사 임원	
고크리스 토퍼한승	남	1963.04	사장	상근	미래사업기획단장	삼성바이오에피스 대표이사	Northwestern Univ.(박사)	계열회사 임원	23
김수목	남	1964.05	사장	상근	법무실장	법무실 송무팀장	서울대(학사)	계열회사 임원	
김우준	남	1968.05	사장	상근	네트워크사업부장	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
김원경	남	1967.08	사장	상근	Global Public Affairs실장	북미총괄 대외협력팀장	The Johns Hopkins Univ.(석사)	계열회사 임원	
남석우	남	1966.03	사장	상근	Foundry CTO	제조&기술담당	연세대(박사)	계열회사 임원	
마우로포르치니	남	1975.05	사장	상근	CDO	PepsiCo, CDO	Polytechnic Univ. of Milan(석사)	계열회사 임원	18
박승희	남	1964.08	사장	상근	Corporate Relations담당	삼성물산, 건설부문 커뮤니케이션팀장	건국대(석사)	계열회사 임원	46
박용인	남	1964.04	사장	상근	System LSI사업부장	System LSI 전략마케팅실장	연세대(석사)	계열회사 임원	
박학규	남	1964.11	사장	상근	사업지원실장	사업지원T/F 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
박홍근	남	1967.06	사장	상근	SAIT 원장	Harvard University, 교수	Stanford University(박사)	계열회사 임원	9
백수현	남	1963.01	사장	상근	커뮤니케이션실장	커뮤니케이션팀장	서울대(학사)	계열회사 임원	
송재혁	남	1967.08	사장	상근	DS부문 CTO	반도체연구소장	서울대(박사)	계열회사 임원	
안중현	남	1963.03	사장	상근	사업지원실 M&A팀장	SGR, 미래산업연구본부장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	30
양걸	남	1962.10	사장	상근	중국삼성전략협력실장	DS부문 중국총괄	서강대(석사)	계열회사 임원	
엄대현	남	1966.03	사장	상근	법무실 담당임원	법무실 송무팀장	한양대(학사)	계열회사 임원	
용석우	남	1970.09	사장	상근	DX부문 보좌역	영상디스플레이사업부장	Polytechnic Univ. of NY(석사)	계열회사 임원	
윤장현	남	1968.12	사장	상근	DX부문 CTO	삼성벤처투자, 대표이사	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	11
이원진	남	1967.08	사장	상근	영상디스플레이사업부장	글로벌마케팅실장	Purdue Univ.(석사)	계열회사 임원	
최원준	남	1970.09	사장	상근	Mobile eXperience COO	Mobile eXperience 개발실장	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	
최윤호	남	1963.01	사장	상근	사업지원실 전략팀장	삼성글로벌리서치, 경영진단실장	성균관대(학사)	계열회사 임원	12
한승환	남	1964.07	사장	상근	의료사업일류화추진단장	삼성물산, 리조트부문 대표이사	서울대(학사)	계열회사 임원	46
한진만	남	1966.10	사장	상근	Foundry사업부장	DS부문 DSA총괄	서울대(학사)	계열회사 임원	
강동구	남	1976.12	부사장	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 Principal Engineer	Purdue Univ.(박사)	계열회사 임원	
강동훈	남	1970.12	부사장	상근	법무실 담당임원	DS부문 법무지원팀 담당임원	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	
강민석	남	1976.10	부사장	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	무선 CX실 Principal Professional	서울대(석사)	계열회사 임원	58
강상용	남	1972.09	부사장	상근	생활가전 HVAC사업팀 담당임원	생활가전 Air Solution사업팀 담당임원	Univ. of Pennsylvania(석사)	계열회사 임원	
강석채	남	1971.06	부사장	상근	Foundry 전략마케팅실장	Foundry Corporate Planning실 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	
강태우	남	1973.10	부사장	상근	재경팀 담당임원	재경팀 Principal Professional	고려대(학사)	계열회사 임원	

강희성	남	1970.08	부사장	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	
고봉준	남	1972.01	부사장	상근	영상디스플레이 CX센터 담당임원	영상디스플레이 CX팀 담당임원	Columbia Univ.(박사)	계열회사 임원	
고재윤	남	1973.01	부사장	상근	유럽총괄 지원팀장	지원팀 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
고재필	남	1970.03	부사장	상근	SAS 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	Purdue Univ.(석사)	계열회사 임원	
곽연봉	남	1967.03	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터장	글로벌인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	광운대(학사)	계열회사 임원	
구본영	남	1967.05	부사장	상근	SAS법인장	글로벌인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
구자천	남	1981.04	부사장	상근	사업지원실 담당임원	사업지원T/F 담당임원	Northwestern Univ.(박사)	계열회사 임원	
구자흠	남	1968.01	부사장	상근	Foundry 기술개발실장	Foundry 기술개발실 담당임원	North Carolina State Univ.(박사)	계열회사 임원	
권기덕	남	1972.07	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	경북대(석사)	계열회사 임원	
권상덕	남	1967.03	부사장	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 담당임원	반도체연구소 Logic TD실장	서울대(박사)	계열회사 임원	
권오겸	남	1977.08	부사장	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
권혁우	남	1973.07	부사장	상근	Global Public Affairs실 담당임원	산업통상자원부 과장	The Johns Hopkins Univ.(석사)	계열회사 임원	51
권혁준	남	1971.06	부사장	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 담당 Master	성균관대(석사)	계열회사 임원	23
김강태	남	1972.10	부사장	상근	Samsung Research 기술전략팀장	Samsung Research SE팀장	중앙대(박사)	계열회사 임원	
김경환	남	1970.06	부사장	상근	법무실 송무팀장	법무실 담당임원	서울대(학사)	계열회사 임원	
김기환	남	1975.03	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	NVIDIA, Principal Research Scientist	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	
김기훈	남	1968.05	부사장	상근	한국총괄 지원팀장	지원팀 담당임원	Univ. of Baltimore(석사)	계열회사 임원	
김대주	남	1969.10	부사장	상근	영상디스플레이 지원팀장	영상디스플레이 지원팀 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(석사)	계열회사 임원	
김대현	남	1974.06	부사장	상근	Samsung Research AI센터장	Samsung Research Global AI센터장	Cornell Univ.(박사)	계열회사 임원	
김동관	남	1969.10	부사장	상근	DS부문 정보보호센터장	삼성SDS 정보보호센터장	한양대(학사)	계열회사 임원	58
김동욱	남	1968.10	부사장	상근	재경팀장	재경팀 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
김동욱	남	1969.06	부사장	상근	메모리 PKG개발팀장	메모리 DRAM개발실 담당임원	Univ. of California, Irvine(박사)	계열회사 임원	
김두일	남	1971.07	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Samsung Research Platform팀장	경북대(학사)	계열회사 임원	
김문수	남	1977.12	부사장	상근	영상디스플레이 개발2팀장	영상디스플레이 개발팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
김병도	남	1967.03	부사장	상근	D2C센터 담당임원	글로벌마케팅실 D2C센터 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	
김보현	남	1973.02	부사장	상근	Foundry People팀장	DS부문 People팀 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	
김성욱	남	1968.06	부사장	상근	한국총괄 D2C팀장	인사팀 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	

김성은	남	1970.05	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 Principal Engineer	경북대(학사)	계열회사 임원	
김성한	남	1970.05	부사장	상근	Foundry Global운영팀장	Foundry Corporate Planning실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
김세윤	남	1973.06	부사장	상근	TSE-S법인장	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
김수진	여	1969.08	부사장	상근	지속가능경영추진센터장	Global Public Affairs팀 담당임원	Univ. of Pennsylvania(박사)	계열회사 임원	
김연정	남	1975.12	부사장	상근	Mobile eXperience 구매팀 담당임원	SEV 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
김영대	남	1968.10	부사장	상근	Foundry 제품기술팀장	Foundry 기술개발실 담당임원	동국대(석사)	계열회사 임원	
김용국	남	1968.01	부사장	상근	사업지원실 담당임원	사업지원T/F 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
김용성	남	1973.09	부사장	상근	SAIT Advanced Device Platform장	종합기술원 Material연구센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
김용재	남	1972.03	부사장	상근	생활가전 개발팀 담당임원	영상디스플레이 Next Product팀장	서강대(석사)	계열회사 임원	
김용찬	남	1969.03	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	경희대(학사)	계열회사 임원	
김유석	남	1965.04	부사장	상근	법무실 IP센터장	법무실 IP센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
김윤호	남	1974.11	부사장	상근	법무실 담당임원	법무실 담당임원	연세대(학사)	계열회사 임원	32
김이수	남	1973.03	부사장	상근	SEVT법인장	SIEL-P(N)공장장	아주대(학사)	계열회사 임원	
김이태	남	1971.01	부사장	상근	System LSI Sensor사업팀 담당임원	System LSI Sensor사업팀 Principal Engineer	포항공대(석사)	계열회사 임원	
김인식	남	1967.09	부사장	상근	재경팀 담당임원	삼성SDS, 전략기획담당 담당임원	Univ. of Michigan, Ann Arbor(석사)	계열회사 임원	
김일룡	남	1974.02	부사장	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 Logic TD팀장	System LSI 제품기술팀장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
김장경	남	1973.05	부사장	상근	사업지원실 담당임원	사업지원T/F 담당임원	홍익대(학사)	계열회사 임원	
김재준	남	1968.01	부사장	상근	메모리 전략마케팅실장	DS부문 미주총괄 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
김재훈	남	1967.01	부사장	상근	SEIB법인장	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
김정식	남	1970.08	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience CX실 담당임원	한양대(석사)	계열회사 임원	
김정헌	남	1972.12	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	DL E&C, 전무	경희대(석사)	계열회사 임원	47
김정현	남	1975.06	부사장	상근	Mobile eXperience CX실장	Mobile eXperience CX실 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	
김종훈	남	1969.12	부사장	상근	메모리 품질실장	메모리 품질실 담당임원	중앙대(학사)	계열회사 임원	
김주년	남	1969.12	부사장	상근	Mobile eXperience Galaxy Value Innovation팀장	Mobile eXperience 품질혁신센터장	성균관대(석사)	계열회사 임원	
김준석	남	1972.10	부사장	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI Project Management팀장	연세대(박사)	계열회사 임원	
김준석	남	1969.04	부사장	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI SOC개발실 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	
김중정	남	1973.11	부사장	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실 분석기술팀장	글로벌 제조&인프라총괄 Common Tech센터장	東北大(박사)	계열회사 임원	
김지윤	여	1975.02	부사장	상근	People팀 담당임원	인사팀 담당임원	Cornell Univ.(석사)	계열회사 임원	
김진수	남	1971.10	부사장	상근	인재개발원 담당임원	CDO 담당임원	국민대(학사)	계열회사 임원	
김창식	남	1970.12	부사장	상근	법무실 IP센터 담당임원	삼성디스플레이, IP팀장	University Of Miami(박사)	계열회사 임원	11

김창업	남	1969.08	부사장	상근	동남아총괄	SEDA-S판매부문장	한양대(학사)	계열회사 임원	
김창태	남	1972.01	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 Principal Engineer	금오공대(학사)	계열회사 임원	
김철기	남	1968.03	부사장	상근	생활가전사업부장	Mobile eXperience 전략마케팅실장	경북대(학사)	계열회사 임원	
김태우	남	1971.05	부사장	상근	메모리 기획팀장	메모리 기획팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
김태훈	남	1970.10	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 평택단지 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	
김태훈	남	1969.04	부사장	상근	AX/PI센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 설비기술연구소장	서울대(박사)	계열회사 임원	
김평진	남	1973.12	부사장	상근	법무실 담당임원	법무실 Principal Legal Counsel	연세대(학사)	계열회사 임원	
김학상	남	1966.09	부사장	상근	Global CS센터장	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Univ. of Massachusetts, Lowell(박사)	계열회사 임원	
김현우	남	1970.02	부사장	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 기술기획팀장	반도체연구소 공정개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
김형로	남	1973.01	부사장	상근	DS부문 People팀 담당임원	DX부문 People팀 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	58
김형욱	남	1979.01	부사장	상근	생활가전 HVAC사업팀 담당임원	Schneider Electric, VP	Vlerick(석사)	계열회사 임원	1
김형재	남	1970.12	부사장	상근	영상디스플레이 Display Solution사업팀장	SELA법인장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
김홍경	남	1965.11	부사장	상근	DS부문 경영지원담당	DS부문 경영지원실장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
김홍식	남	1969.09	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	
나기홍	남	1966.03	부사장	상근	베트남삼성전략협력실장	People팀 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	
노경래	남	1976.12	부사장	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	서강대(학사)	계열회사 임원	
노경윤	남	1972.09	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	메모리 Flash개발실 담당임원	MIT(박사)	계열회사 임원	
노원일	남	1967.08	부사장	상근	SRA연구소장	네트워크 상품전략팀장	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	
다니엘오	남	1974.03	부사장	상근	IR팀장	IR팀 담당임원	The Johns Hopkins Univ.(석사)	계열회사 임원	56
데이브다스	남	1975.06	부사장	상근	SEA 담당임원	SEIB법인장	Northwestern Univ.(석사)	계열회사 임원	
데이빗리	남	1969.07	부사장	상근	Samsung NEXT장	Refactor Capital, Co-founder	New York Univ.(석사)	계열회사 임원	
류경동	남	1970.01	부사장	상근	AX/PI센터 담당임원	SAIT System Research Center장	Univ. of Maryland, College Park(박사)	계열회사 임원	37
류기욱	남	1977.03	부사장	상근	Mobile eXperience 서비스 Biz팀 담당임원	SAP, SVP	Univ. of Washington(석사)	계열회사 임원	3
메노	남	1968.06	부사장	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	SEF법인장	Haarlem Business School(학사)	계열회사 임원	
명호석	남	1967.04	부사장	상근	SEA 담당임원	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀 담당임원	중앙대(학사)	계열회사 임원	
문성우	남	1971.12	부사장	상근	경영혁신센터장	경영혁신센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
문성훈	남	1974.09	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 Principal Engineer	경북대(박사)	계열회사 임원	
문종승	남	1971.08	부사장	상근	생활가전 개발팀장	생산기술연구소장	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	
문준	남	1974.06	부사장	상근	네트워크 개발팀장	네트워크 개발팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	

문희동	남	1971.07	부사장	상근	사업지원실 People팀장	사업지원T/F 담당임원	한양대(학사)	계열회사 임원	
박건태	남	1969.09	부사장	상근	Mobile eXperience 구매팀장	Mobile eXperience 구매팀 담당임원	Univ. of Colorado, Boulder(석사)	계열회사 임원	
박문호	남	1965.01	부사장	상근	People팀 담당임원	경영진단팀 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	
박봉일	남	1972.02	부사장	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI Custom SOC사업팀 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
박상권	남	1971.07	부사장	상근	DS부문 커뮤니케이션팀장	커뮤니케이션팀 담당임원	서울대(학사)	계열회사 임원	
박성욱	남	1972.04	부사장	상근	SCS법인장	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
박성호	남	1968.09	부사장	상근	생활가전 Global제조팀장	SEVT법인장	경북대(석사)	계열회사 임원	
박세근	남	1974.01	부사장	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 DRAM TD팀장	메모리 DRAM개발실 담당임원	성균관대(박사)	계열회사 임원	
박순철	남	1966.07	부사장	상근	경영지원담당	경영지원실장	연세대(학사)	계열회사 임원	
박재성	남	1971.02	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	TSP총괄 TP센터 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	
박정미	여	1968.07	부사장	상근	한국총괄 마케팅팀장	글로벌마케팅실 글로벌브랜드센터장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
박정민	남	1972.03	부사장	상근	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀장	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀 담당임원	Purdue Univ.(박사)	계열회사 임원	
박정호	남	1974.11	부사장	상근	네트워크 전략마케팅팀장	Samsung Research 차세대 통신연구센터장	연세대(박사)	계열회사 임원	
박정호	남	1971.09	부사장	상근	법무팀 담당임원	Compliance팀장	Michigan State Univ.(석사)	계열회사 임원	
박정훈	남	1969.10	부사장	상근	Samsung Research Visual Technology팀장	Samsung Research Media Research팀장	한양대(석사)	계열회사 임원	
박종범	남	1969.02	부사장	상근	서남아총괄	SIEL-S 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
박지선	남	1974.09	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	SRA 담당임원	Univ. of Texas, Austin(박사)	계열회사 임원	
박진영	여	1971.11	부사장	상근	DS부문 구매팀장	DS부문 구매팀 담당임원	서울대(학사)	계열회사 임원	
박찬우	남	1973.05	부사장	상근	한국총괄 B2B통합오퍼링센터 담당임원	생활가전 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	
박찬홍	남	1972.10	부사장	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	Qualcomm, Sr.Director	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	22
박태상	남	1975.01	부사장	상근	SEVT 담당임원	생산기술연구소 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
박현정	남	1969.12	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	DS부문 기획팀 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	
배광진	남	1968.02	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	금오공대(학사)	계열회사 임원	
배상기	남	1974.04	부사장	상근	메모리 지원팀장	메모리 지원팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
배승준	남	1976.03	부사장	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	
백종수	남	1971.01	부사장	상근	기획팀 담당임원	신사업팀장	서울대(석사)	계열회사 임원	
부민혁	남	1973.06	부사장	상근	생활가전 디자인팀장	Mobile eXperience사업부 CX실 담당임원	제주대(학사)	계열회사 임원	
서보철	남	1972.01	부사장	상근	SIEL-P(N)법인장	Mobile eXperience Global운영팀장	동국대(학사)	계열회사 임원	
서원주	남	1976.07	부사장	상근	DS부문 IP팀장	DS부문 미주총괄 VP	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	
서정아	여	1971.05	부사장	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	Mobile eXperience 온라인 Biz센터 담당임원	Columbia Univ.(석사)	계열회사 임원	
서치영	남	1974.12	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 모바일 플랫폼센터 담당임원	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	55

서한석	남	1968.02	부사장	상근	SEG법인장	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	George Washington Univ.(석사)	계열회사 임원	
서형석	남	1968.02	부사장	상근	DS부문 DSC총괄	메모리 전략마케팅실 담당임원	Tsinghua Univ.(석사)	계열회사 임원	
설지윤	남	1974.12	부사장	상근	네트워크 상품전략팀장	네트워크 개발팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
설훈	남	1970.03	부사장	상근	SEG 담당임원	SEROM법인장	고려대(학사)	계열회사 임원	
소피아황	여	1969.11	부사장	상근	Mobile eXperience 모바일 마케팅센터 담당임원	PVH, President	Univ. of Toronto(학사)	계열회사 임원	18
손성원	남	1969.02	부사장	상근	Mobile eXperience 지원팀장	북미총괄 지원팀장	연세대(석사)	계열회사 임원	
손영수	남	1974.02	부사장	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	
손태용	남	1972.08	부사장	상근	영상디스플레이 개발1팀장	영상디스플레이 개발팀장	연세대(석사)	계열회사 임원	
송두근	남	1968.07	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 EHS센터장	글로벌 제조&인프라총괄 글로벌환경안전/인프라센터장	아주대(박사)	계열회사 임원	
송방영	남	1974.10	부사장	상근	사업지원실 담당임원	사업지원T/F 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(석사)	계열회사 임원	
송병무	남	1973.08	부사장	상근	Foundry 전략마케팅실 담당임원	Foundry Corporate Planning실 담당임원	Cornell Univ.(박사)	계열회사 임원	
송용호	남	1967.04	부사장	상근	AX/PI센터장	메모리 Solution개발실장	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	
송인강	남	1971.07	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 기술전략팀 Principal Professional	Vanderbilt Univ.(석사)	계열회사 임원	
송철섭	남	1967.12	부사장	상근	DS부문 DSC 담당임원	Foundry Corporate Planning실 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	
신경섭	남	1968.09	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터장	제조&기술담당 메모리제조기술센터장	Univ. of California, Berkeley(박사)	계열회사 임원	
신승철	남	1973.04	부사장	상근	System LSI 영업팀장	DS부문 DSSEA총괄	연세대(학사)	계열회사 임원	
신승혁	남	1968.01	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Samsung Research IP출원팀장	Polytechnic Univ. of NY(박사)	계열회사 임원	
신영주	남	1969.09	부사장	상근	DS부문 경영진단팀장	DS부문 구매팀 담당임원	Purdue Univ.(박사)	계열회사 임원	
신정규	남	1969.12	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 EHS/인프라기술연구소장	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	Technical Univ. of Munich(박사)	계열회사 임원	37
신종신	남	1973.12	부사장	상근	Foundry Design Platform개발실장	Foundry Design Platform개발실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
신현진	남	1971.01	부사장	상근	Mobile eXperience People팀장	영상디스플레이 People팀장	경북대(학사)	계열회사 임원	
심재현	남	1972.01	부사장	상근	생활가전 지원팀장	지원팀 담당임원	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	
안수진	여	1969.12	부사장	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 차세대연구팀장	DS부문 CTO 반도체연구소 차세대연구실장	포항공대(박사)	계열회사 임원	
안유정	여	1974.08	부사장	상근	CDO 담당임원	Waymo, Head of Design	Illinois Inst. of Tech.(석사)	계열회사 임원	35
안재용	남	1968.08	부사장	상근	사업지원실 담당임원	삼성글로벌리서치, 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	12
안정착	남	1970.12	부사장	상근	DS부문 People팀 담당임원	System LSI Sensor사업팀 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	
양병덕	남	1971.03	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 담당임원	연세대(박사)	계열회사 임원	
양세영	남	1975.08	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
양익준	남	1969.11	부사장	상근	경영혁신센터 담당임원	아프리카총괄 지원팀장	성균관대(학사)	계열회사 임원	
양준철	남	1972.06	부사장	상근	생활가전 구매팀장	생활가전 구매팀 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	

양혜순	여	1968.02	부사장	상근	생활가전 New Biz팀장	생활가전 MDE전략팀장	Michigan State Univ.(박사)	계열회사 임원	
엄재훈	남	1966.06	부사장	상근	상생협력센터장	DS부문 DS대외협력팀장	서강대(석사)	계열회사 임원	
여명구	남	1970.10	부사장	상근	DS부문 People팀장	조직문화개선T/F 담당임원	아주대(석사)	계열회사 임원	
여태정	남	1970.06	부사장	상근	하만협력팀 담당임원	전장사업팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
오문욱	남	1974.02	부사장	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	혁신센터장	서울대(석사)	계열회사 임원	
오정석	남	1970.03	부사장	상근	사업지원실 담당임원	사업지원T/F 담당임원	Tsinghua Univ.(석사)	계열회사 임원	
오치오	남	1967.01	부사장	상근	한국총괄 B2B팀장	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	건국대(석사)	계열회사 임원	
오태영	남	1974.10	부사장	상근	DSRA-Memory 담당임원	DSRA-Memory 연구소장	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	
오형석	남	1970.09	부사장	상근	DS부문 구매팀 담당임원	TSP총괄 구매팀장	고려대(학사)	계열회사 임원	
오화석	남	1972.02	부사장	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	
우영돈	남	1974.01	부사장	상근	법무실 개인정보보호팀장	법무실 담당임원	한양대(학사)	계열회사 임원	
원성근	남	1968.05	부사장	상근	SAS 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	충북대(석사)	계열회사 임원	
원순재	남	1972.01	부사장	상근	메모리 Solution개발실장	메모리 Solution개발실 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
원종욱	남	1962.10	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 EHS센터 담당임원	연세대, 교수	가톨릭대(박사)	계열회사 임원	19
원종현	남	1967.05	부사장	상근	사업지원실 담당임원	삼성글로벌리서치, 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	12
위훈	남	1970.04	부사장	상근	Samsung Research Life Solution팀장	Samsung Research Life Solution팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
유규태	남	1975.02	부사장	상근	의료기기사업부장	의료기기 전략마케팅팀장	Cornell Univ.(박사)	계열회사 임원	46
유미영	여	1968.07	부사장	상근	생활가전 Global CS팀장	생활가전 S/W개발팀장	포항공대(석사)	계열회사 임원	
유병길	남	1970.09	부사장	상근	SEDA-S법인장	SEA 담당임원	Univ. of Virginia(석사)	계열회사 임원	
유상민	남	1973.09	부사장	상근	System LSI IP개발팀장	System LSI SOC사업팀 담당임원	Univ. of Washington(박사)	계열회사 임원	
유종민	남	1974.04	부사장	상근	영상디스플레이 People팀장	People팀 담당임원	경희대(학사)	계열회사 임원	
유한종	남	1973.10	부사장	상근	재경팀 담당임원	SEF 담당임원	Univ. of North Carolina, Chapel Hill(석사)	계열회사 임원	
윤석민	남	1971.02	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	54
윤영조	남	1975.02	부사장	상근	Global Public Affairs실 담당임원	IR팀 담당임원	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	
윤인수	남	1974.11	부사장	상근	Compliance팀장	법무팀 담당임원	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	
윤종덕	남	1969.04	부사장	상근	커뮤니케이션실 담당임원	커뮤니케이션팀 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
윤주한	남	1970.05	부사장	상근	중동총괄 지원팀장	재경팀 담당임원	Univ. of California, Berkeley(석사)	계열회사 임원	
윤태양	남	1968.12	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄, CSO	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터장	고려대(석사)	계열회사 임원	
윤하룡	남	1971.12	부사장	상근	DS부문 DSA 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
이강호	남	1977.10	부사장	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	Global Foundries, Principal Member of Technical Staff	Purdue Univ.(박사)	계열회사 임원	34
이경우	남	1969.04	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발2실 Principal Engineer	한양대(박사)	계열회사 임원	
이계성	남	1967.11	부사장	상근	법무실 해외법무팀장	구주총괄 대외협력팀장	St. Louis Univ.(석사)	계열회사 임원	

이귀호	여	1975.05	부사장	상근	영상디스플레이 Service Business팀 담당임원	영상디스플레이 Service Business팀 Principal Professional	이화여대(학사)	계열회사 임원	
이근호	남	1970.02	부사장	상근	AX/PI센터 담당임원	혁신센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
이금주	여	1971.09	부사장	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실 담당임원	반도체연구소 메모리 TD실 담당임원	중앙대(석사)	계열회사 임원	
이대성	남	1970.09	부사장	상근	중국총괄	SCIC 담당임원	Thunderbird(석사)	계열회사 임원	
이동건	남	1977.05	부사장	상근	RX사업추진실 담당임원	현대차, 상무	MIT(박사)	계열회사 임원	5
이동근	남	1971.08	부사장	상근	네트워크 Global Technology Engineering팀장	네트워크 개발팀 담당임원	한양대(박사)	계열회사 임원	
이무형	남	1970.02	부사장	상근	Global CS센터 담당임원	생활가전 CX팀장	Purdue Univ.(박사)	계열회사 임원	
이민철	남	1970.04	부사장	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	무선 PC사업팀 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	
이병국	남	1965.11	부사장	상근	Mobile eXperience Global제조센터장	SEVT법인장	부산대(학사)	계열회사 임원	
이병원	남	1972.05	부사장	상근	기획팀 담당임원	기획재정부, 부이사관	Indiana Univ., Bloomington(석사)	계열회사 임원	35
이병현	남	1977.10	부사장	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 Principal Engineer	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	34
이상우	남	1972.11	부사장	상근	법무실 담당임원	법무팀 담당임원	연세대(학사)	계열회사 임원	
이상욱	남	1973.04	부사장	상근	영상디스플레이 CX센터 담당임원	BT Group, CDO	Carnegie Mellon Univ.(석사)	계열회사 임원	23
이상원	남	1971.07	부사장	상근	경영진단팀장	서남아총괄 지원팀장	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	
이상주	남	1970.09	부사장	상근	유럽총괄 대외협력팀장	법무실 담당임원	Harvard Univ.(석사)	계열회사 임원	
이상직	남	1970.06	부사장	상근	생활가전 전략마케팅팀장	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	한국외국어대(학사)	계열회사 임원	
이상현	남	1970.09	부사장	상근	DSRJ 담당임원	SCS 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	
이상훈	남	1973.04	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당임원	Univ. of California, Berkeley(박사)	계열회사 임원	50
이석원	남	1970.07	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 설비기술연구소 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
이성진	남	1979.02	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Amazon, Principal Scientist	포항공대(박사)	계열회사 임원	26
이승구	남	1969.08	부사장	상근	People팀 담당임원	SEG 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	
이승엽	남	1968.08	부사장	상근	아프리카총괄	SEIN-S법인장	서울대(학사)	계열회사 임원	
이승재	남	1974.08	부사장	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
이시영	남	1972.04	부사장	상근	Mobile eXperience 품질혁신센터장	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Univ. of Sussex(석사)	계열회사 임원	
이영수	남	1972.01	부사장	상근	생산기술연구소장	SEVT 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
이영웅	남	1969.07	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	MIT(박사)	계열회사 임원	42
이왕익	남	1963.07	부사장	상근	재경팀 담당임원	삼성생명, 지원팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
이윤수	남	1975.11	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Samsung Research Data Intelligence팀장	Univ. of Maryland(박사)	계열회사 임원	
이일환	남	1973.09	부사장	상근	Mobile eXperience 디자인팀장	Mobile eXperience CX실 담당임원	Art Center College Of Design(학사)	계열회사 임원	46
이재범	남	1970.10	부사장	상근	생활가전 기획팀장	영상디스플레이 기획팀장	홍익대(학사)	계열회사 임원	

이재열	남	1970.01	부사장	상근	System LSI LSI사업팀장	System LSI LSI개발실장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
이정삼	남	1967.06	부사장	상근	SESS법인장	TSP총괄 Global운영팀장	인하대(학사)	계열회사 임원	
이정원	남	1977.04	부사장	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI SOC개발실 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	
이정환	남	1971.05	부사장	상근	DS부문 법무실장	DS부문 법무지원팀장	서울대(학사)	계열회사 임원	45
이제현	남	1970.04	부사장	상근	사업지원실 담당임원	사업지원T/F 담당임원	광운대(학사)	계열회사 임원	
이종규	남	1970.02	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발1실 Principal Engineer	한양대(석사)	계열회사 임원	
이종명	남	1970.03	부사장	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실장	반도체연구소 공정개발실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
이종민	남	1971.09	부사장	상근	CX센터장	글로벌마케팅실 CX센터장	Illinois Inst. of Tech.(석사)	계열회사 임원	
이종민	남	1973.06	부사장	상근	System LSI 지원팀장	DS부문 지원팀 담당임원	Univ. of Washington, Seattle(석사)	계열회사 임원	
이종열	남	1970.02	부사장	상근	AX/PI센터 담당임원	System LSI SOC사업팀장	서울대(박사)	계열회사 임원	
이종포	남	1974.10	부사장	상근	영상디스플레이 개발1팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	
이종호	남	1968.01	부사장	상근	Foundry 품질팀장	Foundry 기술개발실 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
이주형	남	1972.08	부사장	상근	Samsung Research AI센터 담당임원	Samsung Research Global AI센터 담당임원	Univ. of Texas, Austin(박사)	계열회사 임원	
이준화	남	1972.03	부사장	상근	Global EHS실장	생활가전 CX팀장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
이진엽	남	1970.02	부사장	상근	메모리 Flash개발실장	DS부문 경영진단팀장	서강대(석사)	계열회사 임원	
이창수	남	1971.07	부사장	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당임원	경희대(학사)	계열회사 임원	
이태관	남	1971.12	부사장	상근	법무실 담당임원	삼성물산, 법무팀 담당임원	George Washington Univ.(석사)	계열회사 임원	
이학민	남	1972.04	부사장	상근	지원팀장	사업지원T/F 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
이한관	남	1971.09	부사장	상근	SRA 담당임원	TSP총괄 인사팀장	성균관대(석사)	계열회사 임원	
이해창	남	1975.10	부사장	상근	System LSI Sensor사업팀장	System LSI 전략마케팅실장	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	
이헌	남	1971.01	부사장	상근	영상디스플레이 전략마케팅팀장	영상디스플레이 영상전략마케팅팀장	Duke Univ.(석사)	계열회사 임원	
이헌	남	1969.02	부사장	상근	SEIN-S법인장	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	Syracuse Univ.(석사)	계열회사 임원	
이형우	남	1970.03	부사장	상근	북미총괄 대외협력팀장(Co)	북미총괄 담당임원	Univ. of Texas, Austin(석사)	계열회사 임원	
이화성	남	1970.09	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
임병일	남	1970.01	부사장	상근	사업지원실 담당임원	사업지원T/F 담당임원	Univ. of Chicago(석사)	계열회사 임원	58
임성수	남	1978.11	부사장	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 DRAM TD팀 담당임원	DS부문 CTO 반도체연구소 DRAM TD실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
임성택	남	1970.10	부사장	상근	생활가전 HVAC사업팀장	생활가전 Air Solution사업팀장	서울대(박사)	계열회사 임원	
임성택	남	1966.06	부사장	상근	한국총괄	중동총괄	연세대(학사)	계열회사 임원	
장상익	남	1968.07	부사장	상근	영상디스플레이 구매팀장	영상디스플레이 구매팀 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	
장성환	남	1971.07	부사장	상근	Mobile eXperience 모바일 마케팅센터 담당임원	Interpublic Group, EVP	Columbia Univ.(석사)	계열회사 임원	28
장세명	남	1968.01	부사장	상근	기획팀장	기획팀 담당임원	Case Western Reserve Univ.(박사)	계열회사 임원	46

장소연	여	1971.06	부사장	상근	Mobile eXperience 모바일 마케팅센터 담당임원	한국총괄 마케팅팀장	이화여대(학사)	계열회사 임원	
장실완	남	1973.02	부사장	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 Principal Engineer	서울대(학사)	계열회사 임원	
장재훈	남	1969.07	부사장	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 Flash TD팀장	DS부문 CTO 반도체연구소 Flash TD실장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
장혁	남	1978.08	상무	상근	SEA 담당임원	북미총괄 Principal Professional	한양대(학사)	계열회사 임원	11
전상욱	남	1971.01	부사장	상근	Mobile eXperience Samsung Care+팀장	Mobile eXperience 전략기획팀장	Washington, Seattle(석사)	계열회사 임원	46
정광희	남	1971.08	부사장	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	DS부문 DSC 담당임원	Tsinghua Univ.(석사)	계열회사 임원	
정성택	남	1976.09	부사장	상근	DS부문 기획팀장	DS부문 기획팀 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	50
정승목	남	1969.05	부사장	상근	중국삼성전략협력실 담당임원	중국전략협력실 담당임원	Thunderbird(석사)	계열회사 임원	
정용덕	남	1976.09	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 Common Tech센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
정원석	남	1971.07	부사장	상근	사업지원실 담당임원	삼성글로벌리서치, 담당임원	한양대(학사)	계열회사 임원	12
정윤	남	1967.05	부사장	상근	북미총괄	Mobile eXperience 전략마케팅실장	서울대(박사)	계열회사 임원	
정인호	남	1975.02	부사장	상근	Foundry 지원팀장	TSP총괄 지원팀장	MIT(석사)	계열회사 임원	
정인희	여	1974.09	부사장	상근	지속가능경영추진센터 담당임원	LG화학, Expert Advisor	Imperial College(석사)	계열회사 임원	58
정재연	여	1974.09	부사장	상근	AI플랫폼센터 담당임원	디바이스플랫폼센터 담당임원	MIT(박사)	계열회사 임원	
정진국	남	1975.10	부사장	상근	Samsung Research 차세대 통신연구센터장	Samsung Research 차세대 통신연구센터 담당임원	서강대(박사)	계열회사 임원	
정혁준	남	1972.05	부사장	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI SOC개발실 담당임원	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	
정혜순	여	1975.12	부사장	상근	SRA 담당임원	Mobile eXperience 개발실 담당임원	부산대(학사)	계열회사 임원	
정호진	남	1971.05	부사장	상근	한국총괄 MX팀장	한국총괄 CE영업팀장	Rutgers Univ.(석사)	계열회사 임원	
정효명	남	1972.11	부사장	상근	상생협력센터 담당임원	삼성글로벌리서치, 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	12
제이콥주	남	1978.11	부사장	상근	DS부문 DSC 담당임원	DS부문 중국총괄 VP	中國科學技術大學(석사)	계열회사 임원	
조기열	남	1971.03	부사장	상근	법무실 법무팀장	삼성디스플레이, 법무실장	경찰대(학사)	계열회사 임원	34
조기재	남	1967.01	부사장	상근	DS부문 지원팀장	메모리 지원팀장	Babson College(석사)	계열회사 임원	
조명호	남	1969.05	부사장	상근	영상디스플레이 Global CS팀장	영상디스플레이 기획팀장	연세대(석사)	계열회사 임원	
조상연	남	1971.12	부사장	상근	DS부문 DSA총괄	DS부문 DSA 담당임원	Univ. of Minnesota, Twin Cities(박사)	계열회사 임원	
조성대	남	1969.06	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발1실 담당임원	RPI(박사)	계열회사 임원	
조성일	남	1973.12	부사장	상근	TSP총괄	글로벌 제조&인프라총괄 TP제조기술센터장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
조성혁	남	1970.05	부사장	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실장	유럽총괄	Univ. of California, Berkeley(석사)	계열회사 임원	
조성훈	남	1970.11	부사장	상근	SEA 담당임원	경영혁신센터 담당임원	건국대(박사)	계열회사 임원	
조성훈	남	1976.01	부사장	상근	System LSI People팀장	People팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
조시정	남	1969.11	부사장	상근	People팀장	People팀 담당임원	경희대(학사)	계열회사 임원	

조영준	남	1971.05	부사장	상근	수원지원센터장	북미총괄 People팀장	성균관대(학사)	계열회사 임원	
조웅	남	1972.08	부사장	상근	법무실 담당임원	삼성SDI, 법무팀장	한양대(학사)	계열회사 임원	54
조인하	여	1974.02	부사장	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	SEUK법인장	서강대(석사)	계열회사 임원	
조철호	남	1971.07	부사장	상근	D2C센터장	글로벌마케팅실 D2C센터장	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	
조필주	남	1971.07	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 지원팀장	종합기술원 기획지원팀장	서울대(박사)	계열회사 임원	
조홍상	남	1966.06	부사장	상근	중남미총괄	SEF법인장	연세대(학사)	계열회사 임원	
주영수	남	1965.08	부사장	상근	성균관대(파견)	삼성생명서비스, 고객지원실 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	
주창훈	남	1970.10	부사장	상근	사업지원실 경영진단팀장	사업지원T/F 담당임원	아주대(석사)	계열회사 임원	
지현기	남	1968.01	부사장	상근	DS부문 상생협력센터장	메모리 기획팀장	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(석사)	계열회사 임원	
지혜령	여	1972.04	부사장	상근	커뮤니케이션실 담당임원	커뮤니케이션팀 담당임원	Univ. of Michigan, Ann Arbor(석사)	계열회사 임원	
차경환	남	1972.04	부사장	상근	중동총괄	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	Univ. of California, Berkeley(석사)	계열회사 임원	
차병석	남	1968.11	부사장	상근	커뮤니케이션실 담당임원	커뮤니케이션팀 담당임원	Helsinki Sch. Of Economics & Business Administration(석사)	계열회사 임원	
채원철	남	1966.05	부사장	상근	Mobile eXperience Digital Wallet팀장	Mobile eXperience CX실 담당임원	광운대(학사)	계열회사 임원	
최광보	남	1971.03	부사장	상근	사업지원실 담당임원	사업지원T/F 담당임원	부산대(학사)	계열회사 임원	
최권영	남	1971.01	부사장	상근	사업지원실 담당임원	사업지원T/F 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	22
최병희	남	1970.05	부사장	상근	CIS총괄	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	
최순	남	1970.10	부사장	상근	SIEL-S 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	Duke Univ.(석사)	계열회사 임원	
최승범	남	1964.12	부사장	상근	AI플랫폼센터장	디바이스플랫폼센터장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
최승은	여	1969.07	부사장	상근	글로벌브랜드센터장	Mobile eXperience 모바일마케팅센터장	서강대(석사)	계열회사 임원	
최승훈	남	1970.10	부사장	상근	상생협력센터 담당임원	삼성생명, 기획팀장	성균관대(석사)	계열회사 임원	46
최용훈	남	1969.07	부사장	상근	영상디스플레이 Global Outsourcing팀장	영상디스플레이 Service Business팀 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	
최재인	남	1976.11	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Apple, Director	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	19
최정연	남	1974.11	부사장	상근	메모리 Design Technology팀장	Foundry Design Platform개발실 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	
최진원	남	1966.09	부사장	상근	재경팀 담당임원	재경팀 담당부장	서울대(학사)	계열회사 임원	
최진혁	남	1967.02	부사장	상근	System LSI SOC사업팀장	DSRA-Memory 연구소장	서울대(박사)	계열회사 임원	
최창규	남	1970.03	부사장	상근	AX/PI센터 담당임원	SAIT AI Research Center장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
최청호	남	1976.11	부사장	상근	법무실 담당임원	광장, 변호사	경북대(학사)	계열회사 임원	45
최황석	남	1969.01	부사장	상근	생활가전 HVAC사업팀 담당임원	생활가전 Air Solution사업팀 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	27
편정우	남	1970.10	부사장	상근	TSP총괄 품질팀장	메모리 품질실 담당임원	Univ. of Texas, Austin(박사)	계열회사 임원	
한의택	남	1974.02	부사장	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	State Univ. of New York, Stony Brook(석사)	계열회사 임원	
함선규	남	1970.01	부사장	상근	네트워크 지원팀장	지원팀 담당임원	Washington Univ. in St. Louis(석사)	계열회사 임원	
허길영	남	1965.08	부사장	상근	DS부문 재경팀장	DS부문 재경팀 담당임원	아주대(석사)	계열회사 임원	

현상진	남	1972.02	부사장	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 차세대공정개발팀장	DS부문 CTO 반도체연구소 차세대공정개발실장	서울대(박사)	계열회사 임원	
홍경선	남	1970.08	부사장	상근	커뮤니케이션실 담당임원	커뮤니케이션팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
홍기준	남	1971.05	부사장	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI SOC개발실 담당임원	Columbia Univ.(석사)	계열회사 임원	
홍석준	남	1970.07	부사장	상근	CSS사업팀장	CSS사업팀 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	40
홍승완	남	1971.06	부사장	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	반도체연구소 메모리 TD실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
홍영기	남	1970.03	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터장	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당임원	Imperial College(박사)	계열회사 임원	
홍유진	여	1972.05	부사장	상근	CDO 담당임원	디자인경영센터 담당임원	Univ. of California, LA(석사)	계열회사 임원	
홍주선	남	1971.10	부사장	상근	생활가전 개발팀 담당임원	영상디스플레이 Global운영팀 담당임원	경희대(석사)	계열회사 임원	
홍희일	남	1970.10	부사장	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 Principal Engineer	한양대(석사)	계열회사 임원	
황경순	남	1968.08	부사장	상근	SAIT Air Science Platform장	UT Austin, 교수	Caltech(박사)	계열회사 임원	40
황근철	남	1973.03	부사장	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 Global Technology Engineering팀장	서울대(박사)	계열회사 임원	
황상준	남	1972.01	부사장	상근	메모리 메모리개발담당	메모리 DRAM개발실장	고려대(박사)	계열회사 임원	
황완구	남	1972.02	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	58
황용호	남	1975.10	부사장	상근	AI플랫폼센터 담당임원	Samsung Research Security&Privacy팀장	포항공대(박사)	계열회사 임원	
황인철	남	1977.11	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 모바일 플랫폼센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
황태환	남	1968.04	부사장	상근	한국총괄 B2B통합오퍼링센터장	생활가전 전략마케팅팀장	경희대(학사)	계열회사 임원	
황희돈	남	1974.01	부사장	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실 담당임원	반도체연구소 메모리 TD실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
강건혁	남	1978.11	상무	상근	DSRA-S.LSI 담당임원	System LSI Design Platform개발실 담당임원	Purdue Univ.(박사)	계열회사 임원	
강도희	남	1974.12	상무	상근	Mobile eXperience 품질혁신센터 담당임원	Mobile eXperience 개발실 담당임원	경북대(석사)	계열회사 임원	
강동우	남	1971.04	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 S.PKG제조기술센터장	글로벌 제조&인프라총괄 AVP제조기술센터장	한양대(석사)	계열회사 임원	
강명진	남	1977.02	상무	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	Foundry 기술개발실 Principal Engineer	연세대(박사)	계열회사 임원	46
강상균	남	1976.06	상무	상근	의료기기 X-ray사업팀장	북미총괄 Principal Professional	서강대(석사)	계열회사 임원	11
강성석	남	1971.07	상무	상근	DS부문 정보보호센터 담당임원	DS부문 정보보호센터 Principal Professional	경북대(석사)	계열회사 임원	11
강신광	남	1968.08	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 EHS센터 담당임원	글로벌인프라총괄 환경안전센터 담당임원	아주대(석사)	계열회사 임원	
강연호	남	1979.11	상무	상근	재경팀 담당임원	관세청, 부이사관	Univ. of York(석사)	계열회사 임원	39
강윤경	여	1968.12	상무	상근	People팀 담당임원	Samsung Research 창의개발센터 담당임원	Univ. of Michigan, Ann Arbor(석사)	계열회사 임원	
강정대	남	1970.09	상무	상근	육상연맹(파견)	재경팀 담당임원	한국방송통신대(학사)	계열회사 임원	

강종호	남	1974.12	상무	상근	SELV법인장	SEAD법인장	인하대(석사)	계열회사 임원	23
강태형	남	1976.05	상무	상근	영상디스플레이 전략마케팅팀 담당임원	영상디스플레이 Customer Marketing팀 담당임원	Univ. of Virginia(석사)	계열회사 임원	38
강혁	남	1984.10	상무	상근	RX사업추진실 담당임원	미래로봇추진단 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	46
경세진	남	1977.10	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 Principal Engineer	성균관대(박사)	계열회사 임원	11
고상도	남	1975.12	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 메모리제조기술센터 Principal Professional	경희대(학사)	계열회사 임원	23
고상원	남	1979.11	상무	상근	영상디스플레이 기획팀장	영상디스플레이 구매팀 담당임원	Stanford Univ.(석사)	계열회사 임원	46
고얄시드	남	1977.12	상무	상근	D2C센터 담당임원	글로벌마케팅실 D2C센터 담당임원	Univ. of Sydney(석사)	계열회사 임원	
고의중	남	1972.02	상무	상근	법무실 담당임원	Compliance팀 담당임원	서울대(학사)	계열회사 임원	58
고정욱	남	1976.02	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	한국총괄 MX팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
고종현	남	1981.01	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 CIS TD팀장	DS부문 CTO 반도체연구소 CIS TD팀 Principal Engineer	Purdue Univ.(박사)	계열회사 임원	23
고주현	남	1974.08	상무	상근	System LSI Sensor사업팀 담당임원	System LSI Sensor사업팀 Principal Engineer	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
고진일	남	1977.02	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	People팀 Principal Professional	고려대(석사)	계열회사 임원	11
고택균	남	1971.05	상무	상근	DS부문 DSC 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당임원	Tsinghua Univ.(석사)	계열회사 임원	
고현목	남	1980.02	상무	상근	Samsung Research AI센터 담당임원	Samsung Research Global AI센터 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	34
곽원근	남	1973.07	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 개발실 Principal Engineer	연세대(석사)	계열회사 임원	34
곽정석	남	1980.09	상무	상근	Samsung Research Data Intelligence팀장	Apple, Tech. Leader	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	15
곽호석	남	1977.05	상무	상근	커뮤니케이션실 담당임원	커뮤니케이션팀 Principal Professional	서울대(학사)	계열회사 임원	11
구관본	남	1975.01	상무	상근	System LSI LSI사업팀 담당임원	System LSI LSI개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
권기덕	남	1977.10	상무	상근	법무실 담당임원	DS부문 법무지원팀 Principal Legal Counsel	서울대(학사)	계열회사 임원	
권기덕	여	1974.10	상무	상근	Mobile eXperience 전략기획팀장	기획팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
권기록	남	1974.07	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 Principal Engineer	성균관대(박사)	계열회사 임원	35
권기성	남	1975.01	상무	상근	메모리 품질실 담당임원	메모리 품질실 Principal Engineer	인하대(학사)	계열회사 임원	35
권기훈	남	1979.10	상무	상근	People팀 담당임원	삼성SDS, Principal Engineer	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	11
권민호	남	1975.08	상무	상근	System LSI Sensor사업팀 담당임원	System LSI Sensor사업팀 Principal Engineer	연세대(박사)	계열회사 임원	23
권석남	남	1976.01	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI SOC사업팀 Principal Engineer	포항공대(석사)	계열회사 임원	11

권영재	남	1972.05	상무	상근	Global CS센터 담당임원	Mobile eXperience 품질혁신센터 담당임원	한양대(석사)	계열회사 임원	
권영현	남	1978.03	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 Common Tech센터 Principal Engineer	중앙대(학사)	계열회사 임원	11
권영호	남	1973.08	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 Principal Engineer	성균관대(석사)	계열회사 임원	23
권영훈	남	1972.02	상무	상근	SEA 담당임원	네트워크 개발팀 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
권주성	남	1980.01	상무	상근	사업지원실 담당임원	삼성글로벌리서치, 담당간부	서울대(석사)	계열회사 임원	11
권춘기	남	1969.04	상무	상근	영상디스플레이 Global제조팀장	SEHC법인장	포항공대(학사)	계열회사 임원	
권혁만	남	1973.06	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI 전략마케팅실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
권형석	남	1973.02	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	System LSI 전략마케팅실 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	
권호범	남	1975.12	상무	상근	Samsung Research S/W혁신센터장	Samsung Research S/W혁신센터 담당임원	New York Univ., Tandon School of Engineering(석사)	계열회사 임원	
김건우	남	1976.01	상무	상근	Mobile eXperience 지원팀 담당임원	SESK 담당임원	MIT(석사)	계열회사 임원	58
김경륜	남	1983.02	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	58
김경석	남	1977.01	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 Principal Engineer	아주대(석사)	계열회사 임원	11
김경아	여	1978.06	상무	상근	DS부문 상생협력센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 EHS센터 Principal Professional	광주과학기술원(석사)	계열회사 임원	11
김경진	여	1977.11	상무	상근	DS부문 People팀 담당임원	DS부문 People팀 Principal Professional	연세대(석사)	계열회사 임원	11
김경태	남	1973.07	상무	상근	한국총괄 마케팅팀 담당임원	한국총괄 IMC팀 Principal Professional	성균관대(학사)	계열회사 임원	46
김경태	남	1973.12	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	부산대(학사)	계열회사 임원	
김경택	남	1975.05	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	Mobile eXperience CX실 Principal Designer	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	34
김광익	남	1974.09	상무	상근	DS부문 지원팀 담당임원	글로벌인프라총괄 평택사업장 Principal Professional	한양대(학사)	계열회사 임원	58
김광훈	남	1975.02	상무	상근	SEDA-P(C)법인장	SEDA-P(C)공장장	인하대(학사)	계열회사 임원	46
김기수	남	1976.05	상무	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 Principal Engineer	서울대(박사)	계열회사 임원	46
김기언	남	1972.06	상무	상근	DS부문 DSSEA총괄	메모리 전략마케팅실 담당임원	한양대(학사)	계열회사 임원	46
김기현	남	1979.01	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 Principal Engineer	중앙대(학사)	계열회사 임원	11
김길섭	남	1979.04	상무	상근	메모리 지원팀 담당임원	사업지원T/F Principal Professional	서울대(석사)	계열회사 임원	23

김대영	남	1977.04	상무	상근	영상디스플레이 개발1팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 담당임원	동국대(학사)	계열회사 임원	11
김대현	남	1974.08	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	SME법인장	경북대(학사)	계열회사 임원	46
김대현	남	1979.11	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 Principal Engineer	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	11
김덕헌	남	1975.06	상무	상근	상생협력센터 담당임원	메타볼라이트, Co-Founder	고려대(학사)	계열회사 임원	
김도기	남	1975.05	상무	상근	People팀 담당임원	DS부문 CTO People팀장	숭실대(학사)	계열회사 임원	46
김도형	남	1977.05	상무	상근	SAIT People팀장	SCS Principal Professional	고려대(학사)	계열회사 임원	23
김동근	남	1976.07	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI SOC개발실 Principal Engineer	Univ. of Maryland, College Park(박사)	계열회사 임원	58
김동수	남	1976.05	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 개발실 Principal Engineer	연세대(박사)	계열회사 임원	23
김동수	남	1975.10	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 People팀장	DS부문 People팀 담당임원	Univ. of Maryland, College Park(석사)	계열회사 임원	58
김동준	남	1973.05	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 담당임원	제조&기술담당 담당임원	광주과학기술원(박사)	계열회사 임원	
김두현	남	1976.10	상무	상근	영상디스플레이 전략마케팅팀 담당임원	SEROM법인장	고려대(학사)	계열회사 임원	23
김래훈	남	1975.07	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI 기반설계실 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(박사)	계열회사 임원	
김명오	남	1972.09	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 Principal Engineer	연세대(석사)	계열회사 임원	
김무성	남	1976.11	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	Gauss Labs, 부사장	Univ. of California, Berkeley(박사)	계열회사 임원	5
김무성	남	1975.12	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 Principal Engineer	포항공대(석사)	계열회사 임원	58
김민성	남	1975.02	상무	상근	미래사업기획단 담당임원	삼성SDI, 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	22
김민우	남	1978.06	상무	상근	영상디스플레이 전략마케팅팀 담당임원	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	한양대(학사)	계열회사 임원	
김범준	남	1977.03	상무	상근	SEA 담당임원	동남아총괄 지원팀장	Univ. of California, LA(석사)	계열회사 임원	34
김범진	남	1975.02	상무	상근	Mobile eXperience Galaxy Value Innovation팀 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(석사)	계열회사 임원	
김병승	남	1976.11	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI SOC개발실 Principal Engineer	서울대(박사)	계열회사 임원	35
김보창	남	1977.09	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	46
김봉수	남	1971.06	상무	상근	DS부문 People팀 담당임원	DS부문 CTO 반도체연구소 DRAM TD팀 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
김상윤	남	1972.01	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	
김상준	남	1976.10	상무	상근	지원팀 담당임원	SEG 담당임원	서강대(학사)	계열회사 임원	23
김상하	여	1981.01	상무	상근	AX팀 담당임원	Samsung Research AI센터 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	23
김상현	남	1978.10	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	SEI 담당임원	Univ. of Michigan, Ann Arbor(석사)	계열회사 임원	34
김석영	남	1973.09	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 Principal Engineer	한양대(석사)	계열회사 임원	35

김석효	남	1975.10	상무	상근	DS부문DS대외협력팀 담당임원	삼성생명 담당임원	한양대(학사)	계열회사 임원	12
김선기	남	1973.11	상무	상근	AX/PI센터 담당임원	혁신센터 담당임원	Virginia Tech(박사)	계열회사 임원	31
김선정	남	1973.02	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실 담당임원	제조담당 Foundry제조기술센터 담당임원	National Univ. of Singapore(박사)	계열회사 임원	58
김성민	남	1976.03	상무	상근	Mobile eXperience 지원팀 담당임원	네트워크 지원팀장	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	58
김성현	남	1977.01	상무	상근	Mobile eXperience 담당임원	Mobile eXperience 개발실 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	23
김성훈	남	1977.02	상무	상근	네트워크 Global Technology Engineering팀 담당임원	네트워크 개발팀 Principal Engineer	서울대(석사)	계열회사 임원	23
김세웅	남	1978.12	상무	상근	경영혁신센터 담당임원	네트워크 지원팀 Principal Professional	서강대(학사)	계열회사 임원	11
김세진	여	1973.07	상무	상근	Mobile eXperience 모바일 마케팅센터 담당임원	Mobile eXperience 마케팅팀 담당임원	Duke Univ.(석사)	계열회사 임원	46
김수연	여	1977.09	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 개발실 Principal Engineer	Univ. of York(석사)	계열회사 임원	34
김승연	여	1975.04	상무	상근	Mobile eXperience 모바일 마케팅센터 담당임원	Mobile eXperience 마케팅팀 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	
김시우	남	1972.10	상무	상근	System LSI LSI사업팀 담당임원	System LSI LSI개발실 Principal Engineer	단국대(석사)	계열회사 임원	
김영무	남	1976.09	상무	상근	SEA 담당임원	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	The Johns Hopkins Univ.(석사)	계열회사 임원	58
김영상	남	1974.06	상무	상근	AX팀 담당임원	경영혁신센터 담당임원	Indiana Univ., Bloomington(석사)	계열회사 임원	23
김영아	여	1976.02	상무	상근	Mobile eXperience 모바일 마케팅센터 담당임원	Adidas, VP	이화여대(학사)	계열회사 임원	26
김영우	남	1972.12	상무	상근	DS부문 기획팀 담당임원	삼성글로벌리서치, 담당임원	Columbia Univ.(석사)	계열회사 임원	40
김영일	남	1974.12	상무	상근	DS부문 DSA 담당임원	DS부문 미주총괄 Principal Professional	고려대(학사)	계열회사 임원	46
김영정	남	1972.03	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	58
김영주	남	1973.07	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	한양대(석사)	계열회사 임원	58
김영집	남	1979.05	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 Principal Engineer	서울대(박사)	계열회사 임원	46
김용관	남	1976.04	상무	상근	상생협력센터 담당임원	IR팀 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(박사)	계열회사 임원	
김용상	남	1972.08	상무	상근	Foundry 전략마케팅실 담당임원	DS부문 DSA 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
김용완	남	1970.04	상무	상근	TSP총괄 Global운영팀장	메모리 Global운영팀장	연세대(학사)	계열회사 임원	
김용한	남	1976.02	상무	상근	생활가전 Global제조팀 담당임원	생활가전 담당임원	고려대(박사)	계열회사 임원	58
김용훈	남	1972.11	상무	상근	한국총괄 CE팀장	한국총괄 CE팀 담당임원	한양대(학사)	계열회사 임원	
김우년	남	1970.09	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	
김우일	남	1978.02	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI SOC사업팀 Principal Engineer	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(박사)	계열회사 임원	23

김운	남	1975.01	상무	상근	한국총괄 e-Commerce팀 담당임원	한국총괄 e-Commerce팀 Principal Professional	한양대(학사)	계열회사 임원	11
김원겸	남	1975.03	상무	상근	SEEG-P법인장	영상디스플레이 Global제조팀 Principal Professional	광운대(학사)	계열회사 임원	23
김원국	남	1975.11	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 Principal Engineer	경북대(석사)	계열회사 임원	58
김원기	남	1977.10	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	Apple, Head of Business	Georgia Inst. of Tech.(석사)	계열회사 임원	5
김원우	남	1970.03	상무	상근	영상디스플레이 전략마케팅팀 담당임원	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	
김원종	남	1976.10	상무	상근	영상디스플레이 Service Business팀 담당임원	유럽총괄 Principal Professional	서강대(학사)	계열회사 임원	11
김원희	남	1971.04	상무	상근	SEI법인장	SEAU법인장	Mcgill Univ.(석사)	계열회사 임원	
김유나	여	1979.01	상무	상근	Samsung Research 기술전략팀 담당임원	SRPOL연구소장	포항공대(박사)	계열회사 임원	58
김유승	남	1978.02	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	Intuitive, Staff Engineer	Carnegie Mellon Univ.(박사)	계열회사 임원	33
김윤재	남	1973.02	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실 담당임원	반도체연구소 메모리 TD실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
김윤형	남	1987.03	상무	상근	Samsung Research AI센터 담당임원	MIT, 부교수	Harvard Univ.(박사)	계열회사 임원	1
김은경	여	1974.04	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 Principal Engineer	단국대(학사)	계열회사 임원	
김은용	남	1979.02	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 Principal Engineer	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	46
김은하	여	1971.05	상무	상근	법무실 IP센터 담당임원	법무실 IP센터 Principal Engineer	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	
김의겸	남	1987.11	상무	상근	RX사업추진실 담당임원	성균관대, 부교수	성균관대(박사)	계열회사 임원	1
김의송	남	1978.05	상무	상근	Mobile eXperience People팀 담당임원	People팀 Principal Professional	한동대(학사)	계열회사 임원	23
김인범	남	1973.05	상무	상근	영상디스플레이 개발1팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	46
김인철	남	1973.12	상무	상근	DS부문 커뮤니케이션팀 담당임원	DX부문 경영지원실 Principal Professional	고려대(석사)	계열회사 임원	35
김인형	남	1973.12	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI SOC개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
김재관	남	1976.01	상무	상근	아프리카총괄 지원팀장	SRA 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	34
김재성	남	1972.04	상무	상근	SEROM법인장	SEA 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	
김재진	남	1969.11	상무	상근	People팀 담당임원	인사팀 담당임원	항공대(학사)	계열회사 임원	
김재현	남	1977.07	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 Principal Engineer	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	23
김재홍	남	1973.03	상무	상근	Mobile eXperience 지원팀 담당임원	지원팀 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	
김재환	남	1969.07	상무	상근	법무실 IP센터 담당임원	법무실 IP센터 Principal Legal Counsel	The Ohio State Univ.(박사)	계열회사 임원	46
김재훈	남	1974.12	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Facebook, S/W Engineer	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	
김정민	여	1974.11	상무	상근	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀 담당임원	IBM, VP	한양대(석사)	계열회사 임원	12

김정수	남	1983.09	상무	상근	영상디스플레이 개발1팀 담당임원	Qualcomm, Principal	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	33
김종현	남	1972.12	상무	상근	중동총괄 담당임원	영상디스플레이 Enterprise Business팀 Principal Professional	세종대(학사)	계열회사 임원	34
김종현	남	1975.11	상무	상근	영상디스플레이 개발1팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	34
김종희	남	1974.01	상무	상근	AI플랫폼센터 담당임원	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	35
김주연	남	1974.12	상무	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	Foundry 기술개발실 Principal Engineer	한양대(박사)	계열회사 임원	46
김주영	남	1977.09	상무	상근	영상디스플레이 Global Outsourcing팀 담당임원	영상디스플레이 Service Business팀 담당임원	한양대(박사)	계열회사 임원	18
김준성	남	1975.08	상무	상근	DS부문 DSA 담당임원	Foundry Corporate Planning실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	46
김준연	남	1973.11	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 담당임원	CSS사업팀 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	30
김지용	남	1975.06	상무	상근	SETK법인장	SEA 담당임원	Syracuse Univ.(석사)	계열회사 임원	46
김지웅	남	1975.06	상무	상근	생활가전 CX팀 담당임원	생활가전 CX팀 Principal Professional	성균관대(석사)	계열회사 임원	11
김지은	여	1978.05	상무	상근	한국총괄 D2C팀 담당임원	한국총괄 D2C팀 Principal Professional	서강대(학사)	계열회사 임원	11
김지훈	남	1975.06	상무	상근	SENA법인장	SENA Principal Professional	서울대(학사)	계열회사 임원	23
김진교	남	1973.05	상무	상근	상생협력센터 담당임원	베트남복합단지 Principal Professional	경찰대(학사)	계열회사 임원	58
김진만	남	1978.09	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 개발실 Principal Engineer	동아대(석사)	계열회사 임원	23
김진묵	남	1977.11	상무	상근	Mobile eXperience Samsung Care+팀 담당임원	Bolttech, 대표이사	고려대(학사)	계열회사 임원	20
김진철	남	1976.11	상무	상근	SEVT 담당임원	Mobile eXperience People팀 Principal Professional	서울대(학사)	계열회사 임원	23
김진호	남	1977.01	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	46
김찬호	남	1975.06	상무	상근	SEVT 담당임원	SEIB 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(석사)	계열회사 임원	
김창수	남	1975.11	상무	상근	SME법인장	SENZ법인장	Univ. of Texas Arlington(석사)	계열회사 임원	23
김창용	남	1973.04	상무	상근	TSP총괄 Peole팀장	SAIT People팀장	고려대(석사)	계열회사 임원	58
김철민	남	1986.11	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 개발실 Principal Engineer	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	11
김철회	남	1977.04	상무	상근	영상디스플레이 CX센터 담당임원	영상디스플레이 CX팀 담당임원	연세대(학사)	계열회사 임원	23
김태경	남	1971.03	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 Flash TD팀 담당임원	DS부문 CTO 반도체연구소 Flash TD실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	41
김태균	남	1976.02	상무	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	RPI(박사)	계열회사 임원	58

김태영	남	1976.03	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	Foundry 기술개발실 담당임원	Kanazawa Univ.(박사)	계열회사 임원	35
김태정	남	1972.12	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당임원	충북대(학사)	계열회사 임원	
김태중	남	1971.05	상무	상근	Mobile eXperience 디자인팀 담당임원	Mobile eXperience CX실 담당임원	한양대(학사)	계열회사 임원	
김태훈	남	1973.01	상무	상근	영상디스플레이 구매팀 담당임원	상생협력센터 담당임원	단국대(학사)	계열회사 임원	
김포천	남	1976.07	상무	상근	생활가전 담당임원	생활가전 CX팀 Principal Engineer	전남대(학사)	계열회사 임원	11
김한조	남	1973.09	상무	상근	의료기기 지원팀장	SEA Principal Professional	Univ. of California, Irvine(석사)	계열회사 임원	34
김향희	여	1972.07	상무	상근	SEF 담당임원	SEROM법인장	고려대(학사)	계열회사 임원	58
김현근	남	1973.07	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	메모리 전략마케팅실 Principal Professional	경희대(학사)	계열회사 임원	58
김현기	남	1973.01	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당임원	광운대(학사)	계열회사 임원	46
김현덕	남	1981.06	상무	상근	AX/PI센터 담당임원	혁신센터 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(박사)	계열회사 임원	45
김현석	남	1976.10	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 Flash TD팀 담당임원	DS부문 CTO 반도체연구소 Flash TD실 담당임원	고려대(박사)	계열회사 임원	58
김현수	남	1970.09	상무	상근	SAIT 미래기술육성센터장	SR 기술전략팀 담당임원	성균관대(박사)	계열회사 임원	
김현종	남	1977.11	상무	상근	법무실 담당임원	법무실 Principal Legal Counsel	Columbia Univ.(석사)	계열회사 임원	
김형섭	남	1970.12	상무	상근	상생협력센터 담당임원	상생협력센터 Principal Professional	중앙대(학사)	계열회사 임원	
김형수	남	1975.03	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 메모리제조기술센터 Principal Engineer	서강대(석사)	계열회사 임원	23
김형옥	남	1979.04	상무	상근	Foundry Design Platform개발실 담당임원	Foundry Design Platform개발실 Principal Engineer	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	35
김형준	남	1972.05	상무	상근	Global CS센터 담당임원	생활가전 개발팀 담당임원	숭실대(석사)	계열회사 임원	58
김호균	남	1968.12	상무	상근	상생협력센터 담당임원	중남미총괄 대외협력팀장	연세대(석사)	계열회사 임원	
김효정	여	1981.11	상무	상근	영상디스플레이 Global운영팀장	영상디스플레이 Global운영팀 Principal Professional	숙명여대(학사)	계열회사 임원	11
김후성	남	1972.01	상무	상근	System LSI 품질팀장	System LSI Global Operation실 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
김희승	남	1970.09	상무	상근	중국삼성전략협력실 담당임원	System LSI People팀장	고려대(석사)	계열회사 임원	
김희열	남	1975.09	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 TP제조기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 TP센터 Principal Engineer	고려대(석사)	계열회사 임원	35
나원만	남	1975.06	상무	상근	SEM-P 담당임원	SEM-P Principal Professional	영남대(학사)	계열회사 임원	34
나현수	남	1971.06	상무	상근	지원팀 담당임원	중국총괄 지원팀장	인하대(학사)	계열회사 임원	
남경인	남	1973.03	상무	상근	경영혁신센터 담당임원	SELS법인장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
남덕우	남	1974.11	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당임원	동국대(학사)	계열회사 임원	35

남인호	남	1975.06	상무	상근	DS부문 구매팀 담당임원	DS부문 구매팀 Principal Professional	건국대(학사)	계열회사 임원	23
남태호	남	1969.03	상무	상근	DS부문 재경팀 담당임원	DS부문 경영지원실 담당임원	경북대(박사수료)	계열회사 임원	39
노대용	남	1978.02	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 메모리제조기술센터 Principal Professional	고려대(석사)	계열회사 임원	23
노미정	여	1971.04	상무	상근	Foundry 전략마케팅실 담당임원	DS부문 DSA 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
노수혁	남	1970.04	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 Global운영팀 담당임원	연세대(박사)	계열회사 임원	
노승남	남	1973.04	상무	상근	TSP총괄 지원팀장	사업지원T/F Principal Professional	연세대(석사)	계열회사 임원	
다니엘아라우조	남	1981.08	상무	상근	Mobile eXperience 전략기획팀 담당임원	사업지원T/F Principal Professional	Univ. Of Pennsylvania(석사)	계열회사 임원	46
드미트리	남	1972.07	상무	상근	SERC 담당임원	SERC VP	Moscow Institute of Physics and Technology(석사)	계열회사 임원	
류일곤	남	1968.07	상무	상근	Mobile eXperience 구미지원센터장	SEVT 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	
류철우	남	1975.04	상무	상근	SEF 담당임원	지원팀 Principal Professional	Duke Univ.(석사)	계열회사 임원	23
류호열	남	1977.03	상무	상근	생활가전 Global CS팀 담당임원	생활가전 Global CS팀 Principal Professional	한국과학기술원(박사수료)	계열회사 임원	23
류효겸	남	1980.10	상무	상근	Foundry Design Platform개발실 담당임원	Broadcom, Principal Engineer	Univ. of Michigan(박사)	계열회사 임원	
마띠유	남	1981.10	상무	상근	기획팀 담당임원	사업지원T/F Principal Professional	MIT(석사)	계열회사 임원	
명승일	남	1976.11	상무	상근	서남아총괄 지원팀장	지원팀 담당임원	Vanderbilt Univ.(석사)	계열회사 임원	34
모한	남	1973.07	상무	상근	SRI-Bangalore연구소장	SRI-Bangalore 담당임원	Acharya Nagarjuna Univ.(학사)	계열회사 임원	
목진호	남	1968.09	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	글로벌기술센터 담당임원	연세대(박사)	계열회사 임원	
문광진	남	1973.03	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 차세대공정개발팀 담당임원	DS부문 CTO 반도체연구소 차세대공정개발팀 Principal Engineer	건국대(학사)	계열회사 임원	23
문석진	남	1974.06	상무	상근	DS부문 DSC 담당임원	Foundry 지원팀 담당임원	계명대(학사)	계열회사 임원	35
문성만	남	1976.07	상무	상근	기획팀 담당임원	Siemens Health, Power Archi	Univ. of Utah(박사)	계열회사 임원	19
문성수	남	1979.02	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 Principal Engineer	서울대(박사)	계열회사 임원	11
문원민	남	1980.12	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 Principal Engineer	명지대(학사)	계열회사 임원	11
문종기	남	1975.10	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	Bell Textron, Staff Engineer	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	18
문준기	남	1975.02	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	SEA 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	34
문진옥	남	1971.12	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	한양대(박사)	계열회사 임원	
문태호	남	1974.11	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 TP제조기술센터 담당임원	TSP총괄 품질팀장	동아대(학사)	계열회사 임원	35

문태화	남	1975.01	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 개발실 Principal Engineer	경희대(학사)	계열회사 임원	23
문희철	남	1977.03	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 개발실 Principal Engineer	동국대(학사)	계열회사 임원	11
민경일	남	1978.08	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 Principal Engineer	연세대(박사)	계열회사 임원	11
박건호	남	1976.07	상무	상근	중국총괄 지원팀장	생활가전 지원팀 Principal Professional	서강대(학사)	계열회사 임원	11
박기루	남	1987.02	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	Amazon, Sr.Scientist	Vienna Univ. of Technology(박사)	계열회사 임원	8
박대순	남	1980.07	상무	상근	Global Public Affairs실 담당임원	Global Public Affairs실 Principal Professional	서울대(석사)	계열회사 임원	11
박명훈	남	1975.09	상무	상근	SEDA-P(M) 담당임원	생활가전 지원팀 Principal Professional	성균관대(학사)	계열회사 임원	23
박민규	남	1976.09	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 Principal Engineer	연세대(박사)	계열회사 임원	
박병수	남	1972.12	상무	상근	한국총괄 B2B유통전략팀장	한국총괄 B2B팀 담당임원	한양대(학사)	계열회사 임원	46
박봉태	남	1974.10	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	SCS 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
박상교	남	1972.03	상무	상근	Compliance팀 담당임원	중국삼성전략협력실 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	
박상도	남	1973.12	상무	상근	People팀 담당임원	북미총괄 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	
박상영	남	1976.01	상무	상근	유럽총괄 People팀장	Mobile eXperience People팀 담당임원	아주대(석사)	계열회사 임원	34
박상욱	남	1975.10	상무	상근	SIEL-S 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 Principal Professional	경북대(석사)	계열회사 임원	23
박상욱	남	1978.05	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 차세대공정개발팀 담당임원	DS부문 CTO 반도체연구소 차세대공정개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	35
박상훈	남	1969.09	상무	상근	Mobile eXperience 지원팀 담당임원	법무실 담당임원	Syracuse Univ.(석사)	계열회사 임원	
박상훈	남	1978.02	상무	상근	Foundry Design Platform개발실 담당임원	Foundry Design Platform개발실 Principal Engineer	포항공대(박사)	계열회사 임원	58
박성범	남	1984.10	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI SOC개발실 Principal Engineer	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	58
박성열	남	1978.04	상무	상근	DS부문 People팀 담당임원	DS부문 People팀 Principal Professional	중앙대(학사)	계열회사 임원	11
박성우	남	1976.04	상무	상근	커뮤니케이션실 담당임원	커뮤니케이션팀 담당임원	Univ. Of Chicago(석사)	계열회사 임원	34
박승일	남	1976.01	상무	상근	AI플랫폼센터 담당임원	글로벌마케팅실 D2C센터 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	23
박영민	남	1975.12	상무	상근	SCIC 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	Emory Univ.(석사)	계열회사 임원	34
박영재	남	1977.10	상무	상근	한국총괄 CE팀 담당임원	한국총괄 CE팀 Principal Professional	아주대(학사)	계열회사 임원	11
박영진	남	1974.10	상무	상근	SECE법인장	CIS총괄 Principal Professional	한양대(학사)	계열회사 임원	12
박은중	남	1976.05	상무	상근	생활가전 지원팀 담당임원	SEA 담당임원	Univ. of North Carolina, Chapel Hill(석사)	계열회사 임원	34
박일한	남	1976.10	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 Principal Engineer	서울대(박사)	계열회사 임원	23

박장용	남	1979.01	상무	상근	법무실 담당임원	법무실 Principal Legal Counsel	서울대(학사)	계열회사 임원	
박재범	남	1977.08	상무	상근	메모리 People팀장	DS부문 People팀 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	58
박재식	남	1976.08	상무	상근	생활가전 Global운영팀 담당임원	생활가전 구매팀 담당임원	경희대(학사)	계열회사 임원	46
박재우	남	1978.02	상무	상근	SEAU 담당임원	서남아총괄 Principal Professional	고려대(학사)	계열회사 임원	11
박재헌	남	1975.06	상무	상근	DS부문 법무팀장	DS부문 법무지원팀 담당임원	서울대(학사)	계열회사 임원	23
박재현	남	1970.07	상무	상근	글로벌브랜드센터 담당임원	글로벌마케팅실 담당임원	한양대(석사)	계열회사 임원	
박정대	남	1976.12	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 인프라품질분석팀장	포항공대(박사)	계열회사 임원	
박정일	남	1976.08	상무	상근	한국총괄 MX팀 담당임원	한국총괄 B2C유통전략팀 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	23
박정재	남	1974.01	상무	상근	Compliance팀 담당임원	재경팀 담당임원	Univ. of Texas, Austin(석사)	계열회사 임원	
박제임스	남	1973.06	상무	상근	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀 담당임원	무선 Global Mobile B2B팀 Principal Professional	California Polytechnic State Univ.(학사)	계열회사 임원	
박종만	남	1971.11	상무	상근	AI플랫폼센터 담당임원	디바이스플랫폼센터 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	58
박종민	남	1968.08	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	Western Digital, Director	한국과학기술원(학사)	계열회사 임원	33
박종우	남	1972.02	상무	상근	한국총괄 B2B팀 담당임원	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	서울시립대(학사)	계열회사 임원	58
박종진	남	1982.02	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	Amazon Lab126, Pr.Scientist	Univ. of Michigan(박사)	계열회사 임원	17
박준성	남	1976.08	상무	상근	DS부문 기획팀 담당임원	DS부문 기획팀 Principal Professional	중앙대(학사)	계열회사 임원	11
박준영	남	1974.10	상무	상근	SEA 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	Univ. of Paris 11(석사)	계열회사 임원	
박준호	남	1972.05	상무	상근	CX센터 담당임원	글로벌마케팅실 CX센터 담당임원	한양대(학사)	계열회사 임원	
박진표	남	1972.11	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	DS부문 DSA 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
박찬형	남	1973.06	상무	상근	SEDA-S 담당임원	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	City Univ. of New York(석사)	계열회사 임원	46
박창서	남	1980.06	상무	상근	S.LSI사업부 S/W혁신팀장	AI센터 담당임원	Univ. of California, Berkeley(박사)	계열회사 임원	
박철범	남	1966.03	상무	상근	상생협력센터 담당임원	상생협력센터 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	
박철웅	남	1973.01	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience CX실 담당임원	연세대(학사)	계열회사 임원	58
박충신	남	1973.09	상무	상근	People팀 담당임원	의료기기 People팀장	경북대(석사)	계열회사 임원	
박태호	남	1969.03	상무	상근	경영혁신센터 담당임원	SEAG법인장	Univ. of Pittsburgh(석사)	계열회사 임원	
박태훈	남	1974.11	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	58
박현근	남	1973.01	상무	상근	Foundry 기획팀장	DS부문 기획팀 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
박현준	남	1978.01	상무	상근	People팀 담당임원	구주총괄 People팀장	한국외국어대(학사)	계열회사 임원	46
박형규	남	1976.05	상무	상근	SEA 담당임원	영상디스플레이 Enterprise Business팀 Principal Professional	고려대(학사)	계열회사 임원	11
박형민	남	1977.03	상무	상근	생활가전 CX팀장	한국총괄 MX팀 담당임원	서울대(학사)	계열회사 임원	

박형신	여	1977.02	상무	상근	Mobile eXperience 디자인팀 담당임원	Mobile eXperience CX실 담당임원	제주대(학사)	계열회사 임원	34
박혜린	여	1975.02	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅실 Principal Professional	서울대(석사)	계열회사 임원	23
박호우	남	1971.03	상무	상근	System LSI Sensor사업팀 담당임원	제조담당 Foundry제조기술센터 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	58
박환홍	남	1973.10	상무	상근	지원팀 담당임원	Mobile eXperience 지원팀 Principal Professional	연세대(석사)	계열회사 임원	34
반수형	남	1972.06	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	생활가전 개발팀 담당임원	아주대(학사)	계열회사 임원	46
반일승	남	1974.11	상무	상근	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	SEJ Principal Professional	경희대(학사)	계열회사 임원	
방지훈	남	1973.11	상무	상근	S.LSI AX/PI팀장	System LSI SOC사업팀 담당임원	Carnegie Mellon Univ.(석사)	계열회사 임원	
배범희	남	1985.09	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	생산기술연구소 Principal Engineer	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	46
배윤수	남	1974.12	상무	상근	재경팀 담당임원	기획팀 Principal Professional	Harvard Univ.(석사)	계열회사 임원	34
백상훈	남	1976.01	상무	상근	Foundry Design Platform개발실 담당임원	Foundry Design Platform개발실 Principal Engineer	성균관대(석사)	계열회사 임원	23
백승엽	남	1978.03	상무	상근	메모리 지원팀 담당임원	DS부문 지원팀 Pricipal Professional	부산대(학사)	계열회사 임원	11
백아론	남	1979.10	상무	상근	RX사업추진실 담당임원	Samsung Research Robot센터 담당임원	Stanford Univ.(석사)	계열회사 임원	58
백피터	남	1971.06	상무	상근	DS부문 IP팀 담당임원	법무실 IP센터 Principal Legal Counsel	Univ. of Minnesota, Minneapolis(석사)	계열회사 임원	
백혜성	여	1980.02	상무	상근	생활가전 HVAC사업팀 담당임원	생활가전 Air Solution사업팀 담당임원	연세대(학사)	계열회사 임원	34
변준호	남	1972.07	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	Southern Illinois Univ.(박사)	계열회사 임원	
서경헌	남	1970.05	상무	상근	People팀 담당임원	인사팀 담당임원	광운대(학사)	계열회사 임원	58
서무현	남	1975.07	상무	상근	DS부문 DSJ 담당임원	DS부문 DSJ Principal Professional	성균관대(학사)	계열회사 임원	11
서성기	남	1972.12	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	건국대(학사)	계열회사 임원	
서재홍	남	1974.03	상무	상근	영상디스플레이 Global CS팀 담당임원	영상디스플레이 Global CS팀 Principal Professional	아주대(석사)	계열회사 임원	23
서정혁	남	1972.07	상무	상근	Samsung Research People팀장	네트워크 인사팀장	건국대(학사)	계열회사 임원	58
서정현	남	1974.04	상무	상근	SAIT 기획지원팀장	SCS 담당임원	Univ. of Wisconsin, Madison(석사)	계열회사 임원	
서창우	남	1974.06	상무	상근	영상디스플레이 Display Solution사업팀 담당임원	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원	Manchester(석사)	계열회사 임원	46
서현석	남	1974.06	상무	상근	Samsung Research 기술전략팀 담당임원	경영진단팀 담당임원	Univ. of California, Berkeley(석사)	계열회사 임원	34
석지원	여	1980.06	상무	상근	Mobile eXperience 모바일 마케팅센터 담당임원	Mobile eXperience 마케팅팀 담당임원	서강대(학사)	계열회사 임원	23
선동석	남	1974.04	상무	상근	AX/PI센터 담당임원	혁신센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
선종우	남	1974.06	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실 공정혁신팀장	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실 담당임원	고려대(박사)	계열회사 임원	35

성낙희	남	1973.03	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI SOC개발실 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	
성백민	남	1971.05	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 인프라기술센터 Principal Engineer	한양공고(고교)	계열회사 임원	58
성종훈	남	1978.11	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 Principal Engineer	고려대(석사)	계열회사 임원	23
성훈제	남	1972.10	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 Principal Engineer	고려대(학사)	계열회사 임원	11
성희연	여	1974.03	상무	상근	CX센터 담당임원	글로벌마케팅실 D2C센터 담당임원	Stanford Univ.(석사)	계열회사 임원	17
소재민	남	1983.04	상무	상근	영상디스플레이 개발2팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	58
손석제	남	1973.08	상무	상근	경영혁신센터 담당임원	Nike, Director	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	29
손석준	남	1974.07	상무	상근	SEM-P법인장	생활가전 Global제조팀 담당임원	전남대(석사)	계열회사 임원	
손성민	남	1973.06	상무	상근	Mobile eXperience Global운영팀장	Mobile eXperience Global운영팀 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	58
손영아	여	1973.05	상무	상근	지원팀 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	46
손왕익	남	1984.03	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 개발실 Principal Engineer	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	34
손용훈	남	1973.03	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실 담당임원	반도체연구소 메모리 TD실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	58
손준호	남	1976.08	상무	상근	동남아총괄 지원팀장	Mobile eXperience 지원팀 담당임원	Emory Univ.(석사)	계열회사 임원	46
손현석	남	1976.03	상무	상근	SAMEX법인장	SEH-P법인장	홍익대(학사)	계열회사 임원	46
손호민	남	1969.02	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 Common Tech센터 담당임원	한양대(석사)	계열회사 임원	
송기재	남	1970.04	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 TP제조기술센터 담당임원	TSP총괄 TP센터 담당임원	광운대(박사)	계열회사 임원	
송문경	여	1977.08	상무	상근	Mobile eXperience 모바일 마케팅센터 담당임원	글로벌마케팅실 D2C센터 담당임원	한동대(학사)	계열회사 임원	34
송보영	여	1976.10	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	포항공대(석사)	계열회사 임원	46
송상철	남	1973.09	상무	상근	영상디스플레이 Service Business팀 담당임원	Big Data센터장	Univ. of Maryland, College Park(박사)	계열회사 임원	
송승호	남	1981.10	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	Mobile eXperience CX실 Principal Professional	Univ. of California, Berkeley(석사)	계열회사 임원	23
송영근	남	1970.01	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	Intel, Principal Engineer	건국대(학사)	계열회사 임원	45
송원철	남	1976.01	상무	상근	영상디스플레이 지원팀 담당임원	SAMEX 담당임원	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	46
송윤종	남	1971.10	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 차세대연구팀 담당임원	DS부문 CTO 반도체연구소 차세대연구실 담당임원	Virginia Tech(박사)	계열회사 임원	
송정우	남	1977.12	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 DRAM TD팀 담당임원	메모리 DRAM개발실 담당임원	State Univ. of New York, Buffalo(박사)	계열회사 임원	46
송정은	여	1976.12	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	Mobile eXperience 마케팅팀 Principal Professional	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	23

송태중	남	1971.04	상무	상근	Foundry 전략마케팅실 담당임원	Foundry Corporate Planning실 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	
송택상	남	1978.03	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	Rambus, Technical Director	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	32
송호영	남	1972.12	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 Principal Engineer	서울대(박사)	계열회사 임원	
쉐인학비	남	1972.05	상무	상근	SEA 담당임원	SEA VP	Fairleigh Dickinson Univ.(석사)	계열회사 임원	
시티촉	남	1972.11	상무	상근	TSE-S 담당임원	TSE-S VP	Georgia State Univ.(석사)	계열회사 임원	23
신규범	남	1972.06	상무	상근	Mobile eXperience 품질혁신센터 담당임원	무선 Global CS팀 Principal Professional	부산대(학사)	계열회사 임원	
신대중	남	1971.11	상무	상근	SEDA-P(M)법인장	Mobile eXperience Global제조센터 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	
신무섭	남	1976.01	상무	상근	Mobile eXperience Global제조센터 담당임원	SEV Principal Professional	경희사이버대(학사)	계열회사 임원	23
신문선	남	1975.04	상무	상근	생활가전 HVAC사업팀 담당임원	생활가전 Air Solution사업팀 담당임원	한국해양대(학사)	계열회사 임원	46
신병무	남	1970.08	상무	상근	SEEG-S법인장	SEGR법인장	연세대(학사)	계열회사 임원	34
신상용	남	1973.05	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 평택단지 담당임원	홍익대(학사)	계열회사 임원	46
신승주	남	1972.04	상무	상근	SELA법인장	SEASA법인장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
신용우	남	1974.12	상무	상근	메모리 기획팀 담당임원	DS부문 기획팀 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	58
신원화	남	1976.11	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 Principal Engineer	성균관대(박사)	계열회사 임원	46
신의창	남	1971.05	상무	상근	생활가전 People팀장	People팀 담당임원	한국외국어대(학사)	계열회사 임원	43
신인철	남	1974.06	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 People팀장	TSP총괄 People팀장	고려대(석사)	계열회사 임원	
신재영	남	1974.07	상무	상근	SECA법인장	Mobile eXperience 전략마케팅실 Principal Professional	한양대(학사)	계열회사 임원	23
심근섭	남	1983.08	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	D.E Shaw Research, Engineer	MIT(박사)	계열회사 임원	14
심우철	남	1982.06	상무	상근	SRPOL연구소장	Samsung Research Security & Privacy팀 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	58
심재혁	남	1978.04	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 EHS센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	서강대(학사)	계열회사 임원	48
심재황	남	1975.08	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	DS부문 CTO 반도체연구소 Flash TD실 Principal Engineer	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	23
심호준	남	1977.12	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	DS부문 상품기획실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
심황윤	남	1971.01	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 Principal Engineer	연세대(석사)	계열회사 임원	58
아라이	남	1968.08	상무	상근	DS부문 DSJ총괄	DS부문 일본총괄 VP	한국외국어대(학사)	계열회사 임원	
안대현	남	1972.02	상무	상근	한국총괄 B2C유통전략팀장	한국총괄 B2C유통전략팀 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	
안덕민	남	1974.05	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 메모리제조기술센터 Principal Engineer	성균관대(석사)	계열회사 임원	23
안성준	남	1975.01	상무	상근	AX/PI센터 담당임원	System LSI S/W Architecture팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	

안성호	남	1976.04	상무	상근	SEHA법인장	생활가전 Global제조팀 Principal Professional	인하대(학사)	계열회사 임원	11
안신헌	남	1972.09	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	한양대(학사)	계열회사 임원	58
안영모	남	1973.10	상무	상근	상생협력센터 담당임원	상생협력센터 Principal Professional	경북대(학사)	계열회사 임원	34
안용석	남	1974.11	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 DRAM TD팀 담당임원	DS부문 CTO 반도체연구소 DRAM TD실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	46
안재상	남	1976.08	상무	상근	DS부문 구매팀 담당임원	DS부문 구매팀 Principal Professional	서울대(석사)	계열회사 임원	11
안재용	남	1977.02	상무	상근	AX/PI센터장	AX팀장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	46
안정식	남	1975.10	상무	상근	Global CS센터 담당임원	Global CS센터 Principal Professional	중앙대(학사)	계열회사 임원	11
안주원	여	1977.03	상무	상근	하만협력팀 담당임원	생활가전 기획팀 담당임원	서강대(학사)	계열회사 임원	46
안치용	남	1975.12	상무	상근	메모리 품질실 담당임원	메모리 품질실 Principal Engineer	성균관대(학사)	계열회사 임원	46
안희영	여	1976.12	상무	상근	영상디스플레이 Service Business팀 담당임원	영상디스플레이 Service Business팀 Principal Professional	연세대(석사)	계열회사 임원	46
양시준	남	1974.01	상무	상근	중남미총괄 지원팀장	네트워크 지원팀 담당임원	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	
양종훈	남	1974.05	상무	상근	DS부문 구매팀 담당임원	TSP총괄 구매팀장	서울대(석사)	계열회사 임원	46
양준원	남	1976.03	상무	상근	SET법인장	중국총괄 Principal Professional	National Taiwan Univ.(석사)	계열회사 임원	11
양진기	남	1971.05	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	SRA 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
양진호	남	1976.03	상무	상근	Mobile eXperience 서비스 Biz팀 담당임원	Tencent, Sr.Director	Tsinghua Univ.(석사)	계열회사 임원	5
양택진	남	1971.08	상무	상근	Samsung Research 기술전략팀 담당임원	Samsung Research 기술전략팀 Principal Professional	연세대(학사)	계열회사 임원	
양희철	남	1975.07	상무	상근	Mobile eXperience UX팀장	Mobile eXperience CX실 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	
엄윤성	남	1979.04	상무	상근	SEA 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅실 Principal Professional	한동대(학사)	계열회사 임원	11
엄훈섭	남	1975.06	상무	상근	Mobile eXperience 구매팀 담당임원	SEV 담당임원	항공대(학사)	계열회사 임원	23
연지현	여	1974.10	상무	상근	System LSI 영업팀 담당임원	System LSI 전략마케팅실 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	58
염강수	남	1972.08	상무	상근	커뮤니케이션실 담당임원	커뮤니케이션팀 담당임원	서울대(학사)	계열회사 임원	
염부호	남	1972.04	상무	상근	D2C센터 담당임원	글로벌마케팅실 D2C센터 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	58
염종범	남	1977.06	상무	상근	DS부문 People팀 담당임원	Mobile eXperience People팀 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	46
예장희	남	1975.12	상무	상근	SECH법인장	생활가전 전략마케팅팀 Principal Professional	성균관대(학사)	계열회사 임원	23
오동윤	남	1975.12	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	Sony, Director	서울대(학사)	계열회사 임원	6
오상진	남	1977.11	상무	상근	DS부문 DSA 담당임원	DS부문 지원팀 담당임원	MIT(석사)	계열회사 임원	58

오석민	여	1974.07	상무	상근	Mobile eXperience UX팀 담당임원	Mobile eXperience CX실 담당임원	New York Univ.(석사)	계열회사 임원	
오성혁	남	1971.09	상무	상근	Mobile eXperience Samsung Care+팀 담당임원	삼성화재, 일반보험전략팀장	고려대(학사)	계열회사 임원	22
오영기	남	1973.01	상무	상근	인재개발원 담당임원	인재개발원 Principal Professional	충남대(학사)	계열회사 임원	46
오용찬	남	1972.10	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	SIEL-S 담당임원	홍익대(학사)	계열회사 임원	46
오정환	남	1973.12	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실 담당임원	반도체연구소 공정개발실 Principal Engineer	연세대(석사)	계열회사 임원	46
오준영	남	1969.02	상무	상근	메모리 PKG개발팀 담당임원	TSP총괄 C.PKG개발팀 담당임원	The Ohio State Univ.(박사)	계열회사 임원	
오창호	남	1971.03	상무	상근	Mobile eXperience 구매팀 담당임원	SEV 담당임원	동아대(학사)	계열회사 임원	
오혁상	남	1969.06	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 S.PKG제조기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 TP제조기술센터 담당임원	부산대(석사)	계열회사 임원	
옥신우	남	1978.05	상무	상근	지원팀 담당임원	Mobile eXperience 지원팀 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	23
올라프	남	1971.01	상무	상근	SEG 담당임원	SEG VP	Johannes Gutenberg Univ.(석사)	계열회사 임원	58
왕지연	여	1977.09	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	Mobile eXperience CX실 Principal Designer	홍익대(학사)	계열회사 임원	46
우람찬	남	1978.01	상무	상근	System LSI 기획팀장	System LSI 기획팀 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	29
우성훈	남	1977.02	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 Principal Engineer	고려대(석사)	계열회사 임원	11
우수영	남	1979.09	상무	상근	System LSI LSI사업팀 담당임원	System LSI LSI사업팀 Principal Engineer	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	11
우준명	남	1980.12	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 Principal Engineer	서울대(박사)	계열회사 임원	35
우현수	남	1973.09	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	연세대(학사)	계열회사 임원	35
우형동	남	1970.09	상무	상근	DS부문 상생협력센터 담당임원	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	
원석준	남	1970.02	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 Common Tech센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
원찬식	남	1975.12	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	글로벌기술센터 Principal Engineer	서강대(박사)	계열회사 임원	58
유금현	남	1976.12	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 S.PKG제조기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 S.PKG제조기술센터 Principal Engineer	충북대(학사)	계열회사 임원	11
유기훈	남	1980.07	상무	상근	동남아총괄 People팀장	사업지원T/F Principal Professional	연세대(학사)	계열회사 임원	11
유미경	여	1974.05	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	

유상현	남	1980.02	상무	상근	영상디스플레이 지원팀 담당임원	사업지원T/F Principal Professional	MIT(석사)	계열회사 임원	11
유성종	남	1976.03	상무	상근	System LSI LSI사업팀 담당임원	System LSI LSI개발실 Principal Engineer	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	46
유성호	남	1973.02	상무	상근	사업지원실 담당임원	사업지원T/F 담당임원	Stanford Univ.(석사)	계열회사 임원	58
유송	남	1975.05	상무	상근	SEA 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	연세대(학사)	계열회사 임원	58
유호인	남	1979.02	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 Principal Engineer	서울대(석사)	계열회사 임원	11
유화열	남	1971.11	상무	상근	System LSI LSI사업팀 담당임원	System LSI LSI개발실 Principal Engineer	인하대(석사)	계열회사 임원	
윤가람	여	1983.08	상무	상근	Samsung Research Visual Technology팀 담당임원	Meta, Manager	Univ. of Arizona(박사)	계열회사 임원	52
윤기영	남	1974.11	상무	상근	SEPOL법인장	SEBN법인장	한양대(학사)	계열회사 임원	34
윤남호	남	1968.12	상무	상근	한국총괄 B2C유통전략팀 담당임원	한국총괄 MX팀 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(석사)	계열회사 임원	
윤보영	여	1977.08	상무	상근	네트워크 Cloud Solution사업팀장	네트워크 개발팀 담당임원	이화여대(석사)	계열회사 임원	58
윤상용	남	1976.07	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 Principal Engineer	서울대(석사)	계열회사 임원	35
윤석호	남	1972.07	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 담당임원	CSS사업팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
윤석호	남	1973.04	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	한국기계연구원, 열에너지솔루션실장	서울대(박사)	계열회사 임원	45
윤성욱	남	1974.06	상무	상근	People팀 담당임원	유럽총괄 담당임원	연세대(학사)	계열회사 임원	58
윤성현	남	1973.05	상무	상근	SIEL-P(C)법인장	SIEL-P(C)공장장	부산대(학사)	계열회사 임원	34
윤성호	남	1974.01	상무	상근	생활가전 선행개발팀 담당임원	GE, Staff Engineer	Cambridge Univ.(박사)	계열회사 임원	45
윤성환	남	1972.04	상무	상근	법무실 IP센터 담당임원	법무실 IP센터 Principal Engineer	State Univ. of New York, Buffalo(석사)	계열회사 임원	46
윤송호	남	1974.10	상무	상근	DS부문 DSC 담당임원	메모리 Solution개발실 담당임원	광운대(학사)	계열회사 임원	58
윤승국	남	1977.10	상무	상근	RX사업추진실 담당임원	Cruise, Staff S/W Engineer	MIT(박사)	계열회사 임원	20
윤원재	남	1975.08	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 Principal Engineer	고려대(박사)	계열회사 임원	23
윤원주	남	1978.01	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 Principal Engineer	고려대(박사)	계열회사 임원	35
윤찬현	남	1971.10	상무	상근	Mobile eXperience 구매팀 담당임원	무선 구매팀 Principal Professional	영남대(학사)	계열회사 임원	
윤창빈	남	1977.06	상무	상근	메모리 품질실 담당임원	메모리 품질실 Principal Engineer	인하대(학사)	계열회사 임원	23
윤철웅	남	1970.07	상무	상근	SEUK법인장	SELV법인장	인하대(학사)	계열회사 임원	
윤호용	남	1969.12	상무	상근	SEM-S법인장	SEM-S 담당임원	Drexel Univ.(석사)	계열회사 임원	
은성민	남	1977.01	상무	상근	Foundry 지원팀 담당임원	DS부문 DSA 담당임원	Wake Forest Univ.(석사)	계열회사 임원	46
은형래	남	1974.06	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 Principal Engineer	고려대(석사)	계열회사 임원	23
이강규	남	1972.09	상무	상근	DS부문 기획팀 담당임원	사업지원실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	12
이강승	남	1977.07	상무	상근	System LSI Global운영팀장	System LSI Global운영팀 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	

이강욱	남	1986.05	상무	상근	DX부문 CTO 담당임원	Samsung Research AI센터 Principal Engineer	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	11
이경우	남	1977.07	상무	상근	메모리 품질실 담당임원	메모리 품질실 Principal Engineer	서울대(박사)	계열회사 임원	23
이경준	남	1976.06	상무	상근	한국총괄 MX팀 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	
이경호	남	1975.10	상무	상근	System LSI Sensor사업팀 담당임원	System LSI Sensor사업팀 Principal Engineer	포항공대(박사)	계열회사 임원	58
이계훈	남	1980.02	상무	상근	영상디스플레이 개발1팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 담당임원	서울대(학사)	계열회사 임원	58
이광열	남	1974.11	상무	상근	지원팀 담당임원	아프리카총괄 지원팀장	Emory Univ.(석사)	계열회사 임원	58
이광우	남	1977.07	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 Principal Engineer	포항공대(석사)	계열회사 임원	11
이광재	남	1974.03	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	생산기술연구소 Principal Engineer	Univ. of Michigan, Ann Arbor(박사)	계열회사 임원	34
이규원	남	1974.03	상무	상근	DS부문 DSJ 담당임원	DS부문 일본총괄 Principal Professional	Waseda Univ.(석사)	계열회사 임원	
이규철	남	1973.06	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	생산기술연구소 Principal Engineer	서울산업대(학사)	계열회사 임원	34
이근석	남	1975.10	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 Principal Engineer	성균관대(박사)	계열회사 임원	11
이근수	남	1970.12	상무	상근	상생협력센터 담당임원	상생협력센터 Principal Professional	세종대(학사)	계열회사 임원	
이기욱	남	1970.08	상무	상근	생활가전 Global CS팀 담당임원	Mobile eXperience 개발실 담당임원	동아대(학사)	계열회사 임원	
이기철	남	1972.11	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 선행개발팀 담당임원	고려대(박사)	계열회사 임원	
이남호	남	1972.02	상무	상근	DS부문 경영혁신팀장	AI센터 담당임원	성균관대(박사)	계열회사 임원	
이대준	남	1978.04	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	Google, Staff Data Scientist	Univ. of Chicago(석사)	계열회사 임원	9
이동진	남	1971.01	상무	상근	SEH-P법인장	영상디스플레이 Global제조팀 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	
이동하	남	1968.07	상무	상근	AX/PI센터 담당임원	혁신센터 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	
이동환	남	1980.02	상무	상근	DS부문 지원팀 담당임원	사업지원실 Principal Professional	Columbia Univ.(석사)	계열회사 임원	11
이두환	남	1976.12	상무	상근	Global CS센터 담당임원	Global CS센터 Principal Professional	동국대(학사)	계열회사 임원	23
이두희	남	1973.11	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	SGE법인장	단국대(석사)	계열회사 임원	46
이명재	남	1979.01	상무	상근	법무실 담당임원	법무실 Principal Legal Counsel	HEC Paris(석사)	계열회사 임원	34
이명준	남	1976.07	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 차세대공정개발팀 담당임원	DS부문 CTO 반도체연구소 차세대공정개발실 담당임원	Univ. of Arizona(박사)	계열회사 임원	35
이문근	남	1976.08	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 Principal Engineer	고려대(학사)	계열회사 임원	23
이병국	남	1977.02	상무	상근	Mobile eXperience People팀 담당임원	People팀 Principal Professional	연세대(학사)	계열회사 임원	23

이병일	남	1983.07	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 Principal Engineer	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	46
이병진	남	1970.09	상무	상근	DS부문 해외법무팀장	DS부문 법무지원팀 담당임원	Univ. Of Wisconsin, Madison(석사)	계열회사 임원	
이병철	남	1972.11	상무	상근	기획팀 창의개발센터장	의료기기 People팀장	성균관대(석사)	계열회사 임원	58
이병한	남	1974.05	상무	상근	재경팀 담당임원	재경팀 Principal Professional	Univ. Of Wisconsin, Madison(학사)	계열회사 임원	46
이병헌	남	1974.11	상무	상근	기획팀 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	Manchester Business School(석사)	계열회사 임원	58
이보나	여	1973.02	상무	상근	생활가전 CX팀 담당임원	생활가전 MDE전략팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	58
이상빈	남	1979.02	상무	상근	생활가전 Global제조팀 담당임원	생활가전 Global제조팀 Principal Professional	한양대(석사)	계열회사 임원	23
이상석	남	1976.10	상무	상근	경영진단팀 담당임원	경영진단팀 Principal Professional	성균관대(석사)	계열회사 임원	11
이상수	남	1975.06	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	무선 개발실 Principal Engineer	아주대(석사)	계열회사 임원	
이상엽	남	1977.06	상무	상근	SRA 담당임원	Mobile eXperience 지원팀 Principal Professional	성균관대(학사)	계열회사 임원	11
이상엽	남	1967.11	상무	상근	상생협력센터 담당임원	삼성물산, 상생협력팀 담당부장	서울대(학사)	계열회사 임원	46
이상욱	남	1972.08	상무	상근	Mobile eXperience 품질혁신센터 담당임원	Mobile eXperience 개발실 담당임원	금오공대(학사)	계열회사 임원	
이상육	남	1971.01	상무	상근	Mobile eXperience 품질혁신센터 담당임원	무선 제품기술팀 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	
이상인	남	1984.02	상무	상근	Samsung Research 담당임원	TikTok, Design Lead	School of Visual Arts(학사)	계열회사 임원	17
이상천	남	1977.10	상무	상근	네트워크 Global Technology Engineering팀 담당임원	네트워크 Global Technology Engineering팀 Principal Engineer	고려대(석사)	계열회사 임원	11
이상희	남	1974.09	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 Mask개발팀장	반도체연구소 Mask개발팀 Principal Engineer	서울대(박사)	계열회사 임원	58
이석림	남	1974.03	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	SEAS법인장	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	58
이선교	남	1976.01	상무	상근	SIEL-P(N) 담당임원	Mobile eXperience 지원팀 Principal Professional	한양대(학사)	계열회사 임원	23
이선웅	남	1976.12	상무	상근	SERC 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	서강대(학사)	계열회사 임원	34
이선일	남	1978.02	상무	상근	SRUK연구소장	Samsung Research Visual Technology팀 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	23
이선화	여	1975.08	상무	상근	CX센터 담당임원	글로벌마케팅실 CX센터 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	58
이성기	남	1983.05	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Apple, Sr.Engineering Manager	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(박사)	계열회사 임원	9
이성심	여	1977.10	상무	상근	기획팀 담당임원	기획팀 Principal Professional	서울대(석사)	계열회사 임원	11
이성원	남	1976.03	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	Samsung Research 차세대통신연구센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
이성준	남	1981.10	상무	상근	Foundry 전략마케팅실 담당임원	Foundry Corporate Planning실 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(학사)	계열회사 임원	36

이성훈	남	1975.11	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 Flash TD팀 담당임원	DS부문 CTO 반도체연구소 Flash TD실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	46
이세문	남	1979.12	상무	상근	Samsung Research Platform팀장	Samsung Research Platform팀 Principal Engineer	서울대(석사)	계열회사 임원	11
이승목	남	1973.09	상무	상근	한국총괄 People팀장	SAIT People팀장	고려대(학사)	계열회사 임원	
이승민	남	1981.03	상무	상근	Mobile eXperience UX팀 담당임원	Mobile eXperience CX실 담당임원	MIT(석사)	계열회사 임원	36
이승연	여	1975.11	상무	상근	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀 담당임원	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀 Principal Engineer	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	11
이승윤	남	1978.07	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 개발실 Principal Engineer	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	11
이승준	남	1974.04	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 Flash TD팀 담당임원	DS부문 CTO 반도체연구소 Flash TD실 담당임원	한양대(석사)	계열회사 임원	46
이승철	남	1977.11	상무	상근	CSS사업팀 담당임원	DS부문 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	39
이승환	남	1980.07	상무	상근	네트워크 Global Technology Engineering팀 담당임원	네트워크 시스템솔루션팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	34
이승환	남	1971.05	상무	상근	CSS사업팀 담당임원	LED사업팀 Principal Engineer	고려대(석사)	계열회사 임원	58
이승훈	남	1976.03	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 차세대공정개발팀 담당임원	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	46
이신재	남	1972.11	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 Principal Engineer	인하대(학사)	계열회사 임원	
이영아	여	1983.03	상무	상근	생활가전 UX팀장	영상디스플레이 UX팀 Principal Designer	Carnegie Mellon Univ.(학사)	계열회사 임원	34
이영학	남	1974.09	상무	상근	AX/PI센터 담당임원	혁신센터 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	46
이용훈	남	1974.04	상무	상근	영상디스플레이 Display Solution사업팀 담당임원	Walmart, VP	Columbia Univ.(석사)	계열회사 임원	10
이우용	남	1975.10	상무	상근	지원팀 담당임원	SEDA-P(M) 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	46
이원용	남	1978.11	상무	상근	미래사업기획단 담당임원	SAIT 기획지원팀장	MIT(박사)	계열회사 임원	46
이윤경	여	1979.09	상무	상근	Big Data센터장	Big Data센터 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(박사)	계열회사 임원	
이의형	남	1975.09	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	46
이인실	여	1979.12	상무	상근	생활가전 구매팀 담당임원	생활가전 구매팀 Principal Professional	고려대(석사)	계열회사 임원	11
이인학	남	1975.05	상무	상근	DS부문DS대외협력팀 담당임원	DS부문 상생협력센터 Principal Professional	광운대(석사)	계열회사 임원	23
이일한	남	1975.04	상무	상근	상생협력센터 담당임원	삼성물산, 상생협력팀장	서울시립대(석사)	계열회사 임원	12
이재승	남	1980.01	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	8
이재영	남	1974.11	상무	상근	네트워크 People팀장	사업지원T/F 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	
이재호	남	1974.08	상무	상근	Global CS센터 담당임원	Global CS센터 Principal Professional	서강대(석사)	계열회사 임원	34
이재훈	남	1974.01	상무	상근	Mobile eXperience 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	연세대(학사)	계열회사 임원	58
이정원	남	1971.07	상무	상근	네트워크 Global제조팀장	네트워크 Global운영팀장	경북대(학사)	계열회사 임원	

이정자	여	1969.04	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	
이정준	남	1976.01	상무	상근	상생협력센터 담당임원	상생협력센터 Principal Professional	고려대(학사)	계열회사 임원	11
이정호	남	1974.11	상무	상근	People팀 담당임원	한국총괄 People팀장	경북대(학사)	계열회사 임원	58
이정환	남	1977.02	상무	상근	네트워크 Cloud Solution사업팀 담당임원	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	경희대(석사)	계열회사 임원	11
이존기	남	1972.11	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 개발실 Principal Engineer	금오공대(학사)	계열회사 임원	11
이종덕	남	1976.07	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	생산기술연구소 Principal Professional	한양대(학사)	계열회사 임원	11
이종석	남	1973.02	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Apple, CPU Micro Architect	Virginia Tech(박사)	계열회사 임원	47
이종우	남	1978.04	상무	상근	System LSI LSI사업팀 담당임원	System LSI Design Platform개발실 담당임원	Univ. of Michigan, Ann Arbor(박사)	계열회사 임원	
이종필	남	1972.11	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 Principal Engineer	경북대(석사)	계열회사 임원	
이종해	남	1977.10	상무	상근	SEHC 담당임원	영상디스플레이 지원팀 Principal Professional	홍익대(학사)	계열회사 임원	11
이종호	남	1976.02	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 TP제조기술센터 담당임원	TSP총괄 Package개발실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
이준표	남	1971.06	상무	상근	생활가전 C&M사업팀장	생활가전 C&M사업팀 담당임원	Univ. of Maryland, College Park(박사)	계열회사 임원	59
이중원	남	1975.06	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 Principal Engineer	서울대(박사)	계열회사 임원	58
이지석	남	1978.04	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당임원	Stanford Univ.(박사수료)	계열회사 임원	38
이지연	여	1979.06	상무	상근	한국총괄 B2B팀 담당임원	한국총괄 B2B팀 Principal Professional	서울대(석사)	계열회사 임원	23
이지영	여	1976.08	상무	상근	Mobile eXperience 디자인팀 담당임원	Mobile eXperience CX실 담당임원	제주대(학사)	계열회사 임원	58
이지현	남	1976.06	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 Principal Engineer	포항공대(박사)	계열회사 임원	11
이지훈	남	1976.02	상무	상근	사업지원실 담당임원	사업지원T/F 담당임원	Northwestern Univ.(석사)	계열회사 임원	
이지훈	남	1970.11	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	SECA법인장	State Univ. of New York, Stony Brook(석사)	계열회사 임원	
이진영	남	1976.01	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 Principal Professional	성균관대(석사)	계열회사 임원	11
이진욱	남	1972.01	상무	상근	DS부문 DS대외협력팀장	DS부문 DS대외협력팀 담당임원	아주대(석사)	계열회사 임원	58
이진원	남	1973.03	상무	상근	생활가전 Global CS팀 담당임원	생활가전 Global CS팀 Principal Professional	서울대(박사)	계열회사 임원	
이창수	남	1975.11	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 Principal Engineer	항공대(학사)	계열회사 임원	23
이창훈	남	1975.03	상무	상근	DS부문 재경팀 담당임원	DS부문 재경팀 Principal Professional	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	11

이충현	남	1975.09	상무	상근	SEEA법인장	Mobile eXperience 전략마케팅실 Principal Professional	충북대(학사)	계열회사 임원	11
이치훈	남	1969.08	상무	상근	DS부문 People팀 담당임원	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
이태선	남	1978.09	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	SEWA법인장	연세대(학사)	계열회사 임원	23
이태용	남	1977.11	상무	상근	생활가전 HVAC사업팀 담당임원	생활가전 Air Solution사업팀 담당임원	Univ. of California, Irvine(석사)	계열회사 임원	11
이태호	남	1974.05	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 Principal Engineer	원광대(석사)	계열회사 임원	34
이택천	남	1974.06	상무	상근	한국총괄 e-Commerce팀 담당임원	G마켓, 고문	경희대(학사)	계열회사 임원	16
이한용	남	1976.05	상무	상근	법무실 IP센터 담당임원	김앤장, Sr.Foreign Attorney	George Washington Univ.(석사)	계열회사 임원	55
이혁	남	1973.02	상무	상근	Mobile eXperience Digital Wallet팀 담당임원	기획팀 담당임원	Duke Univ.(석사)	계열회사 임원	40
이현동	남	1972.02	상무	상근	영상디스플레이 전략마케팅팀 담당임원	SESAR법인장	영남대(학사)	계열회사 임원	58
이현수	남	1980.12	상무	상근	영상디스플레이 개발2팀 담당임원	영상디스플레이 Service Business팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	34
이현우	남	1974.10	상무	상근	People팀 담당임원	인사팀 담당임원	경북대(석사)	계열회사 임원	
이현정	여	1971.11	상무	상근	SCIC 담당임원	한국총괄 마케팅팀 담당임원	고려대(박사)	계열회사 임원	58
이형주	남	1976.10	상무	상근	SEM-S 담당임원	SEH-S법인장	Univ. of North Carolina, Chapel Hill(석사)	계열회사 임원	11
이형중	남	1980.01	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	사업지원실 Principal Professional	국민대(학사)	계열회사 임원	11
이형철	남	1976.02	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 개발실 Principal Engineer	광운대(학사)	계열회사 임원	23
이혜경	여	1978.01	상무	상근	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	Ericsson, Sr.Director	San Diego State Univ.(석사)	계열회사 임원	24
이호	남	1972.07	상무	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	Foundry 기술개발실 Principal Engineer	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
이호신	남	1970.12	상무	상근	법무실 IP센터 담당임원	법무실 IP센터 Principal Legal Counsel	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	
이훈신	남	1974.09	상무	상근	Global EHS실 담당임원	Global EHS센터 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	57
이흔철	남	1976.03	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	Ericsson, Sr.Researcher	고려대(박사)	계열회사 임원	25
이희곤	남	1978.09	상무	상근	IR팀 담당임원	재정경제부, 서기관	Univ. of Pittsburgh(석사)	계열회사 임원	2
인우성	남	1977.08	상무	상근	영상디스플레이 개발1팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	23
인현진	남	1981.04	상무	상근	DS부문 IP팀 담당임원	Fish and Richardson, Equity Partner	MIT(박사)	계열회사 임원	1
임경욱	여	1978.05	상무	상근	AX/PI센터 People팀장	DS부문 People팀 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	23
임경춘	남	1977.12	상무	상근	DS부문 경영진단팀 담당임원	DS부문 경영진단팀 Principal Professional	서울대(석사)	계열회사 임원	11
임산	남	1973.03	상무	상근	사업지원실 담당임원	DS부문 기획팀 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	58
임수현	남	1977.07	상무	상근	SESK 담당임원	영상디스플레이 지원팀 Principal Professional	Univ. of Maryland, College Park(석사)	계열회사 임원	23
임영수	남	1969.06	상무	상근	한국총괄 B2B팀 담당임원	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	영남대(학사)	계열회사 임원	

임윤모	남	1977.10	상무	상근	생활가전 구매팀 담당임원	생활가전 구매팀 Principal Professional	인하대(학사)	계열회사 임원	34
임전식	남	1969.08	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	전북대(학사)	계열회사 임원	
임지운	남	1975.07	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실 담당임원	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실 Principal Engineer	서울대(박사)	계열회사 임원	23
임지훈	남	1972.12	상무	상근	글로벌브랜드센터 담당임원	글로벌마케팅실 글로벌브랜드센터 담당임원	서울대(학사)	계열회사 임원	
장경모	남	1977.10	상무	상근	네트워크 지원팀 담당임원	SEG 담당임원	연세대(학사)	계열회사 임원	34
장민희	남	1976.01	상무	상근	생활가전 C&M사업팀 담당임원	LG전자, 부장	부산대(석사)	계열회사 임원	12
장세정	남	1974.04	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 품질실 담당임원	서울대(학사)	계열회사 임원	
장순복	여	1977.04	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 Principal Engineer	부산대(학사)	계열회사 임원	
장용일	남	1974.09	상무	상근	SESAR법인장	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	23
장욱	남	1973.11	상무	상근	SEJ법인장	SEJ 담당임원	한국외국어대(학사)	계열회사 임원	46
장윤형	남	1977.09	상무	상근	중국삼성전략협력실 담당임원	중국삼성전략협력실 Principal Professional	서울대(석사)	계열회사 임원	23
장윤희	남	1974.09	상무	상근	지원팀 담당임원	SIEL-P(N) 담당임원	Emory Univ.(석사)	계열회사 임원	46
장정렬	남	1977.01	상무	상근	SIEL-S 담당임원	네트워크 개발팀 Principal Engineer	중앙대(석사)	계열회사 임원	46
장제열	남	1979.02	상무	상근	의료기기 전략마케팅팀장	GE Healthcare, General Manager	연세대(학사)	계열회사 임원	11
장준희	남	1974.01	상무	상근	SEUK 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	한국외국어대(학사)	계열회사 임원	
장지호	남	1970.09	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	GCT, VP	서울대(박사)	계열회사 임원	
장흥민	남	1972.06	상무	상근	Global CS센터 담당임원	동남아총괄 CS팀장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	46
전대호	남	1971.01	상무	상근	DS부문 상생협력센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 People팀장	아주대(석사)	계열회사 임원	
전상욱	남	1980.08	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 개발실 Principal Engineer	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	46
전성훈	남	1977.01	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 Principal Engineer	연세대(박사)	계열회사 임원	58
전소영	여	1974.05	상무	상근	IR팀 담당임원	SEA 담당임원	Univ. of Texas, Dallas(석사)	계열회사 임원	
전승수	남	1976.07	상무	상근	AI플랫폼센터 담당임원	디바이스플랫폼센터 담당임원	고려대(박사)	계열회사 임원	
전영우	남	1974.12	상무	상근	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀 담당임원	HP, Director	York Univ.(석사)	계열회사 임원	31
전윤광	남	1975.05	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 Principal Engineer	서울대(석사)	계열회사 임원	11
전중원	남	1976.05	상무	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	Foundry 기술개발실 Principal Engineer	서울대(박사)	계열회사 임원	23
전진규	남	1974.05	상무	상근	SEA 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	한양대(학사)	계열회사 임원	

전진완	남	1974.03	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	
전형민	남	1974.03	상무	상근	SEI 담당임원	SEAU 담당임원	중앙대(학사)	계열회사 임원	34
전형석	남	1978.01	상무	상근	재경팀 담당임원	재경팀 Principal Professional	서울대(석사)	계열회사 임원	11
전희정	여	1977.09	상무	상근	Foundry 전략마케팅실 담당임원	Foundry Corporate Planning실 담당임원	Arizona State Univ.(박사)	계열회사 임원	32
정강일	남	1974.10	상무	상근	영상디스플레이 CX팀 담당임원	영상디스플레이 Next Product팀 담당임원	Illinois Inst. of Tech.(석사)	계열회사 임원	58
정광섭	남	1970.04	상무	상근	재경팀 담당임원	삼성물산, 경영정보팀 수석	한양대(석사)	계열회사 임원	58
정기호	남	1973.08	상무	상근	SEACE 담당임원	생활가전 Air Solution Business팀 담당임원	한국해양대(학사)	계열회사 임원	58
정대인	남	1972.12	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	Qualcomm, Principal Engineer	Univ. of California, Sandiego(박사)	계열회사 임원	6
정석희	남	1975.01	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 개발실 Principal Engineer	고려대(석사)	계열회사 임원	34
정성엽	남	1974.09	상무	상근	커뮤니케이션실 담당임원	커뮤니케이션팀 담당임원	한국외국어대(학사)	계열회사 임원	25
정성원	남	1971.12	상무	상근	영상디스플레이 전략마케팅팀 담당임원	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	58
정성원	남	1974.07	상무	상근	메모리 Global운영팀장	메모리 Global운영팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	58
정성훈	남	1976.01	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	메모리 전략마케팅실 Principal Professional	Duke Univ.(석사)	계열회사 임원	35
정세환	남	1973.10	상무	상근	한국총괄 CE팀 담당임원	한국총괄 B2B팀 담당임원	한국해양대(학사)	계열회사 임원	34
정승일	남	1973.08	상무	상근	SELS법인장	경영혁신센터 담당임원	Indiana Univ., Bloomington(석사)	계열회사 임원	46
정승진	남	1972.11	상무	상근	메모리 품질실 담당임원	메모리 Solution개발실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
정신영	여	1973.03	상무	상근	Foundry 품질팀 담당임원	Foundry 제품기술팀 Principal Engineer	Univ. of Florida(석사)	계열회사 임원	58
정영환	남	1971.08	상무	상근	SCIC 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	복단대(석사)	계열회사 임원	46
정원철	남	1973.12	상무	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	DS부문 CTO 반도체연구소 Logic TD팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
정윤찬	남	1968.09	상무	상근	상생협력센터 담당임원	베트남복합단지 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	
정윤현	남	1976.10	상무	상근	생활가전 Global CS팀 담당임원	Mobile eXperience 품질혁신센터 Principal Professional	금오공대(석사)	계열회사 임원	11
정인호	남	1970.11	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	
정재훈	남	1977.02	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 CSE팀장	DS부문 CTO 반도체연구소 CSE팀 Principal Engineer	Texas A&M Univ.(박사)	계열회사 임원	11
정주영	남	1977.07	상무	상근	AX/PI센터 담당임원	카카오엔터프라이즈, 부사장	서강대(학사)	계열회사 임원	33
정진희	여	1977.11	상무	상근	영상디스플레이 전략마케팅팀 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	전남대(학사)	계열회사 임원	34
정춘화	남	1974.09	상무	상근	SCS 담당임원	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	35
정택정	남	1979.10	상무	상근	영상디스플레이 지원팀 담당임원	구주총괄 Principal Legal Counsel	Univ. of Bonn(석사)	계열회사 임원	23

정한기	남	1976.05	상무	상근	메모리 PKG개발팀 담당임원	메모리 DRAM개발실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	46
정혁준	남	1974.09	상무	상근	생활가전 광주지원센터장	생활가전 광주지원센터 Principal Professional	전남대(학사)	계열회사 임원	58
정홍욱	남	1977.10	상무	상근	커뮤니케이션실 담당임원	커뮤니케이션팀 담당임원	Hitotsubashi Univ.(석사)	계열회사 임원	34
정희범	남	1979.06	상무	상근	법무실 담당임원	법무실 Principal Legal Counsel	고려대(학사)	계열회사 임원	23
제이슨밀러	남	1982.07	상무	상근	Mobile eXperience Digital Wallet팀 담당임원	Apple, Product Lead	Univ. of California, San Diego(석사)	계열회사 임원	11
제희원	남	1978.09	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI CP개발실 Principal Engineer	서울대(박사)	계열회사 임원	46
조강욱	남	1977.08	상무	상근	북미총괄 지원팀장	동남아총괄 지원팀장	성균관대(학사)	계열회사 임원	46
조근수	남	1976.06	상무	상근	재경팀 담당임원	재경팀 Principal Professional	Duke Univ.(석사)	계열회사 임원	34
조근휘	남	1974.02	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 Logic TD팀 담당임원	DS부문 CTO 반도체연구소 Logic TD실 담당임원	고려대(박사)	계열회사 임원	35
조미선	여	1980.04	상무	상근	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	Ericsson, VP	한국외국어대(학사)	계열회사 임원	45
조성욱	남	1980.10	상무	상근	북미총괄 People팀장	사업지원T/F Principal Professional	Michigan State Univ.(석사)	계열회사 임원	23
조성제	남	1977.04	상무	상근	People팀 담당임원	People팀 Principal Professional	Michigan State Univ.(석사)	계열회사 임원	46
조성희	남	1974.08	상무	상근	영상디스플레이 Display Solution사업팀 담당임원	SRI-Delhi연구소장	서강대(석사)	계열회사 임원	46
조승기	남	1978.08	상무	상근	영상디스플레이 개발1팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 담당임원	Univ. of Colorado, Boulder(석사)	계열회사 임원	11
조영민	남	1973.03	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	메모리 전략마케팅실 Principal Professional	성균관대(석사)	계열회사 임원	23
조영상	남	1980.09	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Google, Sr.Staff S/W Engineer	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	25
조영석	남	1976.11	상무	상근	재경팀 담당임원	전장사업팀 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	46
조용석	남	1975.11	상무	상근	사업지원실 담당임원	사업지원T/F 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	22
조욱래	남	1972.03	상무	상근	DS부문 재경팀 담당임원	제조&기술담당 지원팀장	Purdue Univ.(석사)	계열회사 임원	
조원희	남	1975.11	상무	상근	SAS 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	23
조유성	남	1971.06	상무	상근	Global EHS실 담당임원	Global EHS센터 담당임원	서울과학기술대(석사)	계열회사 임원	
조윤상	남	1975.10	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 Principal Engineer	한양대(학사)	계열회사 임원	11
조은경	여	1970.08	상무	상근	Mobile eXperience 모바일 마케팅센터 담당임원	Mobile eXperience 마케팅팀 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	34
조익현	남	1972.01	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 Principal Engineer	성균관대(석사)	계열회사 임원	
조지호	남	1972.04	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 Principal Engineer	부산대(학사)	계열회사 임원	58
조철민	남	1971.03	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI SOC개발실 Principal Engineer	연세대(학사)	계열회사 임원	
조철용	남	1975.08	상무	상근	영상디스플레이 디자인팀장	영상디스플레이 디자인팀 Principal Designer	홍익대(학사)	계열회사 임원	46

조철형	남	1971.03	상무	상근	SSEC법인장	SEDA-P(M)공장장	충북대(학사)	계열회사 임원	
조호근	남	1977.11	상무	상근	하만협력팀 담당임원	재경팀 담당임원	Univ. Of California, LA(석사)	계열회사 임원	46
조훈영	남	1973.08	상무	상근	Samsung Research AI센터 담당임원	Samsung Research Global AI센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	56
조희권	남	1976.06	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	SEA 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
주재완	남	1968.02	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
주현태	남	1972.12	상무	상근	TSE-P법인장	생활가전 Global제조팀 담당임원	울산대(학사)	계열회사 임원	58
주형빈	남	1973.06	상무	상근	SAVINA-S법인장	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	경희대(학사)	계열회사 임원	
지안마우로벨라	남	1984.12	상무	상근	CDO 담당임원	PepsiCo, VP	상하이교통대(석사)	계열회사 임원	9
진영두	남	1972.06	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 S/W개발팀 담당임원	동아대(학사)	계열회사 임원	46
차도현	남	1973.04	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 담당임원	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	
차순우	남	1971.09	상무	상근	Foundry사업부 Foundry CTO 담당임원	DS부문 CTO 반도체연구소 PKG개발팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	13
차완철	남	1979.05	상무	상근	People팀 담당임원	생활가전 People팀 Principal Professional	고려대(학사)	계열회사 임원	11
차지호	남	1976.04	상무	상근	상생협력센터 담당임원	경영진단팀 담당임원	전남대(학사)	계열회사 임원	23
찰리장	남	1973.10	상무	상근	SRA 담당임원	Samsung Research 차세대통신연구센터 담당임원	Univ. of Wisconsin, Madison(박사)	계열회사 임원	34
채교석	남	1978.09	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 Principal Engineer	한양대(박사)	계열회사 임원	23
채동혁	남	1973.10	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	세미브레인, 팀장	서울대(석사)	계열회사 임원	41
채수연	여	1977.10	상무	상근	커뮤니케이션실 담당임원	커뮤니케이션팀 Principal Professional	경북대(학사)	계열회사 임원	23
천기철	남	1970.09	상무	상근	메모리 품질실 담당임원	DS부문 DSC 담당임원	Univ. Of Minnesota, Twin Cities(박사)	계열회사 임원	
천상필	남	1969.05	상무	상근	서남아총괄 대외협력팀장	Global Public Affairs실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
천홍문	남	1976.02	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 품질혁신센터 담당임원	단국대(학사)	계열회사 임원	34
최경수	남	1971.12	상무	상근	경영진단팀 담당임원	상생협력센터 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	
최고은	여	1984.02	상무	상근	RX사업추진실 담당임원	Samsung Research Robot센터 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	11
최동규	남	1977.02	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 설비기술연구소 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	23
최동열	남	1978.01	상무	상근	SAMEX 담당임원	지원팀 Principal Professional	Emory Univ.(석사)	계열회사 임원	11
최동준	남	1974.01	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	메모리 전략마케팅실 Principal Professional	광운대(학사)	계열회사 임원	11
최명진	남	1974.06	상무	상근	경영혁신센터 담당임원	경영혁신센터 Principal Professional	고려대(석사)	계열회사 임원	34
최민기	남	1977.10	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 개발실 Principal Engineer	Univ. of Wisconsin, Madison(박사)	계열회사 임원	34
최병철	남	1971.06	상무	상근	생활가전 Global운영팀장	영상디스플레이 Global운영팀장	성균관대(석사)	계열회사 임원	

최보람	여	1977.08	상무	상근	CX센터 담당임원	글로벌마케팅실 CX센터 담당임원	Manchester Business School(석사)	계열회사 임원	11
최삼종	남	1973.03	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실 소재기술팀장	글로벌 제조&인프라총괄 Common Tech센터 담당임원	한양대(박사)	계열회사 임원	
최상선	남	1975.03	상무	상근	Big Data센터 담당임원	글로벌마케팅실 Big Data센터 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	34
최서림	남	1972.02	상무	상근	DS부문 경영진단팀 담당임원	설비기술연구소 기획지원팀장	서울대(석사)	계열회사 임원	58
최성훈	남	1977.07	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 개발실 Principal Engineer	고려대(석사)	계열회사 임원	11
최승기	남	1977.01	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 개발실 Principal Engineer	Univ. of York(석사)	계열회사 임원	11
최승림	남	1972.02	상무	상근	재경팀 담당임원	CIS총괄 지원팀장	서울대(석사)	계열회사 임원	58
최연호	남	1975.03	상무	상근	SEG 담당임원	영상디스플레이 지원팀 담당임원	연세대(학사)	계열회사 임원	34
최영	남	1969.07	상무	상근	한국총괄 B2C유통전략팀 담당임원	한국총괄 MX팀 담당임원	항공대(학사)	계열회사 임원	
최영일	남	1973.08	상무	상근	SAS 담당임원	Foundry 지원팀 담당임원	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	
최원경	여	1973.08	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 차세대연구팀 담당임원	TSP총괄 Package개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
최원서	남	1977.02	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 개발실 Principal Engineer	서울대(석사)	계열회사 임원	34
최원호	남	1981.02	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	Western Digital, Sr. Technologist	Univ. Of Minnesota, Twin Cities(박사)	계열회사 임원	33
최유진	여	1979.06	상무	상근	영상디스플레이 UX팀장	영상디스플레이 UX팀 Principal Designer	Illinois Inst. of Tech.(석사)	계열회사 임원	58
최윤석	남	1974.09	상무	상근	Foundry사업부 Foundry CTO 담당임원	TSP총괄 C.PKG개발팀 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
최윤성	남	1975.05	상무	상근	System LSI DTCO팀장	System LSI 제품기술팀 담당임원	Univ. of Florida(박사)	계열회사 임원	29
최인수	남	1973.02	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	메모리 상품기획실 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	46
최일환	남	1972.11	상무	상근	Big Data센터 담당임원	글로벌마케팅실 Big Data센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	58
최장석	남	1973.06	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	메모리 상품기획실 담당임원	충남대(학사)	계열회사 임원	46
최재혁	남	1974.06	상무	상근	경영진단팀 담당임원	Mobile eXperience 지원팀 담당임원	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	
최종구	남	1978.03	상무	상근	상생협력센터 담당임원	상생협력센터 Principal Professional	경찰대(학사)	계열회사 임원	23
최종근	남	1978.01	상무	상근	SCS 담당임원	SAIT 기획지원팀장	MIT(석사)	계열회사 임원	35
최종무	남	1975.08	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 Principal Engineer	아주대(석사)	계열회사 임원	
최종민	남	1976.05	상무	상근	Mobile eXperience Digital Health팀 담당임원	Mobile eXperience Digital Health팀 Principal Engineer	서울대(박사)	계열회사 임원	34
최종성	남	1977.01	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI SOC개발실 Principal Engineer	연세대(박사)	계열회사 임원	23

최준일	남	1976.01	상무	상근	Mobile eXperience Digital Health팀 담당임원	Mobile eXperience Digital Health팀 Principal Professional	고려대(석사)	계열회사 임원	23
최중훈	남	1973.01	상무	상근	경영진단팀 담당임원	베트남삼성전략협력실 담당임원	단국대(학사)	계열회사 임원	23
최진필	남	1973.04	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	SCS 담당임원	연세대(박사)	계열회사 임원	
최창환	남	1977.08	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	Amazon, Supply Chain Head	고려대(석사)	계열회사 임원	18
최창훈	남	1973.08	상무	상근	SEAU법인장	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	58
최철환	남	1974.04	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 연구라인기술팀장	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	홍익대(학사)	계열회사 임원	46
최혁승	남	1976.04	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 모바일 플랫폼센터 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	46
최호석	남	1978.01	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Morgan Stanley, VP	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	32
최효석	남	1981.02	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실 담당임원	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실 Principal Engineer	서울대(박사)	계열회사 임원	35
추민기	남	1975.10	상무	상근	SIEL-S 담당임원	SECE법인장	서강대(학사)	계열회사 임원	46
추민수	남	1973.10	상무	상근	People팀 담당임원	SEPCO법인장	Univ. of California, LA(석사)	계열회사 임원	58
카리야 타카시	남	1969.02	상무	상근	DS부문 DSRJ 담당임원	TDK, 총괄부장	東北大(박사)	계열회사 임원	47
코너피어스	남	1970.04	상무	상근	SEF법인장	SEPOL법인장	Univ. of Dublin(석사)	계열회사 임원	
하경수	남	1979.04	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	58
하지훈	남	1985.08	상무	상근	Samsung Research 차세대통신연구센터 담당임원	Samsung Research 차세대통신연구센터 Principal Engineer	고려대(박사)	계열회사 임원	23
하헌재	남	1984.02	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Meta, H/W System Engineer	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	32
하헌재	남	1970.08	상무	상근	DS부문 People팀 담당임원	DS부문 People팀 Principal Professional	광운대(학사)	계열회사 임원	46
한글라라	여	1976.02	상무	상근	영상디스플레이 구매팀 담당임원	영상디스플레이 구매팀 Principal Professional	경희대(학사)	계열회사 임원	46
한기욱	남	1980.12	상무	상근	중국삼성전략협력실 담당임원	중국삼성전략협력실 Principal Legal Counsel	연세대(학사)	계열회사 임원	23
한상섭	남	1972.04	상무	상근	북미총괄 CS팀장	Global CS센터 담당임원	광운대(석사)	계열회사 임원	58
한상욱	남	1974.02	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 개발실 Principal Engineer	Univ. of Texas, Austin(박사)	계열회사 임원	46
한상원	남	1976.05	상무	상근	한국총괄 MX팀 담당임원	한국총괄 MX팀 Principal Professional	서울대(석사)	계열회사 임원	23
한석근	남	1978.09	상무	상근	SESK법인장	SERK법인장	경기대(학사)	계열회사 임원	34
한성웅	남	1980.11	상무	상근	사업지원실 담당임원	People팀 Principal Professional	연세대(학사)	계열회사 임원	11
한장수	남	1970.02	상무	상근	북미총괄 법무지원팀장	무선 지원팀 담당임원	State Univ. of New York, Buffalo(박사)	계열회사 임원	

한정남	남	1973.01	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
한종호	남	1976.01	상무	상근	생활가전 지원팀 담당임원	영상디스플레이 지원팀 담당임원	Vanderbilt Univ.(석사)	계열회사 임원	
한진규	남	1973.12	상무	상근	Samsung Research 기술표준연구팀장	Samsung Research 차세대통신연구센터 담당임원	연세대(박사)	계열회사 임원	
한진우	남	1980.07	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 DRAM TD팀 담당임원	DS부문 CTO 반도체연구소 DRAM TD실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	53
한태린	여	1980.09	상무	상근	AX/PI센터 담당임원	Meta, Sr.Engineering Manager	MIT(석사)	계열회사 임원	1
함민기	남	1975.02	상무	상근	CDO 담당임원	디자인경영센터 담당임원	강원대(학사)	계열회사 임원	23
허욱	남	1972.05	상무	상근	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	네트워크 전략마케팅팀 Principal Professional	Waseda Univ.(학사)	계열회사 임원	46
허일정	남	1978.05	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 EHS/인프라기술연구소 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	47
허정철	남	1971.08	상무	상근	Mobile eXperience 품질혁신센터 담당임원	Mobile eXperience 품질혁신센터 Principal Professional	연세대(석사)	계열회사 임원	34
허준	남	1972.08	상무	상근	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀 담당임원	SEA 담당임원	한양대(석사)	계열회사 임원	46
허준영	남	1977.02	상무	상근	사업지원실 담당임원	사업지원T/F 담당임원	연세대(학사)	계열회사 임원	58
허준회	남	1979.03	상무	상근	DSRA-S.LSI 담당임원	System LSI SOC사업팀 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	
허지영	남	1970.09	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 EHS센터 담당임원	글로벌인프라총괄 환경안전센터 담당임원	부산대(학사)	계열회사 임원	
헨릭얀손	남	1975.03	상무	상근	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	네트워크 담당임원	Chalmers Univ.(석사)	계열회사 임원	45
현대은	남	1975.10	상무	상근	SRI-Delhi연구소장	영상디스플레이 CX팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
현재웅	남	1975.09	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	메모리 상품기획실 담당임원	RPI(석사)	계열회사 임원	38
현정혁	남	1977.09	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	46
홍석구	남	1981.10	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실 Principal Engineer	서울대(박사)	계열회사 임원	11
홍순상	남	1972.08	상무	상근	Mobile eXperience 서비스 Biz팀 담당임원	무선 서비스Biz팀 Principal Professional	연세대(학사)	계열회사 임원	58
홍연석	남	1972.01	상무	상근	Mobile eXperience Global제조센터 담당임원	SEIN-P법인장	경북대(석사)	계열회사 임원	58
홍영주	남	1977.08	상무	상근	CIS총괄 지원팀장	네트워크 지원팀 담당임원	서울대(학사)	계열회사 임원	58
홍유석	남	1972.12	상무	상근	법무실 담당임원	법무실 Principal Legal Counsel	Univ. of Notre Dame(석사)	계열회사 임원	
홍재석	남	1981.11	상무	상근	생활가전 지원팀 담당임원	생활가전 지원팀 Principal Legal Counsel	Univ. of Notre Dame(석사)	계열회사 임원	23
홍정우	남	1976.02	상무	상근	상생협력센터 담당임원	상생협력센터 Principal Professional	성균관대(학사)	계열회사 임원	23

홍주현	남	1975.10	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	Apple, Program Manager	Harvard Univ.(석사)	계열회사 임원	2
홍준식	남	1971.12	상무	상근	SCS 담당임원	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	전북대(석사)	계열회사 임원	
홍준화	남	1974.05	상무	상근	영상디스플레이 전략마케팅팀 담당임원	Nike, Sr.Director	Univ. of Chicago(석사)	계열회사 임원	26
홍창표	남	1973.05	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	메모리 전략마케팅실 Principal Professional	한양대(학사)	계열회사 임원	23
홍희영	남	1979.04	상무	상근	SGE법인장	SEMAG법인장	성균관대(석사)	계열회사 임원	11
황근하	남	1970.05	상무	상근	SEHC법인장	영상디스플레이 Global제조팀장	아주대(학사)	계열회사 임원	
황보용	남	1970.10	상무	상근	기획팀 담당임원	창의개발센터장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
황영삼	남	1977.10	상무	상근	의료기기 People팀장	동남아총괄 People팀장	한양대(학사)	계열회사 임원	46
황일권	남	1973.12	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	생산기술연구소 Principal Professional	고려대(석사)	계열회사 임원	46
황정호	남	1974.08	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	Mobile eXperience CX실 Principal Professional	고려대(석사)	계열회사 임원	11
황현익	남	1977.08	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 TP제조기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 TP제조기술센터 Principal Engineer	광운대(학사)	계열회사 임원	11
황호송	남	1967.01	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 EHS센터 담당임원	글로벌인프라총괄 환경안전센터 담당임원	Imperial College(박사)	계열회사 임원	

※ 미등기임원 소유주식수는 작성기준일 현재 보통주(의결권 있는 주식) 100,802,501주(이재용 회장 97,414,196주 등),
우선주(의결권 없는 주식) 171,609주(이재용 회장 137,757주 등)이며, 작성기준일 이후 변동은 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)의
'임원・주요주주 특정증권등 소유상황보고서' 등을 참조하시기 바랍니다.

※ 최대주주와의 관계는「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」제3조 제1항에 기재되어 있는 관계를 참고하여 기재하였습니다.

※ 재직기간은 기업공시서식 작성기준에 따라 미등기임원으로서 5년 이상 회사에 계속 재직해온 경우에는 기재를 생략하였습니다.

라. 미등기임원의 변동

작성기준일 이후 보고서 제출일 현재까지 변동된 미등기임원은 다음과 같습니다.

구분(사유)	성명	성별	출생연월	직위	담당업무	최대주주와의 관계
임원	데이비드골드	남	1978.04	부사장	영상디스플레이 담당임원	계열회사 임원
선임	김지하	남	1987.01	상무	DS부문 기획팀 담당임원	계열회사 임원

※ 최대주주와의 관계는「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」제3조 제1항에 기재되어 있는 관계를 참고하여 기재하였습니다.

2. 임원의 보수 등

임원의 보수 등은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기·사업보고서에 기재 예정)

IX. 계열회사 등에 관한 사항

계열회사 등에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기・사업보고서에 기재 예정)

X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등

당사는 2026년 3분기말 현재 Samsung Electronics America, Inc. (SEA) 등 해외종속법인의 유연한 자금조달을 위하여 통합채무보증을 제공하고 있습니다.

(단위 : 천US$, %)

법인명 (채무자)	관계	채권자	내용	목적	보증시작일	보증종료일	채무보증한도		채무금액			이자율
							기초	기말	기초	증감	기말	
SEA	계열회사	BOA 외	지급보증	운영자금	2025-11-09	2027-06-13	1,278,000	3,575,000	-	-	-	-
SEM	계열회사	BBVA 외	지급보증	운영자금	2025-11-09	2027-08-19	715,000	580,000	-	-	-	-
SAMCOL	계열회사	Citibank 외	지급보증	운영자금	2025-11-09	2027-06-13	180,000	111,000	-	-	-	-
SEDA	계열회사	BRADESCO 외	지급보증	운영자금	2025-11-09	2027-09-30	329,000	1,071,000	-	-	-	-
SECH	계열회사	Citibank 외	지급보증	운영자금	2025-12-17	2027-06-13	64,000	50,000	-	-	-	-
SEPR	계열회사	BBVA 외	지급보증	운영자금	2025-12-17	2027-06-13	150,000	127,000	-	-	-	-
SSA	계열회사	SCB 외	지급보증	운영자금	2025-11-09	2027-06-13	286,000	122,000	-	-	-	-
SEMAG	계열회사	Citibank 외	지급보증	운영자금	2025-12-17	2026-12-16	46,000	16,000	-	-	-	-
SETK	계열회사	BNP 외	지급보증	운영자금	2025-11-09	2027-06-13	947,000	887,000	11,639	128,114	139,753	36.78%
SETK-P	계열회사	BNP 외	지급보증	운영자금	2025-11-09	2026-12-16	70,000	70,000	-	-	-	-
SECE	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2025-12-17	2026-12-16	114,000	15,000	-	-	-	-
SEEG	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2026-06-14	2027-06-13	85,000	30,000	-	-	-	-
SEIN	계열회사	BNP 외	지급보증	운영자금	2025-11-09	2027-06-13	70,000	70,000	-	-	-	-
SJC	계열회사	Mizuho Bank 외	지급보증	운영자금	2025-11-09	2027-05-31	809,211	492,639	-	-	-	-
SEUC	계열회사	Credit Agricole	지급보증	운영자금	2025-11-09	2026-11-08	115,000	-	-	-	-	-
SEDAM	계열회사	Santander	지급보증	운영자금	2025-11-09	2027-06-13	537,000	150,000	-	-	-	-
SECA	계열회사	BoA	지급보증	운영자금	2025-11-09	2026-11-08	72,000	19,000	-	-	-	-
SELA	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2025-12-17	2026-12-16	90,000	60,000	-	-	-	-
SEEH	계열회사	Citibank 외	지급보증	운영자금	2025-11-01	2027-09-05	938,400	233,000	-	-	-	-
SELV	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2025-12-17	2026-12-16	10,000	10,000	-	-	-	-
SEIL	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2025-12-17	2026-12-16	15,600	-	-	-	-	-
SAPL	계열회사	Citibank 외	지급보증	운영자금	2025-11-09	2026-12-16	404,000	35,000	-	-	-	-
SAVINA	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2026-06-14	2027-06-13	51,000	51,000	-	-	-	-
SEV	계열회사											
SEVT	계열회사											
SEHC	계열회사											
SCIC	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2026-06-14	2027-06-13	270,000	10,000	-	-	-	-
SESP	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2025-11-09	2026-11-08	30,000	10,000	-	-	-	-
SME	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2025-11-09	2026-11-08	110,000	100,000	-	-	-	-
SAMEX	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2025-12-17	2026-12-16	5,000	5,000	-	-	-	-
SEASA	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2025-12-17	2026-12-16	2,000	2,000	-	-	-	-
SSAP	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2025-11-09	2026-11-08	35,000	10,000	-	-	-	-
SEPM	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2026-06-14	2027-06-13	35,000	-	-	-	-	-
SESAR	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2026-06-14	2027-06-13	20,000	20,000	-	-	-	-
SEUZ	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2025-12-17	2026-12-16	20,000	-	-	-	-	-
Flakt	계열회사	BNP	지급보증	운영자금	2026-03-16	2026-11-08	-	60,000	-	-	-	-

법인명 (채무자)	관계	채권자	내용	목적	보증 시작일	보증 종료일	채무보증한도		채무금액			이자율
							기초	기말	기초	증감	기말	
Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	계열회사	SocGen	지급보증	운영자금	2025-11-09	2026-11-08	15,000	-	-	-	-	-
Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	계열회사											
Harman International Japan Co., Ltd.	계열회사	MUFG	지급보증	운영자금	2025-11-09	2026-11-08	25,000	25,000	-	-	-	-
Harman International Industries Limited	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2026-06-14	2027-06-13	30,000	30,000	-	-	-	-
Harman International Industries Inc.	계열회사	JP Morgan	지급보증	운영자금	2026-06-14	2027-06-13	100,000	100,000	-	-	-	-
Harman Holding Ltd. Hong Kong	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2026-06-14	2027-06-13	30,000	30,000	-	-	-	-
합 계							8,103,211	8,176,639	11,639	128,114	139,753	-

※ 별도 기준입니다. [△는 부(-)의 값임]

※ 건별 채무보증금액이 자기자본의 0.1% 이상 2.5% 미만인 경우 경영위원회, 2.5% 이상인 경우 이사회 의결을 통해 결정됩니다.

※ 당사는 종속기업별 채무보증 만기, 일반적인 신용공여 조건의 이율 등을 감안하여 산정된 채무보증 수수료를 수취하고 있습니다. 당사는 2025년 중 $1,199천의 수수료를 청구하여, 2026년 수취하였습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등

당사는 2026년 3분기 중 법인의 생산설비 증설 등 목적으로 자산을 Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS) 등의 계열회사에 매각하였으며, 생산 효율화 등을 위해 자산을 계열회사로부터 매입하였습니다.

(단위 : 백만원)

법인명	관계	거래종류	거래일자	거래대상물	거래목적	거래금액	처분손익
SAS	계열회사	자산매각	2026.09.29	기계장치 등	생산설비 증설/생산효율화 등	286,377	137,329
SCS	계열회사	자산매각/매입	2026.09.23	기계장치 등	생산설비 증설/생산효율화 등	97,970	43,422
SESS	계열회사	자산매각/매입	2026.09.08	기계장치 등	생산설비 증설/생산효율화 등	27,882	1,504
SEVT	계열회사	자산매각/매입	2026.07.14	기계장치 등	생산설비 증설/생산효율화 등	1,623	94
TSLED	계열회사	자산매입	2026.04.23	기계장치 등	생산설비 증설/생산효율화 등	1,417	-
세메스	계열회사	자산매각	2026.05.20	기계장치 등	생산설비 증설/생산효율화 등	1,121	624
SEDA	계열회사	자산매입	2026.04.14	기계장치 등	생산설비 증설/생산효율화 등	400	-

※ 별도 기준입니다. [△는 부(-)의 값임]

※ 거래일자는 최근 거래일자 기준입니다.

※ 거래금액은 시장 및 가치평가 등을 거쳐 적절히 산정되었으며, 거래 다음달 15일・30일 이내 현금 지급조건 등 통상적인 조건으로 거래되었습니다.

※ 상기 자산양수도 거래는 이사회 결의 대상이 아닙니다.

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 거래금액이 1억원 미만인 경우에는 기재를 생략하였습니다.

3. 대주주와의 영업거래

2026년 3분기 중 계열회사인 Samsung Semiconductor, Inc. (SSI) 등과 매출, 매입 등의 영업거래를 하였습니다.

(단위 : 백만원)

법인명	관계	거래종류	거래기간	거래내용	거래금액
SSI	계열회사	매출입 등	2026.01~2026.09	반도체 매출 등	182,852,423
SSS	계열회사	매출입 등	2026.01~2026.09	반도체 매출 등	80,881,647
SEVT	계열회사	매출입 등	2026.01~2026.09	스마트폰 매출입 등	36,136,869
SEA	계열회사	매출입 등	2026.01~2026.09	스마트폰 및 가전제품 매출입 등	23,520,325
SEV	계열회사	매출입 등	2026.01~2026.09	스마트폰 매출입 등	18,696,114
SET	계열회사	매출입 등	2026.01~2026.09	스마트폰 및 가전제품 매출입 등	15,431,225

※ 별도 기준입니다.

※ 공시대상은 최근사업연도 매출액의 5% 이상 기준입니다.

4. 대주주에 대한 주식기준보상 거래

당사는 2025년 7월 이사회 및 산하 위원회의 결의를 거쳐 6기 장기성과인센티브(LTI)의 일부를 2025년 7월 양도제한이 없는 주식으로 지급하였으며, 당시 미지급된 수량은 2026년 7월 양도제한이 없는 주식으로 지급하였습니다. 또한, 2026년 7월 이사회 및 산하 위원회의 결의를 거쳐 7기 장기성과인센티브(LTI)의 일부를 2026년 7월 양도제한이 없는 주식으로 지급하였으며, 미지급 수량은 2027년과 2028년에 양도제한이 없는 주식으로 지급하기로 약정하였습니다.
한편, 성과인센티브(OPI)를 양도제한주식(RSA)으로 2026년 1월에 지급하였으며, 성과조건부 주식(PSU)을 가득조건 성취시 2028년부터 3년간 분할지급하기로 약정하였습니다.

(단위 : 주)

거래 상대방	회사와의 관계	부여일/ 지급일 (취소일)	명칭	신규 부여수량	누적 부여수량	당기주식 지급수량	누적변동수량		기말 미지급 수량	가득조건	지급 시기	양도 제한 기간	부여근거 및 절차
							지급	취소					
전영현	등기임원 (계열회사 임원)	2025.01.23/ 2026.01.26	'24년OPI 주식보상	5,135	5,135	5,135	5,135	-	-	-	2026.01	2년	경영위원회 결의
		2026.07.10/ 2026.07.13	7기 LTI 주식보상	31,406	31,406	10,469	10,469	-	20,937	-	2027.07 이후	-	보상위원회 결의
		2025.10.13	PSU	135,000	135,000	-	-	-	135,000	3년 후 기준주가 상승률에 따라 지급여부 및 수량 결정	2028.10 이후	-	보상위원회 결의
		2026.01.29/ 2026.01.30	'25년OPI 주식보상	10,652	10,652	10,652	10,652	-	-	-	2026.01	1년	보상위원회 결의
노태문	등기임원 (계열회사 임원)	2025.02.14/ 2026.01.26	'24년 OPI 주식보상	40,579	40,579	40,579	40,579	-	-	-	2026.01	2년	보상위원회 결의
		2025.07.25/ 2026.07.13	6기 LTI 주식보상	45,357	45,357	22,678	45,357	-	-	-	2026.07	-	보상위원회 결의
		2026.07.10	7기 LTI 주식보상	21,430	21,430	-	-	-	21,430	-	2027.07 이후	-	보상위원회 결의
		2025.10.13	PSU	135,000	135,000	-	-	-	135,000	3년 후 기준주가 상승률에 따라 지급여부 및 수량 결정	2028.10 이후	-	보상위원회 결의
		2026.01.29/ 2026.01.30	'25년 OPI 주식보상	7,299	7,299	7,299	7,299	-	-	-	2026.01	1년	보상위원회 결의
김용관	등기임원 (계열회사 임원)	2025.01.23/ 2026.01.26	'24년 OPI 주식보상	8,606	8,606	8,606	8,606	-	-	-	2026.01	2년	경영위원회 결의
		2025.07.25/ 2026.07.13	6기 LTI 주식보상	12,698	12,698	6,349	12,698	-	-	-	2026.07	-	경영위원회 결의
		2026.07.10/ 2026.07.13	7기 LTI 주식보상	10,921	10,921	3,641	3,641	-	7,280	-	2027.07 이후	-	보상위원회 결의
		2025.10.13	PSU	50,000	50,000	-	-	-	50,000	3년 후 기준주가 상승률에 따라 지급여부 및 수량 결정	2028.10 이후	-	경영위원회 결의
		2026.01.29/ 2026.01.30	'25년 OPI 주식보상	2,903	2,903	2,903	2,903	-	-	-	2026.01	1년	경영위원회 결의
신제윤	등기임원 (계열회사	2025.10.13	PSU	1,000	1,000	-	-	-	1,000	3년 후 기준주가 상승률에 따라 지급여부 및 수량 결	2028.10 이후	-	대표이사 결정후 당사자

	임원)									정			약정서체결
김준성	등기임원 (계열회사 임원)	2025.10.13	PSU	1,000	1,000	-	-	-	1,000	3년 후 기준주가 상승률에 따라 지급여부 및 수량 결정	2028.10 이후	-	대표이사 결정후 당사자 약정서체결
허은녕	등기임원 (계열회사 임원)	2025.10.13	PSU	1,000	1,000	-	-	-	1,000	3년 후 기준주가 상승률에 따라 지급여부 및 수량 결정	2028.10 이후	-	대표이사 결정후 당사자 약정서체결
조혜경	등기임원 (계열회사 임원)	2025.10.13	PSU	1,000	1,000	-	-	-	1,000	3년 후 기준주가 상승률에 따라 지급여부 및 수량 결정	2028.10 이후	-	대표이사 결정후 당사자 약정서체결
이혁재	등기임원 (계열회사 임원)	2025.10.13	PSU	1,000	1,000	-	-	-	1,000	3년 후 기준주가 상승률에 따라 지급여부 및 수량 결정	2028.10 이후	-	대표이사 결정후 당사자 약정서체결

※ 주식기준보상 약정 시점에 미등기임원인 경우에는 경영위원회 결의, 사내이사인 경우에는 보상위원회 결의에 근거하여 약정이 이루어졌습니다.

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용 진행 및 변경사항

가. 공시내용 진행 및 변경사항

(단위 : 백만 달러)

신고일자	계약내역	계약금액	변동가능성
2025.07.26	- 계약명: 반도체 위탁생산 공급계약 - 계약상대방: Tesla, Inc. - 계약기간 : 2025.7월~2033.12월	16,544	- 계약기간, 계약금액 등은 고객사 수요 및 사업 경과에 따라 변동될 수 있음 - 기 공시사항에 변동사항 발생시 별도 공시 예정임

※ 당사의 제품가격, 생산능력, 납품상황 등 영업비밀에 해당하는 정보의 누설 우려가 있는 항목 (수량, 금액, 기납품액, 수주잔고)의 기재는 생략하였습니다.

2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건 등

당사는 다수의 회사 등과 정상적인 영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 및 규제기관의 조사 등을 진행 중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 당사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

당사(삼성전자㈜, 삼성디스플레이㈜ 등)는 분할된 삼성디스플레이㈜ 등의 분할 전 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다.

그 밖의 우발부채 및 약정사항에 대해서는 'III. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표주석' 및 '5. 재무제표 주석'을 참조하시기 바랍니다.

나. 채무보증내역

(단위 : 천US$, %)

법인명 (채무자)	관계	채권자	내용	목적	보증시작일	보증종료일	채무보증한도		채무금액			이자율
							기초	기말	기초	증감	기말	
SEA	계열회사	BOA 외	지급보증	운영자금	2025-11-09	2027-06-13	1,278,000	3,575,000	-	-	-	-
SEM	계열회사	BBVA 외	지급보증	운영자금	2025-11-09	2027-08-19	715,000	580,000	-	-	-	-
SAMCOL	계열회사	Citibank 외	지급보증	운영자금	2025-11-09	2027-06-13	180,000	111,000	-	-	-	-
SEDA	계열회사	BRADESCO 외	지급보증	운영자금	2025-11-09	2027-09-30	329,000	1,071,000	-	-	-	-
SECH	계열회사	Citibank 외	지급보증	운영자금	2025-12-17	2027-06-13	64,000	50,000	-	-	-	-
SEPR	계열회사	BBVA 외	지급보증	운영자금	2025-12-17	2027-06-13	150,000	127,000	-	-	-	-
SSA	계열회사	SCB 외	지급보증	운영자금	2025-11-09	2027-06-13	286,000	122,000	-	-	-	-
SEMAG	계열회사	Citibank 외	지급보증	운영자금	2025-12-17	2026-12-16	46,000	16,000	-	-	-	-
SETK	계열회사	BNP 외	지급보증	운영자금	2025-11-09	2027-06-13	947,000	887,000	11,639	128,114	139,753	36.78%
SETK-P	계열회사	BNP 외	지급보증	운영자금	2025-11-09	2026-12-16	70,000	70,000	-	-	-	-
SECE	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2025-12-17	2026-12-16	114,000	15,000	-	-	-	-
SEEG	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2026-06-14	2027-06-13	85,000	30,000	-	-	-	-
SEIN	계열회사	BNP 외	지급보증	운영자금	2025-11-09	2027-06-13	70,000	70,000	-	-	-	-
SJC	계열회사	Mizuho Bank 외	지급보증	운영자금	2025-11-09	2027-05-31	809,211	492,639	-	-	-	-
SEUC	계열회사	Credit Agricole	지급보증	운영자금	2025-11-09	2026-11-08	115,000	-	-	-	-	-
SEDAM	계열회사	Santander	지급보증	운영자금	2025-11-09	2027-06-13	537,000	150,000	-	-	-	-
SECA	계열회사	BoA	지급보증	운영자금	2025-11-09	2026-11-08	72,000	19,000	-	-	-	-
SELA	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2025-12-17	2026-12-16	90,000	60,000	-	-	-	-
SEEH	계열회사	Citibank 외	지급보증	운영자금	2025-11-01	2027-09-05	938,400	233,000	-	-	-	-
SELV	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2025-12-17	2026-12-16	10,000	10,000	-	-	-	-
SEIL	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2025-12-17	2026-12-16	15,600	-	-	-	-	-
SAPL	계열회사	Citibank 외	지급보증	운영자금	2025-11-09	2026-12-16	404,000	35,000	-	-	-	-
SAVINA	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2026-06-14	2027-06-13	51,000	51,000	-	-	-	-
SEV	계열회사											
SEVT	계열회사											
SEHC	계열회사											
SCIC	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2026-06-14	2027-06-13	270,000	10,000	-	-	-	-
SESP	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2025-11-09	2026-11-08	30,000	10,000	-	-	-	-

SME	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2025-11-09	2026-11-08	110,000	100,000	-	-	-	-
SAMEX	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2025-12-17	2026-12-16	5,000	5,000	-	-	-	-
SEASA	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2025-12-17	2026-12-16	2,000	2,000	-	-	-	-
SSAP	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2025-11-09	2026-11-08	35,000	10,000	-	-	-	-
SEPM	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2026-06-14	2027-06-13	35,000	-	-	-	-	-
SESAR	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2026-06-14	2027-06-13	20,000	20,000	-	-	-	-
SEUZ	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2025-12-17	2026-12-16	20,000	-	-	-	-	-
Flakt	계열회사	BNP	지급보증	운영자금	2026-03-16	2026-11-08	-	60,000	-	-	-	-

법인명 (채무자)	관계	채권자	내용	목적	보증 시작일	보증 종료일	채무보증한도		채무금액			이자율
							기초	기말	기초	증감	기말	
SDN	계열회사	SIEL	지급보증	운영자금 등	2026-02-19	2029-02-19	556,979	364,640	473,432	△108,792	364,640	7.83%
Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	계열회사	SocGen	지급보증	운영자금	2025-11-09	2026-11-08	15,000	-	-	-	-	-
Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	계열회사											
Harman International Japan Co., Ltd.	계열회사	MUFG	지급보증	운영자금	2025-11-09	2026-11-08	25,000	25,000	-	-	-	-
Harman International Industries Limited	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2026-06-14	2027-06-13	30,000	30,000	-	-	-	-
Harman International Industries Inc.	계열회사	JP Morgan	지급보증	운영자금	2026-06-14	2027-06-13	100,000	100,000	-	-	-	-
Harman Holding Ltd, Hong Kong	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2026-06-14	2027-06-13	30,000	30,000	-	-	-	-
SAS	계열회사	Epcor	지급보증	운영자금 등	2022-04-26	채무소멸시	275,000	275,000	-	-	-	-
SEA	계열회사	US Government	지급보증	보조금	2024-12-20	채무소멸시	6,435,000	6,435,000	-	-	-	-
합 계							15,370,190	15,251,279	485,071	19,322	504,393	-

※ 연결 기준입니다. SDN 건은 삼성디스플레이㈜, SAS 건은 SEA가 각각 채무보증인입니다. [△는 부(-)의 값임]

※ 건별 채무보증금액이 자기자본의 0.1% 이상 2.5% 미만인 경우 경영위원회, 2.5% 이상인 경우 이사회 의결을 통해 결정됩니다.

또한 종속기업인 삼성디스플레이㈜의 경우 건별 채무보증금액이 100억원 이상인 경우 이사회 의결을 통해 결정됩니다.

※ 상기 채무보증에 대하여 당사가 보증하는 채무보증의 대가로 종속기업별 채무보증 만기, 일반적인 신용공여 조건의 이율 등을

감안하여 수수료를 수취하고 있습니다.

당사는 2025년 중 $1,199천의 수수료를 청구하여, 2026년 수취하였습니다.

한편 삼성디스플레이㈜는 SDN에게 2025년 중 $2,841천의 수수료를 청구하여 2026년 수취하였습니다.

※ SEA의 US Government 채무는 SAS가 반도체 보조금 계약 불이행시 미 상무부에 반환해야하는 금액에 대한

모법인의 지급보증 계약입니다.

3. 제재 등과 관련된 사항

제재 등과 관련된 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기・사업보고서에 기재 예정)

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기・사업보고서에 기재 예정)

XII. 상세표

1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

연결대상 종속회사 현황(상세)는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기・사업보고서에 기재 예정)

2. 계열회사 현황(상세)

계열회사 현황(상세)는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기・사업보고서에 기재 예정)

3. 타법인출자 현황(상세)

타법인출자 현황(상세)는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기・사업보고서에 기재 예정)

4. 연구개발실적(상세)

☞ 본문 위치로 이동

부문		연구과제 등	연구결과 및 기대효과 등
DX 부문	영상 디스플레이	Micro RGB (~2026.06.)	□ Micro RGB LED 기반 4K TV(115인치) - MR95F(115인치) - Micro RGB Technology 사용하여 향상된 색 정확도와 세밀한 명암 표현 (Micro RGB Matrix Plus), 높은 색 정확도, Glare Free, VRR 4K 144Hz 적용으로 당사만의 품격 있는 화질과 실제의 Object를 보는 듯한 심도 높은 화질 제공 - R95(65・75・85인치) : Micro RGB 기술 적용 통한 컬러 표현력 강화 및 시청 몰입감을 강조하는 프리미엄 디자인, WOC Ready 솔루션으로 완성되는 진정한 Flagship만의 가치를 제공하는 Micro RGB TV 최상위 모델 (Micro RGB Technology, Micro RGB Color Booster Pro, Glare Free, VRR 165Hz 적용, Real Top 스피커 통한 Object Tracking sound+ 및 AI 기반 객체 분리 기술 적용, 초슬림 베젤(SNB) 전면 디자인 및 들뜸 없이 벽에 초밀착되는 Zero Gap Pocket 설계와 WOC Ready 통한 무선 연결 지원) - R85(65・75・85・100") : Real Micro R/G/B를 사용하여 최상의 컬러 경험을 제공하면서도 시장 내 Micro RGB 신규 카테고리의 성공적인 안착 및 물량 증대를 위한 Essential 모델 (Micro RGB Technology, Micro RGB Color Booster Pro, VRR 144Hz 적용, Object Tracking Sound Lite 및 AI 기반 객체 분리 기술 적용, QN80 플랫폼 사용으로 원가 절감 효과 극대화,강성 있는 느낌을 제공하는 Solidity 디자인 적용)
		Neo QLED 8K (~2026.06.)	□ Mini LED 기반 초고화질 & 슬림 8K TV - QN900 (65・75・85・98") / QN800 (65・75・85") / QN700 (55・65・75") / QN60 (65・75・85") - 세밀한 Mini LED의 향상된 명암비로 더욱 실제를 보는 듯한 QLED 8K 화질 - Neural Quantum Processor 8K 적용하여 입체감과 현실감 있는 시청 경험 제공 - OTS(Object Tracking Sound) 기능으로 공간을 감싸는 입체감 있는 음질 경험 제공 - 8K Wireless One Connect Box, 8K AI Upscailing Pro, AI HDR Remastering Pro, AI Motion Enhancer Pro, 8K 120Hz 4K 240Hz VRR을 적용한 QN990F 도입 - Tizen 10.0 적용 QN990H 도입
		Neo QLED 4K (~2026.03.)	□ Mini LED 기반 4개 시리즈, 9개 사이즈 (43・50・55・65・75・85・98・100・115") - Mini LED 적용을 통한 Slim 구현 및 Bezel-less/Metal를 통한 디자인 프리미엄 Look - Quantum Nano-Layer Multi-Cell 구조를 적용하여 Slim하면서도 높은 광 효율과 광 Profile 조절이 가능한 New LED - 장르별 선호 화질 선택 時, AI 활용하여 장르별 맞춤형 화질 변환 - 편리한 사용성 제공하는 New Home을 통해 빠른 진입점 및 추천경험 제공 - NQ5 SI Gen3 Processor 적용을 통한 강화된 AI 기능 제공(QN90F) (Live Translate, Click to Search, Home Insight 등) - Glare Free, VRR 4K 165Hz 적용 (QN90F)
		OLED TV (~2026.03.)	□ Quantum Dot 기반 self-emitting Display Flat 4K TV (55・65・77") - S95 (55・65・77") : 165Hz VRR 적용된 QD-OLED Display와 OLED Glare Free 적용된 True Reality 화질과 Ultra Slim Flat 폼팩터에 Top Speaker가 내장된 Infinity One Design에 Object Tracking Sound 및 ATMOS 까지 모두 적용된 진정한 TV 가치를 제공하는 OLED TV '26년형 : 벽에 완전히 밀착되는 프리미엄 디자인(Dual Plate Design)과 WOC Ready 솔루션 적용

			- S90 (55・65・77") : Neo QLED 外, 삼성 OLED 라인업 강화하여 Premium TV 시장 內 포지셔닝 확대를 위해 144Hz VRR 적용된 OLED Display의 화질과 Laser Slim Design에 OTS Lite 및 ATMOS 적용으로 부족함 없는 입체 사운드 경험을 제공하는 OLED TV - NQ5 SI Gen3 Processor 적용을 통해 강화된 AI 기능 제공(S90/S95F) □ White OLED 기반 self-emitting Display Flat 4K TV (42・48・55・65・77・83") - S95 (83") : 상동 '26년형 : 벽에 완전히 밀착되는 프리미엄 디자인(Dual Plate Design)과 WOC Ready 솔루션 적용 - S90 (42・48・55・65・77・83") : 상동 - S85 (55・65・77・83") : OLED 판매 확대 및 손익 개선 중심의 신규 라인업으로 기획된 White OLED Display와 최후부까지 곡선으로 날렵하게 이어지는 Contour Design에 OTS Lite 및 ATMOS 적용으로 부족함 없는 입체 사운드 경험을 제공하는 OLED TV
		Neo Mini LED TV (~2026.06.)	□ Neo Mini LED 기반 2개 시리즈, 7개 사이즈 (43・50・55・65・75・85・100") - M80(55・65・75・85") / M70(43・50・55・65・75・85") / M90(100") □ 기획 배경 : Mini LED 적용 기반 신규 제품 카테고리 창출로 경쟁사 Fak-QD 대응 강화 □ 사양 및 효과 - Mini LED+고색(KSF) 적용 기반 광효율 및 컬러 재현력 개선을 통한 화질 강화 - 인도 지역 특화 사운드 강화(20→30W) 추가 도입 - 메탈 기반의 디자인으로 세련되면서 단단한 이미지 제공 - AI 통한 생생한 컬러 제공과 Contrast 강화 및 AI 스마트 기능 지원(M80)
		QLED TV (~2026.03.)	□ Flat QLED 4K TV (32・43・50・55・ 60・65・70・75・82・85・98") - 4K 최고의 화질(AI/밝기/시야각) 및 음질(OTS)을 통한 시청 경험을 극대화한 Flagship QLED - 최고의 명암비, 시야각 Free, Life-like 컬러와 최적의 밝기로 몰입감을 극대화 - 음성인식 및 AI 기술 기반으로 외부 환경 및 사용자 Context를 인지하여 최적의 시청 경험 제공 - 고가의 전문 장비 없이 모바일로 손쉽게 TV 화질을 Calibration - Game Bar를 통한 캐주얼 게이머들을 위한 게임 경험 확대 - Art Store x Ambient 서비스 통합 및 도입 확대(QLED 이상), AI SoC 탑재(Q7F↑)
		UHD TV (~2026.09.)	□ Flat UHD TV (43・50・55・58・60・65・70・75・85・98 ") □ Slim한 Bezel-less 디자인과 실제 자연색에 가까운 Color를 제공하는 UHD Smart TV □ 사양 및 효과 - Dynamic Crystal Color 및 Dual LED를 통해 원본 컨텐츠의 화질을 그대로 표현하는 UHD 화질 - Multi-media Screen 경험 제공, 풍부한 컨텐츠, Smart Home의 경험을 통해 완성된 Smart 경험 제공 - Game Hub, IoT Hub, Chat Together, Voice Ready, Daily+, SmartThings Mobile Plugin 기능 추가를 통한 Smart 경험 강화 - 인도 지역 특화 사운드 강화(20→30W) 추가 도입(43・50・55・65 ") □ Flat FHD/HD TV (24・27・32・40・43・50") - 3면 Bezel-Less 디자인, Full Screen UI 반영하여 확장된 경험을 제공하는 FHD/HD Smart TV
		Lifestyle TV (~2026.06.)	□ The Sero (43") - Modern & Simple 한 세로형 Screen에 판상형 Speaker가 부착된 360도 Design - 다양한 거주공간 어디에도 쉽게 거치 가능, 이동 가능한 Floor 스탠드 제공 - 기울어진 폼팩터에도 외광/실내 조명 반사 없는 화질로 기존 제품의 VoC 대폭 개선 □ The Frame (32・43・50・55・65・75・85") - Real 액자 디자인 및 액자 설치 경험 완성 - 다양한 명화, 사진 등 감상 가능, 인테리어와 조화로운 Lifestyle 디자인 채용 - 초대형 Life Style 제품 Needs에 따른 85" 추가도입 - 외광/실내 조명 반사 없이 항상 종이와 같은 질감을 표현하는 화질로 Real Frame 경험 완성 - 4K Wireless One Connect Box 적용한 QFLS03W 도입 - 기존 무선OC/유선OC에 더해 Built-in Type 연결 솔루션 적용한 QHLS03M 도입

			□ The Serif (43・50・55・65") - 'I' 형태 Serif Font 디자인으로 확실한 차별화 및 인테리어 감성 극대화 - 대형 사이즈 제품 포지션 확대를 위한 65" 추가도입 - 외광/실내 조명 반사 없이 항상 매트한 질감을 표현하는 화질로 가구와 같은 디자인 완성 - White 외 Dark계열 신규컬러(Ivy Green) 옵션 제공 □ The Terrace (55・65・75") - 옥외에서 휴식과 Entertainment를 동시에 즐기려는 Lifestyle 대응을 위한 차별화된 제품 □ The Premiere (100~130") - 초단초점・레이저・고화질 폼팩터에 업계 최고 Smart UX/OTT 경험 제공 - Blended 디자인으로 벽 근처에 쉽게 놓고 원하는 공간에 적합한 사이즈로 투영 - 당사 TV의 완성된 콘텐츠 경험과 차별화된 화질・음질을 제공하는 프로젝터 □ The Freestyle (30～100") / Freestyle Rev (30～100") - 언제 어디서나 다양한 컨텐츠를 쉽게 감상할 수 있는 Movable Smart Screen - 다양한 공간에 쉽게 놓이며 각도/거리에 상관없이 최적 시청 경험 제공(Auto Focus/Auto Keystone) - 기본 Cradle로 다양한 공간에 거치 사용성이 추가되고 소켓을 통해 신규 설치 확장도 가능
		더 무빙스타일 (~2025.09.)	□ 더 무빙스타일 (UFLSM7K 27 인치) - 언제 어디서나 내가 원할 때 원하는 공간에서 사용할 수 있는 Detachable Companion Screen - 전원선 연결 없이 스크린 단독으로 3시간 사용 가능한 배터리 탑재 - 누구나 사용할 수 있는 Touch Screen
		Sound Bar (~2026.03.)	□ Sound Bar Q990B - 업계 최초, TV에서 사운드바로 무선 ATMOS 전송(Wireless ATMOS) - TV와 Soundbar의 모든 채널을 활용하여 극장과 같은 최상의 Cinema True ATMOS 제공 - 사운드바 자체 공간 보정 기술 탑재 □ Sound Bar Q990F - AI 기술을 이용한 Immersive 사운드 최적화 경험 제공 - 고음질 음향 코덱(RAAT, IMAF) 신규 적용, Roon Ready 인증 - Dual Unit Low-vibe Compact Woofer 탑재한 저진동 출력개선 □ Wi-Fi Speaker SBLS70H - 집 안 인테리어에 녹아들 수 있는 사운드 오브제로, 에르완 부흘렉의 디자인을 가미한 ORA - 4가지 방향 스피커 유닛 탑재 음향 구조 및 waveguide/pattern control 적용한 3D 사운드 - 26년 Q-symphony를 통해 연결성 강화된 Wi-Fi Speaker - 음악 감상에 특화된 사운드 모드와 instant play 버튼 제공
		모니터 (~2026.06.)	□ 스마트 모니터 M80B (32") - 초슬림, Flat Back, Warm White 컬러 적용 Lifestyle 디자인 - Magnetic 방식의 전용 카메라 In-box 영상 커뮤니케이션 - 스마트 경험 강화(VOD 시청/모바일 연결/PC-less기능/IoT/Communication/Game) □ 게이밍 모니터 G85NB (32") - 세계 최초 UHD 240Hz 1ms(GTG) 최고 게이밍 성능 모니터 (1000R Curved) - 새로운 수준 화질 경험을 제공하는 Odyssey Neo (Mini LED, Quantum HDR2000) □ 세계 최초 1000R 대형 게임 스크린 G97NB (55") - 1000R, 16:9, 55" Big Curved Screen으로 근접 환경에서도 시야각 제약 없는 최대 사이즈 화면으로 최고의 몰입감 제공 - 세로로 회전하고 자유로운 각도 조정으로 우주선 조종석에 앉은 것 같은 새로운 몰입 경험 제공 - 4K 165Hz 입출력 및 반응속도 1ms까지 지원 가능한 게임 전용 패널 □ QD-OLED 게이밍 모니터 (G85SB 34") - True RGB 자발광 Display와 Quantum Dot 기술의 조합으로 다양한 컬러를 정교하게 표현 - 0.1ms 최고 응답속도, 175Hz 주사율로 보다 깨끗한 화면으로 게임 플레이 가능

			- Gaming Hub 적용으로 Cloud Game, 콘솔 등 All-In-One Game Discovery Platform 도입 □ 5K 초고해상도 모니터 (S90PC 27") - 4K 대비 50% 이상 더 많은 픽셀로 더 많은 정보를 담는 5K(5120X2880) 해상도 - 모니터 후드 없이도 빛 반사를 줄여 화면 왜곡을 없애고 눈을 보호하는 Matte Display - MAC/Windows 모두 만족하는 Thunderbolt 4 및 miniDP 제공 - 나의 작업/ 일상/ 공간에 맞춰 활용하는 '스마트스크린' □ DUHD Flagship Gaming 모니터 (G95NC 57") - 신규 57”초대형 폼팩터 및 초고화질 Dual UHD(7680X2160)을 통한 '극한의 몰입감' 제공 - 240Hz 주사율, 1ms 최고 응답속도로 보다 깨끗한 화면으로 게임 플레이 가능 □ 무안경 3D Gaming 모니터 (G90XF 27”) - 3D 전용 안경 없이, 3D 컨텐츠 경험을 통한 몰입감 제공 - 2D ↔ 3D 전환 및 3D 진입을 위한 별도 SW (Reality Hub) 제공 - 165Hz 주사율, 1ms 최고 응답속도 통해 보다 깨끗한 화면으로 게임 플레이 가능 □ AI 4K OLED 스마트 모니터 (M90SF 32”) - AI Features (AI Explore, AI Picture) - 4K OLED 32”165Hz - Super Slim Design (6.9mm) □ 세계 최고 주사율 게이밍 모니터 (G60SF 27") - 최고 주사율 500Hz, 0.03ms 최고 응답속도 - QD-OLED, VESA DisplayHDR TrueBlack 500 인증 □ 세계 최초 초고해상도 게이밍 모니터 (G80HS 32") - 초고해상도 6K(6144x3456) 적용을 통한 사실적인 화질 표현 - Dual Mode(6K 165Hz/3K 330Hz)통해 적합한 게임 타이틀 혹은 장르별 최적 모드로 게임 플레이 가능 - 1ms (GTG) 응답 속도 및 Display Port 2.1 적용 □ 4K QD-OLED 게이밍 모니터 (G80SH 27・32") - True RGB 자발광 Display 와 Quantum Dot 기술의 조합으로 다양한 컬러를 정교하게 표현 - 픽셀 단위로 광원을 조절하므로 깊은 블랙 표현 및 Halo Free 가능, True Black 화질 구현 - 0.03ms 최고 응답속도, 240Hz 주사율로 보다 깨끗한 화면으로 게임 플레이 가능 □ WUHD 고해상도 모니터 (S85TH 40") - 21:9 WUHD(5120X2160) 더 많은 정보 제공과 1000R로 눈에 편안한 화면 제공 - Thunderbolt5(140W) & Easy Connection □ 5K 고해상도 모니터 (S80HF 27") - 5K 초고해상도(5120X2880):4K 比 77% 더 많은 정보량 제공하는 5K 해상도로 4K 대비 생산성 향상 - USB-C(90W), LAN, USB-Hub : USB-C와 다양한 단자 제공으로 Clean Desk 환경 및 편의성 제공
		사이니지 (~2026.06.)	□ LCD 기반의 B2B향 Smart Signage (Standalone, Hotel-TV, Video Wall, Outdoor, Biz-TV 등) - 인치 : 13・24・32・43・49・50・55・65・75・85・98" - 라인업 확장(인치/사양 등) : Standalone(QHFX) 115" □ LED 소자를 활용한 Indoor / Outdoor 사이니지 / LED S-box(LED control box) - 신규 S-box 추가 : CS4F/CJ4F □ All-in-one Kiosk (24") : Tizen向 결제모듈/주문 등 부가 장치 일체형 결제 플랫폼 □ 교육용 전자칠판(FLiP 5.0) : WMFX 55・65・75・85 - 4K 그래픽 지원, 판서 경험 개선(Vector Drawing 지원), SmartThings Pro 지원 및 AI 기능 지원 □ The Wall / AIO(All-in-one) / Micro-LED B2B향 (CoB 기반) - IWC/IAB 등 CoB기반 프리미엄 LED 모듈형 사이니지 - 외자모듈 제품 추가 : MMF/MMF-A(2025.04), MPF(2025.09) □ 시네마향 LED 사이니지(ICD) - 기존 제품(ICH P3.3/2.5) 신규 전환, 신규 Pitch 추가(P1.25)/확장설치 Upscaling 기능 추가

			□ E-Paper (EMDX 32") : 포스터/액자 등을 정지 이미지를 사용하여 디지털 전환 - 13" 라인업 추가, 사용성 개선(저전력 wifi, 버튼으로 배터리 shipping mode 해제 등) □ Spatial Signage (SMHX 32・85") - 3D Plate 적용하여 2D Detail과 3D 깊이감을 동시에 제공, 컨텐츠 內 물체와 배경 컬러 및 그림자 효과 間 조합
		프로젝터 (~2026.06.)	□ Freestyle(2021.01) / Freestyle Rev.(2023.06) - 언제 어디서나 다양한 컨텐츠를 쉽게 감상할 수 있는 Movable Smart Screen □ Premiere 7 Rev./ Premiere 9 Rev.(2024.06) : 2020년 출시제품 성능/기능 개선 □ Premiere 5 (2025.03~) - Triple Laser의 선명한 화질 기반 확장된 Screen 경험, 컴팩트한 디자인의 오브제 프로젝터 □ The Freestyle+ (2026.06~) - Freestyle KBF인 휴대성/180도 크래들 경험 유지下 신규 Skin 디자인과 AI 경험 적용한 신모델
	생활가전	냉장고 (~2026.04.)	□ 한국향 초격차 에너지 모델 도입(초절전 1등급, 1등급-22%달성) - 세계 최고 효율 압축기 적용 (W1, EER 9.3) - Set 열부하 저감(VIP Coverage 증대) - 기계실 방열 증대(Comp 측 Side Cool 추가) □ Global Wide BMF 냉장고 - 고효율 에너지 등급 및 AI Energy mode 적용, 에너지 비용 절감 - SpaceMax 적용으로 내용적 확대로 수납 편의성 - SmartThings 기반 시간대별 고내 조명 자동 조절 등 Smart 서비스 제공 □ 중국 가옥 맞춤 냉장고(W83cm) - 좌우 제로갭 설치로 주방 공간에 딱 맞게 빌트인처럼 매끈하게 설치 가능 - AI에너지 모드 적용으로 실사용 에너지 절감(중국에너지 1등급) - 최적 온도와 습도에서 전문적으로 식재료 특화 보관 제공(건습/보습 Box) - Wide Open 자동 도어 열림 기능 적용 □ Peltier 적용 냉장고 - Peltier 적용 및 폐열 활용을 통한 최고 효율 및 에너지 등급 달성 - 2개 냉각방식(Comp+Peltier)의 장점을 결합하여 소비자 Value 창출 ・ 1등급 -30% 에너지 달성 (기존 1등급 -22%) ・ Peltier 냉각 시스템 Compact化로 내용적 확보(기존 875L → 900L) □ 유럽 Built-In BMF 냉장고 - 유럽향 빌트인 BMF 대용량(380리터 ↑) 최고 에너지 등급 달성 - AI Energy 적용, 동급比 10% 이상 실사용 에너지 절감 - Full 간냉 및 [냉동→냉장 전환] 기능 제공 □ 한국 4Door 김치냉장고 도입 (소분/숙성 기능 장착) - 식재료 소분 저장/저온 숙성 가능한 별도 공간 제공 ・ 김치숙성, 육류해동, 반죽발효 등 다양한 모드로 활용성 강화 - 개정 에너지 규격 기준 1등급 고효율 모델 도입 □ 한국 오토 오픈 4Door 김치냉장고 도입 - Auto Open Door 적용으로 사용 편의성 강화 - 냄새 저감 김치통 적용으로 다양한 식재료 보관 가능 - 숙성, 해동, 발효 가능한 맞춤숙성실 제공 □ 인도 에너지 규제 대응 TMF 냉장고 - 외관 디자인 변경 (Flat Door 적용) - AI Energy Mode 적용(전 모델 Wi-fi 적용 및 통합 PBA 반영) □ 북미향 36인치 FDR 냉장고 - AI HOME을 통한 MDE 경험 제공 및 소비자 맞춤형 최적 컨텐츠 제공

			- 32인치 패밀리허브를 통한 대화면 스크린 - 양손을 자유롭게 하는 Auto Open Door □ 글로벌 36인치 T-Type FDR 냉장고 - 9인치 LCD 및 Bixby LLM으로 소비자의 상황에 맞춰 가장 필요한 최적 컨텐츠 제공 - AI Vision Inside 2.0, 자동인식 식품 확대 - AI 하이브리드 대체로 용량 및 에너지 우위 강화 - 양손을 자유롭게 하는 Auto Open Door - 무발포 도어 및 제로갭(키친핏)_3월 도입 □ 한국 무발포 Door 적용 FDR 냉장고 - 무발포 도어 및 제로갭, AI 하이브리드 쿨링 □ 한국 4Door 김치냉장고(제로캡 키친핏) - 4mm 제로갭 설치 적용(좌우 설치갭) - 음성 제어로 더 편리해진 사용성: 오토오픈도어, 빅스비 음성 제어 - 김치 유산균 숙성 모드로 김치맛 전문성 강화 □ 글로벌 1Door 냉장고/냉동고 - 자동 문 열림 기능 적용하여 사용자 편의성 개선 - 유럽 식생활에 맞는 식재료 분리 보관 수납 개선 - Duct와 Door에 Metal Cooling을 적용하여 신선 보관 □ 한국 36인치 T-Type FDR 냉장고 - 덜 닫혀도 안심되는 오토 오픈&클로즈 도어 - Gemini 기반 식품 종수 제한없이 인식하는 AI Vision - 하이브리드 쿨링으로 더욱 효율적인 에너지 사용, 초격차 에너지 1등급-35% □ 북미/중남미향 3Door FDR 냉장고 - Zero clearance fit (제로 클리어런스 도어)로 설치와 사용이 더욱 편리해진 FDR - 내외관 신규 디자인 : 신규 디스펜서, 핸들 및 플랫 덕트, 라이팅 개선 - 외장 디스펜서와 Sphere Ice 적용을 통한 Water & Ice 기능 강화
		세탁기 (~2026.03.)	□ BESPOKE 그랑데AI 원바디 Top-Fit - 한국향 BESPOKE 그랑데AI 일체형 Washer - 세탁기(21kg)와 건조기(17kg) 일체형 원바디 디자인 - 심플한 플랫 디자인 □ 세탁건조기 BESPOKE AI 콤보 - ONE 솔루션 : 세탁물 이동없이 편리하게 하나로 세탁건조 - AI 홈 : 터치화면 및 음성인식으로 간편하게 세탁건조 - AI 맞춤코스 : 세탁물에 맞는 최적의 코스로 작동 □ SSEC 24”9kg Slim 콤보 - Space Max 기술 적용: 좁은 주거 환경에서도 대용량 9kg을 한번에 세탁 - AI Energy Mode: 전기 에너지를 한층 더 절감 (AI Energy 사용시 70% 절감) - Ductless 타입 콤보 플랫폼으로 건조 시간 기존 대비 최대 50% 절약 - AI Wash, AI 에코버블, Flex Auto Dispenser 등으로 세탁성능 및 사용 편의성 강화 □ 북미 27”Vent 콤보 - Vent 건조 방식을 적용 - "All-in-one 컨셉" 및 "AI Home" 등으로 소비자 사용 경험 개선 - AI Optiwash&Dry로 소비자의 관여를 줄이면서 최적화된 코스 제공 - Auto Open Door 및 Easy Lint Clean 필터 등으로 차별화 POD 제공 □ Bespoke AI 3세대(7”AI Home) - 글로벌향 3세대 비스포크 세탁기(결합형/분리형) - 7”대화면 AI Home 및 Bixby 음성 제어

			- AI 맞춤 세탁/건조로 옷감 감지 기술 고도화 - 최대용량 세탁/건조 용량 제공으로 대용량 세탁물 케어 니즈 충족 □ Bespoke AI 콤보 Infinite - Infinite 디자인 적용을 통한 초프리미엄 라인업 확보 - 매립형 도어 디자인 및 터치 도어 디자인 - 필터 청소성 개선, 건조영량 확보(15kg→18kg) □ 유럽/글로벌 Slim 세탁기 - 에너지 개선 A등급, EcoBubble 기술 활용, 전력 소비량 절감 (최대 70%↓) - 포질감지 세탁 알고리즘 통한 옷감 손상 개선 - EcoBubble과 BubbleShot으로 세탁시간 단축 □ Bespoke 3세대 Mass(2.8"LCD) - 스마트 다이얼(2.8"LCD+JOG) 적용된 3세대 비스포크 결합/분리형 - AI맞춤세탁+,AI진동소음 시스템 적용을 AI 기능 강화 - 세자투, 오토오픈도어 □ 3세대 Bespoke AI 콤보(7"LCD) - 국내 유일, 최대 용량 콤보 세탁 25kg/건조 18+kg - 세탁부터 건조까지 79분↓ 달성(*쾌속 코스 3kg DOE기준) - 세제자동투입, 오토오픈도어+,이지린트필터, AI맞춤세탁/건조+코스, AI맞춤추천
		건조기 (~2026.08.)	□ 글로벌 3세대 비스포크 HP 건조기 - 대화면(7") AI Home 및 Bixby 음성제어 - 최대용량 세탁/건조 용량 제공으로 대용량 세탁물 케어 니즈 충족 - AI 맞춤 세탁/건조+로 옷감 감지 기술 고도화 (업계 최고 수준) □ Bespoke 3세대 Mass(2.8"LCD) 건조기 - 스마트 다이얼(2.8"LCD+JOG) 적용된 3세대 비스포크 결합/분리형 - AI맞춤 건조를 통한 기능 강화 - 오토오픈도어, 열교환기 직수세척(결합형) □ Bespoke 3세대 프리미엄 디자인(7"LCD) 건조기 - Bespoke 3세대 디자인 적용 - AI Wash+ & Dry, 7"LCD 적용 □ 유럽 F-Gas 규제 대응 친환경 냉매(R290) 건조기 - 친환경 냉매 R290, 에너지 B등급, Hygiene Care - Optimal Dry, Quick Dry 35'
		에어컨 (~2026.07.)	□ 유럽 EHS 신형 플랫폼 적용 및 라인업 강화로 매출 확대 - 저소음 규제 대응 : 독일을 중심으로 유럽 국가별 소음 규제 확대 대응 - 저온 성능 강화 : -25℃외기에서 정격 난방 성능 100% 구현 - 고온 토출수 : Heat Pump 단일 사이클 최고 70℃ 토출수 구현 - 디자인 차별화 : 주거 환경에 조화를 이루는 Dark 색상 계열의 1FAN 실외기 □ BESPOKE 무풍에어컨 윈도우핏 - 방안에서도 직바람 없이 시원한 무풍 냉방 - 진동과 소음을 줄여 숙면을 도와주는 32 dB 저소음 모드 - 상황에 맞춰 선택하는 고효율 에너지 맞춤 절전 - 더 강력한 냉방 성능과 더 커진 팬으로 골고루 시원하게 대용량 강력 냉방 - 빈틈없이 쉽고 안전하게 간편 안심 설치킷 □ Infinite Line 1Way BESPOKE 무풍 시스템에어컨 - 자연스럽게 공간의 무드를 만들어내는 은은한 간접조명 엣지 라이팅 - 고효율 에너지 맞춤절전 와이드 무풍 - 공기질부터 내부 관리까지 케어 8단계

			- 상황에 맞춰 선택해 에너지를 절감하는 AI 절약모드 □ 유럽 EHS 신 냉매(R290) 신규 플랫폼 - 2027년 냉매 규제에 따른 신 냉매(R290) 솔루션 대응 - 보일러 시장 대체를 위한 고온 토출수 구현 (Max 출수 75℃) - 저소음 구현 (최저 35dB(A)) □ 유럽 EHS 하이드로 유닛(탱크 일체형 및 벽걸이형) 실내기 개발 - 통합 Energy 관리 솔루션/고객 사용경험 및 편의성 향상(CX-MDE 기반 에너지 절전) - AI Energy 및 업계 최고 급탕효율 성능으로 경쟁사 比 연간 소비 전력량 15% 절감 - Slim Fit 설계로 유럽내 증가하고 있는 공동 주택(아파트 등) 수요 선점 대응 □ 시스템 에어컨 주력 상품인 DVM S의 혁신 고효율 신규 플랫폼 도입 - 캐나다內 Top 에너지 효율 달성(경쟁사 제품比 IEER 효율 경쟁력 리더쉽 확보) - 캐나다內 최대 용량 달성(단일 Set 최대 20Ton, D社 단일 Set 최대 14Ton) - 캐나다內 최대 난방 운전 온도 범위 ・ 당사 -30~24℃, D사 -25~16℃, X사 -30~16℃ □ 모듈 고효율화 및 실외기 신규 개발을 통한 RAC 경쟁력 확보 - RAC 전모델 Smart 기능 (AI절전) 및 DC화를 통한 제품 경쟁력 확보 - 부품 종수 감축을 통한 원가 경쟁력 제고 - 9/12K STD급 실외기 체적 경쟁력 확보(기존 104리터 대비 85리터, 체적 19%) - 이태리 에너지 보조금 조건 충족 - Twin 압축기 적용으로 진동, 소음 저감 및 저부하 운전 영역 확대 □ 북미 냉매 규제 시행 ('25.1.1 통관 기준 시행)에 따른 R32 신모델 도입 - Wi-Fi BLE 기능 적용 - 습도 센서를 이용한 쾌적 제습 운전 □ 주거용 통합 쾌적 시스템에어컨 실내기 도입(AI에어콤보제품) - 환기/청정+시스템에어컨 연동 정온 제습 기술 결합, 주거용 통합 공조 솔루션 제공 - 온도/습도 분리 제어로 과냉방 없는 쾌적 솔루션 제공, 최대 40% 에너지 절감 - AI에어콤보+DVM Home 연계를 통한 한국 주거용 시스템에어컨 경쟁력 강화 □ 동남아 R32 냉매적용 냉전 모델도입 - 동남아 경쟁사 냉전 모델 R32 냉매 적용 제품 도입 - 당사 동남아 R410A 적용 중으로 GWP가 낮은 R32로 전환 필요 - 태국은 R32 냉전 '23.4Q 도입 → R32냉전 플랫폼 횡전개(동남아) □ 북미 R32 MONO HT Quiet 라인업 도입 - 북미 화석 연료 규제/친환경 정책으로 '28年까지 16% 고성장 전망 - 유럽比 대형 주택 비중이 높은 북미 시장 대응, 정격 용량 상향 (14kW → 16kW) - 경쟁사比 효율/소음/토출수 온도/난방 운전 범위 우위로 북미 AWHP 시장 선점 추진 □ 북미 유니터리 시장의 R454B 냉매 전환에 따라 Hylex R454B 냉매 적용 신모델 개발 - Full 라인업 운영 통한 고효율 / Entry 시장 동시 공략 - 접점 통신 방식으로 비통신 실내기 조합 확장 가능 (Flexibility) - SmartThings 통한 원격 제어 및 모니터링 등 차별화 신기능 제공 (Connectivity) - 제품 교체 시 기존 배관/전선 재사용 (Easy installation) □ FAC 신규 디자인 제품 출시 - 초 Slim Body로 거실 내 설치 공간 최소화 및 조화로운 인테리어 연출 - 핵심 속성별(바람 모드, 냉방 타입, 공기청정, 위생) 소비자 Needs 충족 - 내부 고객 Value Up ・제품 디자인/효율/POD 강화하여 RRP 400만원 이상 프리미엄 매출 확대 ・플랫폼 표준화(3종→1종)를 통한 제조 및 원가 경쟁력 강화 □ 한국향 EHS 히트펌트보일러

			- 재생에너지 활성화 방안으로 난방 전기화 시범사업(열히트펌프 보급) - EHS R32 MONO HT Quiet 라인업 한국 도입 - 겨울철 난방이나 급탕에 충분한 최대 70℃ 온도 제공 - 일상에 방해없는 저소음 운전 □ 북미/유럽 DVM S Mini HP 모델 - 북미/유럽 냉매규제 대응을 위한 R32 적용 신모델 - 안전성/설치성/기능 등 제품 경쟁력 확보
		청소기 (~2025.03.)	□ BESPOKE 제트 AI 청소기(최고 흡입력 280W) - 흡입력 및 원조 POD(청정 스테이션) 지속 강화 및 M/S 강화 - 280W 세계최고 흡입력 구현으로 강력하고 깨끗한 청소 - 최적의 청소 모드를 자동으로 설정하고 자가 진단으로 유지보수 가이드 제공 □ 스틱 청소기 제트 4.0 고온 세척 브러시 - 고온수를 스프레이 형태로 오염물에 직접분사하는 물걸레 브러시 - 약 50℃ 이상의 고온수를 바닥에 직접 분사, 효과적으로 찌든 때 제거 - 20초 내외의 짧은 예열 시간, 하나의 배터리로 최소 30분 이상 사용 - 추가 배터리 없이 1.51kg의 가벼운 물걸레 무게로 편리하게 청소 □ 한국향 건습식 로봇청소기 BESPOKE AI 스팀 - 건습식 독립 청소/AI 바닥 인식 /AI 사물인식 - 자동 착탈 가능한 회전형 물걸레 및 카펫 오염 방지를 위한 물걸레 Lifting - 스팀 살균까지 가능한 걸레 자동 세척/건조 청정 스테이션 □ 400W 흡입력 스틱 청소기 - 세계 최고 수준인 400W 압도적 흡입력으로 강력한 청소 성능 제공 - HEPA Filtration적용으로 미세먼지 배출 걱정 없는 깨끗한 청소 보장 - AI 모드2.0 으로 청소 환경 인식하여 최적의 청소 성능 제공 및 배터리 사용량 절감 - 무게는 가볍게 청소 면적은 더 넓게 적용한 액티브 슬림 브러시 - 에어 블로워 : 눈에 보이지 않는 먼지까지 손쉽게 청소
		오븐 (~2026.04.)	□ 가스오븐 북미 Gas Slide-In Range - 스테인리스 중심의 Premium 스타일로 디자인 경쟁력 강화 - Bar Type 의 신규 디자인 핸들 - Air fry mode 확대 □ 전기오븐 북미 Radiant Slide-In Range - 전면 컨트롤부 Black Glass → Stainless Steel 적용(Pro-Style 디자인) - Bar Type 의 신규 디자인 핸들 적용으로 사용자 편의성 개선 - Air fry 성능 강화(조리 속도 15% 개선) - PL 방지 위한 3 Step Knob의 감성 품질 개선 □ 유럽 후드 일체형 인덕션 - 고성능(최대 풍량_720CMH)/고효율(에너지효율 A+) - 견고하고 Matte 한 소재의 프리미엄 고경도 글라스 - 스마트한 후드 동작(공기질에 따른 풍량 자동 조절)
		식기세척기 (~2026.02.)	□ 북미 프리미엄 시장 핵심 사양 차별화를 통한 제품 경쟁력 확보 - 최고 에너지 효율 Energy Star Most Efficient 확보, 시장 최저 소음 38dBA 달성 - Rack 사용성 강화:Extra Large 3rd Rack, Storm Wash Zone, Glide(Soft) Rail 적용 - 편의성 강화 : Auto Open Door 적용 □ 유럽 24인치 글로벌 자가 식기세척기 - 가볍게 밀어 문을 열 수 있는 Auto Open Door - 고감도 탁도 센서와 AI 딥러닝 알고리즘 활용한 AI Wash - 최상단 컵 전용 세척 공간으로 효율적 공간 활용

		정수기 (~2026.03.)	□ 한국 카운터탑 정수기 - 음성 출수 및 관리 - 내부 유로관 전해수 자동세척, 자동 배수 - SmartThings 원격 제어/모니터링 □ 한국 카운터탑 얼음정수기 - 국내 유일 NSF 인증 가정용 카운터탑 얼음정수기 - Bixby 음성 제어 및 Voice ID 출수 제공 - 유로관 및 얼음 저장고 AI 자동 살균
		에어드레서 (~2026.02.)	□ 에어드레서 4세대 신모델(주름 집중케어) - 의류 거치 후 자동으로 주름 케어 가능한 주름 집중케어존 적용 - 듀얼에어워시, 듀얼제트스팀 등 기본성능 및 New Air Hanger - AI 맞춤건조
		전자레인지 (~2026.04.)	□ 북미 Dual Vent OTR(후드 겸용 전자레인지) - 업계 최초 Dual Ventilation(기존 하단+전면 추가) 적용, 포집효율 82% 구현 - Auto Open & Close Flip을 적용하여 후드 작동시 자동으로 전면 Vent On - WiFi 장착 및 SmartThings를 통해 모바일 기기 제어 - 쿡탑 동작 시 연동되어 후드기능 자동 동작
	MX	Galaxy 폴더블 (~2026.08.)	□ Galaxy Z Fold6 (2024.07.) - 얇고 가벼운 무게로 뛰어난 휴대성 제공을 통한 제품 경쟁력 강화 - 한단계 더 진화된 Galaxy AI를 통해 차별화된 사용자 경험 제공 - 인치(Main/Sub) : 7.6" QXGA+ (2160 x 1856) / 6.3" HD+ (2376 x 968) - 사이즈(H x W x D) & 무게 : Open 153.5 x 132.6 x 5.6mm, Close 153.5 x 68.1 x 12.1mm, 239g - Platform(H/W, S/W) : Snapdragon 8 Gen 3, Android 14, One UI 6.1.1 - 폴더블 폼팩터와 Galaxy AI 기능 탑재를 통한 Galaxy Intelligence 경험 혁신 ・서클 투 서치, 실시간 통역, 노트/채팅 어시스트 등 ・듀얼 스크린 활용한 '대화 번역 모드' 등 - 향상된 카메라/갤러리 경험 제공 ・포토/그리기 어시스트, 날씨 및 시간 배경 화면 등 - 무게 14g 감소, 두께(Close) 1.3mm 감소, Cover Display 0.1" 증가
			□ Galaxy Z Flip6 (2024.07.) - 내구성 향상을 통한 제품 경쟁력 강화 - 한단계 더 진화된 Galaxy AI를 통해 차별화된 사용자 경험 제공 - 인치(Main/Sub) : 6.7" FHD+ (2640 x 1080) / 3.4" (748 x 720) - 사이즈(H x W x D) & 무게 : Open 165.1 x 71.9 x 6.9mm, Close 85.1 x 71.9 x 14.9mm, 187g - Platform(H/W, S/W) : Snapdragon 8 Gen 3, Android 14, One UI 6.1.1 - 폴더블 폼팩터와 Galaxy AI 기능 탑재를 통한 Galaxy Intelligence 경험 혁신 ・서클 투 서치, 실시간 통역, 포토/노트/채팅 어시스트 등 ・듀얼 스크린 활용한 '대화 번역 모드', 플렉스윈도우에서의 '답장 추천' 기능 지원 등 - 고화소 카메라(Wide 50MP) 적용 및 향상된 Flex 카메라 경험 제공 ・저조도/원거리 선명한 디테일 제공 ・플렉스모드에서 카메라 자동줌(Auto Zoom) 기능 지원으로 편리한 핸즈프리 촬영 - Display Folding부 내구성 강화 ・화면 내구성 강화 및 폴딩부 굴곡 개선
			□ Galaxy Z Fold SE (2024.10.) - 더 넓고 더 슬림해진 디자인, 핵심 사양을 강화하여 제품 경쟁력 확보 - 한 단계 더 진화된 Galaxy AI를 통해 차별화된 사용자 경험 제공 - 인치(Main/Sub) : 8.0" QXGA+ (2184 x 1968) / 6.5" FHD+ (2520 x 1080)

			- 사이즈(H x W x D) & 무게 : Open 157.9 x 142.6 x 4.9mm, Close 157.9 x 72.8 x 10.6mm, 236g - Platform(H/W, S/W) : Snapdragon 8 Gen 3, Android 14, One UI 6.1.1 - 폴더블 폼팩터의 기본 사용성 향상 (Z Fold6 比) ・무게 3g 감소, 두께(Close) 1.6mm 감소, Main Display 0.4", Cover Display 0.2"증가 ・Cover Display의 화면 비율(21:9) 개선을 통한 클로즈 상태의 사용성 향상 - 2억 화소 초고해상도 카메라를 적용하여, 폴더블 최고의 카메라 성능 확보 - 더 넓은 화면을 활용한 Galaxy AI 를 통해 Galaxy Intelligence 경험 혁신 ・서클 투 서치, 실시간 통역, 노트/채팅 어시스트, 듀얼 스크린 활용한 '대화 번역 모드' 등
			□ Galaxy Z Fold7 (2025.07.) - 가장 얇고 가벼운 디자인과 대화면으로 몰입형 멀티태스킹과 AI 지원 - 인치(Main/Sub) : 8.0" QXGA+ (2184 x 1968) / 6.5" FHD+ (2520 x 1080) - 사이즈(H x W x D) & 무게 : Open 158.4 x 143.2 x 4.2mm, Close 158.4 x 72.8 x 8.9mm, 215g - Platform(H/W, S/W) : Snapdragon 8 Elite, Android 16, One UI 8.0 - Galaxy Z Fold 시리즈 중 가장 얇고 가벼운 디자인 * Open 4.2/Close 8.9mm, 215g - 실장 구조 및 부품 소재 개선을 통한 슬림/경량화 디자인 구현 및 내구성 강화 ・Armor Flex Hinge 적용으로 외부 충격을 균일하게 분산시켜 슬림한 디자인 및 내구성 확보 ・힌지 소재 및 이중레일 구조 변경으로 슬림 힌지 내구성 확보 ・디스플레이 내구성 강화 및 폴딩부 굴곡 개선을 통한 고객 체감 품질 향상 - 대화면 경험 강화 ・메인 화면 전작비 증가(Fold6 7.6"→Fold7 8.0")로 멀티태스킹, 영화 감상, AI 등 사용성 증대 ・커버 화면 확대(Fold6 6.3"/22.1:9→Fold7 6.5"/21:9)를 통한 Bar Type과 동등 사용성 제공 - 폴더블에 최적화된 One UI 8과 강화된 Galaxy AI 경험 제공 ・멀티모달 AI 경험과 One UI 8을 통한 폴더블 폼팩터에 최적화된 Galaxy AI 경험 제공 ・실시간 통역, 생성형 이미지 편집, 개인화 추천 등 AI 기반 기능 강화
			□ Galaxy Z Flip7 (2025.07.) - 콤팩트한 디자인에 강력한 모바일 AI 기능 결합 - 인치(Main/Sub) : 6.9" FHD+ (2520 x 1080) / 4.1" (1048 x 948) - 사이즈(H x W x D) & 무게 : Open 166.7 x 75.2 x 6.5mm, Close 85.5 x 75.2 x 13.7mm, 188g - Platform(H/W, S/W) : Exynos2500, Android 16, One UI 8.0 - Full 커버 스크린 적용으로 확장된 사용성 강화 ・Flip 시리즈 최초로 4.1" 플렉스 윈도우 탑재 (Flip6 노치형 3.4") ・플렉스 윈도우를 통한 Now Bar 및 Now Brief 등 개인화 AI 경험 제공 - 한손에 담기는 콤팩트한 사이즈와 향상된 성능으로 제품 경쟁력 강화 ・접었을 때 두께 13.7mm, 무게 188g으로, 휴대성과 사용 편의성 강화 ・코닝 Gorilla Glass Victus2, Armor Aluminum 프레임, Armor Flex Hinge 탑재로 내구성 확보 ・배터리 실장 공간 최적화로 배터리 용량 개선 (Flip6 4000mAh→Flip7 4300mAh) ・3nm 최신프로세서 탑재로 안정적 퍼포먼스 제공 - Flip 시리즈 최초로 삼성 덱스 지원
			□ Galaxy Z Flip7 FE (2025.07.) - 첫 보급형 폴더블폰 - 인치 : 6.7" FHD+ (2640 x 1080) / 3.4" (748 x 720) - 사이즈(H x W x D) & 무게 : Open 165.1 x 71.9 x 6.9mm, Close 85.1 x 71.9 x 14.9mm, 187g - Platform(H/W, S/W) : Exynos2400, Android 16, One UI 8.0 - 플렉스 윈도우를 통한 개인화 AI 경험 제공 - 프로비쥬얼 엔진으로 강화된 Camera Zoom 경험 제공 및 FlexCam 기능 제공
			□ Galaxy Z TriFold (2025.12.) - 혁신적 폼팩터의 3단 폴더블 스마트폰

			・접었을 때는 프리미엄 스마트폰, 펼쳤을 때는 10”대화면 경험 제공 - 인치(Main/Sub) : 10.0" QXGA+ (2160 x 1584) / 6.5" FHD+ (2520 x 1080) - 사이즈(H x W x D) & 무게 : Open 159.2 x 214.1 x 3.9~4.2mm, Close 159.2 x 75.0 x 12.9mm, 309g - Platform(H/W, S/W) : Snapdragon 8 Elite, Android 16, One UI 8.0 - 화면 양쪽을 모두 안으로 접는 '인폴딩' 구조로 설계하여 메인 디스플레이 보호 - 3단으로 접히는 폼팩터에 최적화된 아머 플렉스힌지(Armor Flex Hinge) 탑재 ・좌우 대칭 형태의 듀얼 레일 구조로 설계되어 안정적인 폴딩 경험 제공 ・티타늄 소재 힌지를 적용하여 내구성 향상 및 무게 증가 최소화 - 5,600mAh 대용량 배터리 탑재, 45W 초고속 충전 지원 및 45W 충전 어댑터 기본 제공 - 10" 대화면에서 직관적이고 확장된 사용자 경험 제공 ・멀티윈도우 기능을 활용, 최대 3개의 앱을 동시에 실행하고 앱 크기를 자유롭게 조정 ・태블릿용 삼성 덱스(Samsung Dex) 탑재하여 대화면 활용성 극대화
			□ Galaxy Z Fold8 Ultra (2026.08.) - Ultra급 성능/카메라/대화면 탑재로 생산성 및 콘텐츠 제작 경험 강화 - 인치(Main/Sub) : 8.0" QXGA+ (2504 x 2256) / 6.5" FHD+ (2520 x 1080) - 사이즈(H x W x D) & 무게 : Open 158.4 x 143.2 x 4.1mm, Close 158.4 x 72.8 x 8.9mm, 215g - Platform(H/W, S/W) : Snapdragon® 8 Elite Gen 5, Android 17, One UI 9.0 - 슬림한 디자인과 215g 무게로 휴대성과 대화면 생산성 동시 구현 ·Open 4.1mm의 슬림한 폼팩터와 8.0" 메인 디스플레이를 통해 멀티태스킹 및 콘텐츠 제작 ·플렉스 티타늄(Flex Titanium) 기술 적용으로 내구성 강화 ·5,000mAh 배터리 탑재로 업무/창작/엔터테인먼트 사용성 강화 (최대 27시간 동영상 시청) - Ultra급 카메라 시스템으로 전문적인 콘텐츠 제작 경험 제공 ·2억 화소 광각 카메라에 HDR 지원 및 1,000만 화소 3배 광학 줌 망원 카메라 탑재 ·향상된 노이즈 분석, 코덱 기반 8K 영상 촬영・편집 활용성 강화 ·전/후면 카메라 동시 촬영 지원 Dual Recording 및 선택 인물 중심 영상 편집 My FanCam 지원 ·슈퍼 스테디(Super Steady) 모드 개선으로 움직임이 많은 장면 촬영시 완성도 제고 - 폴더블에 최적화된 One UI 9 및 Galaxy AI 경험 제공 ·Gemini Intelligence, Now Nudge, Now Brief 등 AI 경험을 대화면・분할 화면 환경에서 활용
			□ Galaxy Z Fold8 (2026.08.) - 사용성과 Pocketable 고려한 Wide 대화면Fold 신규 폼팩터 - 인치(Main/Sub) : 7.6" QXGA+ (1848 x 2448) / 5.5" WUXGA+ (1972 x 1248) - 사이즈(H x W x D) & 무게 : Open 123.9 x 161.4 x 4.5mm, Close 123.9 x 81.9 x 9.7mm, 201g - Platform(H/W, S/W) : Snapdragon® 8 Elite Gen 5, Android 17, One UI 9.0 - 최적의 비율을 가진 신규 화면비 폴더블 폰으로 대화면 Value 제공 ·화면비 : Open (4:3), Close (10:16) ·4,800mAh 배터리 탑재, 최대 26시간 동영상 재생 지원, 최대 3000nits 밝기 - 플렉스 티타늄(Flex Titanium) 기술 적용으로 내구성 강화 - 다양한 사진/동영상 촬영 기능 지원으로 경험 확대 ·전/후면 카메라 동시 촬영 지원 Dual Recording 및 선택 인물 중심 영상 편집 My FanCam 지원 ·슈퍼 스테디(Super Steady)모드 개선으로 움직임이 많은 장면 촬영시 완성도 제고 - 폴더블에 최적화된 One UI 9 및 Galaxy AI 경험 제공 ·Gemini Intelligence, Now Nudge, Now Brief 등 AI 경험을 대화면・분할 화면 환경에서 활용
			□ Galaxy Z Flip8 (2026.08.) - 슬림 Flip 폼팩터 구현으로 디자인 완성도 제고 - 인치(Main/Sub) : 6.9" FHD+ (2520 x 1080) / 4.1" (1048 x 948) - 사이즈(H x W x D) & 무게 : Open 166.9 x 75.4 x 6.1 mm, Close 85.7 x 75.4 x 13.1 mm, 180g

			- Platform(H/W, S/W) : Exynos2600, Android 17, One UI 9.0 - 슬림한 디자인과 성능 개선을 통한 제품 경쟁력 강화 ·전작비 얇고, 가벼운 플립 단말 : Flip7 6.5t/188g → Flip8 6.1t/180g ·4,300mAh 배터리 탑재, 최대 31시간 동영상 재생 지원, 최대 2,600nits 밝기 ·2nm 최신프로세서 탑재로 안정적 퍼포먼스 제공 - Cover 화면 사용성 개선을 통한 Flex Window 경험 강화 ·Cover 화면에서도 앱을 사용할 수 있도록 UI 사용성 개선 ·Now Brief 생성형/편집형 카드 기능 지원을 통한 Cover 화면 AI 경험 강화
		Galaxy S (~2026.09.)	□ Galaxy S24・S24+・S24 Ultra (2024.01.) - Galaxy AI 기능 탑재를 통한 Galaxy Intelligence 경험 혁신, 일상에 새로운 경험과 가치를 제공 ・서클 투 서치, 실시간 통역, 포토/노트/채팅 어시스트 등 신규 AI 기능 제공 - 인치 : S24 6.2" FHD+ (2340 x 1080), S24+ 6.7" Quad HD+ (3120 x 1440), S24 Ultra 6.8" Quad HD+ (3120 x 1440) - 사이즈(H x W x D) & 무게 : S24 147.0 x 70.6 x 7.6mm 167g, S24+ 158.5 x 75.9 x 7.7mm, 196g S24 Ultra 162.3 x 79.0 x 8.6mm, 232g - Platform(H/W, S/W) : Snapdragon 8 Gen 3/Exynos 2400, Android 14, One UI 6.1 - Slimmer and even bezels 적용으로 몰입감 있는 디스플레이 경험 강화 - One-mass 디자인을 통한 조형의 일체감 완성 - 향상된 AI ProVisual Engine 탑재로 카메라 촬영 및 갤러리 감상/편집 강화 ・스페이스 줌, 나이토그래피로 선명한 고품질 사진 촬영 ・Instant Slow-mo, Edit Suggestion 기능 제공 - 디스플레이 야외 시인성 개선 * Peak 밝기: 1,750nit → 2,600nit - S24 Ultra, 메탈 프레임 티타늄 소재 적용을 통한 내구성 강화 및 고급감 극대화 - S24 Ultra, 고화소 망원 카메라 적용 * 10MP (S23 Ultra) → 50MP (S24 Ultra)
			□ Galaxy S24 FE (2024.10.) - 최신 플래그십 경험의 장벽을 낮추는 균형 잡힌 프리미엄 (with Galaxy AI) - 인치 : 6.7" FHD+ (2340 x 1080) - 사이즈(H x W x D) & 무게 : 162.0 x 77.3 x 8.0mm, 213g - Platform(H/W, S/W) : Exynos 2400e, Android 14, One UI 6.1 - 전작 대비 향상된 H/W 제공으로 사용자 경험 극대화 ・AP (Exynos2200→Exynos2400e), Display (6.4"→6.7"), Battery (4,500mAh→4,700mAh) - 플래그십 AI기반의 Full Experience 제공 (서클 투 서치, 실시간 통역, AI 사진편집 등) - 향상된 AI ProVisual Engine 탑재로 카메라 촬영 및 갤러리 감상/편집 강화 - 디스플레이 야외 시인성 개선 * Peak 밝기: 1,450nit → 1,900nit
			□ Galaxy S25(2025.02.) - Galaxy AI 경험 고도화로 모바일 AI 경험의 새로운 패러다임 제시 ・Now Brief, Google Gemini, Gemini Live, 오디오 지우개 등 신규 AI 기능 제공 - 인치 : S25 6.2"FHD+ (2340 x 1080), S25+ 6.7"Quad HD+ (3120 x 1440), S25 Ultra 6.9"Quad HD+ (3120 x 1440) - 사이즈(H x W x D) & 무게 : S25 146.9 x 70.5 x 7.2mm, 162g, S25+ 158.4 x 75.8 x 7.3mm, 190g S25 Ultra 162.8 x 77.6 x 8.2mm, 218g - 사양 및 기능 ・ Platform(H/W, S/W) : Snapdragon 8 Elite, Android 15, One UI 7.0 ・ 둥근 모서리 형상으로 Galaxy S 시리즈의 통일된 정체성 표현 ・ 실장 구조 최적화 및 부품 경량화로 全 모델 슬림/경량化 (S24 7.6t → S25 7.2t, S24+ 7.7t → S25+ 7.3t, S24 Ultra 8.6t → S25 Ultra 8.2t, S24 167g → S25 162g, S24+ 196g → S25+ 190g, S24 Ultra 232g → S25 Ultra 218g)

			・ Galaxy 맞춤형 프로세서 탑재로 디스플레이 화질 및 배터리 효율 향상 ・더 강력해진 AI ProVisual Engine 탑재로 카메라 촬영 및 갤러리 감상/편집 강화 (향상된 10bit HDR 지원으로 어두운 곳에서도 선명한 영상 촬영, Object-aware Engine을 통해 주변의 빛을 분석하여 자연스러운 피부 톤과 질감 표현, 원하는 사진을 AI로 분석하여 나만의 맞춤형 필터 제공) ・ S25 Ultra, 코닝 고릴라 아머2 글래스 적용을 통한 디스플레이 글래스 내구성 강화 ・ S25 Ultra, 업그레이드된 고화소 초광각 카메라 적용 *12MP (S24 Ultra) → 50MP (S25 Ultra)
			□ Galaxy S25 Edge(2025.05.) - Beyond Slim, 초슬림 / 초경량 디자인에 담긴 기술적 혁신 - 인치 : 6.7"Quad HD+ (3120 x 1440) - 사이즈(H x W x D) & 무게 : 158.2 x 75.6 x 5.8 mm, 163g - 사양 및 기능 ・ Platform(H/W, S/W) : Snapdragon 8 Elite, Android 15, One UI 7.0 ・ 최적의 실장 구조 및 부품 경량화로 가장 얇은 Galaxy 디자인 설계 ・ 티타늄 프레임 및 코닝 글라스 세라믹2 적용으로 제품 내구성 확보 ・ 초슬림 모델에 최적화된 방열 구조 및 더 넓어진 Vapor Chamber로 성능 극대화 ・ 200MP 초고해상도 광각 카메라의 Slim 설계로 S25 Ultra급 촬영 경험 제공
			□ Galaxy S25 FE (2025.09.) - 플래그십 핵심 경험 확산을 통한 Entry Flagship 경쟁력 강화 - 인치 : 6.7" FHD+ (2340 x 1080) - 사이즈(H x W x D) & 무게 : 161.3 x 76.6 x 7.4 mm, 190g - Platform (H/W, S/W) : Exynos 2400, Android 16, One UI 8.0 - 전작 대비 향상된 H/W 제공으로 사용자 경험 극대화 ・전면카메라 (10MP→12MP), 배터리/충전 (4,700mAh/25W→4,900mAh/45W) ・실장 최적화 및 부품 경량화로 슬림/경량화 실현 (8.0mm / 213g → 7.4mm / 190g) - 플래그십과 동일한 Galaxy AI 기반 Full Experience 제공 ・번역, 요약, Now Brief(개인 맞춤형 정보), Gemini Live, 생성형 이미지, Audio Eraser 등 - One UI 8.0 기본 탑재로 사용자 경험 극대화 ・더욱 강력한 보안 및 개인정보 보호 (KEEP), UI/앱 사용성 강화 등
			□ Galaxy S26 (2026.03.) - 고객 경험 혁신 및 AI Phone 리더십 지속 ・ OS Level 로 통합된 AI 성능 고도화로 상황과 맥락을 이해하여 가장 개인화되고 능동적으로 알아서 수행해 주는 AI 경험 제공 - 인치 : S26 6.3"FHD+ (2340 x 1080), S26+ 6.7"Quad HD+ (3120 x 1440), S26 Ultra 6.9"Quad HD+ (3120 x 1440) - 사이즈(H x W x D) & 무게 : S26 149.6 x 71.7 x 7.2mm, 167g S26+ 158.4 x 75.8 x 7.3mm, 190g S26 Ultra 163.6 x 78.1 x 7.9mm, 214g - 사양 및 기능 ・ Platform : Snapdragon 8 Elite Gen5/Exynos 2600, Android 16, One UI 8.5 ・ 전 제품 모서리 곡률7R(반지름 7mm)로 일원화하여 갤럭시S 시리즈의 디자인 아이덴티티 강조 ・ 실장 구조 최적화 및 부품 경량화로 Ultra 최초 7㎜ 대 두께 확보 S25 Ultra 8.2t / 218g → S26 Ultra 7.9t / 214g ・ S26 Ultra, 업계 최초 Privacy Display 적용 및 몰입감 높은 Viewing 경험 제공 ・ 사용자의 맥락과 의도를 파악해 능동적으로 반응하는 사용자 맞춤형 AI 경험 제공 사용자 데이터 기반의 개인화된 맞춤형 제안(Now Nudge) / 브리핑(Now Brief)

			・ 수평 고정 옵션 보강으로 동영상 촬영시 흔들림을 보정하여 안정적인 촬영 지원(Super Steady)
			□ Galaxy S26 FE (2026.09.) - 플래그십 핵심 경험 확산을 통한 Entry Flagship 경쟁력 강화 - 인치 : 6.7" FHD+ (2340 x 1080) - 사이즈(H x W x D) & 무게 : 161.6 x 76.9 x 7.4 mm, 192g - 사양 및 기능 ・ Platform(H/W, S/W) : Exynos 2500, Android 17, One UI 9.0 ・ 전작 비 향상된 AP/카메라 경쟁력 강화 (Root,4nm→Solomon,3nm, 전면카메라 화각80°→ 85°) ・ 플래그십 수준의 Galaxy AI 경험 제공 : Browsing Assist, Writing Assist, Photo Assist, Audio Eraser, Live Translation, Now Brief(개인 맞춤형 정보) 등
		Galaxy Tab (~2025.11.)	□ Galaxy Tab S10+・S10 Ultra (2024.10.) - 인치 : Tab S10 Plus 12.4"WQXGA+ (2800 x 1752) Tab S10 Ultra 14.6"WQXGA+ (2960 x 1848) - 사이즈(H x W x D) & 무게 :Tab S10 Plus 185.4 x 285.4 x 5.6 mm, 571g Tab S10 Ultra 208.6 x 326.4 x 5.4 mm, 718g - Platform(H/W, S/W) : Mediatek Dimensity 9300+, Android 14, One UI 6.1.1 - S펜을 활용한 쉽고 편리한 AI 사용 경험 - Dynamic AMOLED 2X Display, 120Hz, 저반사 코팅
			□ Galaxy Tab S10 FE・FE+ (2025.04.) - 인치 : Tab S10 FE+ 13.1"WQXGA+ (2880 x 1800) Tab S10 FE 10.9"WQXGA+ (2304 x 1440) - 사이즈(H x W x D) & 무게: Tab S10 FE+ 194.7 x 300.6 x 6.0 mm, 664g Tab S10 FE 165.8 x 254.3 x 6.0 mm, 497g - 사양 및 기능 ・ Platform(H/W, S/W) : Exynos 1580, Android 15, One UI 7.0 ・ 13.1"(FE+) Display 적용하여 최적화된 시청 경험 제공 ・ 향상된 Creativity & Productivity 와 최적화된 AI기능 제공
			□ Galaxy Tab Active5 Pro (2025.04.) - 인치 : 10.1"WUXGA (1920 x 1200) - 사이즈(H x W x D) & 무게: 170.2 x 242.9 x 10.2 mm, 683g - 사양 및 기능 ・ Platform(H/W, S/W) : Snapdragon 7s Gen 3, Android 15, One UI 7.0 ・ 2개 배터리를 사용하여 전원을 끄지 않고 교환 및 용량을 증대하여 사용성 증대 ・ 전면 NFC, Knox Vault 적용하여 보안을 비롯한 생산성 강화
			□ Galaxy Tab S11 Ultra/Basic (2025.09.) - 인치 : Tab S11 Ultra 14.6" WQXGA+ (2960 x 1848) Tab S11 11.0" WQXGA (2560 x 1600) - 사이즈(H x W x D) & 무게: Tab S11 Ultra 208.5 x 326.3 x 5.1mm, 692g(Wifi) Tab S11 165.3 x 253.8 x 5.5mm, 469g(WiFi) - 사양 및 기능 ・Platform(H/W, S/W) : MediaTek MT6991, Android 16, One UI 8.0 ・최대 밝기 1,600nits, 고휘도모드(HBM) 1,000nits 지원 Dynamic AMOLED 2X 디스플레이 ・새로운 S펜을 장착한 역대 가장 얇고, 가벼운 태블릿 * Ultra 기준 692g/5.1mm ・극강의 AI 파워를 만드는 더 강력한 성능 * Ultra 기준 NPU 33%↑, CPU 24%↑, GPU 27%↑
			□ Galaxy Tab S10 Lite (2025.09.) - 인치 : 10.9" WUXGA+ (2112 x 1320)

			- 사이즈(H x W x D) & 무게: 165.8 x 254.3 x 6.6mm, 524g - 사양 및 기능 ・Platform(H/W, S/W) : Samsung Exynos 1380, Android 15, One UI 7.0 ・10.9인치, 90Hz 주사율, 최대 600nit 밝기의 Display ・최대 256GB 스토리지, 8G 메모리, microSD(최대2TB) 저장공간 지원 ・키보드 커버의 AI Key를 통해 신속한 AI 기능 사용 지원
			□ Galaxy Tab A11, A11+ (2025.11.) - 인치 : Tab A11 8.7" WXGA+ (1340 x 800) Tab A11+ 11" WUXGA (1920 x 1200) - 사이즈(H x W x D) & 무게 : Tab A11 124.7 x 211 x 8.0mm, 335g Tab A11+ 168.7 x 257.1 x 6.9mm, 480g - 사양 및 기능 ・Platform(H/W, S/W) : Tab A11 MTK MT8781, Android 15, One UI 7.0 Tab A11+ MTK MT8775, Android 16, One UI 8.0 ・최대 256GB 스토리지, 8G 메모리, microSD(최대2TB) 저장공간 지원 ・Galaxy 아이덴티티 적용한 New Design 적용 (PUI 통일, Cam Deco, Speaker Hole) ・다양한 국가의 Needs를 위한 3.5Φ Earphone jack 지원
		Galaxy A, M (~2026.09)	□ Galaxy A25 5G (2024.01.) - 인치 : 6.5" FHD+ (2340 x 1080) - 사이즈(H x W x D) & 무게 : 161.0 x 76.5 x 8.3mm, 197g - Platform(H/W, S/W): Exynos 1280, Android 14, One UI 6.0 - 6.5" FHD+, 120Hz 주사율을 지원하여 향상된 화면 경험 제공 - 50MP OIS 광각 카메라 적용으로 흔들림 없는 고화소 사진 촬영 가능 - 5,000mAh 대용량 배터리 적용
			□ Galaxy A15 (2024.01.) - 인치 : 6.5" FHD+ (2340 x 1080) - 사이즈(H x W x D) & 무게 : 160.1 x 76.8 x 8.4mm, 200g - Platform(H/W, S/W): [5G] D6100+ / [LTE] G99, Android 14, One UI 6.0 - 전작(A14) 대비 디스플레이 업그레이드를 통한 화질 향상 (LCD → Super AMOLED) - 25W 고속 충전 가능한 5,000mAh 대용량 배터리 탑재 - Knox Vault 지원으로 보안 및 사생활 보호 강화
			□ Galaxy A55 5G (2024.03.) - 인치 : 6.6" FHD+ (2340 x 1080) - 사이즈(H x W x D) & 무게 : 161.1 x 77.4 x 8.2mm, 213g - Platform(H/W, S/W): Exynos 1480, Android 14.0, One UI 6.1 - 강화된 카메라 센서 및 AP로 더 완벽해진 Nightography와 비디오 촬영 경험 제공 - Metal + Glass 적용, Young & Energetic한 CMF 구현으로 디자인 경쟁력 강화 - 6.6" FHD+ 대화면 디스플레이 적용으로 향상된 화면 경험 제공 (전작 A54-5g 6.4")
			□ Galaxy A35 5G (2024.03.) - 인치 : 6.6" FHD+ (2340 x 1080) - 사이즈(H x W x D) & 무게 : 161.7 x 78.0 x 8.2mm, 209g - Platform(H/W, S/W): Exynos 1380, Android 14, One UI 6.1 - HID(Hole In Display), Back Glass적용하여 디자인 차별화 - Knox Vault로 보안을 강화하고, OS UP 4회 및 Security MR 5회 지원하여 품질 보증 확대
			□ Galaxy A06 (2024.09.) - A05 후속 최저가 LTE 모델로 Entry Seg 물량 확대 - 인치 : 6.7" HD+ (1600 x 720)

			- 사이즈(H x W x D) & 무게 : 167.3 x 77.3 x 8.0mm, 189g - Platform(H/W, S/W): G85, Android 14, One UI 6.1 - 대화면 Slim 디자인 (두께 8.00mm) 적용 - 측면 지문 지원 및 Samsung Knox Vault 보안솔루션 탑재로 데이터 보안 강화
			□ Galaxy A16 5G (2024.10.) - A15 5G 후속, Entry 5G 시장 성장 대응 - 인치 : 6.7" FHD+ (2340 x 1080) - 사이즈(H x W x D) & 무게 : 164.4 x 77.9 x 7.9mm, 200g - Platform(H/W, S/W): Exynos 1330 / D6300, Android 14, One UI 6.1 - 6.7"대화면 디스플레이 및 Slim 디자인 (두께 7.9mm) 적용 - OS 6회/SMR 6년 업데이트 지원 및 IP54 방수방진 등급 적용
			□ Galaxy A16 (2024.11.) - A15 후속 Entry LTE 물량 대응 - 인치 : 6.7" FHD+ (2340 x 1080) - 사이즈(H x W x D) & 무게 : 164.4 x 77.9 x 7.9mm, 200g - Platform(H/W, S/W): G99, Android 14, One UI 6.1 - 6.7"대화면 디스플레이 및 Slim 디자인 (두께 7.9mm) 적용 - OS 6회/SMR 6년 업데이트 지원 및 IP54 방수방진 등급 적용
			□ Galaxy A06 5G(2025.02.) - 5G Entry 시장 대응 및 물량 견인 모델 - 인치 : 6.7" HD+ (1600 x 720) - 사이즈(H x W x D) & 무게 : 167.3 x 77.3 x 8.0mm, 191g - 사양 및 기능 ・Platform(H/W, S/W): D6300, Android 15, One UI Core 7.0 ・Entry 5G Seg 최초 도입 및 Slim 디자인(8.0mm), 대화면 디스플레이(6.7") 적용 ・IP54 적용, 측면지문 지원 및 Samsung Knox Vault 보안솔루션 탑재로 데이터 보안 강화
			□Galaxy M16 5G (2025.02.) - 서남아 온라인 판매를 위한 5G Entry JDM모델 - 인치 : 6.7" FHD+ (2340 x 1080) - 사이즈(H x W x D) & 무게 : 164.4 x 77.9 x 7.9mm, 191g - 사양 및 기능 ・Platform(H/W, S/W): D6300, Android 14, One UI Core 6.1 ・Super AMOLED 적용 및 50MP+5MP+2MP/13MP 카메라 탑재 ・25W 고속 충전 가능한 5000mAh 대용량 배터리 탑재 ・Knox Vault 지원으로 보안 및 사생활 보호 강화
			□ Galaxy A56 5G (2025.03.) - A55 5G 후속으로 핵심 사양의 실체감 성능 강화를 통한 High Seg 경쟁력 확보 - 인치 : 6.7" FHD+ (2340 x 1080) - 사이즈(H x W x D) & 무게 : 162.2 x 77.5 x 7.4mm, 198g - 사양 및 기능 ・Platform(H/W, S/W): Exynos 1580, Android 15, One UI 7.0 ・더 Slim하고 가벼워진 바디의 프리미엄 디자인 (두께 8.2t→7.4t, 무게 213g→198g) ・전작 比 강화된 셀피 동영상 촬영 경험 제공 및 밝고 선명해진 Nightography 경험 제공 (전면카메라 12MP 신규센서 및 10bit HDR 적용 / 후면 Wide 및 전면 카메라 LN mode 적용) ・AI로 빠르게 선택하여 최적의 화질로 촬영하고 다양한 사진 편집 경험 확대 제공 (AI segmentation, AI Powered Context-Aware, Edit Suggestion, Image Clipper 기능 등 제공) ・강력해진 AP와 방열 시스템으로 압도적인 성능 구현 (AP Rose→Santa, Vapor Chamber Size↑)

			□ Galaxy A36 5G (2025.03.) - A35 5G 후속으로 디자인 및 실 체감 중심 핵심 경험 강화 - 인치 : 6.7" FHD+ (2340 x 1080) - 사이즈(H x W x D) & 무게 : 162.9 x 78.2 x 7.4mm, 195g - 사양 및 기능 • Platform(H/W, S/W): Snapdragon 6 Gen3, Android 15, One UI 7.0 • 7.4t Slim Design, 6.7" FHD+ Super AMOLED Display, 45W Fast Charging 제공 • Awesome Intelligence 적용으로 모바일 AI 대중화 선도 * Object Eraser, AI Select等 • IP67등급 방수/방진
			□ Galaxy A26 5G(2025.03.) - 디자인 및 체감 성능 강화하여 Mid seg 5G시장 경쟁력 확보 - 인치 : 6.7" FHD+ (2340 x 1080) - 사이즈(H x W x D) & 무게 : 164.0 x 77.5 x 7.7mm, 200g - 사양 및 기능 • Platform(H/W, S/W): Exynos 1380 / Exynos1280(LA only), Android 15, One UI 7.0 • 7.7t Slim Design, 6.7" FHD+ Super AMOLED Display, Glass CMF 적용으로 디자인 경쟁력 강화 • Awesome Intelligence 적용으로 모바일 AI 대중화 선도 * Object Eraser, AI Select等 • IP67등급 방수/방진
			□ Galaxy M56 5G(2025.04.) - 서남아 온라인 판매를 위한 High Seg 모델 - 인치 : 6.7" FHD+ (2340 x 1080) - 사이즈(H x W x D) & 무게 : 162.0 × 77.3 × 7.2mm, 180g - 사양 및 기능 • Platform(H/W, S/W): Exynos 1480, Android 15, One UI 7.0 • Slim 디자인 (7.2mm), Slim 베젤 Super AMOLED Display 적용 • 전작比 강화된 AP와 확장된 베이퍼 챔버 면적으로 강력한 성능 지원 • OS 6회/Security 6년 upgrade 지원/Knox Vault 지원으로 보안 및 사생활 보호 강화
			□ Galaxy XCover7 Pro(2025.04.) - XCover6 Pro 5G 후속으로 핵심 사양의 강화를 통한 High-end Rugged Seg 지속 성장 - 인치 : 6.6" FHD+ (2408 x 1080) - 사이즈(H x W x D) & 무게 : 168.6 x 79.9 x 10.2mm, 240g - 사양 및 기능 • Platform(H/W, S/W): Snapdragon 7s Gen3, Android 15, One UI 7.0 • IP68 등급 방진 및 방수 기능과 미국 국방부 밀스펙(MIL-STD-810H) 내구성 확보 • 전작比 강화된 AP, Battery(4050→4350mAh), SPK (Mono→Stereo) • 단단해 보이면서도 정밀한 디테일을 담아 충격에 강한 내구성을 표현한 디자인으로 경쟁력 강화
			□ Galaxy M36 5G(2025.06.) - 한국향 KT 전용 단말(JUMP4) - 인치 : 6.7"FHD+ (2340 x 1080) - 사이즈(H x W x D) & 무게 : 164.4 x 77.9 x 7.7mm, 197g - 사양 및 기능 • Platform(H/W, S/W): Exynos 1380, Android 15, One UI 7.0 • 6.7"Super AMOLED Display 및 Slimmer Bezel 적용으로 Immersive viewing experience 제공 • 12MP+8MP+2MP/13MP 카메라 탑재 • 7.7t Slim design 및 후면 커버 GFRP(전작比 강도2.9배↑) 적용으로 내구성 강화 * Glass-Fiber Reinforced Plastic • OS 6회/Security 6년 upgrade 지원/Knox Vault 지원으로 보안 및 사생활 보호 강화

			□ Galaxy A17 5G(2025.08.) - 전작 A16-5G 比 디자인 및 카메라 성능 강화하여 저가 5G 시장 경쟁력 확보 - 인치 : 6.7" FHD+ (2340 x 1080) - 사이즈(H x W x D) & 무게 : 164.4 x 77.9 x 7.5mm, 192g - 사양 및 기능 · Platform(H/W, S/W) : Exynos 1330, Android 15, One UI 7.0 · 전작 比 Slim 디자인 (7.5t) 및 카메라 성능 강화 (50MP OIS 지원) · 후면 커버 GFRP 적용으로 내구성 강화 * GFRP : Glass-Fiber Reinforced Plastic · OS 6회/Security 6년 upgrade 지원/Knox Vault 지원으로 보안 및 사생활 보호 강화
			□ Galaxy A07 (2025.08.) - 4G Entry 시장 물량 견인 모델 - 인치 : 6.7" HD+ (1600 x 720) - 사이즈(H x W x D) & 무게 : 167.4 x 77.4 x 7.6mm, 184g - 사양 및 기능 · Platform(H/W, S/W): G99, Android 15, One UI 7.0 · 6.7" 대화면 디스플레이 적용 및 Smoothing Viewing 경험 제공 · 전작 比 강화된 AP(6nm) 및 Slim한 디자인 적용 (두께 7.6mm) · OS 6회/Security 6년 upgrade 지원/Knox Vault 지원으로 보안 및 사생활 보호 강화
			□ Galaxy A17 (2025.09.) - A16 후속, 카메라 경험 강화 및 Slim 디자인 적용된 LTE 단말 - 인치 : 6.7"FHD+ (2340 x 1080) - 사이즈(H x W x D) & 무게 : 164.4 x 77.9 x 7.5mm, 190g · Platform(H/W, S/W): G99, Android 15, One UI 7.0 · 6.7"Super AMOLED Display 적용으로 Immersive viewing experience 제공 · 전작 比 Slim 디자인 (7.5t) 및 카메라 성능 강화 (50MP OIS 지원) · OS 6회/Security 6년 upgrade 지원/Knox Vault 지원으로 보안 및 사생활 보호 강화
			□ Galaxy A07 5G(2026.01.) - 전작 A06-5G 比 6,000mAh 배터리 적용 및 개선된 Display 성능으로 Entry 5G 시장 대응 - 인치 : 6.7"HD+ (1600 x 720) - 사이즈(H x W x D) & 무게 : 167.4 x 77.4 x 8.2mm, 199g - 사양 및 기능 · Platform(H/W, S/W): 24E, Android 16, One UI 8.0 · 6,000mAh 배터리 적용으로 긴 사용 시간 제공 · Display refresh rate 120Hz 적용 및 고휘도모드(HBM) 800nits 지원으로 야외 시인성 개선
			□ Galaxy A57 5G(2026.04) - A56 5G 후속, 실체감 성능 강화를 통한 High Seg 경쟁력 확보 - 인치 : 6.7"FHD+ (2340 x 1080) - 사이즈(H x W x D) & 무게 : 161.5 x 76.8 x 6.9mm, 179g - 사양 및 기능 · Platform(H/W, S/W): Exynos 1680, Android 16, One UI 8.5 · 전작 A56-5G 比 AP / 디스플레이 / 메모리 / 방수 경쟁력 강화 : Santa → Terra / OCTA → UB / 12+512GB 추가 / IP67 → IP68 · 더 Slim하고 가벼워진 바디의 프리미엄 디자인 : 두께 7.4 → 6.9mm, 무게 198 → 179g
			□ Galaxy A37 5G(2026.04) - A36 5G 후속, 실체감 성능 강화를 통한 Mid Seg Volume Drive 지속 - 인치 : 6.7" FHD+ (2340 x 1080) - 사이즈(H x W x D) & 무게 : 162.9 x 78.2 x 7.4mm, 196g

			- 사양 및 기능 • Platform(H/W, S/W): Exynos 1480, Android 16, One UI 8.5 • Exynos 1480 적용으로 실체감 성능 강화 • 1.0um Big Pixel Camera로 저조도에서도 압도적인 화질과 최상의 Visual Experience 제공 • IP68등급 방수/방진 적용
			□ Galaxy A27 5G (2026.07) - A26 5G 比 주요 하드웨어 사양 강화를 통한 Mid Seg 경쟁력 확보 - 인치: 6.7" FHD+ (2340 x 1080) - 사이즈(H x W x D) & 무게 : 162.4 x 78.2 x 7.8mm, 200g - 사양 및 기능 • Platform(H/W, S/W): Snapdragon 6 Gen 3, Android 16, One UI 8.5 • 슬림 베젤 적용 6.7"FHD+ Super AMOLED 디스플레이 통해 매끄러운 시청 경험 제공 • Snapdragon 6 Gen 3 프로세서 적용으로 일상적인 작업을 손쉽게 처리 • HDR 기능이 탑재된 12MP 전면 카메라로 밝은 햇빛 아래에서도 선명하고 생생한 이미지 촬영
			□ Galaxy M47 5G (2026.07) - M36 5G 比 주요 하드웨어 사양 강화를 통한 온라인시장 Mid Seg 경쟁력 확보 - 인치: 6.7" FHD+ (2340 x 1080) - 사이즈(H x W x D) & 무게 : 162.4 x 78.2 x 8.1mm, 206g - 사양 및 기능 • Platform(H/W, S/W): Snapdragon 6 Gen 3, Android 16, One UI 8.5 • 슬림 베젤 적용 6.7"FHD+ Super AMOLED 디스플레이 통해 매끄러운 시청 경험 제공 • Snapdragon 6 Gen 3 프로세서 적용으로 일상적인 작업을 손쉽게 처리 • HDR 기능이 탑재된 12MP 전면 카메라로 밝은 햇빛 아래에서도 선명하고 생생한 이미지 촬영 • 대용량 6000mAh 배터리 적용
			□ Galaxy A08 (2026.09) - A07 比 주요 AP 성능 강화 후속 모델 출시 - 인치: 6.7" HD+ (1600 x 720) - 사이즈(H x W x D) & 무게 : 167.4 x 77.4 x 8.0mm, 197g - 사양 및 기능 • Platform(H/W, S/W): G99+, Android 17, One UI 9.0 • AP 성능 강화(G99+ 적용)로 향상된 성능 제공 • 대용량 6000mAh 배터리 및 IP64 적용으로 사용성/내구성 강화
		Galaxy Book (~2026.08.)	□ Galaxy Book4 Ultra (2024.01.) - 인치 : 16" WQXGA+ (2880 x 1800) - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 355.4 x 250.4 x 16.5mm, 1.86kg - Platform, OS : Intel® Core™ Ultra Processor, Windows 11 - Dynamic AMOLED 2X : 3K(2880x1800), 120Hz, 컬러볼륨 120% (DCI-P3 기준), 500nit(HDR) - 그래픽 : NVIDIA® GeForce RTX™ 4050/4070 - AKG 쿼드 스피커(우퍼 Max 5W x 2, 트위터 2W x 2), Smart Amp, Dolby Atmos®, 2M Camera - Memory, SSD : LPDDR5X, NVMe SSD - Bluetooth v5.3, WiFi 6E, 802.11 ax 2x2 - Battery : 76Wh
			□ Galaxy Book4 Pro 360 (2024.01.) - 인치 : 16" WQXGA+ (2880 x 1800) - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 355.4 x 252.2 x 12.8mm, 1.66kg - Platform, OS : Intel® Core™ Ultra Processor, Windows 11 - Dynamic AMOLED 2X : 3K(2880x1800), 120Hz, 컬러볼륨 120% (DCI-P3 기준), 500nit(HDR), S펜

			- 그래픽 : Intel® Arc™ Graphics - AKG 쿼드 스피커(우퍼 Max 5W x 2, 트위터 2W x 2), Smart Amp, Dolby Atmos®, 2M Camera - Memory, SSD : LPDDR5X, NVMe SSD - Bluetooth v5.3, WiFi 6E, 802.11 ax 2x2 - Battery : 76Wh
			□ Galaxy Book4 Pro (2024.01.) - 인치 : 16" WQXGA+ (2880 x 1800) 14" WQXGA+ (2880 x 1800) - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 16"355.4 x 250.4 x 12.5mm, 1.56kg 14"312.3 x 223.8 x 11.6mm, 1.23kg - Platform, OS : Intel® Core™ Ultra Processor, Windows 11 - Dynamic AMOLED 2X : 3K(2880x1800), 120Hz, 컬러볼륨 120% (DCI-P3 기준), 500nit(HDR) - 그래픽 : Intel® Arc™ Graphics - AKG 쿼드 스피커(우퍼 Max 5W x 2, 트위터 2W x 2), Smart Amp, Dolby Atmos®, 2M Camera - Memory, SSD : LPDDR5X, NVMe SSD - Bluetooth v5.3, WiFi 6E, 802.11 ax 2x2 - Battery : 16"76Wh, 14"63Wh
			□ Galaxy Book4 Edge (2024.06.) - 인치 : 16" WQXGA+ (2880 x 1800) 14" WQXGA+ (2880 x 1800) - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 16"355.4 x 250.4 x 12.3mm, 1.55kg 14"312.3 x 223.8 x 10.9mm, 1.16kg - Platform, OS : Qualcomm Snapdragon X Elite (12 core), Windows 11 - Dynamic AMOLED 2X : 3K (2880x1800), 120Hz, 컬러볼륨 120% (DCI-P3 기준), 500nit (HDR) - 그래픽 : Qualcomm Adreno - 쿼드 스피커 (16"우퍼 Max 5W x 2, 트위터 2W x 2 / 14"우퍼 Max 4W x 2, 트위터 2.7W x 2), Dolby Atmos, 2M Camera - Memory, SSD : 16"16GB, eUFS 512GB, 1TB / 14"16GB, eUFS 512GB - Bluetooth v5.3, WiFi 7, 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be - Battery : 16"61.8Wh, 14"55.9Wh - Next Gen AI PC 시장 선도를 위한 AI 기능 탑재
			□ Galaxy Book5 Pro 360 (2024.09.) - 인치 : 16" WQXGA+ (2880 x 1800) - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 355.4 x 252.2 x 12.8mm, 1.69kg - Platform, OS : Intel® Core™ Ultra Processor, Windows 11 - Dynamic AMOLED 2X : 3K(2880x1800), 120Hz, 컬러볼륨 120% (DCI-P3 기준), 500nit(HDR), S펜 - 그래픽 : Intel® Arc™ Graphics - 쿼드 스피커(우퍼 Max 5W x 2, 트위터 3.3W x 2), Smart Amp, Dolby Atmos®, 2M Camera - Memory, SSD : LPDDR5X, NVMe SSD - Bluetooth v5.4, WiFi 7, 802.11 be 2x2 - Battery : 76.1Wh
			□ Galaxy Book4 Pro 360 5G (2024.10.) - 인치 : 16" WQXGA+ (2880 x 1800) - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 355.4 x 252.2 x 12.8mm, 1.73kg - Platform, OS : Qualcomm Snapdragon X Elite (12 core), Windows 11 - Dynamic AMOLED 2X : 3K (2880x1800), 120Hz, S펜 - 그래픽 : Qualcomm Adreno

			- 쿼드 스피커 (우퍼 Max 5W x 2, 트위터 2W x 2), Smart Amp, Dolby Atmos, 2M Camera - Battery : 76Wh
			□ Galaxy Book4 Edge (2024.10.) - 인치 : 15.6" FHD (1920 x 1080) - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 356.6 x 229.75 x 15.0mm, 1.5kg - Platform, OS : Qualcomm Snapdragon X Plus (8 core), Windows 11 - 그래픽 : Qualcomm Adreno - Bluetooth v5.3, WiFi 7 지원 - 스테레오 스피커 (1.5 W x 2), Dolby Atmos, 2M Camera - Battery : 61.2 Wh
			□ Galaxy Book5 Pro/Pro H (2025.01.) - 인치 : 16" WQXGA+ (2880 x 1800) 14" WQXGA+ (2880 x 1800) - 사이즈(W x H x D) & 무게: 16" 355.4 x 250.4 x 12.5mm, 1.56kg 14" 312.3 x 223.8 x 11.6mm, 1.23kg - 사양 및 기능 • Platform : Intel® Core™ Ultra Processor Lunar lake (Pro) Intel® Core™ Ultra Processor Arrow lake (Pro H) • OS : Windows 11 • Dynamic AMOLED 2X : 2880x1800, 500nit(HDR) • 그래픽 : Intel® Arc™ Graphics • 쿼드 스피커 (우퍼 Max 5W x 2, 트위터 (16"3.3W x 2 / 14"2W x 2)), Smart Amp, Dolby Atmos®, 2M Camera • Memory, SSD : LPDDR5X, NVMe SSD • Bluetooth v5.4, WiFi 7, 802.11 be 2x2 • Battery : 16" 76.1Wh, 14" 63.1Wh
			□ Galaxy Book5 360 (2025.02.) - 인치 : 15.6" FHD (1920 x 1080) - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 355.4 x 228.0 x 13.7mm, 1.46kg - 사양 및 기능 • Platform, OS : Intel® Core™ Ultra Processor Lunar lake, Windows 11 • AMOLED FHD(1920x1080), 500nit(HDR) • 그래픽 : Intel® Arc™ Graphics • 스테레오 스피커(2W x 2), Dolby Atmos®, 2M Camera • Memory, SSD : LPDDR5X, NVMe SSD • Bluetooth v5.4, WiFi 7, 802.11 be 2x2 • Battery : 68.1Wh
			□ Galaxy Book4 Edge (2025.06.) - 인치 : 15.6" FHD (1920 x 1080) - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 356.6 x 229.75 x 15.0mm, 1.5kg - 사양 및 기능 • Platform, OS : Qualcomm Snapdragon X (8 core), Windows 11 • 그래픽 : Qualcomm Adreno • Bluetooth v5.4, WiFi 7 지원 • 스테레오 스피커 (1.5 W x 2), Dolby Atmos, 2M Camera • Battery : 61.2 Wh
			□ Galaxy Book5 (2025.07.)

			- 인치 : 15.6" FHD (1920 x 1080) - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 356.6 x 228.0 x 15.1mm, 1.55kg - 사양 및 기능 • Platform, OS : Intel® Core™ Ultra Processor Arrow lake, Windows 11 • 그래픽 : Intel® Graphics • 스테레오 스피커(2W x 2), Dolby Atmos®, 2M Camera • Memory, SSD : LPDDR5X, NVMe SSD • Bluetooth v5.2, WiFi 6, 802.11 ax 2x2 • Battery : 61.2Wh
			□ Galaxy Chromebook3 360 (2025.09.) - 인치 : 12.4" WQXGA (2560 x 1600) - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 287.9 x 206.6 x 16.9mm, 1.28kg - 사양 및 기능 • Platform, OS : Intel® Processor Twin lake, Chrome OS • 그래픽 : Intel® Graphics • 스테레오 스피커(1.5W x 2), 8M/1M Camera • Memory, SSD : LPDDR5X, eUFS • Bluetooth v5.3, WiFi 6E, 802.11 ax 2x2 • Battery : 45.6Wh
			□ Galaxy Book5 Edge 5G (2025.11.) - 인치 : 15.6" FHD (1920 x 1080) - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 356.6 x 229.8 x 15.5mm, 1.66kg - 사양 및 기능 • Platform, OS : Qualcomm Snapdragon X (8 core), Windows 11 • 그래픽 : Qualcomm Adreno • Bluetooth v5.4, 5G Sub6, WiFi 7 • 스테레오 스피커 (1.5W x 2), Dolby Atmos, 2M Camera • Battery : 61.2 Wh
			□ Galaxy Book6 Ultra (2026.01.) - 인치 : 16"터치 스크린 WQXGA+ (2880 x 1800) - 사이즈 (W x H x D) & 무게 : 외장 그래픽 356.9 x 248.0 x 15.4mm, 1.89kg 내장 그래픽 356.9 x 248.0 x 15.4mm, 1.79kg - 사양 및 기능 • Platform, OS : Intel® Core™ Ultra Processor Panther lake, Windows 11 • 그래픽 : Intel® Arc™ Graphics (내장 그래픽) NVIDIA® GeForce RTX™ 5060/5070 (외장 그래픽) • 식스 스피커 (우퍼 2W x 4, 트위터 1W x 2), Dolby Atmos®, 2M Camera • Memory, SSD : LPDDR5X, NVMe SSD • Bluetooth v5.4, WiFi 7, 802.11 be 2x2 • Battery : 80.20Wh
			□ Galaxy Book6 Pro (2026.01.) - 인치 : 16"터치 스크린 WQXGA+ (2880 x 1800) 14"터치 스크린 WQXGA+ (2880 x 1800) - 사이즈 (W x H x D) & 무게 : 16" 356.9 x 248.0 x 11.9mm, 1.59kg 14" 314.2 x 220.6 x 11.6mm, 1.24kg - 사양 및 기능 • Platform, OS : Intel® Core™ Ultra Processor Panther lake, Windows 11

			• 그래픽 : Intel® Arc™ Graphics, Intel® Graphics (4Xe only) • 16”쿼드 스피커 (우퍼 2W x 2, 트위터 1W x 2), Dolby Atmos®, 2M Camera 14”스테레오 스피커 (1.6W x 2), Dolby Atmos®, 2M Camera • Memory, SSD : LPDDR5X, NVMe SSD • Bluetooth v5.4, WiFi 7, 802.11 be 2x2 • Battery : 16” 78.07Wh, 14” 67.18Wh
			□ Galaxy Book6 (2026.03.) - 인치 : 16”터치 스크린 WUXGA (1920 x 1200), 16”WUXGA (1920 x 1200) 14” WUXGA (1920 x 1200) - 사이즈 (W x H x D) & 무게 : 16” 터치 스크린 357.1 x 248.0 x 16.8mm, 1.84kg 16” 357.1 x 248.0 x 14.9mm, 1.74kg 14” 313.4 x 221.1 x 14.9mm, 1.43kg - 사양 및 기능 • Platform, OS : Intel® Core™ Ultra Processor Panther lake, Windows 11 • 그래픽 : Intel® Graphics • 스테레오 스피커 (2W x 2), Dolby Atmos®, 2M Camera • Memory, SSD : LPDDR5X, NVMe SSD • Bluetooth v5.4, WiFi 6E, 802.11 ax 2x2 • Battery : 61.2Wh
			□ Galaxy Book6 Edge (2026.05.) - 인치 : 16” WQXGA+ (2880 x 1800) 터치 스크린 - 사이즈 (W x H x D) & 무게 : 355.4 x 250.4 x 12.3mm, 1.55kg - 사양 및 기능 • Platform, OS : Qualcomm Snapdragon® X2 Elite, Windows 11 • 그래픽 : Qualcomm® Adreno™ • 쿼드 스피커 (우퍼 1.6W x 2, 트위터 2.0W x 2), Dolby Atmos®, 2M Camera • Memory, SSD : LPDDR5X, eUFS • Bluetooth v5.4, WiFi 7, 802.11 be 2x2 • Battery : 61.8Wh
			□ Galaxy Book6 (2026.08.) - 인치 : 14” WUXGA (1920 x 1200) - 사이즈 (W x H x D) & 무게 : 313.0 x 221.0 x 15.7mm, 1.35kg - 사양 및 기능 • Platform, OS : Intel® Core™ 5 Processor Wildcat lake, Windows 11 • 그래픽 : Intel® Graphics • 스테레오 스피커 (2W x 2), Dolby Atmos®, 2M Camera • Memory, SSD : LPDDR5X, NVMe SSD • Bluetooth v5.4, WiFi 6E, 802.11 ax 2x2 • Battery : 61.2Wh
		Galaxy 워치 (~2026.08.)	□ Galaxy Watch7 / Galaxy Watch Ultra (2024.07.) - 인치 : Watch7 (44mm) 37.3mm Super AMOLED (480 x 480) Watch7 (40mm) 33.3mm Super AMOLED (432 x 432) Watch Ultra (47mm) 37.3mm Super AMOLED (480 x 480) - 사이즈(H x Wx D) & 무게 : Watch7 (44mm) 44.4 x 44.4 x 9.7 mm, 33.8g Watch7 (40mm) 40.4 x 40.4 x 9.7 mm, 28.8g Watch Ultra (47mm) 47.4 x 47.1 x 12.1 mm, 60.5g - Platform(H/W, S/W): Exynos W1000(5Core,3nm), Wear OS Powered by Samsung (Wear OS 5)

			- 강력한 하드웨어로 높은 사용성 제공 ・3나노 프로세서 탑재하여 빠른 CPU 속도와 소모 전류 효율 개선 ・이중 주파수 GPS 시스템 탑재하여 복잡한 환경에서의 GPS 정확도 개선 - 강화된 건강 모니터링 제공 ・최종당화산물 지표(AGEs Index) 측정 제공 ・수면 무호흡 감지 및 개선된 수면 AI 알고리즘 적용하여 정확한 수면 측정 지원 - 극대화된 성능을 통해 차원 높은 아웃도어 피트니스 경험 제공 (Ultra only) ・시그니처 원형 디자인에 새로운 쿠션 디자인 가미 ・다이나믹 러그 시스템 적용으로 쉬운 체결과 완벽한 착용감 제공 ・10ATM 방수 지원 등 극한 환경에서 다양한 피트니스 활동 측정 ・긴 배터리 수명 제공 : 절전모드 100시간, 운동 중 절전모드 48시간 사용 가능 - 배터리 : 47mm 590mAh, 44mm 425mAh, 40mm 300mAh 적용
			□ Galaxy Watch8 / Galaxy Watch8 Classic (2025.07.) - 인치 : Watch8 Classic (46mm) 34.0mm Super AMOLED (438 x 438) Watch8 (44mm) 37.3mm Super AMOLED (480 x 480) Watch8 (40mm) 34.0mm Super AMOLED (438 x 438) - 사이즈(H x W x D) & 무게 : Watch8 Classic (46mm) 46.0 x 46.4 x 10.6 mm, 63.5g Watch8 (44mm) 46.0 x 43.7 x 8.6 mm, 34.0g Watch8 (40mm) 42.7 x 40.4 x 8.6 mm, 30.0g - Platform(H/W, S/W): Exynos W1000(5Core,3nm), Wear OS Powered by Samsung (Wear OS 6) - 가장 얇은 디자인으로 뛰어난 착용감과 강력한 성능 제공 ・부품 집적도 개선하여 가장 얇은 두께 구현 ・쿠션 디자인 전 라인업에 확대 및 밴드 결합 구조 개선 통한 착용감 향상 ・최대 3,000 니트 밝기 구현으로 시인성 개선, 더 커진 배터리용량으로 장시간 사용성 지원 - 수면부터 운동, 항산화, 심혈관까지 고도화된 건강 인사이트 제시 ・취침 시간 가이드 기능으로 수면 패턴 분석 및 최적의 취침 시간 제안 ・수면 중 혈관 스트레스 측정 등 심혈관에 영향주는 생활 패턴 관리 ・러닝 코칭 기능 제공 및 러닝 수준 분석을 통한 개인 맞춤형 운동 계획 수립 및 실시간 코칭 ・스마트워치 최초의 항산화 지수 기능 탑재하여 식단과 생활 패턴 개선 통한 노화 관리 - One UI 8 Watch와 제미나이 탑재하여 스마트하고 직관적인 사용 경험 제공 ・UI 인터페이스 개선하여 최소한의 조작으로 삼성헬스, 날씨, 일정 등 핵심정보 확인 ・구글과 협업으로 Wear OS 6 및 제미나이 탑재하여 음성 명령으로 손쉽게 동작 수행 - 배터리 : 46mm 445mAh, 44mm 435mAh, 40mm 325mAh 적용
			□ Galaxy Watch9 / Galaxy Watch Ultra2 (2026.08.) - 인치 : Watch Ultra2 (47mm) 38.5mm Super AMOLED (498 x 498) Watch9 (44mm) 37.3mm Super AMOLED (480 x 480) Watch9 (40mm) 34.0mm Super AMOLED (438 x 438) - 사이즈(H x W x D) & 무게 : Watch Ultra2 (47mm) 47.4 x 47.1 x 10.7 mm, 61.5g Watch9 (44mm) 46.0 x 43.7 x 8.6 mm, 34.0g Watch9 (40mm) 42.7 x 40.4 x 8.6 mm, 31.5g - Platform(H/W, S/W): Qualcomm SDW6100(5Core,3nm), Wear OS Powered by Samsung (Wear OS 7) - 독보적인 하드웨어와 쿠션 디자인으로 뛰어난 착용감 및 강력한 내구성 구현 ·800mAh 대용량 배터리, 두께 10.7mm 설계 및 실리콘 밴드 적용하여 착용감 개선(Ultra2) ·티타늄 프레임과 IP69K·10 ATM 방수 및 다이빙 장비 안전 규격 EN13319 인증(Ultra2) ·최초 5,000니트(Ultra2) 디스플레이로 야외에서도 선명한 가시성 제공 - 강화된 신기능으로 사용자 맞춤형 종합 건강 인사이트 제공

			·심박수, 심박변이도, 피부온도, 혈중산소포화도 등의 측정을 통한 '생체 징후' 기능 탑재 ·수면, 체성분 및 혈관 스트레스 변화 추이 바탕의 '심장 건강 점수' 제공 ·FDA 승인 '수면 무호흡 감지' 기능 업그레이드 및 회복 상태 분석 '에너지 점수' 제공 ·'트레일 러닝' 및 실시간 '수분 섭취 가이드' 지원(Ultra2) - One UI 9.0 Watch와 Google Gemini 탑재하여 직관적이고 스마트한 사용 경험 제공 ·손목 들어올리는 동작만으로 Galaxy AI 음성 명령 수행 및 다양한 앱의 주요 정보 확인 가능 - Battery : Ultra2 800mAh, Watch9 44mm 445mAh, 40mm 390mAh 및 고주파 고속충전(Ultra2)
		Galaxy 버즈 (~2026.03.)	□ Galaxy Buds3 Pro / Buds3 (2024.07.) - 신규 Stem 디자인을 통한 착용성 개선 ・차별화된 Futuristic Blade 디자인으로 선망성 확보 - 오디오 기기 특성을 반영한 AI를 통해 개인 맞춤형 사운드 경험 제공 ・주변 환경에 따른 소음 최적화 및 착용 상태에 따른 실시간 사운드 최적화 - 통역 듣기모드 지원을 통한 자유로운 소통 경험 제공 - 사이즈(H x W x D)& 무게 : Buds3 Pro 18.1 x 19.8 x 33.2 mm, 5.4g Buds3 18.1 x 20.4 x 31.9 mm, 4.7g Cradle 48.7 x 58.9 x 24.4 mm, 46.5g - Platform(H/W, S/W) : BES2800(6nm)/BES2700(12nm), RTOS - 오디오 음질 개선 ・24bit/96kHz UHQ 지원 *Buds2 Pro(24bit/48kHz Hi-Fi) ・Buds3 Pro 분리형 2 Way Speaker 적용 ・Adaptive EQ 지원 *Buds2 Pro(Fixed EQ) - 설계 최적화를 통한 통화 품질 개선 ・Complex DNN/VPU 솔루션 적용으로 음성 명료도 강화 ・Super Wide Band 통화 지원으로 음성 대역폭 강화 - Cradle 버튼 Pairing 적용으로 직관적인 동작 경험 제공 - Intelligence 기능 경험 강화 ・Buds3 Pro Siren/Voice Detect 및 Adaptive Noise Control 지원 - 배터리 : Buds3 Pro 53mAh, Buds3 48mAh, Cradle 515mAh
			□ Galaxy Buds3 FE (2025.09.) - Buds FE 후속으로 모던한 Blade Design 적용 및 더 강화된 주요 기능으로 경쟁력 확보 - 사이즈(H x W x D) & 무게 : Earbuds 21.1 x 18.0 x 33.8 mm, 5g Cradle 48.7 x 58.9 x 24.4 mm, 41.8g - Platform(H/W, S/W) : BES2700Y-A8T(12nm), RTOS - Blade Design 확대 적용 및 정교한 컴퓨터 모델링 통한 최적의 착용감 제공 - 직관적인 Pinch & Swipe 컨트롤 및 Cradle 하단 Pairing 버튼을 통한 손쉬운 연결 경험 - 11mm 스피커 탑재를 통한 강화된 사운드 품질 및 선명한 통화품질, ANC 성능 향상 - 통역 모드 지원 및 음성 호출을 통한 Gemini 사용으로 손쉽게 Galaxy AI 경험 제공 - Earbuds IP54 등급 방수/방진
			□ Galaxy Buds4 Pro / Galaxy Buds4 (2026.03.) - 착용감, Sound & 통화품질, Galaxy 연동 경험 등 기본기 전반에 대폭 향상 - 사이즈(H x W x D) & 무게 : Buds4 Pro 30.9 x 18.1 x 19.6mm, 5.1g Buds4 30.5 x 18.3 x 19.3mm, 4.6g Cradle 51.0 x 28.3 x 51.0mm, 44.3g(Buds4Pro) / 45.1g(Buds4) - Platform(H/W, S/W) : BES2810YP(6nm)/ BES2700Y(12nm), RTOS - 메탈 블레이드 디자인 및 장시간 착용에도 안정성과 편안함 제공 ・ 새롭게 디자인된 메탈 블레이드에 음각 처리된 핀치 컨트롤 영역으로 직관적인 기기 제어 ・ 다양한 귀 형상을 반영한 정교한 인체공학적 설계로 편안한 착용감

			- 더 강화된 초고음질 사운드 및 통화 품질 제공 · 스피커의 진동 면적 극대화로 풍부한 저음부터 선명한 고음까지 균형 잡힌 사운드 · 사용자의 착용 상태를 실시간으로 분석하는 적응형 ANC 알고리즘으로 주변 소음 제어 · 강화된 딥 뉴럴 네트워크(DNN) 기술을 통한 선명한 음성 및 슈퍼 와이드 밴드로 깨끗한 통화 품질 - Galaxy 경험 강화 · 헤드 제스처 기능으로 고개를 움직이는 동작만으로 전화를 받거나 빅스비 제어 가능 · 갤럭시 웨어러블 앱 설치 없이 기기 설정에서 기능 설정 지원
		Galaxy 링 (2024.07.)	□ Galaxy 링 (2024.07.) - 일상 중 항시 착용 가능한 디자인으로 Galaxy Health 경험 확장 - 사이즈 : 11종 (5호 ~ 15호) - 크기 & 무게 : (Ring) 7.0(W) x 2.6 mm(D), 2.3g(5호) ~ 3.3g(15호) (Cradle) 48.9(H) x 48.9(W) x 24.5mm(D), 61.3g - Platform(H/W, S/W) : nRF5340, Zephyr RTOS - 24/7 상시 착용에 용이한 디자인 및 배터리 사용시간 · 슬림하고 가벼운 디자인으로 편안한 착용감 · 한번 충전하면 최대 7일 사용으로 건강 정보 지속 측정 가능 * 5호 18mAh ~ 15호 23.5mAh - 티타늄 소재 및 10ATM, IP68 방수 적용으로 내구성 강화 - 개인 맞춤형 건강 관리 기능 제공 · 개인의 컨디션 관리를 위한 지표 및 개인화된 인사이트 메시지 제공 · 고도화된 수면 분석 및 코칭 지원 · 고/저심박수 알림, 자동 운동 감지 등 일상 활동에 대한 모니터링 - Galaxy 사용자 차별화된 사용 경험 제공 · 단말과 연계된 Easy Pairing, 제스처 컨트롤, 링 위치 찾기 지원 · 워치와 동시 착용 시 사용시간 개선 등 최적의 사용성 제공
		Galaxy XR (2025.10.)	□ Galaxy XR (2025.10.) - 세계 최초 Android XR 기반 VST(Video See Through) 기기 - 인치 : 4K 마이크로 OLED 디스플레이(3552 x 3840) - 무게 : 545g - 사양 및 기능 · Platform (H/W, S/W) : XR2+ Gen2, Android 14, One UI XR · Camera 및 Audio 기반 저지연/고정확도 트래킹 솔루션 개발로 신규 인터렉션 경험 제공 : Hand ↔ Eye 자동 인터렉션 전환, Gemini 기반 Conversational UI 등 · Android 기반의 우수한 에코 확장성 제공 · Controller 연동을 통한 다양한 게임 사용 편의성 제공 · 신규 폼팩터 Visor Window (고곡률, 대면적 비대칭 3D Glass) 양산 기술 개발 · OLEDoS 기반 저지연/고화질 Rendering pipeline 구현으로 쾌적한 사용 경험 제공
	네트워크	RAN S/W Package (~2025.10.)	□ 5G vRAN SW PKG (2024.06.) - RedCap Energy-saving 기능 시험 완료(5G IoT 디바이스의 전력 소모를 줄이는 기능 시험) · 업계 최초로 vRAN 기반 5G RedCap Energy-saving 기술 시험 완료 · 당사는 vRAN RedCap 기술 검증(美 vRAN 상용망 등)을 이어오고 있으며, 향후 tRAN, vRAN 모두 상용 기능 제공할 계획 * tRAN(traditional RAN) : 하드웨어 기반 기지국 * RedCap(Reduced Capability) : 5G 저전력 사물 인터넷(IoT) 기술 □ AI 기반 5G 기지국 품질 최적화 기술(AI-RAN Parameter Recommender) (2024.10.) - 기지국 환경에 맞는 최적의 파라미터(parameter, 매개변수)를 자동으로 추천하는 AI기반 기술을 개발, SKT와 협력하여 상용망에 적용 및 실증 - 향후 기지국 성능 극대화로 체감품질 향상 및 트래픽 변화 빈번한 곳에 확대 적용 예정

			□ MCPTX SW Package 개발 ('25.10월) - 영국 정부 국가재난안전망(ESN)에 당사 MCPTX 솔루션 개발 공급 후 상용망에서 첫 Demo(성능/안정성) 성공적으로 시연함 * MCPTX : Mission Critical Push-to-X(Talk/Video/Data) - 재난안전망에서 다양한 시스템(음성,데이터,비디오)간의 통합 통신을 가능하게 하는 솔루션 * ESN : Emergency Service Network - 영국 정부에서 구축/운용하는 국가재난안전망(Emergency Service Network)
		기지국 (~2026.04.)	□ 캐나다 n77(3.4~3.8GHz) NR 64T64R 신규 MMU (2024.08.) - 새로운 구조의 New PAM(Power Amplifier Module : 전력 증폭기 모듈) 적용한 고출력의 New MMU 플랫폼 제품 개발 - 기존 제품대비 Wideband 지원(고효율)으로 고출력, 저전력을 요구하는 글로벌 시장 진입이 가능해져 5G 시장 확대에 기여 * Wideband 지원: 넓은 주파수 대역 사용으로 많은 양의 데이터 동시 전송으로 전송속도가 빠름 □ PCS/AWS 640W Dual Band RU 개발 (2025.09.) * PCS(Personal Communication Service): 주로 1.9GHz 주파수 대역 * AWS(Advanced Wireless Services): 주로 1.7/2.1GHz 주파수 대역 - 북미 PCS/AWS 주파수 대역에서 당사 최초 고출력(640W) Dual Band RU 개발 - 신규 Chip 플랫폼 적용을 통해 기존 대비 제품 경쟁력 강화 (출력은 향상, 사이즈/무게는 감소) □ PCS/AWS 720W Dual Band RU 개발 (2026.02.) - 북미 PCS/AWS 주파수 대응, 당사 최초 720W 고출력 Dual Band RU 개발 확보 □ 1.8GHz/2.1GHz 4T4R 320W RU 개발 (2026.04) - 유럽 사업자 대응을 위해 1.8GHz/2.1GHz 대역 지원, Wideband AMP 적용한 당사 첫 제품 개발 및 공급 . 신규 O-RAN(open RAN)칩과 Wideband AMP 적용으로 기존 제품(Single-band AMP) 대비 사이즈 및 무게 감소 * Single-band AMP(단일 대역 증폭기): 특정 주파수 대역을 증폭하도록 설계된 협대역 앰프 * Wideband AMP(광대역 증폭기): 서로 다른 주파수 대역을 동시에 증폭할 수 있도록 설계된 광대역 앰프
DS 부문	메모리	모바일용 DRAM (~2024.12.)	□ 미디어텍과 업계 최고 속도 LPDDR5X 동작 검증 성공 (2024.07.) - 미디어텍 최신 플래그십 모바일AP '디멘시티'에 검증 완료로 고성능 제품 상용화 선도 - 온디바이스 AI 시대에 저전력・고성능 LPDDR D램 역할 증대 - 모바일 분야 넘어 AI 가속기, 서버, HPC, 오토모티브 등 응용처 적극 확대 □ LPDDR 기반 서버용 메모리 모듈 SOCAMM2 개발 ('25.12월) - LPDDR을 새로운 폼팩터에 구현한 제품으로 기존 RDIMM 대비 2배 이상의 대역폭과 55% 이상 낮은 전력 소비를 제공 - 분리형 모듈 구조로 LPDDR을 메인보드에 직접 실장(Soldering) 하지 않고 장착, 수평 장착 구조(기존 서버용 메모리는 수직)로 공간 활용도 및 냉각 효율 향상
		서버용 DRAM (~2025.06.)	□ 업계 최선단 10나노급 6세대 D램 양산 ('25.6월) - 10나노급 5세대 D램 대비 생산성 30% 이상 향상, 저전력 특성 약 10% 개선 - 신소재 적용 등으로 EUV 공정 최적화 - 10나노급 6세대 라인업에 HBM 등을 포함하여 다양한 AI 응용처에 대응 예정
		그래픽 DRAM (~2025.01.)	□ 업계 최초 24Gb GDDR7 D램 개발 ('24.10.) - 12나노급 미세 공정 적용해 셀 집적도 증가, 업계 최고 용량 24Gb 구현 - 'PAM3 신호 방식' 적용으로 40Gbps의 속도 자랑, 최대 42.5Gbps 가능 - 'Clock 컨트롤 제어 기술' 적용 등으로 저전력 특성 구현 및 전력 효율 극대화 - 기존 그래픽 D램 응용처부터 AI 워크스테이션, 데이터센터까지 폭넓게 활용 □ 업계 최초 24Gb GDDR7 D램 양산 ('25.1월)

			- 그래픽 D램 중 최고 용량인 24Gb 구현으로, 고용량 그래픽 카드 수요에 대응 가능한 집적도 확보 - 업계 최고 수준인 최대 42.5Gbps 속도 및 총 1.92TB/s 대역폭을 지원하여 차세대 AI 및 그래픽 환경에 최적화 - 고열전도성 신소재 적용으로 패키지 열저항 특성을 이전 GDDR7 제품 대비 11% 개선, 고성능 동작 환경에서의 신뢰성 강화 - '25.12월 대한민국 기술대상 대통령상 수상
		HBM (~2026.05.)	□ 업계 최초 36GB HBM3E 12H D램 개발 (2024.02.) - 12단 적층으로 업계 최대 용량 36GB 구현, - Advanced TC NCF 기술로 HBM3 8단과 동일한 높이로 12단 적층 구현 및 성능과 용량 모두 50% 이상 향상 - 업계 최소 7마이크로미터 칩간 간격으로 수직 집적도 개선 및 다양한 사이즈의 범프를 적용 - 고객사에 샘플 제공 시작, 상반기 양산 예정 □ 세계 최초 업계 최고 성능의 HBM4 양산 출하 (2026.02.) - 최선단 공정 1c D램(10나노급 6세대) 및 4나노 베이스 다이 적용 - JEDEC 표준(8Gbps) 상회하는 11.7Gbps(최대 13Gbps) 동작성능 확보 - 24GB(8H)~48GB(16H) 용량 제공, 저전력 설계 등 전력효율 및 발열 해결 - 로직 - 메모리 - 파운드리 - 패키징을 아우르는 '원스톱 솔루션', 선제적 인프라 투자로 공급 안정성 확보 □ 업계 최초 HBM4E 12단 샘플 출하 (2026.05.) - 핀당 14Gbps의 속도로 안정적으로 동작하며, 최대 16Gbps까지 구현해 빠른 데이터 처리를 지원 - 전작 HBM4 대비 20% 이상 향상된 수치로, 단일 스택 기준 초당 3.6TB(테라바이트)에 달하는 대역폭 구현 - 저전력 설계 및 패키징 구조 최적화 기술을 적용해 전작 대비 에너지 효율은 16%, 열 저항 특성은 14% 이상 개선 - 로직 - 메모리 - 파운드리 - 패키징을 아우르는 '원스톱 솔루션'을 통해 공급 안정성 확보 - 업계 최대 수준의 생산 능력과 선제적 인프라 투자를 통해 고객 수요에 유연한 대응 추진
		NAND (~2024.09.)	□ 업계 최초 '9세대 V낸드' 양산 (2024.04.) - 업계 최초 '1Tb TLC 9세대 V낸드' 양산 - 더블 스택(Double Stack) 구조로 구현 가능한 최고 단수 V낸드 - 업계 최소 크기 두께, 차세대 인터페이스 적용 등으로 기술 리더십 증명 - 최첨단 기술로 셀 면적은 줄이면서 간섭 현상은 줄여 이전 세대 대비 비트 밀도 1.5배 증가 □ 업계 최초 'QLC 9세대 V낸드' 양산 (2024.09.) - 9세대 V낸드 QLC, TLC 모두 업계 최초 출시로 고용량 QLC・고성능 TLC 통해 차세대 낸드플래시 시장 경쟁력 강화 - '채널 홀 에칭' 기술로 더블 스택 구조 등 혁신 기술 집약을 통해 업계 최고 단수 제품 구현 - 브랜드 제품 시작으로 모바일 UFS, PC・서버 SSD 등 응용처 확대
		eStorage (~2026.06.)	□ 업계 최초 온디바이스 AI 최적화 UFS 5.0 개발 (2026.06.) - V9 낸드 기반으로 업계 최고 성능 10.8GB/s 데이터 전송 대역폭 갖춰 UFS 4.1 대비 2배 이상 향상 - 모바일 저전력 환경에 최적화된 클락 게이팅, 멀티 전압 기술 적용으로 전작 대비 전력 효율 40% 개선 - 전작 대비 16.7% 작아진 패키지 구현으로 용량은 최대 1TB까지 제공
		서버 SSD (~2026.07.)	□ 차세대 인터페이스 PCIe 6.0 기반 서버용 SSD PM1763 개발 - 9세대 V낸드와 4나노 기반 컨트롤러 탑재로 성능 및 전력 효율 향상 - 16TB 용량 기준 업계 최고 성능 구현 - 액체 냉각 환경에 최적화된 제품으로 D2C(Direct to Chip) 냉각 방식 활용해 장시간 성능 유지 □ AI 인프라에 최적화된 기업용 SSD PM1763 양산('26.7월) - 9세대 V낸드와 4나노 기반 컨트롤러 탑재로 성능 및 전력 효율 향상

			- 4/8/16TB 3가지 용량 제공 및 16TB 용량 기준 연속 읽기・쓰기 속도는 각각 최대 초당 28,400MB, 21,900MB로 전작(PM1753) 대비 약 2배 향상, 업계 최고 성능 구현 - 소자에 냉각판을 부착하는 D2C 방식 활용하여 액체 냉각 환경에 최적화 - 전작 대비 전력 효율이 1.8배 이상 향상돼 데이터센터 운영 비용 절감에 기여
		Client SSD (~2024.10.)	□ 업계 최고 성능 최대 용량 PC용 SSD PM9E1 양산 (2024.10.) - 8채널 PCIe 5.0 지원 및 8세대 V낸드 탑재로 업계 최고 성능 구현 - 고용량 4TB 옵션, AI 생성 컨텐츠 등 대용량 파일 저장 가능 - 전작 'PM9A1a' 대비 성능 최대 2배, 전력 효율 50% 이상 개선 - 신규 보안 솔루션인 SPDM 1.2버전 적용으로 데이터 위・변조 방지
		브랜드 SSD (~2026.08.)	□ 성능과 범용성 모두 갖춘 소비자용 SSD '990 EVO' 출시 (2024.01.) - '970 EVO Plus' 대비 읽기・쓰기 속도 최대 43% 향상 - 5나노 신규 컨트롤러 탑재로 전력 효율 최대 70% 개선 - 차세대 인터페이스 PCIe 5.0 x2 지원 - 호스트 메모리 버퍼(HMB) 기술 적용으로 가격 경쟁력 강화 □ PCIe 4.0 기반의 고성능 소비자용 SSD '990 EVO Plus' 출시 (2024.09.) - 8세대 V낸드・5나노 컨트롤러 탑재로 전작 대비 읽기・쓰기 속도 45%, 50% 향상 및 전력 효율 70% 이상 개선 - 고용량 4TB 제품 포함 3가지 용량으로 출시로 소비자 선택지 확대 - 노트북・PC 메인보드에 장착해 성능・용량 간편하게 업그레이드 가능 - 니켈 코팅된 컨트롤러와 열 분산 라벨로 과열 방지, 제품 안정성 강화 □ PCIe 5.0 기반의 고성능 소비자용 SSD '9100 PRO' 출시 (2025.03.) - PCIe 4.0 인터페이스 대비 2배 빠른 속도로, 전작인 '990 PRO' 대비 순차 읽기 속도 99% 향상, 전력 효율 49% 향상 - 고용량 8TB 제품 포함 4가지 용량으로 출시하여 소비자 선택지 확대 - 노트북, 데스크탑, 게임 콘솔까지 설치 가능 □ PCIe 5.0 기반의 고성능 소비자용 SSD '9100 PRO 8TB' 출시 ('25.9월) - PCIe 4.0 인터페이스 대비 2배 빠른 속도로, 전작인 '990 PRO' 대비 순차 읽기 속도 99% 향상, 전력 효율 49% 향상 - 당사 소비자용 SSD 중 최초 8TB 대용량 모델로 게이머, 크리에이터, 전문가들의 니즈 충족 - 최신 고용량 게임 및 콘텐츠 저장에 최적화(90GB급 게임 80개 저장 가능) - 노트북, 데스크탑, 게임 콘솔 등 다양한 기기와 호환을 위해 11.25mmT 두께의 특수 방열판 설계 적용 □ 신규 Portable SSD 'T7 Resurrected' 출시 ('25.11월) - 기존 T7 모델과 동일 성능(최대 읽기 1,050MB/s, 쓰기 1,000MB/s) 유지하면서, 100% 재활용 알루미늄 외장케이스 등 자원 선순환 고려하여 개발한 제품 (CES 2026 혁신상 'Sustainability & Energy Transition 부문' 수상) - 스마트폰, 태블릿, 게임콘솔 등 다양한 기기와 호환되며, 모바일 4K 영상 촬영 및 편집 작업에 적합 - 신용카드 크기의 컴팩트한 디자인에도, AES 256비트 하드웨어 암호화, 최대 2m 낙하 충격 내구성을 통해 데이터 손실 보호 □ 차세대 포터블 SSD 2종 P9, P7 공개 ('26.8월) - USB4 인터페이스 적용, 플래그십 'P9', 일상형 'P7' 출시 - 연속 읽기 속도 최대 4,000MB/s 이전 세대 대비 속도 2배 향상 및 12K Direct Recording 최적화 - 세계 최초 4,000MB/s 지원 8TB USB4 제품으로 CES 2026 혁신상 수상 및 폭넓은 디바이스 호환성과 검증된 내구성으로 높은 만족도 기대
		CXL (~2024.06.)	□ 업계 최초 '레드햇 인증 CXL 인프라' 구축 (2024.06.) - 삼성전자 내부 연구시설인 SMRC에 레드햇 인증 CXL 인프라 구축하여

			제품부터 소프트웨어까지 모든 서버 구성 요소 자체 검증 가능 - 업계 최초 CMM-D 레드햇 인증 등 신속한 제품 개발 진행, 고객 맞춤 솔루션 제공 - 美 '레드햇 서밋 2024'에서 CXL 기반 서버 성능 향상 기술 시연
		브랜드 Card (~2025.11.)	□ 업계 최초 SD 익스프레스 마이크로SD 카드 개발 (2024.02.) - 마이크로SD 카드 최고 연속 읽기 성능인 초당 800 메가바이트(800MB/s)와 256GB의 고용량을 제공 - SSD에 탑재했던 DTG(Dynamic Thermal Guard) 기술을 최초 적용해 소형 폼팩터에서 발생하는 발열 문제를 효과적으로 해결 □ 최신 V낸드 기반 고용량 1TB UHS- I 마이크로 SD카드 양산 (2024.02.) - 8세대 V낸드로 마이크로 SD카드에 테라바이트급 고용량 구현 - 방수, 낙하마모 등 극한 외부환경에서도 데이터를 안전하게 보호 □ 고용량 1TB 마이크로SD 카드 2종 출시 (2024.08.) - 업계 최고 용량 1Tb TLC 8세대 V낸드 적용하여 테라바이트급 고용량 구현 - 최대 용량 1TB로 고성능・고용량 솔루션에 대한 요구 충족 - 28나노 컨트롤러 탑재로 전력 효율 개선, 배터리 소모량 감소 □ 차세대 게이밍을 위한 microSD Express 카드 'P9 Express' 출시 (2025.11.) - 닌텐도 스위치 2에 최적화된 microSD Express 카드로 256/512GB 용량 출시 - PCIe 인터페이스 및 NVMe 프로토콜 기술 기반으로 최대 800MB/s의 순차 읽기 속도 제공, UHS-I microSD 카드 대비 4배 빠른 성능 - SSD에 탑재된 기술인 HMB(Host Memory Buffer), DTG(Dynamic Thermal Guard) 등 적용하여 장시간 게임 중에도 안정적인 성능 유지 - 물, 온도, X-ray, 자기장 등 6대 위험요소로 부터 데이터 보호하는 내구성 지원
		Automotive (~2024.09.)	□ 퀄컴 차량용 솔루션에 'LPDDR4X' 공급 (2024.08.) - 삼성전자-퀄컴, 차량용 반도체 분야에서 첫 협력 시작하여 스냅드래곤 디지털 섀시에 공급 및 프리미엄 차량용 인포테인먼트 지원 - 영하 40℃~영상 105℃까지 극한 환경에서도 안정적 성능 보장 - 글로벌 완성차 및 자동차 부품 업체 등 고객사에 장기 공급 계획 □ 업계 최초 8세대 V낸드 기반 차량용 SSD 개발 (2024.09.) - 256GB SSD 샘플 고객 제공 및 차량 내 AI 기능 지원 최적화 - 8세대 V낸드・5나노 기반 컨트롤러 탑재로 업계 최고 속도 구현 - 고성능 SLC 모드 지원으로 고용량 파일 빠르게 접근 가능 - 내년 초 2TB 제품 출시로 차량용 고용량 SSD 고객 수요 대응
	SystemLSI	이미지센서 (~2026.08.)	□ 업계 최초 망원용 2억화소 모바일 이미지 센서 공개(HP9, 0.56um/200Mp) - 독자 개발 신규 소재 적용 마이크로 렌즈 적용, 저조도 감도 대폭 향상 - 3배 망원 모듈 탑재시 최대 12배 줌까지 선명한 화질 구현 □ 새로운 픽셀 기술의 집약체로 듀얼 픽셀 '아이소셀 GNJ' 출시(GNJ, 1.0um/50Mp) - '센서 자체 줌' 기능 탑재로 잔상, 모아레 현상 없는 선명한 해상력 구현 - 픽셀 간 격벽 물질 변경으로 픽셀 간섭 현상 최소화해 빛 투과율 향상 □ 모든 화각에서 일관된 카메라 경험 선사, '아이소셀 JN5' 출시(JN5, 0.64um/50Mp) - 얇은 옵티컬 포맷 적용하여 광각, 초광각부터 전면, 망원용까지 채용 가능 □ 얇은 스마트폰 구현 가능한 센서 솔루션(ALoP : All Lenses on Prism) 공개 - 렌즈와 프리즘 구조를 재배치하여 렌즈 직경이 커져도 작은 모듈 사이즈 유지 □ 업계 최초 나노 프리즘 적용... '아이소셀 JNP' 출시(JNP, 0.64um/50Mp) - 업계 최초 나노 프리즘 적용,전세대 제품(JN5) 대비 감도 25% 향상 - 최신 센서 기술(하드웨어 리모자이크, 듀얼 슬로프 게인, Super QPD) 적용으로 선명한 화질 및 정확한 자동 초점 구현 □ 업계 최초 0.5um 픽셀 2억화소 센서... '아이소셀 HP5' 출시(HP5, 0.5um/200Mp) - FDTI(Front Deep Trench Isolation), D-VTG(Dual Vertical Transfer Gate),

			DCC(DTI Center Cut) 등 최신 픽셀 기술 적용, 밝고 선명한 이미지 구현 - 업계 최소 크기 2억화소 센서로 얇고 세련된 카메라 디자인 가능 및 E2E AI 리모자이크 기술 탑재로 빠른 이미지 처리 구현 □ 업계 최초 'DeepPix' 적용 2억화소 센서 '아이소셀 HPC' 출시(HPC, 0.6um/200Mp) - FDTI(Front Deep Trench Isolation) 기반 DeepPix 적용, 풀웰 커패시티(FWC) 전작 대비 60% 향상, 노이즈 감소 및 다이내믹 레인지 확대 - 네이티브 16비트 RAW 출력(RAW10~RAW16) 및 싱글 프레임 16비트 HDR 지원, 기존 HDR 대비 최대 4배 풍부한 색 표현 구현
		엑시노스 (~2026.03.)	□ 삼성전자, 최신 기술 적용 모바일 AP '엑시노스 1480' 공개 - 최신 4나노 공정 적용, 전작 대비 22% 개선된 전력 효율성 - 강력한 AI성능 기반으로 콘텐츠 인식 이미지 프로세싱 기능 탑재 - AMD RDNA 기반 엑스클립스 530 GPU 탑재로 전 세대 대비 그래픽 성능 향상 □ 삼성전자, 최신 기술 적용 웨어러블 SOC '엑시노스 W1000' 공개 - 웨어러블 최초 3나노 공정 적용 및 Big 코어 탑재, 전작(엑시노스 W930) 대비 싱글코어 3.4배, 멀티코어 3.7배 성능 개선 - 최신 패키지(FO-PLP: Fan-Out Panel Level Packaging, SiP: System in Packaging, ePoP: embedded Package on Package) 적용으로 시스템 실장 공간 확보 극대화 □ 삼성전자, 성능 대폭 개선한 모바일 AP '엑시노스 1580' 공개 - CPU 업그레이드(Armv9) 및 트라이 클러스터 아키텍처 적용으로 탁월한 CPU 성능 - 3세대 커스텀 GPU(Xclipse 540) 탑재로 전세대(1480) 대비 최대 성능 37% 향상 - 2억화소 이미지 센서 처리 기능 및 초당 14.7조 회의 연산(TOPS) 지원 NPU 탑재 □ 삼성전자, 강력한 CPU/GPU/NPU 통합 성능의 '엑시노스 2500' 공개 - 저전력 아키텍처, 최첨단 3나노 GAA 공정 및 FOWLP 패키지 기술 적용으로 전력 효율 향상 - 전작(엑시노스 2400) 대비 39% 향상된 AI 성능으로 강력하고 개인화된 기능 제공 □ 삼성전자, 업계 최초 2nm GAA 공정 기반 최첨단 모바일 AP '엑시노스 2600' 출시 - 최신 CPU 코어 적용 및 아키텍처 개선 등을 통해 전작(엑시노스 2500) 대비 CPU 39%, GPU Ray Tracing 50%, NPU AI 113%의 성능 개선 - 모바일 SoC 업계 최초 히트 패스 블록(HPB) 탑재로 방열 성능 개선 - 최대 230Mp 초고해상도 카메라 센서 지원 및 AI 기반 영상 보정 지원 등 실사용 경험을 위한 성능 강화 □ 삼성전자, 세가지 위성 통신 기술을 단일 칩에 통합한 '엑시노스 모뎀 5410' 출시 - LTE DTC, NB-IoT NTN, NR-NTN 통신 기술을 단일 칩에 지원하여, 외딴 지역에서도 안정적인 연결성 구현 - 4nm EUV 공정 사용하여 대기 전력 소비 개선 및 효율성 향상 - 3GPP Release 17 표준 기반, FR1 및 FR2 대역을 동시에 활용하여 최대 14.79Gbps 지원 □ 삼성전자, 모바일 온디바이스 AI 경험을 위한 차세대 플랫폼 '엑시노스 1680' 출시 - 1개의 빅코어, 4개의 미들코어, 3개의 리트코어로 구성된 트라이 클러스터 아키텍처 적용 - AMD RDNA3 아키텍처 기반 Xclipse 550 탑재, 전작(엑시노스 1580) 대비 16% 성능 향상 - 2억화소 이미지 센서 지원 및 고도화된 이미지 처리 기술 적용, 선명하고 생생한 이미지 디테일 경험 구현 □ 삼성전자, Wi-Fi7과 Bluetooth 6 결합한 Baseband IC '엑시노스 커넥트 6375' 출시 - 5nm FinFET 공정으로 전력 효율 향상 및 발열 저감으로 안정적이고 일관된 연결 품질 제공 - Wi-Fi7(802.11be) 지원해 최대 6.45Gbps 고속 전송 구현 - 진화된 Bluetooth 기술 기반으로 센티미터 단위의 정밀한 거리 측정 및 향상된 오디오 성능 제공
		LSI (~2025.06.)	□ 업계 최초 하드웨어 PQC(Post Quantum Cryptography) 탑재 IC 개발(S3SSE2A) - 독립적인 보안 처리 및 정보 저장 가능하여, AP의 보안 연산과 관계없이 더욱 안전한 보안 환경 제공 □ 무선 전력 컨소시엄(Wireless Power Consortium)의 Qi 표준을 지원하는 무선충전 IC 개발(S2MIW06)

			- 다양한 환경에서 일관된 성능 지원 및 대용량 내장 메모리 활용 펌웨어 기반 동작 - 최대 50W의 고출력 무선 충전 및 스마트폰의 무선 배터리 공유 기능 지원 □ 고용량/고속 특성에 최적화된 최첨단 서버/클라이언트 DDR5 메모리 모듈 솔루션 출시(S2FPD01, S2FPD02, S2FPC01, S2FTD01, S2FHD01, S2FCD31) - DIMM 모듈 전력 공급(PMIC), 시스템 운영/관리(SPD: Serial Presence Detect, TS: Temperature Sensor), 성능 향상(CKD: Client Clock Driver) 칩셋 제공
	Foundry	HPC 전용 4나노 4세대 공정 (2024.11.)	□ High-Performance Computing(HPC) 전용 공정인 4나노 4세대 공정 양산 - 고속 동작 트랜지스터와 개선된 후속 배선 공정 (BEOL) 추가를 통한 RC 지연 감소 제공하는 고성능 저전력 HPC용 최적화된 공정 - 2.5D/3D 선행 패키지 기술 지원 가능
		3나노 2세대 GAA 공정 (2025.03).	□ GAA 트랜지스터 적용한 3나노 2세대 공정 양산 - 3나노 2세대 GAA 공정은 5나노 공정 대비 면적 35% 감소 및 소비전력 40% 이상 감소, 성능 최대 30% 향상을 통해 저전력, 고성능 구현 - 플래그십 5G 스마트폰의 속도와 배터리 요구사항에 부응하며, AI 및 HPC 등 다양한 응용분야 지원
		2나노 1세대 GAA 공정 (2025.09.)	□ 모바일 최적화된 2나노 1세대 GAA 공정 양산 - 2나노 1세대 GAA 공정은 3나노 2세대 대비 성능 5%, 전력 효율 8% 개선되고 면적은 5% 감소 - GAA 공정의 DTCO(Design-Technology Co-Optimization)를 통해 첨단 모바일 프로세서에 필요한 고성능 저전력 지원
SDC	디스플레이 패널	Galaxy S24 AMOLED개발 (2024.01.)	□ Galaxy S24 (6.16"FHD+, 6.66"WQ+, 6.79WQ+) - 고해상도 저소비전력 기술과 패널 Dead Space 최소화 기술 접목 - 고해상도에서 고휘도 및 저전력, Slim Bezel구현. 화질 특성 및 사용자 체감성능 향상
		31.5"UHD, 27"QHD QD-OLED개발 (2024.01.)	□ 31.5"(140ppi), 27"(360Hz) QD-OLED 모니터개발 - 초정밀 잉크젯 프린팅 기술 및 당사 고유 AI 기반 구동 알고리즘 기술로 고해상도(140ppi), 고주사율(360㎐) 자발광 제품 개발
		BMW Mini 13.4" 185ppi개발 (2024.06.)	□13.4", 차량 Center Information Display用 Round OLED Display (1,752 x 1,660) - Automotive向 Round Shape 최초 적용 - 新 보상회로 및 패널구조 개발로, 비정형 Display의 영역별 균일특성 확보 - 대면적 비정형 OCTA 기술 개발
		Surface Pro 10 개발 (2024.05.)	□ 13" WQ+ (2,880x1,920, 3:2) - 30Hz 저주파 구동 노트북 OLED 최초 적용 (30~120Hz 가변주사율)으로 低소비전력 구현
		Galaxy Z Fold6용폴더블 OLED개발 (2024.07.)	□ 7.61" (2,160x1,856) 폴더블用 Display - 광효율 및 시인성 개선 新패널 구조/재료 적용으로 低소비전력 구현, 화질 개선 - 폴더블 내구성 향상 구조/재료 적용
		Google Pixel 9proXL용 OLED개발 (2024.09.)	□ 6.75" 고화질/저전력 스마트폰用 Display・1,344 x 2,992, Peak 휘도 3,000nit - 低소비전력 패널 구조와 고효율 신규 유기재료 적용으로 밝기와 수명, 화질 개선 및 소비전력 10% 감소
		Galaxy S25 Ultra AMOLED 개발 (2025.01.)	□ 6.86" WQ (1,440 x 3,120) - 전작比 Display size는 확대하고 좌우,하단 Border 및 두께 감소로 Full Screen, Slim 디자인 구현 - 120Hz 주사율, 고휘도(Peak 2,600nit)
		27"UHD 16:9 QD-OLED 모니터 개발 (2025.03.)	□ 자발광 최고 해상도 27"U 16:9 (160ppi) 프리미엄 모니터 - 초정밀 제어 잉크젯 프린팅 기술로 27"UHD 고해상도구현, Pixel 집적도 향상 - 선명한 고화질 제품으로 게임 몰입감 향상 및 사진 편집, 동영상 제작 등 생산성 증가 기여 가능
		27"QHD 500Hz QD-OLED 모니터 개발 (2025.05.)	□ 세계최초 자발광 최고 주사율 27"QHD 500Hz QD-OLED Display - 초고주사율 구동 알고리즘 및 패널 최적화 기술로 기존 360Hz → 500Hz로 자발광 최고 주사율 구현 - 자발광 고유의 빠른 응답속도를 바탕으로 고성능 게임 및 스포츠 영상 등에 최적의 사용경험 제공

		Galaxy Z Fold7용 폴더블 OLED 개발 (2025.07.)	□ 8.0" QXGA+ (2,184x1,968) Slim 폴더블 디스플레이 - 모듈 신공법 적용으로 두께 Slim 화 - 강건 패널(충격 분산 평탄화 구조) 및 내충격 강화 모듈 구조 적용으로 전작比 얇은 두께에서도 내구성 강화
		Galaxy Watch8용 OLED 개발 (2025.07.)	□ 1.34"(438x438) 저소비전력 디스플레이 - 저소비전력 패널 구동 회로 고도화 적용으로 전작比 소비전력 개선 - 최대 밝기 3,000nit로 야외 시인성 우수
		Galaxy Z TriFold용 OLED 개발 (2025.12.)	□ 9.96" 대화면 2-Folding 디스플레이 (1,584 x 2,160) - 강건한 패널 구조와 유연한 저탄성 모듈 소재 적용으로 얇은 두께에서의 폴딩특성과 내구성을 확보하여 대화면 2-Fold (in-Folding) 신규 폼팩터 구현
		Galaxy S26 Ultra용 OLED 개발 (2026.03.)	□ 6.89" WQ Privacy 디스플레이 - FMP(Flex Magic Pixel)기술을 스마트폰에 최초 도입하여 Privacy 기능을 패널에 내장・픽셀을 정밀하게 제어하여 상하좌우 및 특정영역의 시야각을 조절함으로써 스마트폰 사용자 편의 개선 - LEADTM (Pol-less)기술 기반으로 광효율 향상 및 소비전력 저감
		34"QHD+ 360Hz V-stripe 모니터 개발 (2026.04)	□ 세계 최초 V-stripe 360Hz 모니터 (34"QHD+) ・신규 픽셀 구조(V-stripe) 적용한 주사(360Hz), 고휘도(최고 휘도 1300nit) 제품으로 최상의 게이밍 경험 제공 ・텍스트 가독성 향상으로 게이밍 뿐만 아니라 문서작업/콘텐츠 제작 등으로 사용자 확대
		Galaxy Z Fold8용 폴더블 OLED 개발 (2026.07)	□ 8.0" (2,504x2,256) 폴더블 디스플레이 - 폴더블 최초 티타늄 합금 소재 및 초정밀 가공 기술 적용으로 두께, 주름(Crease), 내구성 개선 - 고해상도 설계 및 신규 유기재료, 화소 신호 제어 기술로 해상도 향상 및 소비전력 절감

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

2. 전문가와의 이해관계